

# 목 차

반기보고서 .....	1
<b>【대표이사 등의 확인】</b> .....	2
I. 회사의 개요 .....	3
1. 회사의 개요 .....	3
2. 회사의 연혁 .....	11
3. 자본금 변동사항 .....	17
4. 주식의 총수 등 .....	18
5. 정관에 관한 사항 .....	19
II. 사업의 내용 .....	20
1. 사업의 개요 .....	20
2. 주요 제품 및 서비스 .....	22
3. 원재료 및 생산설비 .....	23
4. 매출 및 수주상황 .....	29
5. 위험관리 및 파생거래 .....	34
6. 주요계약 및 연구개발활동 .....	41
7. 기타 참고사항 .....	47
III. 재무에 관한 사항 .....	66
1. 요약재무정보 .....	66
2. 연결재무제표 .....	69
3. 연결재무제표 주식 .....	76
4. 재무제표 .....	145
5. 재무제표 주식 .....	151
6. 배당에 관한 사항 .....	212
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 .....	214
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 .....	214
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 .....	218
8. 기타 재무에 관한 사항 .....	219
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 .....	242
V. 회계감사인의 감사의견 등 .....	243
1. 외부감사에 관한 사항 .....	243
2. 내부통제에 관한 사항 .....	248
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .....	249
1. 이사회에 관한 사항 .....	249
2. 감사제도에 관한 사항 .....	268
3. 주주총회 등에 관한 사항 .....	274
VII. 주주에 관한 사항 .....	277
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .....	287
1. 임원 및 직원 등의 현황 .....	287
2. 임원의 보수 등 .....	337
IX. 계열회사 등에 관한 사항 .....	352
X. 대주주 등과의 거래내용 .....	376
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .....	380
1. 공시내용 진행 및 변경사항 .....	380
2. 우발부채 등에 관한 사항 .....	380
3. 제재 등과 관련된 사항 .....	383

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 .....	394
XII. 상세표 .....	398
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) .....	398
2. 계열회사 현황(상세) .....	410
3. 타법인출자 현황(상세) .....	427
4. 연구개발실적(상세) .....	431
<b>【 전문가의 확인 】</b> .....	453
1. 전문가의 확인 .....	453
2. 전문가와의 이해관계 .....	453

# 반기보고서

(제 54 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터  
2022년 06월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2022년 8월 16일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

한 종 희

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

## 【 대표이사 등의 확인 】

### 확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서  
2022년 반기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여  
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의  
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 반기보고서에 표시된  
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이  
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에  
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2022. 8. 16

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 회



---

신고업무 담당임원: 박 학 규



---

# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd.입니다.

### 나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.

당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

### 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

전화번호: 031-200-1114

홈페이지: <https://www.samsung.com/sec>

### 라. 주요 사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 경영을 하고 있습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄, DS 부문산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 및 SDC, Harman 산하 종속기업 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주요 제품
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
SDC	스마트폰용 OLED 패널 등
Harman	디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등

※ 당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 CE부문과 IM부문을 DX부문으로 통합하였으며, 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS부문과 별도로 구분하였습니다.

### [DX 부문]

DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 휴대폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품 등을 생산·판매하는 사업을 영위하고 있습니다. Neo QLED 등 프리미엄 기술력을 바탕으로 한 프리미엄 TV, 경험을 중시하는 소비자들의 라이프스타일(Lifestyle)에 맞춰 출시한 Lifestyle TV, 그리고 소비자들의 다양한 Needs에 맞춘 비스포크(BESPOKE) 제품 등 차별화된 제품, 기술 및 디자인으로 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있으며 특히 TV는 2021년까지 16년 연속으로 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 핵심제품인 스마트폰은 '갤럭시(GALAXY)' 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 당사는 앞으로도 프리미엄 TV와 Lifestyle TV 시장에서의 혁신 노력을 계속하고, 비스포크(BESPOKE) 제품의 글로벌 판매를 본격 강화하는 한편, Galaxy Ecosystem을 통해 고객들이 모바일 뿐 아니라 TV와 가전까지 편리하게 활용할 수 있는 최고의 Multi Device 경험을 제공해 나가겠습니다. 또한 소비자의 Needs와 Trend를 반영한 신제품을 지속적으로 출시하여 글로벌 브랜드로서의 위상 및 시장 지배력을 계속 강화해 나가고 단말, 칩셋으로 이어지는 End-to-End 솔루션과 5G 초기시장에서의 상용화 경험을 바탕으로 글로벌 5G 시장을 리드하겠습니다.

## [DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산·판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계·판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고, 고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, 선형 공정 개발을 통한 AP, CIS 등 제품의 차별화 및 파운드리 공급처를 다변화하여 시장 수요에 대응하는 등 시장 지배력을 확대하고 있습니다.

Foundry 사업은 선단 공정에서 요소 기술과 신구조 도입을 통해 기술 경쟁력을 확보하고, 글로벌 반도체 공급 부족 상황에서도 안정적인 공급역량을 확보하는 한편, 레거시 공정에 대한 지속적인 수요 강세에도 적극적으로 대응하여 사업을 확장하고 있습니다.

## [SDC]

SDC의 중소형 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편 폴더블·롤러블·전장 등 신규 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고, 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

## [Harman]

Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 디자인하고 개발하는 전장부품 사업과 소비자 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업으로 구성되어 있습니다. Harman은 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편, 오디오 시장에서도 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. Harman은 시장 인지도가 높은 브랜드와 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 자체 개발 및 전략적 인수 등을 통해 각 사업 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업부문별 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.



## 마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2022년 반기말 현재 233개사입니다. 전년말 대비 6개 기업이 증가하고 1개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	228	6	1	233	141
합계	228	6	1	233	141

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(당기 연결대상회사의 변동내용)

구분	자회사	사유
신규 연결	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	설립
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	설립
	Apostera Gmbh	지분취득
	Apostera UA, LLC	지분취득
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	설립
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	지분취득
연결 제외	AMX UK Limited	청산
	-	-

## 바. 중소기업 해당 여부

당사는 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당
벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	미해당

## 사. 신용평가에 관한 사항

당사는 Moody's(미국) 및 S&P(미국)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2022년 반기말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa3, 전망치는 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 전망치는 안정적(Stable)입니다.

평가대상 유가증권	평가일	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	비고
회사채 US\$ Bond ('97년 발행, '27년 만기)	2020.07	AA-	S&P	정기평가
	2020.09	Aa3	Moody's	정기평가
	2021.07	AA-	S&P	정기평가
	2021.08	Aa3	Moody's	정기평가

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa~C), S&P (AAA~D)

구분	Moody's		S&P	
	등급	정의	등급	정의
투자적격 등급	Aaa	채무상환능력 최상, 신용위험 최소	AAA	채무상환능력이 극히 높음, 최고등급
	Aa1/Aa2/Aa3	채무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음	AA+/AA/AA-	채무상환능력이 매우 높음
	A1/A2/A3	채무상환능력 중상, 신용위험 낮음	A+/A/A-	채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함
	Baa1/Baa2/ Baa3	채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나 투기적 요소가 있음	BBB+/BBB/ BBB-	채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에 좀 더 취약함
투기 등급	Ba1/Ba2/Ba3	투기적 성향, 신용위험 상당함	BB+/BB/BB-	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼
	B1/B2/B3	투기적 성향, 신용위험 높음	B+/B/B-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음
	Caa	투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음	CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함
	Ca	투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내 부도발생 가능, 원리금 상환가능성 존재	CC	채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만 사실상 부도가 예상됨
	C	부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음	C	현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무보다 낮게 추정됨
			D	금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파 기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태

☞ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권발행의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

## 아. 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 1975년 6월 11일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장	1975년 06월 11일	해당사항 없음	해당사항 없음

## 2. 회사의 연혁

### 가. 회사의 연혁

1969.01.13	삼성전자공업주식회사로 설립
1975.06.11	기업공개
1984.02.28	삼성전자주식회사로 상호 변경
1988.11.01	삼성반도체통신주식회사 흡수 합병
2012.04.01	LCD사업부 분사(삼성디스플레이(주) 설립)
2017.03.05	'QLED TV' 진화된 퀀텀닷 기술 적용 TV 출시
2017.03.10	전장 기업 Harman International Industries, Inc. 지분(100%) 인수
2017.07.04	세계 최대 규모 평택 반도체 라인 가동
2017.11.01	프린팅솔루션 사업 매각
2018.08.30	'QLED 8K TV' 퀀텀닷 기술과 8K 해상도 적용 TV 출시
2019.04.03	'갤럭시 S10 5G' 5G 스마트폰 출시
2019.06.04	소비자 라이프스타일 맞춤형 냉장고 '비스포크(BESPOKE)' 출시
2019.09.04	'엑시노스 980' 5G 모바일 프로세서 공개
2019.09.06	'갤럭시 폴드' 새로운 폼팩터 폴더블폰 공개
2020.01.29	'그랑데 AI' 인공지능 기반 세탁기·건조기 출시
2020.02.04	AI·차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 출시
2020.02.11	'갤럭시 Z 플립' 폴더블폰 공개
2020.08.30	세계 최대 규모 평택 반도체 2라인 가동
2021.01.07	'Neo QLED TV' 공개
2021.05.11	'비스포크 홈' 글로벌 시장 확대 선언
2021.06.03	전세계 반도체 업체 최초 전 사업장 '탄소/물/폐기물 저감' 인증
2021.08.11	'갤럭시 Z 폴드3', '갤럭시 Z 플립3' 공개
2021.10.12	업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산
2021.11.09	업계 최초 LPDDR5X D램 개발
2021.11.24	미국 테일러市에 신규 파운드리 라인 투자 발표
2022.02.10	'갤럭시 S22' 시리즈 공개
2022.02.17	비스포크 인피니트 라인 공개
2022.06.30	세계 최초 3나노 GAA 파운드리 양산

### 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다.  
최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

## 다. 경영진의 중요한 변동

2022년 반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인 (한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 4인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성) 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2018.03.23	정기주총	사내이사 이상훈 사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 김종훈 사외이사 김선욱 사외이사 박병국	-	사내이사 권오현 사내이사 윤부근(사임) 사내이사 신종균(사임) 사외이사 김한중 사외이사 이병기
2018.03.23	-	대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진	-	-
2019.03.20	정기주총	사외이사 김한조 사외이사 안규리	사외이사 박재완	사외이사 이인호 사외이사 송광수
2019.10.26	-	-	-	사내이사 이재용
2020.02.14	-	-	-	사내이사 이상훈(사임)
2020.03.18	정기주총	사내이사 한종희 사내이사 최윤희	-	-
2021.03.17	정기주총	-	사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 박병국 사외이사 김종훈 사외이사 김선욱	-
2021.03.17	-	-	대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진	-
2021.12.31	-	-	-	사내이사 최윤희(사임)
2022.02.15	-	대표이사 한종희	-	대표이사 김기남(사임) 대표이사 김현석(사임) 대표이사 고동진(사임)
2022.03.16	정기주총	사내이사 경계현 사내이사 노태문 사내이사 박학규 사내이사 이정배 사외이사 한화진 사외이사 김준성	사외이사 김한조	-

2022.03.16	-	-	-	사내이사 김기남(사임) 사내이사 김현석(사임) 사내이사 고동진(사임)
2022.03.16	-	대표이사 경계현	-	-
2022.03.19	-	-	-	사외이사 박재완 사외이사 안규리
2022.04.20	-	-	-	사외이사 한화진(사임)
2022.05.17	-	-	-	사외이사 박병국(퇴임)

- ※ 2018년 3월 23일 이사회에서 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.
- ※ 2021년 3월 17일 이사회에서 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2021년 12월 31일 최윤호 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

## 라. 최대주주의 변동

2021년 4월 29일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 삼성생명보험(주)으로 변동되었습니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고
2021.04.29	삼성생명보험(주)	1,263,050,053	21.16%	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며, 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

## 마. 상호의 변경

2018년 중에는 종속기업 Harman Connected Services Finland OY의 사명이 Harman Finland Oy로, Harman Professional Singapore Pte. Ltd의 사명이 Harman Singapore Pte. Ltd.로 변경되었습니다.

2019년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Greece S.A. (SEGR) 사명이 Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)로 변경되었습니다.

2021년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Portuguesa S.A. (SEP) 사명이 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)로 변경되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.  
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.



## 바. 합병 등에 관한 사항

2018년 중 종속기업 Samsung Pay, Inc.는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었으며, 종속기업 Harman Connected Services Holding Corp.은 종속기업 Harman Connected Services, Inc.에 합병되었습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)는 종속기업 NexusDX, Inc. 지분(100%)을 매각하였습니다.

2019년 중 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)은 Corephotonics Ltd. 지분을 인수하였으며, 당사는 관계기업인 삼성전기(주)의 PLP(Panel Level Package) 사업을 양수하였습니다. 또한, 종속기업 Duran Audio B.V.가 종속기업 HarmanBecker Automotive Systems Manufacturing Kft에 합병되었으며, 종속기업 Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited (SBSC)가 종속기업 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)에 합병되었습니다.

2021년 중 종속기업 Viv Labs, Inc.는 종속기업 Samsung Research America, Inc (SRA)에 합병되었습니다. 또한, 종속기업 Prismview, LLC는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.

주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

## 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

### 아. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE부문과 IM부문을 DX부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직 체계에 맞추어 SDC를 DS부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)	DX 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기, Mobile eXperience, 네트워크)
	IM 부문 (무선, 네트워크)	
	DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry, DP)	DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry)
		SDC (DP)
	Harman 부문	Harman
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

### 3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

## 4. 주식의 총수 등

### 가. 주식의 총수

2022년 반기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2022년 반기말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2022년 반기말 현재 유통주식수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	20,000,000,000	5,000,000,000	25,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,780,466,850	1,194,671,350	8,975,138,200	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	-
1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	자사주소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-
V. 자기주식수	-	-	-	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-

※ 주식의 총수 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변동을 반영한 수치입니다.

당사는 2018년 5월 3일을 효력 발생일로 하여 보통주 및 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 50주(각 1주당 액면가 100원)로 분할하였습니다.

## 5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2018년 3월 23일이며, 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다.

## II. 사업의 내용

### 1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP(스마트폰 등), 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산·판매하는 DX(Device eXperience) 부문이 있으며, 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고 있는 DS 부문과 중소형 OLED 등의 디스플레이 패널(DP)을 생산·판매하고 있는 SDC가 있습니다. 또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참조하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 31개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이(주)와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매(주), 제품 서비스를 담당하는 삼성전자서비스(주), 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍(주) 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 202개의 비상장 중속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체·DP판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 46개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia) 등 Set제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 74개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과, HHP 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), DP 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·DP 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2022년 반기 당사의 매출은 154조 9,851억원으로 전년 동기 대비 20.1% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Qualcomm, Supreme Electronics, Verizon 등 (알파벳순)이 있습니다.

## 2. 주요 제품 및 서비스

### 가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 텔레매틱스 등을 생산·판매하고 있습니다.

2022년 반기 매출은 DX 부문이 92조 5,240억원(59.7%), DS 부문이 55조 3,650억원(35.7%)이며, SDC가 15조 6,812억원(10.1%), Harman은 5조 6,492억원(3.6%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	925,240	59.7%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	553,650	35.7%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	156,812	10.1%
Harman	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	56,492	3.6%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△142,343	△9.1%
총 계		1,549,851	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참조하시기 바랍니다.

### 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2022년 반기 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 4% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 약 9% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 0.3% 하락하였으며, 디스플레이 패널(스마트폰용 OLED 패널)은 약 13% 상승하였습니다. 또한 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 대비 약 1% 하락하였습니다.



### 3. 원재료 및 생산설비

#### 가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기(주) 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Wafer, Chemical 등을 SK실트론(주), 솔브레인(주) 등으로부터, SDC는 FPCA, Window 등을 (주)비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 SOC(System-On-Chip), 자동차용 메모리 등을 NVIDIA, Arrow 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	원재료	모바일AP	CPU	44,944	11.4%	Qualcomm, MediaTek 등
	원재료	디스플레이 패널	TV·모니터용 화상신호기	36,657	9.3%	CSOT, AUO, BOE 등
	원재료	Camera Module	HHP 카메라	33,047	8.4%	삼성전기(주), 파트론 등
	원재료	기타	-	278,671	70.9%	
	소 계			393,319	100.0%	
DS 부문	원재료	Wafer	반도체원판	13,979	15.1%	SK실트론(주), SUMCO 등
	원재료	Chemical	원판가공	13,048	14.1%	솔브레인(주), 동우화인켐(주) 등
	원재료	기타	-	65,480	70.8%	
	소 계			92,507	100.0%	
SDC	원재료	FPCA	구동회로	13,684	23.5%	(주)비에이치, (주)유니온 등
	원재료	Window	강화유리	7,474	12.8%	Apple, Biel 등
	원재료	기타	-	37,192	63.7%	
	소 계			58,350	100.0%	
Harman	원재료	SOC(System-On-Chip)	자동차용 제품	4,118	11.4%	NVIDIA, Intel 등
	원재료	자동차용 메모리	자동차용 제품	2,049	5.7%	Arrow, Avnet 등
	원재료	기타	-	29,956	82.9%	
	소 계			36,123	100.0%	
기타	원재료	-	-	222	-	
총 계				580,521	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주)는 계열회사입니다.

## 나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 가격은 전년 대비 약 58% 상승하였고, CameraModule 가격은 전년 대비 약 10% 상승하였으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 45% 하락하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 4% 상승하였고, SDC의 FPCA 가격은 약 19% 상승하였으며, 강화유리용 Window 가격은 전년 대비 크게 변동이 없었습니다. Harman의 원재료 중 SOC 가격은 전년 대비 약 3% 하락하였으며, 자동 차용 메모리는 약 1% 상승하였습니다.

## 다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제54기 반기	제53기	제52기
DX 부문	영상기기	28,072	54,235	51,538
	HHP	158,850	319,550	321,600
DS 부문	메모리	985,823,865	1,756,009,941	1,230,287,321
SDC	DP	1,570	3,604	7,274
Harman	디지털 콕핏	5,764	9,066	9,362

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass (2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털콕핏 생산능력은 '각 거래처·제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2022년(제54기) 반기 DX 부문의 영상기기 생산실적은 20,877천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있으며, HHP 생산실적은 119,984천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 985,824백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 DP 생산실적은 1,271천개이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 3,952천개입니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제54기 반기	제53기	제52기
DX 부문	영상기기	20,877	44,133	48,244
	HHP	119,984	260,501	249,218
DS 부문	메모리	985,823,865	1,756,009,941	1,230,287,321
SDC	DP	1,271	2,849	5,977
Harman	디지털 콕핏	3,952	6,928	6,116

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2022년(제54기) 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 영상기기 74.4%, HHP 75.5%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제54기 반기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	영상기기	28,072	20,877	74.4%
	HHP	158,850	119,984	75.5%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 DP 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2022년(제54기) 반기 누적 가동일은 휴일을 포함하여 총 181일입니다. 가동률은 가동가능시간 (가동일 × 생산라인 수 × 24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제54기 반기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	39,096	39,096	100%
SDC	DP	25,200	25,200	100%

Harman의 2022년 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 68.6%입니다.

(단위 : 천개)

부 문	품 목	제54기 반기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	5,764	3,952	68.6%

## 라. 생산설비 및 투자 현황 등

### (생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, SDC 및 Harman 산하 중속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

#### [주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 변영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA

※ Harman의 Automotive 사업은 미국(Novi), 독일(Garching) 등에서, Lifestyle 사업은 미국(Northridge) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 반기말 현재 장부금액은 154조 2,546억원으로 전년말 대비 4조 3,261억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기 초	기초장부금액	98,302	388,694	795,263	180,093	36,933	1,499,285
	- 취득원가	99,436	626,515	2,749,096	180,093	119,580	3,774,720
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,134	△237,821	△1,953,833	-	△82,647	△2,275,435
증 감	일반취득 및 자본적지출	381	9,894	113,466	77,022	6,781	207,544
	감가상각	△248	△16,518	△155,308	-	△8,704	△180,778
	처분·폐기·손상	△353	△779	△248	-	△268	△1,648
	기타	369	7,328	7,559	1,343	1,544	18,143
기 말	기말장부금액	98,451	388,619	760,732	258,458	36,286	1,542,546
	- 취득원가	99,772	646,217	2,872,893	258,458	125,426	4,002,766
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,321	△257,598	△2,112,161	-	△89,140	△2,460,220

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

### (시설투자 현황)

2022년 반기 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 20.3조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2022년에도 주력 사업의 경쟁력강화와 미래 수요 증가 대응을 위한 지속적인 시설투자 계획하에, 시황 변화에 따라 탄력적으로 대응하고, 내실있는 성장을 위한 효율성을 고려하여 시설투자를 추진할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분	내용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신·증설, 보완 등	2022.01~2022.06	건물·설비 등	175,598
SDC	신·증설, 보완 등	2022.01~2022.06	건물·설비 등	15,418
기 타	신·증설, 보완 등	2022.01~2022.06	건물·설비 등	11,503
합 계				202,519

## 4. 매출 및 수주상황

### 가. 매출실적

2022년 반기 매출은 154조 9,851억원으로 전년 동기 대비 20.1% 증가하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 17.3% 증가, DS 부문이 30.7% 증가하였으며, SDC가 13.7% 증가, Harman이 18.0% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제54기 반기	제53기	제52기
DX 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	925,240	1,662,594	1,489,135
DS 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	553,650	953,872	740,540
SDC	제·상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	156,812	317,125	305,857
Harman	제·상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	56,492	100,399	91,837
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△142,343	△237,942	△259,299
합 계			1,549,851	2,796,048	2,368,070

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제54기 반기	제53기	제52기
영상기기	162,558	314,974	277,118
무선	592,282	1,046,806	960,217
메모리	411,668	726,022	555,442
DP	156,812	317,125	305,857

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제54기 반기	제53기	제52기
제·상품	1,470,786	2,658,785	2,235,963
용역 및 기타매출	79,065	137,263	132,107
계	1,549,851	2,796,048	2,368,070

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제54기 반기	제53기	제52기
내수	국내	120,077	221,497	198,331
	미주	360,452	583,805	476,768
수출	유럽	142,440	258,227	235,012
	아시아·아프리카	226,066	336,671	315,598
	중국	304,620	597,247	437,403
계		1,153,655	1,997,447	1,663,112

※ 별도 기준의 내수·수출 매출 현황입니다.



## 나. 판매경로 등

### (1) 국내

판매자	판매 경로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인)	

### (2) 해외

판매자	판매 경로			소비자		
생산법인	판매법인	Retailer			소비자	
		Dealer	Retailer			
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자, Automotive OEM				
		직접판매(B2B 및 온라인)				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer	Retailer		
			Distributor	Dealer		Retailer

### (3) 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직판	기타
비중	19%	26%	52%	3%

## 다. 판매방법 및 조건

### (1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없음

### (2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없음

## 라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

## 마. 주요 매출처

2022년 반기 당사의 주요 매출처는 Apple, Deutsche Telekom, Qualcomm, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 15% 수준입니다.

## 바. 수주상황

2022년 반기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

### 가. 재무위험관리정책

당사의 재무위험관리는 영업 활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 나. 주요 재무위험관리

### (1) 시장위험

#### (환율변동위험)

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

### (이자율변동위험)

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

### (주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2022년 반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 90,393백만원(전반기: 107,635백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,413백만원(전반기: 3,941백만원)입니다.

## (2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

### (3) 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효과적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.



#### (4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

2022년 반기말 현재 당사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고있으며, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제54기 반기말	제53기말
부 채	120,133,986	121,721,227
자 본	327,906,664	304,899,931
부채비율	36.6%	39.9%

## 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적 상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2022년 반기말 현재 당사는 USD, EUR, JPY 등 총 36개 통화에 대하여 2,577건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 관련 자산·부채 장부금액 및 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	172,419	157,515	649,518	756,010

그리고 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

또한, 삼성디스플레이(주)는 TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이(주)가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2022년 반기말 현재 해당 풋옵션의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

### 가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 (영구)
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결기간	2018.01.01~2023.12.31
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 · 부제소 계약 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Apple	계약 유형	소취하 계약
	체결시기	2018.06.26
	목적 및 내용	양사 간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하
Nokia	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2018.10.19
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Microsoft	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.02.11
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2022.12.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.02.28
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
AMD	계약 유형	기술 라이선스 계약
	체결시기	2019.05.30
	목적 및 내용	모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보

Sharp	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.07.30
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

## 나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다.

또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2022년(제54기) 반기 당사의 연구개발비용은 12조 1,779억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 12조 1,771억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원, %)

과 목		제54기 반기	제53기	제52기
연구개발비용 총계		12,177,933	22,596,487	21,229,200
(정부보조금)		△827	△1,053	△8,228
연구개발비용 계		12,177,106	22,595,434	21,220,972
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	-	△193,708	△109,482
	연구개발비(비용)	12,177,106	22,401,726	21,111,490
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100]		7.9%	8.1%	9.0%

※ 연결 누계기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

## 다. 연구개발 조직 및 운영

### (국내)

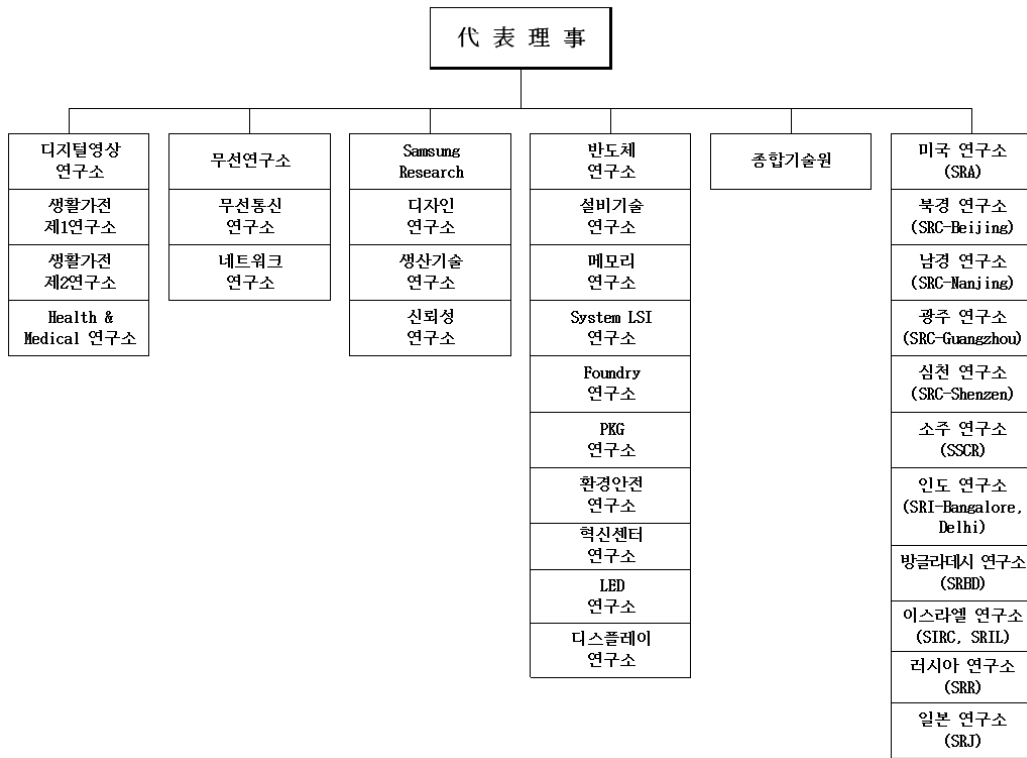
당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문 연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래 성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

### (해외)

미국(SRA), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzen), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SRIL, SIRC), 러시아(SRR), 일본(SRJ) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등의 연구 활동을 수행 중입니다.

또한, 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토·몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가와 한국·미국 등의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2022년 반기말 기준입니다.

## 라. 연구개발실적

2022년 반기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Neo QLED 8K	• Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	• Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	그랑데 AI 세탁기	• 핏케어 코스 적용된 그랑데 AI 24kg 세탁기 / 그랑데 AI 20kg 건조기 출시
	갤럭시 S22	• Galaxy S22 • S22+ • S22 Ultra 출시
	갤럭시 탭	• Galaxy Tab S8 • S8+ • S8 Ultra 출시
	갤럭시 A	• Galaxy A73 5G 출시 • Galaxy A53 5G 출시 • Galaxy A33 5G 출시 • Galaxy A23 LTE 출시 • Galaxy A13 LTE • 5G 출시
	갤럭시북	• Galaxy Book2 Pro 360 출시 • Galaxy Book2 Pro 출시
DS 부문	모바일 DRAM	• 업계 최초 LPDDR5X D램 개발
	엑시노스	• 프리미엄 모바일AP 엑시노스 2200 출시
	LSI	• 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC(S3B512C) 출시
	Foundry	• 세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정
SDC	QD-Display	• TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) • 모니터향 QD-Display (34" QHD)

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조



## 7. 기타 참고사항

### 가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으로 총 223,121건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2022년 반기말 누적, 연결 기준)] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	50,043	86,870	42,230	20,606	9,122	14,250	223,121

2022년 반기 중 총 12.2조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 4,630건, 미국 특허 4,170건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

구분	2022년 반기	2021년	2020년
한국	4,630	8,437	6,648
미국	4,170	8,565	8,520

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Cisco(2014.01.체결), Google(2014.01.), Qualcomm(2018.01.), Nokia(2018.10.), Microsoft(2019.02.), Sharp(2019.07.), Ericsson(2021.05.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2022년 반기 중 미국에서 194건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

## 나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

### (제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

## (사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」 「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「저탄소 녹색성장 기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

**(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)**

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO<sub>2</sub>-eq, TJ)

구 분	2021년	2020년	2019년
온실가스(tCO <sub>2</sub> -eq)	19,267,835	17,234,522	15,998,397
에너지(TJ)	274,298	255,990	242,345

- ※ 연결 기준입니다. 별도 기준은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4-라. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

## 다. 사업부문별 현황

### [DX 부문]

#### (산업의 특성 등)

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산·판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV산업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털방송의 확산 등을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, Flat Panel TV는 화질, 디자인 등 제품의 성능 향상과 지속적인 제품가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존의 브라운관 TV 시장을 빠르게 대체하였습니다.

2010년에는 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체의 부상과 스마트기기에 대한 사용자의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 이후 2017년에 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 퀀텀닷 소재를 사용한 QLED TV가 출시되고, 8K와 MICRO LED TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되어 2021년에 판매된 휴대폰의 75%가 LTE를 지원하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.06).

또한, 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2021년 6.1억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.06).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2021년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 77% 수준, 피쳐폰의 비중은 일부 성장 시장에서의 수요로 인해 23% 수준입니다(출처: Strategy Analytics 2022.06). 또한 스마트폰 보급률은 2021년 51%에서 2022년 53%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.06).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 폴더블 폼팩터, 멀티 카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Advertisement, Mobile Payment, AI, AR 등 소프트웨어 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

**(국내외 시장여건 등)**

2021년에는 프리미엄 TV 시장 수요 창출을 위한 화질, 사운드, 폼팩터 혁신 노력이 지속되었지만, TV 전체 시장 수요는 글로벌 물류 대란 및 공급망 차질 영향 등으로 약 2억 1,354만 대로 감소하였습니다. 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 및 원자재 공급 불안정 확대에 따른 인플레이션 악화 등으로 TV 전체 시장 수요가 2억 879만대로 역성장 할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia,'22.1분기 전망).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 반기	2021년	2020년
TV	31.6%	29.5%	31.9%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.  
(2022년 반기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

또한 스마트폰 시장도 지정학적 불안 지속, 물가상승 등 불확실성으로 인해 2021년 13.6억대에서 2022년 13.0억대로 소폭 역성장할 것으로 전망됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.06). 그동안 교체수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나 19(COVID-19)의 영향 등에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후 2022년에는 1.7억대 수준으로 소폭 감소될 것으로 전망됩니다(출처:Strategy Analytics 2022.06).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 반기	2021년	2020년
스마트폰	22.6%	20.0%	19.6%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계 시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 2021년까지 16년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 당사는 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제위기 상황에서도 QLED 4K·8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다.

2021년에는 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED TV를 출시하여 프리미엄 제품군을 확대하였습니다. 또한 Lifestyle 제품과 Sound Bar제품의 판매 비중도 상승하고 있으며, TV 플러스, 홈 트레이닝, 게임 등 다양한 스마트 생태계에 참여하는 업체들도 확대되고 있습니다. 특히, 당사는 2021년부터 제품 재질부터 패키징(Packaging)에 이르기까지 친환경 사업에 앞장서는 한편, 접근성을 발전시켜서 시각·청각 장애인도 불편없이 제품을 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

2022년에는 Neo QLED 8K 혁신 기술들을 중심으로 75" 이상 초대형 프리미엄 시장 점유율을 확대해가는 한편, 더 프리스타일 제품을 도입하여 라이프스타일 라인업을 더욱 보강할 계획입니다. 친환경 기술을 적극 도입하여 해양 플라스틱 재활용 소재를 일부 제품에 적용하고, 친환경 리모컨을 신제품 전 모델로 확대 예정입니다.

또한 당사는 주력 사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 11년 연속 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다.

또한, 휴대폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성 사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, 혁신적인 컨투어 컷(Contour Cut) 디자인 적용, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수·방진, 고속 유·무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, AI 기술을 활용한 고화질 사진 및 고배율 촬영, 8K 동영상 등 고객의 Needs에 기반한 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'과 한층 더 진화된 '갤럭시 Z 폴드2'를 출시하여 폴더블 대중화를 선도하였습니다.

2021년에는 독보적인 장인정신을 기반으로 내구성을 대폭 강화한 3세대 갤럭시 Z시리즈를 출시 하였습니다. '갤럭시 Z 폴드3'와 '갤럭시 Z 플립3'은 폴더블 스마트폰 최초의 IPX8 등급의 방수기능, 전작 대비 약 80% 향상된 디스플레이 내구성, 20만번의 폴딩 테스트 검증, 언더 디스플레이 카메라, 멀티 태스킹, 멀티 액티브 윈도우, 오토 프레임, 듀얼 프리뷰 등 혁신적인 기술과 사용 편의성을 확대하여 최고의 사용자 경험을 제공하고 있습니다. 또한, 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트폰에도 5G, 쿼드 카메라, 대화면 Infinity Display, 대용량 배터리 등을 적극적으로 채택하여 제품경쟁력을 높이고 있습니다.



스마트폰 외에도 대화면 디스플레이의 멀티 태스킹이 가능한 태블릿, 혁신적인 피트니스 및 웰니스 기능이 탑재된 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품, 급속 무선 충전을 지원하는 충전 스탠드 제품 등 다양한 Galaxy Eco 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부하고 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, SmartThings 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, 5G, AI, IoT, Cloud, AR, Digital Wallet, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하여 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공할 것입니다.

## [DS 부문]

### (산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고(Read) 쓸 수(Write) 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다.

램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System On Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 SOC 제품과 이미지 센서, OLED용 DDI(Display Driver IC) 등을 공급하고 있습니다.

한편, 주문형 반도체(Foundry 서비스)는 다른 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체가 증가하고 있으며, 이러한 팹리스 업체 제품의 위탁생산을 담당하고 있습니다.

### (국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 인플레이션 심화 및 금리 인상 등 글로벌 경기 이슈에 따른 소비심리 위축 영향으로 PC/모바일 메모리 수요는 약세를 보였으나, 당사는 High-Core CPU 비중 확대에 따른 고용량 서버 메모리 수요에 적극 대응하여 매출 성장을 이끌어냈습니다.

그러나 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 코로나 재확산, 인플레이션 심화 등 거시경제 악화 우려에 따른 IT 수요 변동 가능성과 글로벌 공급망 차질 등의 영향으로 시황 불확실성이 상존하고 있습니다.

당사는 고용량·차별화 제품의 출시를 통한 제품 경쟁력 우위를 활용하여 시장 경쟁력을 제고하고, 불확실한 시장 상황에 대응하기 위해 고객사들의 수요에 영향을 미칠수 있는 공급망 차질 등 다양한 이슈를 선제적으로 파악하여 고객 수요에 적기 대응하고 있습니다.

#### < DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 반기	2021년	2020년
DRAM	43.5%	43.0%	42.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

### (영업의 개황 등)

당사는 메모리 사업에서 기술 리더십을 통한 원가 경쟁력 우위를 유지하고, 고부가/고용량 중심 제품 포트폴리오 운영과 더불어 고객이 원하는 제품을 적기 공급할 수 있도록 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

세계 최초 Multi-step EUV가 적용된 차세대 DRAM 양산 라인업을 갖추었고, 7세대 V-NAND 채용 SSD 등 선단 제품으로 생산 및 원가 경쟁력을 강화함으로써 차세대 성장 분야에서 리더십을 더욱 공고히 할 예정입니다.

System LSI는 제한적인 글로벌 반도체 공급 상황과 고객 부품 수요 변동에 맞춰 공급처 다변화 등 Supply Chain 강화로 공급 능력을 확대하고, 고객 협력 강화와 인력 확충 및 차세대 제품 선행 개발로 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

Foundry는 지속적인 고성장이 전망되었으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 봉쇄 및 인플레이션 등 전세계적 경기 불황으로 인해 스마트폰/PC 등 Set 제품의 수요 하향 추세로 일부 성장을 조정이 예상됩니다. 하지만 모바일 5G 비중 지속 증가, CPU의 위탁 생산 비중 증가, 데이터센터 및 Automotive 등 신성장 사업의 수요 견조로 장기적 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

## [SDC]

### (산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD 디스플레이의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, 롤러블, 전장 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

### (국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 인플레이션 등에 따른 소비심리 위축으로 2021년 17.5억대에서 2022년 15.0억대로 감소될 것으로 전망합니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2021년 6.2억대에서 2022년 6.1억대로 전년도와 비슷한 규모를 유지할 것으로 예상되나, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2021년 35%에서 2022년 41%로 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2022.07).

대형 디스플레이 패널 시장의 2022년 전체 수요는 9.9억대로 2021년 9.8억대와 비슷한 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다(출처: Omdia 2022.06).

#### < 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 반기	2021년	2020년
스마트폰 패널	51.1%	51.4%	44.8%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.  
(2022년 반기 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

### (영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, 전장 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 Needs에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·OLED IT 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2022년은 거시 환경의 불확실성이 지속되며, 스마트폰 시장은 제한적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 고객사 Needs에 발맞춰 저소비전력, 고속 구동, UPC(Under Panel Camera) 등 신기술 적용을 확대하는 한편, 원가 경쟁력을 강화하여 스마트폰 제품에서의 OLED 패널 채용률을 지속적으로 높여가겠습니다. 또한 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여, IT, Game, Auto 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 하겠습니다.

한편, 대형 패널 사업은 차별화된 기술 기반의 QD 디스플레이 판매를 점차 늘려가며 프리미엄 시장을 대표하는 제품이 될 수 있도록 사업을 확대해나가겠습니다.

## [Harman]

### (산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다.

전장부품(디지털 콕핏, 텔레매틱스, 카 오디오 등)의 소비자들이 지속해서 가장 최신 기술을 요구함에 따라, 자동차 제조사는 교통수단 공유, 자율주행 등의 분야에서 가장 앞선 기술을 요구하고 있습니다. 특히 전장산업의 커넥티비티(Connectivity) 및 엔터테인먼트 솔루션 시장에서 주요 업체(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)간 경쟁이 매우 치열합니다. 당사는 카 오디오(Car Audio) 분야에서 시스템 솔루션뿐만 아니라 오디오 컴포넌트(스피커, 앰프 등)도 제공하고 있으며, 주요 업체(Bose, Pioneer, Panasonic) 간 경쟁이 매우 치열합니다. 이 분야는 지속적인 기술 발전이 예상되며, 여러 카 오디오 업체가 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 지속해서 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오(포터블 스피커, 헤드폰, 커넥티드 오디오 솔루션 등) 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도 업체(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)가 있습니다. 특히 커넥티드 홈(Connected Home)과 스마트 스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체와 기존 업체 간 경쟁 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 휴대폰 제조사가 절대적인 시장점유율을 차지하고 있는 True Wireless 헤드폰 분야는 폭발적인 성장이 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용 · 대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha가 현재 산업 내에서 널리 알려진 선도 업체입니다.

### (국내외 시장여건 등)

2022년말까지 점진적으로 완화될 것으로 예상됐던 코로나19 팬데믹은 예상보다 완화의 속도가 느린 한편, 러시아-우크라이나 전쟁 영향 등으로 사업의 불확실성이 더욱 높아졌습니다. 이 가운데 중앙은행 긴축 정책에 따른 경제 리스크가 고조되며 향후 1년간 경기 침체 위기도 높아지고 있습니다.

이러한 요인들을 감안하였을때 2022년 전세계 자동차 생산은 2021년 대비 5% 수준 증가에 그칠 것으로 예상됩니다(출처: 2022 IHS Global Light Vehicle Production Forecast).

#### < 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 반기	2021년	2020년
디지털 콕핏	24.8%	25.3%	27.5%

- ※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
- ※ 시장점유율은 외부조사기관인 I.H.S 와 LMC의 자료(수량 기준)를 활용한 당사 추정치입니다.



## (영업의 개황 등)

당사의 Harman은 전장부품 시장에서 선도 기업의 위상을 유지하고 있습니다. 대량 판매 시장에서부터 고급 특화 시장에 걸쳐 차량에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드를 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질 수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카 오디오와 커넥티비티(Connectivity) 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사와의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다. 추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

2020년 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행은 자동차 생산의 중단, 소비·유동 인구의 감소, 소매점의 영업 중단 등 부정적인 영업 환경을 초래하였습니다. 특히, 프로페셔널 오디오 솔루션 사업은 대규모 모임 및 이벤트 축소 등으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 당사의 Harman은 코로나19(COVID-19)의 대유행이 시작되었을 때 다양한 비용 절감 방안을 도입하였으며, 비용을 절감한 분야에 대해서는 향후 재투자를 통해 효율적으로 시장에서 경쟁할 계획입니다.

## 라. 사업부문별 요약 재무 현황

2022년(제54기) 반기 매출은 DX 부문이 92조 5,240억원(59.7%), DS 부문이 55조 3,650억원(35.7%)이며, SDC가 15조 6,812억원(10.1%), Harman은 5조 6,492억원(3.6%)입니다.

2022년(제54기) 반기 영업이익은 DX 부문이 7조 5,772억원으로 전체이익의 26.9%, DS 부문이 18조 4,312억원으로 전체이익의 65.3%를 차지하며, SDC가 2조 1,505억원(7.6%), Harman은 2,032억원(0.7%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구분	제54기 반기		제53기		제52기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	925,240	59.7%	1,662,594	59.5%	1,489,135	62.9%
	영업이익	75,772	26.9%	173,866	33.7%	151,520	42.1%
	총자산	2,555,760	41.9%	2,479,832	42.0%	2,303,623	43.6%
DS 부문	매출액	553,650	35.7%	953,872	34.1%	740,540	31.3%
	영업이익	184,312	65.3%	291,920	56.5%	188,062	52.2%
	총자산	2,582,104	42.3%	2,258,223	38.3%	1,885,692	35.7%
SDC	매출액	156,812	10.1%	317,125	11.3%	305,857	12.9%
	영업이익	21,505	7.6%	44,574	8.6%	22,369	6.2%
	총자산	685,047	11.2%	668,836	11.3%	661,929	12.5%
Harman	매출액	56,492	3.6%	100,399	3.6%	91,837	3.9%
	영업이익	2,032	0.7%	5,991	1.2%	555	0.2%
	총자산	165,472	2.7%	158,874	2.7%	147,020	2.8%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

### (공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품·모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품·모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

##### 가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제54기 반기 2022년 6월말	제53기 2021년 12월말	제52기 2020년 12월말
[유동자산]	236,287,491	218,163,185	198,215,579
· 현금및현금성자산	39,583,141	39,031,415	29,382,578
· 단기금융상품	84,428,822	81,708,986	92,441,703
· 기타유동금융자산	1,308,701	3,409,791	2,828,562
· 매출채권	44,026,232	40,713,415	30,965,058
· 재고자산	52,092,241	41,384,404	32,043,145
· 기타	14,848,354	11,915,174	10,554,533
[비유동자산]	211,753,159	208,457,973	180,020,139
· 기타비유동금융자산	12,992,785	15,491,183	13,778,185
· 관계기업 및 공동기업 투자	10,382,938	8,932,251	8,076,779
· 유형자산	154,254,576	149,928,539	128,952,892
· 무형자산	20,096,926	20,236,244	18,468,502
· 기타	14,025,934	13,869,756	10,743,781
자산총계	448,040,650	426,621,158	378,235,718
[유동부채]	83,362,268	88,117,133	75,604,351
[비유동부채]	36,771,718	33,604,094	26,683,351
부채총계	120,133,986	121,721,227	102,287,702
[지배기업 소유주지분]	318,830,612	296,237,697	267,670,331
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	310,216,785	293,064,763	271,068,211
· 기타	3,312,420	△2,128,473	△8,699,287
[비지배지분]	9,076,052	8,662,234	8,277,685
자본총계	327,906,664	304,899,931	275,948,016
	2022년 1월~6월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	154,985,105	279,604,799	236,806,988
영업이익	28,218,454	51,633,856	35,993,876
연결총당기순이익	22,423,433	39,907,450	26,407,832
· 지배기업 소유주지분	22,083,609	39,243,791	26,090,846
· 비지배지분	339,824	663,659	316,986
기본주당순이익(단위 : 원)	3,251	5,777	3,841
희석주당순이익(단위 : 원)	3,251	5,777	3,841
연결에 포함된 회사수	234개	229개	242개

\* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제52기~제53기 연결감사보고서 및 제54기 반기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

## 나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제54기 반기	제53기	제52기
	2022년 6월말	2021년 12월말	2020년 12월말
[유동자산]	76,194,477	73,553,416	73,798,549
· 현금및현금성자산	3,079,118	3,918,872	989,045
· 단기금융상품	13,104,200	15,000,576	29,101,284
· 매출채권	32,463,228	33,088,247	24,736,740
· 재고자산	21,390,252	15,973,053	13,831,372
· 기타	6,157,679	5,572,668	5,140,108
[비유동자산]	182,776,820	177,558,768	155,865,878
· 기타비유동금융자산	1,504,914	1,664,667	1,542,766
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,362,214	56,225,599	56,587,548
· 유형자산	108,381,976	103,667,025	86,166,924
· 무형자산	8,181,534	8,657,456	7,002,648
· 기타	7,346,182	7,344,021	4,565,992
자산총계	258,971,297	251,112,184	229,664,427
[유동부채]	50,310,861	53,067,303	44,412,904
[비유동부채]	4,745,989	4,851,149	1,934,799
부채총계	55,056,850	57,918,452	46,347,703
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	199,712,456	188,774,335	178,284,102
[기타]	△1,099,416	△882,010	△268,785
자본총계	203,914,447	193,193,732	183,316,724
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2022년 1월~6월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	115,365,546	199,744,705	166,311,191
영업이익	19,310,709	31,993,162	20,518,974
당기순이익	15,843,251	30,970,954	15,615,018
기본주당순이익(단위 : 원)	2,332	4,559	2,299
희석주당순이익(단위 : 원)	2,332	4,559	2,299

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제52기~제53기 감사보고서 및 제54기 반기 검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

## 2. 연결재무제표

### 연결 재무상태표

제 54 기 반기말 2022.06.30 현재

제 53 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기말	제 53 기말
자산		
유동자산	236,287,491	218,163,185
현금및현금성자산	39,583,141	39,031,415
단기금융상품	84,428,822	81,708,986
단기상각후원가금융자산	1,253,196	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	55,505	40,757
매출채권	44,026,232	40,713,415
미수금	5,690,479	4,497,257
선급비용	3,141,748	2,336,252
재고자산	52,092,241	41,384,404
기타유동자산	6,016,127	5,081,665
비유동자산	211,753,159	208,457,973
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,610,592	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,382,193	1,525,344
관계기업 및 공동기업 투자	10,382,938	8,932,251
유형자산	154,254,576	149,928,539
무형자산	20,096,926	20,236,244
순확정급여자산	2,131,474	2,809,590
이연법인세자산	5,114,332	4,261,214
기타비유동자산	6,780,128	6,798,952
자산총계	448,040,650	426,621,158
부채		
유동부채	83,362,268	88,117,133
매입채무	12,560,726	13,453,351
단기차입금	12,989,188	13,687,793
미지급금	13,659,750	15,584,866
선수금	1,271,491	1,224,812
예수금	762,316	1,294,052
미지급비용	27,243,067	27,928,031
당기법인세부채	6,067,653	6,749,149
유동성장기부채	952,811	1,329,968
총당부채	5,995,790	5,372,872

기타유동부채	1,859,476	1,492,239
비유동부채	36,771,718	33,604,094
사채	553,783	508,232
장기차입금	2,943,208	2,866,156
장기미지급금	2,871,992	2,991,440
순확정급여부채	517,143	465,884
이연법인세부채	26,341,382	23,198,205
장기충당부채	2,278,231	2,306,994
기타비유동부채	1,265,979	1,267,183
부채총계	120,133,986	121,721,227
자본		
지배기업 소유주지분	318,830,612	296,237,697
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	310,216,785	293,064,763
기타자본항목	3,312,420	(2,128,473)
비지배지분	9,076,052	8,662,234
자본총계	327,906,664	304,899,931
부채와자본총계	448,040,650	426,621,158



연결 손익계산서

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기		제 53 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	77,203,607	154,985,105	63,671,585	129,060,088
매출원가	46,269,748	93,341,805	37,065,931	78,565,916
매출총이익	30,933,859	61,643,300	26,605,654	50,494,172
판매비와관리비	16,836,814	33,424,846	14,038,909	28,544,559
영업이익	14,097,045	28,218,454	12,566,745	21,949,613
기타수익	463,971	1,164,164	740,668	1,040,410
기타비용	600,393	1,053,503	876,896	1,201,136
지분법이익	259,229	491,706	187,487	335,006
금융수익	5,371,885	8,874,074	1,787,143	4,025,781
금융비용	5,130,979	8,164,297	1,522,717	3,516,599
법인세비용차감전순이익(손실)	14,460,758	29,530,598	12,882,430	22,633,075
법인세비용	3,361,953	7,107,165	3,247,944	5,856,904
계속영업이익(손실)	11,098,805	22,423,433	9,634,486	16,776,171
당기순이익(손실)	11,098,805	22,423,433	9,634,486	16,776,171
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,954,515	22,083,609	9,450,676	16,543,462
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	144,290	339,824	183,810	232,709
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,613	3,251	1,391	2,435
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,613	3,251	1,391	2,435

### 연결 포괄손익계산서

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기		제 53 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	11,098,805	22,423,433	9,634,486	16,776,171
기타포괄손익	3,970,338	5,489,814	1,351,566	5,650,692
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,245,872)	(1,909,188)	244,608	2,111,305
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,195,764)	(1,799,944)	214,593	2,099,604
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(15,627)	(11,875)	51,206	65,631
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(34,481)	(97,369)	(21,191)	(53,930)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	5,216,210	7,399,002	1,106,958	3,539,387
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	295,429	34,846	95,580	41,659
해외사업장환산외환차이	4,919,214	7,356,247	1,012,987	3,470,252
현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,567	7,909	(1,609)	27,476
총포괄손익	15,069,143	27,913,247	10,986,052	22,426,863
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	14,890,896	27,498,046	10,845,374	22,066,553
비지배지분	178,247	415,201	140,678	360,310

연결 자본변동표

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초 과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류 기타자본항목	지배기업 소유주 지분 합계		
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	271,068,211	(8,687,155)	(12,132)	267,670,331	8,277,685	275,948,016
당기순이익(손실)			16,543,462			16,543,462	232,709	16,776,171
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			3,049,926	(1,043,480)		2,006,446	93,158	2,099,604
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				120,984		120,984	(13,694)	107,290
해외사업장환산외환차이				3,422,051		3,422,051	48,201	3,470,252
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(53,866)		(53,866)	(64)	(53,930)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				27,476		27,476		27,476
매각예정분류				(12,132)	12,132	0		0
배당			(15,576,414)			(15,576,414)	(1,711)	(15,578,125)
연결실체내 자본거래 등						0	59	59
연결실체의 변동						0	(477,307)	(477,307)
기타				56		56	4,704	4,760
2021.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	275,085,185	(6,226,066)	0	274,160,526	8,163,740	282,324,266
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)	0	296,237,697	8,662,234	304,899,931
당기순이익(손실)			22,083,609			22,083,609	339,824	22,423,433
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(26,456)	(1,756,494)		(1,782,950)	(16,994)	(1,799,944)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				22,729		22,729	242	22,971
해외사업장환산외환차이				7,264,141		7,264,141	92,106	7,356,247
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(97,392)		(97,392)	23	(97,369)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				7,909		7,909		7,909
매각예정분류						0		0
배당			(4,905,131)			(4,905,131)	(1,457)	(4,906,588)
연결실체내 자본거래 등						0	(404)	(404)
연결실체의 변동						0		0
기타						0	478	478
2022.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	310,216,785	3,312,420	0	318,830,612	9,076,052	327,906,664

### 연결 현금흐름표

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기	제 53 기 반기
영업활동 현금흐름	24,589,135	25,889,535
영업에서 창출된 현금흐름	31,054,031	30,801,574
당기순이익	22,423,433	16,776,171
조정	28,057,798	21,932,516
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(19,427,200)	(7,907,113)
이자의 수취	706,755	686,093
이자의 지급	(264,834)	(155,459)
배당금 수입	229,806	202,632
법인세 납부액	(7,136,623)	(5,645,305)
투자활동 현금흐름	(19,929,267)	(5,746,952)
단기금융상품의 순감소(증가)	(906,942)	15,611,924
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	2,198,246	530,088
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(14,748)	21,731
장기금융상품의 처분	5,343,921	5,029,379
장기금융상품의 취득	(4,326,888)	(4,498,757)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	484,094	2,625,165
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(15,385)	(910,232)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	157,878	88,110
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(76,726)	(46,178)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	6,933	916
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(903,758)	(28,600)
유형자산의 처분	105,839	261,152
유형자산의 취득	(20,157,775)	(23,528,054)
무형자산의 처분	19,036	1,215
무형자산의 취득	(1,576,361)	(1,586,894)
사업결합으로 인한 현금유출액	(31,383)	(5,926)
매각예정자산의 처분으로 인한 현금유입액	0	661,168
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(235,248)	26,841
재무활동 현금흐름	(6,457,643)	(19,642,937)
단기차입금의 순증가(감소)	(668,224)	(3,676,341)
장기차입금의 차입	73,224	0
사채 및 장기차입금의 상환	(955,802)	(390,466)
배당금의 지급	(4,906,518)	(15,576,303)
비지배지분의 증감	(323)	173
매각예정분류	0	139
외화환산으로 인한 현금의 변동	2,349,501	801,425

현금및현금성자산의 순증감	551,726	1,301,210
기초의 현금및현금성자산	39,031,415	29,382,578
기말의 현금및현금성자산	39,583,141	30,683,788

### 3. 연결재무제표 주식

제 54 기 반기 : 2022년 6월 30일 현재

제 53 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

#### 1. 일반적 사항:

##### 가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 233개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 39개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당반기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.



지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽· CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체·DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체·DP 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o. (SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0	
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0	
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0	
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0	

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0	
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	DP 생산	100.0
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	DP 부품 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV · 모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	전자제품 생산, R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	DP 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	DP 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)도우인시스	DP 부품 생산	69.0
	지에프(주)	DP 부품 생산	100.0
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당반기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당반기말		당반기			
	자산	부채	3개월		누 적	
			매출액	분기순이익	매출액	반기순이익
삼성디스플레이(주)	53,799,434	6,207,803	6,845,875	791,204	13,946,851	1,817,837
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	44,048,344	17,888,587	12,333,476	316,721	23,673,944	271,086
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	20,338,336	1,745,237	-	2,505,351	-	2,516,913
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	18,965,597	2,852,795	9,983,377	971,650	20,552,811	1,934,576
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	18,619,962	3,929,345	2,453,729	165,104	4,869,323	321,642
Harman과 그 종속기업(*2)	16,547,201	6,171,479	2,986,052	36,184	5,648,793	126,028
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	16,142,783	9,750,204	12,742,094	33,503	23,653,098	75,744
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	14,581,271	10,466,764	528,784	(43,273)	1,361,932	63,608
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	13,638,441	2,028,773	5,919,010	499,274	11,739,681	928,374
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	12,621,595	8,364,392	-	21,517	-	28,482
Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	9,354,178	920,799	836,674	(12,167)	1,625,295	(14,589)
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	8,555,449	3,579,247	3,488,909	114,899	7,688,929	317,183
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	6,882,310	4,685,891	6,504,147	62,530	13,054,783	138,258
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	6,835,074	1,909,662	5,142,739	56,185	10,814,792	187,691
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,928,702	1,434,277	1,971,171	(45,838)	3,890,800	68,690
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,381,435	625,778	1,602,862	125,102	3,554,895	327,308
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,133,716	2,217,648	1,349,597	(24,169)	2,881,511	(5,105)
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,109,372	487,673	1,297,116	22,286	2,711,163	5,686
Samsung International, Inc. (SII)	2,641,223	749,965	2,245,257	351,949	4,535,557	673,219
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,631,017	2,169,234	3,663,321	60,139	8,262,182	300,226
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,419,047	695,352	612,857	(13,563)	1,420,327	(6,661)
Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	2,265,841	399,955	881,554	42,573	2,205,901	123,503
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,257,768	300,093	788,603	33,918	1,595,752	83,548
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,993,118	2,065,340	1,485,197	(75,712)	3,186,298	(133,174)
세메스(주)	1,971,759	574,931	740,885	54,932	1,466,317	128,901

(\*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전반기			
	자산	부채	3개월		누 적	
			매출액	분기순이익	매출액	반기순이익
삼성디스플레이(주)	54,967,156	9,081,737	6,355,181	1,005,746	12,413,332	1,017,568
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	42,982,054	19,246,751	9,317,000	525,279	18,913,228	728,862
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	19,049,536	5,168,738	1,659,215	384,457	3,144,758	766,651
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	17,521,446	3,425,127	5,995,489	442,022	14,106,224	1,105,944
Harman과 그 종속기업(*2)	15,887,380	6,104,012	2,411,284	58,381	4,770,008	120,663
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	14,683,789	58,381	-	2,257,086	-	2,273,905
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	14,651,496	8,998,502	-	9,776	-	10,689
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	13,744,799	7,955,060	7,782,566	14,051	13,615,982	37,493
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,599,093	9,685,278	553,121	214,923	1,286,821	329,385
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	13,023,272	2,085,411	4,091,453	385,054	9,447,735	877,440
Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	8,705,085	958,537	1,030,294	296,452	1,953,255	564,441
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	7,765,126	5,799,690	8,094,226	100,836	15,108,630	175,073
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,765,019	3,236,745	1,945,212	13,832	5,404,547	206,737
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	6,821,066	2,486,703	3,617,308	229,569	8,053,609	420,324
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,589,505	1,671,097	1,402,834	140,264	2,934,040	282,192
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,129,104	919,721	1,818,069	119,993	3,586,130	199,329
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,018,358	474,223	1,100,874	(23,233)	2,180,560	(30,596)
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,925,062	1,992,367	1,136,018	16,352	2,633,483	29
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,612,357	766,034	538,948	131,394	1,268,273	136,646
Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	2,504,075	641,004	879,859	(7,903)	1,890,482	(32,452)
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,305,275	2,144,805	3,295,257	99,465	7,387,221	597,657
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,289,391	2,228,650	1,425,439	(49,444)	3,199,904	(108,804)
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,149,277	339,425	1,013,269	46,973	1,956,877	94,341
Samsung International, Inc. (SII)	2,125,719	1,041,168	1,765,245	59,685	3,033,326	110,307
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,033,992	1,459,353	1,496,305	6,537	2,720,285	11,537

(\*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.



라. 연결대상범위의 변동

당반기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내역은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	유럽·CIS	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	설립
		Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	설립
		Apostera GmbH	지분취득
		Apostera UA, LLC	지분취득
	아시아 (중국 제외)	DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED	설립
		Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	지분취득
연결제외	유럽·CIS	AMX UK Limited	청산

## 2. 중요한 회계처리방침:

### 2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2022년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기연결재무제표는 보고기간종료일인 2022년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

##### - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

##### - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

## - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

### 2.2. 회계정책

반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정

반기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 코로나19로 연결회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당반기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

### 3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 당반기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,583,141	-	-	-	39,583,141
단기금융상품	84,428,822	-	-	-	84,428,822
단기상각후원가금융자산	1,253,196	-	-	-	1,253,196
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	55,505	-	55,505
매출채권	44,026,232	-	-	-	44,026,232
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,610,592	-	-	11,610,592
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,382,193	-	1,382,193
기타	9,949,776	-	334,806	78,075	10,362,657
계	179,241,167	11,610,592	1,772,504	78,075	192,702,338

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,560,726	-	-	12,560,726
단기차입금	3,404,897	-	9,584,291	12,989,188
미지급금	12,270,350	-	-	12,270,350
유동성장기부채	104,382	-	848,429	952,811
사채	553,783	-	-	553,783
장기차입금	8,500	-	2,934,708	2,943,208
장기미지급금	2,400,941	-	-	2,400,941
기타	10,981,962	343,437	19,869	11,345,268
계	42,285,541	343,437	13,387,297	56,016,275

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,031,415	-	-	-	39,031,415
단기금융상품	81,708,986	-	-	-	81,708,986
단기상각후원가금융자산	3,369,034	-	-	-	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	40,757	-	40,757
매출채권	40,713,415	-	-	-	40,713,415
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,965,839	-	-	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,525,344	-	1,525,344
기타	8,711,973	-	279,127	49,089	9,040,189
계	173,534,823	13,965,839	1,845,228	49,089	189,394,979

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,453,351	-	-	13,453,351
단기차입금	2,131,692	-	11,556,101	13,687,793
미지급금	14,126,970	-	-	14,126,970
유동성장기부채	518,065	-	811,903	1,329,968
사채	508,232	-	-	508,232
장기차입금	1,500	-	2,864,656	2,866,156
장기미지급금	2,562,158	-	-	2,562,158
기타	10,444,290	323,526	13,868	10,781,684
계	43,746,258	323,526	15,246,528	59,316,312

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
비유동항목:		
지분상품	11,610,592	13,965,839

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
유동항목:		
채무상품	55,505	40,757
비유동항목:		
지분상품	768,455	905,094
채무상품	613,738	620,250
소 계	1,382,193	1,525,344
계	1,437,698	1,566,101



나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기업명	당반기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	134,027,281	15.2	932,158	813,546	759,935
주호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	142,736	156,368
주아이마켓코리아	647,320	1.9	324	6,667	6,926
주에스에프에이	3,644,000	10.2	38,262	144,120	131,366
주원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	14,978	17,521
주원익아이피에스	3,701,872	7.5	32,428	110,316	156,589
ASML Holding N.V.	6,297,787	1.5	363,012	3,875,786	5,974,280
Wacom Co., Ltd.	8,398,400	5.0	62,013	66,769	79,256
BYD Company Limited	2,380,100	0.1	79,049	152,993	118,862
Corning Incorporated	80,000,000	9.5	3,980,636	3,259,142	3,530,893
기타			559,450	793,581	1,155,113
계			6,092,110	9,380,634	12,087,109

(\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부금액	평가전금액	평가총당금	장부금액
제품 및 상품	18,694,756	(1,120,644)	17,574,112	13,000,200	(719,621)	12,280,579
반제품 및 재공품	16,005,040	(825,983)	15,179,057	13,967,331	(493,713)	13,473,618
원재료 및 저장품	18,865,194	(1,023,917)	17,841,277	14,864,486	(679,645)	14,184,841
미착품	1,497,795	-	1,497,795	1,445,366	-	1,445,366
계	55,062,785	(2,970,544)	52,092,241	43,277,383	(1,892,979)	41,384,404

6. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당반기와 전반기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초	8,932,251	8,076,779
취득	1,002,798	28,600
처분	(6,913)	(4,519)
이익 중 지분해당액	491,706	335,006
기타(*)	(36,904)	50,028
반기말	10,382,938	8,485,894

(\*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(\*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(\*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(\*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당반기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기(주)	359,237	1,699,902	1,687,646	359,237	1,573,570	1,556,386
삼성에스디에스(주)	147,963	1,720,961	1,736,758	147,963	1,632,847	1,652,155
삼성바이오로직스(주)	1,424,358	2,647,036	2,650,618	443,193	1,571,809	1,577,664
삼성SDI(주)	1,242,605	3,127,156	2,627,993	1,242,605	2,960,235	2,529,650
(주)제일기획	506,162	329,935	630,514	506,162	320,301	621,292
기타	659,623	634,538	846,824	644,903	578,547	793,748
계	4,339,948	10,159,528	10,180,353	3,344,063	8,637,309	8,730,895

(\*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당반기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	138,861	138,857	215,000	135,584	135,580
기타	259,994	66,701	63,728	259,994	67,517	65,776
계	474,994	205,562	202,585	474,994	203,101	201,356

(\*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당반기와 전반기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가			반기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,556,386	143,913	24,503	(37,156)	1,687,646
삼성에스디에스(주)	1,652,155	100,037	26,499	(41,933)	1,736,758
삼성바이오로직스(주)	1,577,664	93,678	(1,888)	981,164	2,650,618
삼성SDI(주)	2,529,650	91,076	20,729	(13,462)	2,627,993
(주)제일기획	621,292	30,141	7,828	(28,747)	630,514
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	135,580	3,277	-	-	138,857
기타	859,524	29,584	(54,700)	76,144	910,552
계	8,932,251	491,706	22,971	936,010	10,382,938

(\*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가			반기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,333,819	117,610	29,452	(24,770)	1,456,111
삼성에스디에스(주)	1,525,857	71,137	24,125	(41,933)	1,579,186
삼성바이오로직스(주)	1,453,012	59,036	(117)	-	1,511,931
삼성SDI(주)	2,326,037	37,529	111,749	(13,464)	2,461,851
(주)제일기획	586,057	24,908	4,898	(24,393)	591,470
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	123,356	7,098	-	-	130,454
기타	728,641	17,688	(62,817)	71,379	754,891
계	8,076,779	335,006	107,290	(33,181)	8,485,894

(\*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당반기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	5,103,411	8,117,813	6,344,592	9,418,214	2,065,765
비유동자산	5,604,568	3,251,652	9,314,850	19,423,672	527,322
유동부채	2,484,860	2,648,705	3,467,676	7,550,664	1,243,068
비유동부채	802,716	879,038	3,711,884	5,243,138	187,510
비지배지분	162,034	222,914	-	514,680	11,765
요약 포괄손익계산서:					
매출	5,089,065	8,786,676	1,162,727	8,790,200	1,922,981
계속영업손익(*)	604,625	464,770	298,983	747,915	105,224
세후중단영업손익(*)	-	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	106,251	110,958	1,476	148,171	28,644
총포괄손익(*)	710,876	575,728	300,459	896,086	133,868
II. 배당					
배당	37,155	41,933	-	13,463	28,748

(\*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):					
유동자산	4,598,269	7,575,968	2,823,175	7,444,907	2,018,598
비유동자산	5,343,105	2,941,464	5,146,835	18,388,286	523,513
유동부채	2,234,657	2,370,290	1,107,295	6,461,286	1,224,222
비유동부채	835,592	703,442	1,871,614	4,175,208	190,622
비지배지분	152,177	214,980	-	492,435	10,125
요약 포괄손익계산서(전반기):					
매출	4,847,454	6,312,184	672,960	6,297,481	1,486,797
계속영업손익(*)	488,235	315,218	182,498	438,333	87,048
세후중단영업손익(*)	(10,937)	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	125,914	88,446	(250)	459,243	13,430
총포괄손익(*)	603,212	403,664	182,248	897,576	100,478
II. 배당(전반기)					
배당	24,770	41,933	-	13,463	24,392

(\*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당반기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	165,312	163,083
비유동자산	132,505	141,411
유동부채	19,161	31,779
비유동부채	935	1,547
요약 포괄손익계산서(*):		
매출	75,043	99,420
계속영업손익	6,553	12,210
세후중단영업손익	-	-
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	6,553	12,210
II. 배당		
배당	-	-

(\* ) 반기 6개월 기준 금액입니다.



(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
반기순손익	28,633	951	17,998	(310)
기타포괄손익	(51,498)	(3,202)	(61,644)	(1,173)
총포괄손익	(22,865)	(2,251)	(43,646)	(1,483)

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당반기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기(주)	17,693,084	2,308,947	3,494,384
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,271,374	2,734,385
삼성바이오로직스(주)	22,217,309	17,551,674	18,815,659
삼성SDI(주)	13,462,673	7,162,142	8,818,051
(주)제일기획	29,038,075	689,654	663,520

## 사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주식 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스(주)는 위 처분에 대한 효력 정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력 정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당반기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초장부금액	149,928,539	128,952,892
일반취득 및 자본적지출	20,754,405	24,055,907
감가상각	(18,077,845)	(14,360,825)
처분·폐기·손상	(164,773)	(287,768)
기타(*)	1,814,250	1,029,656
반기말장부금액	154,254,576	139,389,862

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당반기 및 전반기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출원가	16,292,066	12,672,651
판매비와관리비 등	1,785,779	1,688,174
계	18,077,845	14,360,825

다. 당반기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 4,038,685백만원(전기말: 3,950,567백만원)입니다. 또한, 당반기 중 신규 발생한 사용권자산은 502,506백만원(전반기: 749,906백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 469,474백만원(전반기: 432,080백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초장부금액	20,236,244	18,468,502
개별 취득	859,818	3,259,677
내부개발에 의한 취득	-	170,677
상각	(1,543,029)	(1,471,855)
처분·폐기·손상	(27,801)	(12,296)
기타(*)	571,694	332,308
반기말장부금액	20,096,926	20,747,013

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 사업결합으로 인한 취득 등을 포함하고 있습니다.

나. 당반기 및 전반기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출원가	1,070,464	1,060,884
판매비와관리비 등	472,565	410,971
계	1,543,029	1,471,855

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당반기말	당반기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.0~13.4	9,584,291	11,556,101
무담보차입금	씨티은행 등	0.0~38.5	3,404,897	2,131,692
계			12,989,188	13,687,793
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP Paribas	18.3~47.1	98,028	40,415
리스부채(*2)	CSSD 등	3.3	848,429	811,902
계			946,457	852,317
장기차입금:				
은행차입금	기업은행	1.5~3.8	8,500	1,500
리스부채(*2)	CSSD 등	3.3	2,934,708	2,864,656
계			2,943,208	2,866,156

(\*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(\*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당반기 중 발생한 이자비용은 61,932백만원(전반기: 51,611백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
				당반기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	38,787 (US\$ 30,000천)	35,565 (US\$ 30,000천)
US\$ denominated Debenture Bonds(*2)	2015.05.11	2025.05.15	4.2	517,160 (US\$ 400,000천)	474,200 (US\$ 400,000천)
EURO€ denominated Debenture Bonds(*3)	2015.05.27	2022.05.27	-	-	469,819 (EUR€350,000천)
소 계				555,947	979,584
사채할인발행차금				(662)	(708)
사채할증발행차금				4,852	7,007
계				560,137	985,883
차감: 유동성사채				(6,354)	(477,651)
비유동성사채				553,783	508,232

(\*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(\*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(\*3) 종속기업 Harman Finance International, SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며 이자는 1년마다 후급됩니다. 한편 해당 사채는 2022년 3월 1일 전액 조기상환되었습니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	15,101,824	14,391,209
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	285,298	266,976
소 계	15,387,122	14,658,185
사외적립자산의 공정가치	(17,001,453)	(17,001,891)
순확정급여부채(자산) 계	(1,614,331)	(2,343,706)

나. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
당기근무원가	684,929	624,240
순이자원가(수익)	(49,382)	(19,249)
과거근무원가	56	664
기타	3,417	2,379
계	639,020	608,034

다. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출원가	273,388	254,759
판매비와관리비 등	365,632	353,275
계	639,020	608,034

12. 총당부채:

당반기 중 총당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	1,978,294	1,561,809	734,283	3,405,480	7,679,866
순전입(환입)	928,400	476,237	136,561	732,316	2,273,514
사용	(829,003)	(309,700)	(252,451)	(555,725)	(1,946,879)
기타(*)	66,273	132,019	5,133	64,095	267,520
당반기말	2,143,964	1,860,365	623,526	3,646,166	8,274,021

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.



마. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당반기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO<sub>2</sub>-eq))

구 분	당반기말
무상할당 배출권	1,687
배출량 추정치	1,997

(2) 당반기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기
기초	46,074
증가	1,871
사용	-
당반기말	47,945

(3) 당반기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기
기초	45,049
순전입(환입)	23,365
사용	-
당반기말	68,414

### 13. 우발부채와 약정사항:

#### 가. 소송 등

당반기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

14. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
계약부채(*)	13,196,201	13,235,108

(\*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

## 15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당반기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
임의적립금 등	192,095,157	170,814,107
연결미처분이익잉여금	118,121,628	122,250,656
계	310,216,785	293,064,763

나. 당반기 및 전반기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당 (배당기준일: 2022년과 2021년 3월 31일, 6월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당반기	전반기	
1분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,860,145	4,616,639
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	189,564	166,835
해외사업장환산외환차이	3,439,408	(3,824,733)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,271,369)	(3,173,977)
기타	94,672	86,763
계	3,312,420	(2,128,473)

18. 비용의 성격별 분류:

당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	(4,439,969)	(6,998,972)	20,649	1,760,501
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	28,865,165	56,931,407	19,633,598	42,218,021
급여	7,528,038	15,260,987	6,598,439	13,301,170
퇴직급여	341,528	692,424	336,872	676,056
감가상각비	9,068,814	18,077,845	7,213,089	14,360,825
무형자산상각비	772,552	1,543,029	776,313	1,471,855
복리후생비	1,738,929	3,140,865	1,355,793	2,558,370
유틸리티비	1,383,458	2,782,026	1,142,455	2,342,866
외주용역비	1,652,475	3,135,008	1,376,724	2,783,173
광고선전비	1,397,480	2,865,181	1,118,991	2,229,360
판매촉진비	1,536,956	3,360,354	1,241,802	2,866,329
기타비용	13,261,136	25,976,497	10,290,115	20,541,949
계(*)	63,106,562	126,766,651	51,104,840	107,110,475

(\*) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
<b>(1) 판매비와관리비:</b>				
급여	1,884,465	3,879,818	1,647,928	3,444,562
퇴직급여	72,706	150,000	77,660	155,394
지급수수료	1,806,907	3,537,298	1,468,637	2,929,630
감가상각비	382,702	761,443	378,537	760,611
무형자산상각비	163,203	331,697	134,888	270,471
광고선전비	1,397,480	2,865,181	1,118,991	2,229,360
판매촉진비	1,536,956	3,360,354	1,241,802	2,866,329
운반비	984,085	1,841,718	710,587	1,319,349
서비스비	837,018	1,730,562	693,446	1,514,103
기타판매비와관리비	1,516,418	2,789,669	1,183,917	2,231,690
소 계	10,581,940	21,247,740	8,656,393	17,721,499
<b>(2) 경상연구개발비:</b>				
연구개발 총지출액	6,254,874	12,177,106	5,451,616	10,993,737
개발비 자산화	-	-	(69,100)	(170,677)
소 계	6,254,874	12,177,106	5,382,516	10,823,060
계	16,836,814	33,424,846	14,038,909	28,544,559



20. 기타수익 및 기타비용:

당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익:				
배당금수익	62,400	330,909	68,335	77,069
임대료수익	34,914	69,498	32,967	66,785
유형자산처분이익	63,780	114,200	130,550	206,021
기타	302,877	649,557	508,816	690,535
계	463,971	1,164,164	740,668	1,040,410
(2) 기타비용:				
유형자산처분손실	19,911	24,107	40,627	50,469
기부금	85,866	175,426	95,431	134,638
기타	494,616	853,970	740,838	1,016,029
계	600,393	1,053,503	876,896	1,201,136

21. 금융수익 및 금융비용:

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
<b>(1) 금융수익:</b>				
이자수익	487,194	856,226	254,133	586,681
- 상각후원가 측정 금융자산	487,130	856,097	254,078	586,551
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	64	129	55	130
외환차이	4,490,804	7,099,407	1,409,002	3,117,039
파생상품관련이익	393,887	918,441	124,008	322,061
계	5,371,885	8,874,074	1,787,143	4,025,781
<b>(2) 금융비용:</b>				
이자비용	123,064	272,295	74,232	170,674
- 상각후원가 측정 금융부채	31,904	106,567	24,956	68,223
- 기타금융부채	91,160	165,728	49,276	102,451
외환차이	4,675,575	7,136,257	1,186,226	2,921,078
파생상품관련손실	332,340	755,745	262,259	424,847
계	5,130,979	8,164,297	1,522,717	3,516,599

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

## 22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기말 현재 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 24.1%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당반기 및 전반기의 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 반기순이익	10,954,515	22,083,609	9,450,676	16,543,462
반기순이익 중 보통주 해당분	9,627,448	19,408,327	8,305,789	14,539,332
÷ 가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(원)	1,613	3,251	1,391	2,435

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 반기순이익	10,954,515	22,083,609	9,450,676	16,543,462
반기순이익 중 우선주 해당분	1,327,067	2,675,282	1,144,887	2,004,130
÷ 가중평균유통우선주식수(천주)	822,887	822,887	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(원)	1,613	3,251	1,391	2,435

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당반기 및 전반기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당반기 및 전반기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
법인세비용	7,107,165	5,856,904
금융수익	(3,033,105)	(1,341,113)
금융비용	2,516,133	1,040,969
퇴직급여	692,424	676,056
감가상각비	18,077,845	14,360,825
무형자산상각비	1,543,029	1,471,855
대손상각비(환입)	24,421	2,568
배당금수익	(330,909)	(77,069)
지분법이익	(491,706)	(335,006)
유형자산처분이익	(114,200)	(206,021)
유형자산처분손실	24,107	50,469
재고자산평가손실(환입) 등	1,934,530	591,381
기타	108,064	(159,302)
계	28,057,798	21,932,516

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출채권의 감소(증가)	383,614	(3,806,471)
미수금의 감소(증가)	(656,444)	(55,161)
장단기선급비용의 감소(증가)	(323,801)	(202,122)
재고자산의 감소(증가)	(10,473,730)	(1,594,374)
매입채무의 증가(감소)	(3,479,374)	299,667
장단기미지급금의 증가(감소)	(2,076,950)	15,150
선수금의 증가(감소)	13,502	(113,667)
예수금의 증가(감소)	(563,671)	(90,346)
미지급비용의 증가(감소)	(1,705,600)	(1,643,233)
장단기충당부채의 증가(감소)	326,635	231,002
퇴직금의 지급	(295,378)	(232,658)
기타	(576,003)	(714,900)
계	(19,427,200)	(7,907,113)

나. 당반기 및 전반기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 485,458백만원 및 390,466백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 61,932백만원 및 51,611백만원입니다.

## 25. 재무위험관리:

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 가. 시장위험

### (1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

연결회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

### (2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

### (3) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 90,393백만원(전반기: 107,635백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,413백만원(전반기: 3,941백만원)입니다.



## 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

#### 다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

## 라. 자본위험

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당반기말 현재 연결회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있으며, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
부 채	120,133,986	121,721,227
자 본	327,906,664	304,899,931
부채비율	36.6%	39.9%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	39,583,141	(*1)	39,031,415	(*1)
단기금융상품	84,428,822	(*1)	81,708,986	(*1)
단기상각후원가금융자산	1,253,196	(*1)	3,369,034	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	55,505	55,505	40,757	40,757
매출채권	44,026,232	(*1)	40,713,415	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,610,592	11,610,592	13,965,839	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,382,193	1,382,193	1,525,344	1,525,344
기타(*2)	10,362,657	412,881	9,040,189	328,216
계	192,702,338		189,394,979	
금융부채:				
매입채무	12,560,726	(*1)	13,453,351	(*1)
단기차입금	12,989,188	(*1)	13,687,793	(*1)
미지급금	12,270,350	(*1)	14,126,970	(*1)
유동성장기부채	952,811	6,888	1,329,968	554,106
- 유동성장기차입금	946,457	(*1)(*3)	852,317	(*1)(*3)
- 유동성사채	6,354	6,888	477,651	554,106
사채	553,783	557,308	508,232	546,339
장기차입금	2,943,208	(*1)(*3)	2,866,156	(*1)(*3)
장기미지급금	2,400,941	(*1)	2,562,158	(*1)
기타(*2)	11,345,268	363,306	10,781,684	337,394
계	56,016,275		59,316,312	

(\*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 9,949,776백만원(전기말: 8,711,973백만원)

및 금융부채 10,981,962백만원(전기말: 10,444,290백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	36,796	18,709	55,505
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,039,307	-	2,571,285	11,610,592
당기손익-공정가치금융자산	341,326	-	1,040,867	1,382,193
기타	-	390,264	22,617	412,881
금융부채:				
유동성사채	-	6,888	-	6,888
사채	-	557,308	-	557,308
기타	-	357,868	5,438	363,306

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	35,620	5,137	40,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,608,708	-	2,357,131	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	478,401	-	1,046,943	1,525,344
기타	-	307,213	21,003	328,216
금융부채:				
유동성사채	-	554,106	-	554,106
사채	-	546,339	-	546,339
기타	-	331,956	5,438	337,394

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	28,458	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	15.2%~17.2%(16.2%)
㈜미코세라믹스	24,801	현금흐름할인법 등	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,477,845	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	371,371	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)
기타:				
지분 풋옵션	22,617	이항모형	무위험 이자율	2.9%~3.0%, 2.5%
			가격 변동성	21.4%~31.4%(26.4%), 24.9%~34.9%(29.9%)

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당반기	전반기
기초	3,430,214	6,449,139
매입	108,009	919,311
매도	(160,465)	(110,865)
당기손익으로 인식된 손익	91,008	127,238
기타포괄손익으로 인식된 손익	183,532	1,194,086
기타	1,180	(5,692,367)
반기말	3,653,478	2,886,542

(단위 : 백만원)

금융부채	당반기	전반기
기초	5,438	9,248
기타	-	(2,176)
반기말	5,438	7,072



(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	161,590	-	(116,634)
기타(*2)	2,912	-	(4,158)	-

(\*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(\*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

## 26. 부문별 보고:

### 가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당반기와 전반기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부 거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	44,455,371	28,497,568	7,710,680	2,982,834	77,203,607
감가상각비	610,308	7,051,507	1,284,450	80,322	9,068,814
무형자산상각비	403,013	204,895	59,793	50,151	772,552
영업이익	3,021,697	9,981,053	1,057,643	101,642	14,097,045

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당분기(3개월) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	7,537,814	28,000,484	21,075,357	7,710,680	77,203,607

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당반기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	92,524,038	55,364,982	15,681,171	5,649,180	154,985,105
감가상각비	1,215,157	13,935,829	2,684,014	158,693	18,077,845
무형자산상각비	796,775	412,182	119,181	107,677	1,543,029
영업이익	7,577,158	18,431,184	2,150,507	203,202	28,218,454

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당반기(누적) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	16,255,835	59,228,241	41,166,821	15,681,171	154,985,105

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	36,395,980	23,053,778	6,867,870	2,419,406	63,671,585
감가상각비	585,976	5,157,773	1,348,389	76,676	7,213,089
무형자산상각비	357,434	272,900	60,122	56,758	776,313
영업이익	4,339,240	6,929,550	1,281,864	106,733	12,566,745

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기(3개월) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	7,170,238	21,430,950	17,879,766	6,867,870	63,671,585

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전반기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	78,872,904	42,370,279	13,790,917	4,786,673	129,060,088
감가상각비	1,166,968	10,160,296	2,794,527	153,138	14,360,825
무형자산상각비	651,301	530,455	119,585	112,780	1,471,855
영업이익	9,848,743	10,290,319	1,646,292	219,858	21,949,613

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전반기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	14,390,634	49,634,034	32,314,644	13,790,917	129,060,088

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

나. 지역별 정보

당반기와 전반기의 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	11,262,111	32,479,799	11,100,501	12,010,024	10,351,172	-	77,203,607
비유동자산(*)	130,507,765	11,857,401	5,873,791	9,396,020	17,570,719	(854,194)	174,351,502

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당반기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	23,335,805	61,573,772	24,344,402	24,913,418	20,817,708	-	154,985,105
비유동자산(*)	130,507,765	11,857,401	5,873,791	9,396,020	17,570,719	(854,194)	174,351,502

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	10,329,787	21,993,772	10,868,102	8,927,787	11,552,137	-	63,671,585
비유동자산(*)	118,732,676	9,916,326	6,052,990	9,251,297	17,221,059	(1,037,473)	160,136,875

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전반기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	20,363,266	42,680,194	24,077,485	19,755,166	22,183,977	-	129,060,088
비유동자산(*)	118,732,676	9,916,326	6,052,990	9,251,297	17,221,059	(1,037,473)	160,136,875

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	129,044	-	889,262	185,302
	삼성전기(주)	48,221	-	769,412	-
	삼성SDI(주)	43,494	-	392,753	7,252
	(주)제일기획	30,204	-	456,042	-
	기타	685,854	-	7,752,693	55,766
	관계기업 및 공동기업 계	936,817	-	10,260,162	248,320
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	28,750	-	240,033	2,832,163
	기타	189,235	-	834,358	149,510
	그 밖의 특수관계자 계	217,985	-	1,074,391	2,981,673
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	970	-	14,328	1,068,938
	(주)에스원	4,871	-	246,721	14,330
	기타	83,692	-	133,566	145,829
	기타 계	89,533	-	394,615	1,229,097

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	84,835	-	829,849	253,116
	삼성전기(주)	33,736	-	717,016	-
	삼성SDI(주)	37,164	269	291,022	16,832
	(주)제일기획	25,839	-	357,625	17
	기타	561,509	68	5,475,204	63,979
	관계기업 및 공동기업 계	743,083	337	7,670,716	333,944
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	48,584	12,134	153,854	1,834,247
	기타	200,925	-	888,236	318,677
	그 밖의 특수관계자 계	249,509	12,134	1,042,090	2,152,924
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	223	-	17,218	654,863
	(주)에스원	5,864	-	229,878	22,979
	기타	61,198	2,371	98,463	53,255
	기타 계	67,285	2,371	345,559	731,097

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	73,236	460,932
	삼성전기(주)	12,506	169,754
	삼성SDI(주)	118,051	69,351
	(주)제일기획	89	435,480
	기타	379,135	1,230,134
	관계기업 및 공동기업 계	583,017	2,365,651
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	223,821	1,463,031
	기타	20,342	282,324
	그 밖의 특수관계자 계	244,163	1,745,355
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	793	317,766
	(주)에스원	997	41,098
	기타	12,724	81,872
	기타 계	14,514	440,736

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.



(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	64,521	616,949
	삼성전기(주)	3,659	176,549
	삼성SDI(주)	130,638	100,835
	(주)제일기획	206	428,090
	기타	397,709	1,361,554
	관계기업 및 공동기업 계	596,733	2,683,977
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	220,550	1,739,997
	기타	20,306	251,766
	그 밖의 특수관계자 계	240,856	1,991,763
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	338	1,151,536
	(주)에스원	2,423	40,558
	기타	48,703	185,256
	기타 계	51,464	1,377,350

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업에 903,758백만원 및 28,600백만원을 출자하였습니다. 또한, 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 6,787백만원 및 916백만원의 출자원금을 회수하였습니다.

라. 연결회사가 당반기 및 전반기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 835,814백만원 및 2,683,584백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당반기 및 전반기 중 지급 결의한 배당금은 64,116백만원 및 203,623백만원입니다. 당반기 말 및 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

마. 연결회사가 당반기 중 특수관계자와 체결한 리스계약은 없으며, 전반기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 12,602백만원입니다. 당반기와 전반기 중 특수관계자에게 지급한 리스료는 12,493백만원 및 17,940백만원입니다.

바. 연결회사가 당반기 및 전반기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
단기급여	4,694	4,550
퇴직급여	289	443
기타 장기급여	3,873	4,046

## 4. 재무제표

### 재무상태표

제 54 기 반기말 2022.06.30 현재

제 53 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기말	제 53 기말
자산		
유동자산	76,194,477	73,553,416
현금및현금성자산	3,079,118	3,918,872
단기금융상품	13,104,200	15,000,576
매출채권	32,463,228	33,088,247
미수금	1,566,416	1,832,488
선급비용	995,039	817,689
재고자산	21,390,252	15,973,053
기타유동자산	3,596,224	2,922,491
비유동자산	182,776,820	177,558,768
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,503,038	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	1,876	2,135
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,362,214	56,225,599
유형자산	108,381,976	103,667,025
무형자산	8,181,534	8,657,456
순확정급여자산	1,727,747	2,324,291
이연법인세자산	1,782,944	1,211,100
기타비유동자산	3,835,491	3,808,630
자산총계	258,971,297	251,112,184
부채		
유동부채	50,310,861	53,067,303
매입채무	12,177,539	11,557,441
단기차입금	8,507,002	9,204,268
미지급금	11,813,352	13,206,753
선수금	429,111	474,731
예수금	396,189	624,585
미지급비용	7,391,309	8,275,410
당기법인세부채	4,849,560	5,599,896
유동성장기부채	127,811	139,328
총당부채	4,188,770	3,643,853
기타유동부채	430,218	341,038
비유동부채	4,745,989	4,851,149

사채	31,771	29,048
장기차입금	401,816	431,915
장기미지급금	2,532,115	2,653,715
장기총당부채	1,722,050	1,659,774
기타비유동부채	58,237	76,697
부채총계	55,056,850	57,918,452
자본		
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	199,712,456	188,774,335
기타자본항목	(1,099,416)	(882,010)
자본총계	203,914,447	193,193,732
부채와자본총계	258,971,297	251,112,184

### 손익계산서

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기		제 53 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	58,641,288	115,365,546	45,768,634	90,811,024
매출원가	39,964,268	79,149,180	31,002,588	64,140,150
매출총이익	18,677,020	36,216,366	14,766,046	26,670,874
판매비와관리비	8,518,142	16,905,657	7,047,292	14,506,644
영업이익	10,158,878	19,310,709	7,718,754	12,164,230
기타수익	144,397	427,668	4,281,927	5,639,174
기타비용	99,176	153,785	549,017	597,997
금융수익	2,489,143	4,229,038	757,914	1,678,678
금융비용	2,433,137	3,875,505	703,711	1,560,862
법인세비용차감전순이익(손실)	10,260,105	19,938,125	11,505,867	17,323,223
법인세비용	2,068,797	4,094,874	2,376,677	3,646,429
계속영업이익(손실)	8,191,308	15,843,251	9,129,190	13,676,794
당기순이익(손실)	8,191,308	15,843,251	9,129,190	13,676,794
주당이익				
기분주당이익(손실) (단위 : 원)	1,206	2,332	1,344	2,013
회석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,206	2,332	1,344	2,013

## 포괄손익계산서

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기		제 53 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	8,191,308	15,843,251	9,129,190	13,676,794
기타포괄손익	(100,478)	(217,406)	(80,229)	(64,223)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(100,478)	(217,406)	(80,229)	(64,223)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(61,732)	(115,633)	(61,578)	(7,602)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(38,746)	(101,773)	(18,651)	(56,621)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	8,090,830	15,625,845	9,048,961	13,612,571

자본변동표

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	178,284,102	(268,785)	183,316,724
당기순이익(손실)			13,676,794		13,676,794
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(7,602)	(7,602)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(56,621)	(56,621)
배당			(15,576,414)		(15,576,414)
2021.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	176,384,482	(333,008)	181,352,881
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
당기순이익(손실)			15,843,251		15,843,251
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(115,633)	(115,633)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(101,773)	(101,773)
배당			(4,905,130)		(4,905,130)
2022.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	199,712,456	(1,099,416)	203,914,447

## 현금흐름표

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 반기	제 53 기 반기
영업활동 현금흐름	21,221,889	24,756,254
영업에서 창출된 현금흐름	26,374,703	23,223,905
당기순이익	15,843,251	13,676,794
조정	18,238,275	9,127,825
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,706,823)	419,286
이자의 수취	161,320	167,563
이자의 지급	(117,383)	(45,404)
배당금 수입	137,839	5,200,354
법인세 납부액	(5,334,590)	(3,790,164)
투자활동 현금흐름	(16,415,626)	(1,967,232)
단기금융상품의 순감소(증가)	1,896,376	16,397,999
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(43,009)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	150	90
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	75,028	310,538
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(940,489)	(41,640)
유형자산의 처분	239,039	318,318
유형자산의 취득	(16,286,602)	(17,369,129)
무형자산의 처분	197	455
무형자산의 취득	(1,335,396)	(1,454,242)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(63,929)	(86,612)
재무활동 현금흐름	(5,646,940)	(18,896,543)
단기차입금의 순증가(감소)	(669,755)	(3,266,633)
사채 및 장기차입금의 상환	(72,124)	(55,324)
배당금의 지급	(4,905,061)	(15,574,586)
외화환산으로 인한 현금의 변동	923	18
현금및현금성자산의 순증감	(839,754)	3,892,497
기초의 현금및현금성자산	3,918,872	989,045
기말의 현금및현금성자산	3,079,118	4,881,542



## 5. 재무제표 주석

제 54 기 반기 : 2022년 6월 30일 현재

제 53 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

### 1. 일반적 사항:

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

## 2. 중요한 회계처리방침:

### 2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2022년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2022년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

##### - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

##### - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공포됐으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

## 2.2. 회계정책

반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정

반기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 코로나19로 회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당반기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	3,079,118	-	-	3,079,118
단기금융상품	13,104,200	-	-	13,104,200
매출채권	32,463,228	-	-	32,463,228
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,503,038	-	1,503,038
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,876	1,876
기타	5,488,428	-	-	5,488,428
계	54,134,974	1,503,038	1,876	55,639,888

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,177,539	-	12,177,539
단기차입금	-	8,507,002	8,507,002
미지급금	11,594,599	-	11,594,599
유동성장기부채	6,354	121,457	127,811
사채	31,771	-	31,771
장기차입금	-	401,816	401,816
장기미지급금	2,174,836	-	2,174,836
기타	3,421,604	-	3,421,604
계	29,406,703	9,030,275	38,436,978

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	3,918,872	-	-	3,918,872
단기금융상품	15,000,576	-	-	15,000,576
매출채권	33,088,247	-	-	33,088,247
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,662,532	-	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,135	2,135
기타	5,076,418	-	-	5,076,418
계	57,084,113	1,662,532	2,135	58,748,780

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,557,441	-	11,557,441
단기차입금	-	9,204,268	9,204,268
미지급금	12,948,960	-	12,948,960
유동성장기부채	5,810	133,518	139,328
사채	29,048	-	29,048
장기차입금	-	431,915	431,915
장기미지급금	2,335,218	-	2,335,218
기타	3,056,156	-	3,056,156
계	29,932,633	9,769,701	39,702,334

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
지분상품	1,503,038	1,662,532

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
채무상품	1,876	2,135



나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기업명	당반기말			전기말	
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	134,027,281	15.2	932,158	813,546	759,935
(주)호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	142,736	156,368
(주)아이마켓코리아	647,320	1.9	324	6,667	6,926
(주)케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	1,966	2,194
(주)용평리조트	400,000	0.8	1,869	1,600	1,958
(주)에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	21,412	26,188
(주)원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	6,694	8,761
(주)원익아이피에스	1,850,936	3.8	16,214	55,158	78,295
(주)동진세미켐	2,467,894	4.8	48,277	79,219	125,863
솔브레인홀딩스(주)	461,741	2.2	30,752	8,889	15,976
솔브레인(주)	373,368	4.8	24,866	85,352	103,983
(주)에스앤에스텍	1,716,116	8.0	65,933	33,893	63,153
와이아이케이(주)	9,601,617	11.7	47,336	38,454	59,530
(주)케이씨텍	1,022,216	4.9	20,720	18,451	24,584
(주)엘오티베콤	1,267,668	7.1	18,990	14,262	21,805
(주)뉴파워프라즈마	2,140,939	4.9	12,739	8,296	13,723
(주)에프에스티	1,522,975	7.0	43,009	22,159	38,607
(주)디엔에프	810,030	7.0	20,964	11,259	18,509
Marvell	173,187	0.0	11,705	9,747	17,962
SoundHound AI, Inc.	1,720,957	0.9	13,719	5,963	-
계			1,368,634	1,385,723	1,544,320

(\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부금액	평가전금액	평가총당금	장부금액
제품 및 상품	5,982,490	(410,325)	5,572,165	3,884,713	(366,987)	3,517,726
반제품 및 재공품	11,758,546	(503,560)	11,254,986	9,384,285	(222,291)	9,161,994
원재료 및 저장품	4,350,450	(370,273)	3,980,177	3,211,380	(258,464)	2,952,916
미착품	582,924	-	582,924	340,417	-	340,417
계	22,674,410	(1,284,158)	21,390,252	16,820,795	(847,742)	15,973,053

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당반기 및 전반기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초	56,225,599	56,587,548
취득	1,211,063	41,640
처분	(74,448)	(287,300)
반기말	57,362,214	56,341,888

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.  
(종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(\*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(\*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당반기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기(주)	17,693,084	2,308,947	445,244	3,494,384	445,244
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,271,374	560,827	2,734,385	560,827
삼성바이오로직스(주)	22,217,309	17,551,674	1,595,892	18,815,659	443,193
삼성SDI(주)	13,462,673	7,162,142	1,242,605	8,818,051	1,242,605
(주)제일기획	29,038,075	689,654	491,599	663,520	491,599

7. 유형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초장부금액	103,667,025	86,166,924
일반취득 및 자본적지출	16,792,529	16,856,817
감가상각	(12,020,188)	(9,167,696)
처분·폐기·손상	(157,453)	(173,461)
기타	100,063	(5,553)
반기말장부금액	108,381,976	93,677,031

나. 당반기 및 전반기의 계정과목별 유형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출원가	11,133,349	8,326,859
판매비와관리비 등	886,839	840,837
계	12,020,188	9,167,696

다. 당반기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 682,813백만원(전기말: 730,325백만원)입니다. 또한, 당반기 중 신규 발생한 사용권자산은 31,866백만원(전반기: 130,282백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 79,028백만원(전반기: 60,813백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초장부금액	8,657,456	7,002,648
내부개발에 의한 취득	-	170,677
개별 취득	800,515	3,237,185
상각	(1,265,858)	(1,188,525)
처분·폐기·손상	(16,893)	(11,317)
기타	6,314	7,348
반기말장부금액	8,181,534	9,218,016

나. 당반기 및 전반기의 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출원가	967,462	958,792
판매비와관리비 등	298,396	229,733
계	1,265,858	1,188,525

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당반기말	당반기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.0~13.4	8,507,002	9,204,268
유동성장기차입금:				
리스부채(*2)	-	1.7	121,457	133,518
장기차입금:				
리스부채(*2)	-	1.7	401,816	431,915

(\*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(\*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당반기 중 발생한 이자비용은 4,571백만원(전반기: 2,204백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당반기말	당반기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	38,787 (US\$ 30,000천)	35,565 (US\$ 30,000천)
사채할인발행차금				(662)	(707)
계				38,125	34,858
차감: 유동성사채				(6,354)	(5,810)
비유동성사채				31,771	29,048

(\*) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	11,720,390	11,155,187
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	19,384	18,449
소 계	11,739,774	11,173,636
사외적립자산의 공정가치	(13,467,521)	(13,497,927)
순확정급여부채(자산) 계	(1,727,747)	(2,324,291)

나. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
당기근무원가	515,017	453,725
순이자원가(수익)	(45,950)	(20,053)
계	469,067	433,672

다. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출원가	186,374	169,443
판매비와관리비 등	282,693	264,229
계	469,067	433,672



12. 총당부채:

당반기 중 총당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	386,713	1,496,525	558,982	2,861,407	5,303,627
순전입(환입)	300,612	541,360	91,345	764,483	1,697,800
사용	(228,690)	(309,700)	(194,281)	(541,731)	(1,274,402)
기타	-	132,019	-	51,776	183,795
당반기말	458,635	1,860,204	456,046	3,135,935	5,910,820

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.

다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당반기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO<sub>2</sub>-eq))

구 분	당반기말
무상할당 배출권	1,123
배출량 추정치	1,523

(2) 당반기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기
기초	46,073
증가	1,872
당반기말	47,945

(3) 당반기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기
기초	45,049
순전입(환입)	23,351
사용	-
당반기말	68,400

13. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

(1) 당반기말 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

해외종속기업	보증처	보증종료일	당반기말	
			관련 차입금	채무보증한도
SETK	BNP 외	2023-06-13	297,602	1,043,370
SETK-P	BNP 외	2022-12-16	43,181	168,077
SEDAM	Citibank 외	2023-06-13	166,909	442,172
SEIL	Citibank	2022-12-16	12,706	20,169
기타	기타	-	-	8,943,048
계			520,398 (US\$ 402,504천)	10,616,836 (US\$ 8,211,645천)

(2) 당반기말 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 442,727백만원입니다.

(3) 당반기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

#### 나. 소송 등

당반기말 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제 기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

#### 다. 분할과 관련된 연대책무

회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

14. 계약부채 :

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
계약부채(*)	1,120,362	1,104,756

(\*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

## 15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당반기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금 등	199,261,667	188,323,546
계	199,712,456	188,774,335

나. 당반기 및 전반기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당(배당기준일: 2022년과 2021년 3월 31일, 6월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당반기	전반기	
1분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(25,054)	90,579
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,834,770)	(2,732,997)
기타	1,760,408	1,760,408
계	(1,099,416)	(882,010)



18. 비용의 성격별 분류:

당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	(2,057,842)	(4,147,431)	294,395	1,439,503
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	28,305,000	55,942,597	19,973,009	41,402,129
급여	3,820,721	8,060,769	3,400,978	6,964,494
퇴직급여	236,313	472,649	218,740	437,970
감가상각비	6,092,718	12,020,188	4,620,852	9,167,696
무형자산상각비	637,341	1,265,858	634,671	1,188,525
복리후생비	1,005,792	1,686,083	736,269	1,347,076
유틸리티비	835,588	1,668,263	668,375	1,354,725
외주용역비	944,007	1,747,749	776,490	1,590,939
광고선전비	435,815	788,863	341,013	590,036
판매촉진비	254,948	660,344	145,395	446,045
기타비용	7,972,009	15,888,905	6,239,693	12,717,656
계(*)	48,482,410	96,054,837	38,049,880	78,646,794

(\*) 손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
<b>(1) 판매비와관리비:</b>				
급여	563,646	1,292,305	476,881	1,125,054
퇴직급여	40,861	82,316	37,880	78,969
지급수수료	681,356	1,342,168	551,677	1,130,842
감가상각비	100,601	199,384	99,335	199,864
무형자산상각비	90,610	179,405	55,715	109,752
광고선전비	435,815	788,863	341,048	590,036
판매촉진비	254,948	660,344	145,395	446,045
운반비	298,887	560,372	246,575	443,375
서비스비	226,239	501,542	171,069	451,362
기타판매비와관리비	606,931	1,046,927	445,683	838,265
소 계	3,299,894	6,653,626	2,571,258	5,413,564
<b>(2) 경상연구개발비:</b>				
연구개발 총지출액	5,218,248	10,252,031	4,545,134	9,263,757
개발비 자산화	-	-	(69,100)	(170,677)
소 계	5,218,248	10,252,031	4,476,034	9,093,080
계	8,518,142	16,905,657	7,047,292	14,506,644

20. 기타수익 및 기타비용:

당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
<b>(1) 기타수익:</b>				
배당금수익	10,331	137,839	4,083,583	5,218,583
임대료수익	42,472	85,710	40,701	81,890
유형자산처분이익	40,594	88,692	81,385	214,269
기타	51,000	115,427	76,258	124,432
계	144,397	427,668	4,281,927	5,639,174
<b>(2) 기타비용:</b>				
유형자산처분손실	3,185	4,119	5,301	8,505
기부금	76,946	129,403	81,760	109,356
기타	19,045	20,263	461,956	480,136
계	99,176	153,785	549,017	597,997

21. 금융수익 및 금융비용:

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
<b>(1) 금융수익:</b>				
이자수익	85,462	168,920	51,926	134,215
- 상각후원가 측정 금융자산	85,462	168,920	51,926	134,215
외환차이	2,392,638	3,789,545	705,988	1,544,463
파생상품관련이익	11,043	270,573	-	-
계	2,489,143	4,229,038	757,914	1,678,678
<b>(2) 금융비용:</b>				
이자비용	65,175	119,096	34,253	66,367
- 상각후원가 측정 금융부채	12,109	23,926	13,452	22,490
- 기타금융부채	53,066	95,170	20,801	43,877
외환차이	2,367,962	3,756,409	617,028	1,442,065
파생상품관련손실	-	-	52,430	52,430
계	2,433,137	3,875,505	703,711	1,560,862

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

## 22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기 현재 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.5%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당반기 및 전반기의 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
반기순이익	8,191,308	15,843,251	9,129,190	13,676,794
반기순이익 중 보통주 해당분	7,198,986	13,923,947	8,023,249	12,019,941
÷ 가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(원)	1,206	2,332	1,344	2,013

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당반기		전반기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
반기순이익	8,191,308	15,843,251	9,129,190	13,676,794
반기순이익 중 우선주 해당분	992,322	1,919,304	1,105,941	1,656,853
÷ 가중평균유통우선주식수(천주)	822,887	822,887	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(원)	1,206	2,332	1,344	2,013

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당반기 및 전반기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당반기 및 전반기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
법인세비용	4,094,874	3,646,429
금융수익	(1,111,466)	(408,773)
금융비용	1,031,223	374,645
퇴직급여	472,649	437,970
감가상각비	12,020,188	9,167,696
무형자산상각비	1,265,858	1,188,525
대손상각비(환입)	6,180	11,153
배당금수익	(137,839)	(5,218,583)
유형자산처분이익	(88,692)	(214,269)
유형자산처분손실	4,119	8,505
재고자산평가손실(환입) 등	662,791	152,313
기타	18,390	(17,786)
계	18,238,275	9,127,825

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
매출채권의 감소(증가)	1,214,372	(2,830,839)
미수금의 감소(증가)	286,145	376,551
장단기선급비용의 감소(증가)	(182,769)	(127,710)
재고자산의 감소(증가)	(5,988,520)	913,260
매입채무의 증가(감소)	462,580	2,158,893
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,720,329)	65,940
선수금의 증가(감소)	(45,620)	(32,953)
예수금의 증가(감소)	(228,396)	(51,235)
미지급비용의 증가(감소)	(971,137)	(545,434)
장단기충당부채의 증가(감소)	423,398	247,124
퇴직금의 지급	(179,735)	(112,224)
기타	(776,812)	357,913
계	(7,706,823)	419,286

나. 당반기 및 전반기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 72,124백만원 및 55,324백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 4,571백만원 및 2,204백만원입니다.



## 25. 재무위험관리:

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 가. 시장위험

### (1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

### (2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

### (3) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 13,857백만원(전반기: 14,447백만원)입니다.

## 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용 위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

#### 다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

라. 자본위험

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당반기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있으며, 보고 기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말	전기말
부 채	55,056,850	57,918,452
자 본	203,914,447	193,193,732
부채비율	27.0%	30.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	3,079,118	(*1)	3,918,872	(*1)
단기금융상품	13,104,200	(*1)	15,000,576	(*1)
매출채권	32,463,228	(*1)	33,088,247	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,503,038	1,503,038	1,662,532	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	1,876	1,876	2,135	2,135
기타	5,488,428	(*1)	5,076,418	(*1)
계	55,639,888		58,748,780	
금융부채:				
매입채무	12,177,539	(*1)	11,557,441	(*1)
단기차입금	8,507,002	(*1)	9,204,268	(*1)
미지급금	11,594,599	(*1)	12,948,960	(*1)
유동성장기부채	127,811	6,888	139,328	6,276
- 유동성장기차입금	121,457	(*2)	133,518	(*2)
- 유동성사채	6,354	6,888	5,810	6,276
사채	31,771	37,459	29,048	35,863
장기차입금	401,816	(*2)	431,915	(*2)
장기미지급금	2,174,836	(*1)	2,335,218	(*1)
기타	3,421,604	(*1)	3,056,156	(*1)
계	38,436,978		39,702,334	

(\*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*2) 유동성장기부채, 장기차입금에 포함되어 있는 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,385,723	-	117,315	1,503,038
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,876	1,876
금융부채:				
유동성사채	-	6,888	-	6,888
사채	-	37,459	-	37,459

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,544,320	-	118,212	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,135	2,135
금융부채:				
유동성사채	-	6,276	-	6,276
사채	-	35,863	-	35,863

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.



(3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	28,458	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	15.2%~17.2%(16.2%)
(주)미코세라믹스	24,801	현금흐름할인법 등	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당반기	전반기
기초	120,347	130,242
매도	(150)	(90)
기타포괄손익으로 인식된 손익	12,822	301
기타	(13,828)	(13)
반기말	119,191	130,440

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	2,930	-	(2,176)

(\*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	30,994,646	28,327,697	58,641,288
감가상각비	135,790	5,914,663	6,092,718
무형자산상각비	391,409	191,232	637,341
영업이익	545,002	9,611,354	10,158,878

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당반기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	62,111,009	54,703,997	115,365,546
감가상각비	271,910	11,664,052	12,020,188
무형자산상각비	773,610	385,034	1,265,858
영업이익	1,740,202	17,564,175	19,310,709

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	23,556,329	22,790,654	45,768,634
감가상각비	133,198	4,447,066	4,620,852
무형자산상각비	344,859	260,713	634,671
영업이익	1,698,006	6,017,451	7,718,754

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전반기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	50,197,392	41,812,570	90,811,024
감가상각비	267,394	8,818,093	9,167,696
무형자산상각비	623,235	507,556	1,188,525
영업이익	3,792,637	8,363,172	12,164,230

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 당반기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o. (SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0	
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0	
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0	
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0	

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.



지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	DP 생산	100.0
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	DP 부품 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 · 반도체 · DP 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV · 모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	전자제품 생산, R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	DP 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 · FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	DP 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)도우인시스	DP 부품 생산	69.0
	지에프(주)	DP 부품 생산	100.0
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5	

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이㈜	116,235	-	374,350	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	18,774,290	-	99,204	-
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	25	-	15,071	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	4,503,346	-	15,027,178	59
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	113,310	5,135	4,869,112	1,608
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	43,916	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	22,720,846	-	244,899	-
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	871,795	-	4,008	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	3,073,882	6	8,133,380	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	28	-	1,625,294	1,430
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	3,062,570	-	2,585,609	-
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	10,266,046	-	47	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	836,339	-	-	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	633,873	-	10,335	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	354,262	2,775	2,858,565	355
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	845,212	-	48,687	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	916,293	-	1,536,606	-
	Samsung International, Inc. (SII)	185,607	216	4,529,493	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,651,208	-	1,719	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	416,273	-	1,214	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	233,426	141	1,513	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	154,618	-	-	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,991,533	-	3,567	-
세메스㈜	4,709	-	1,123,457	-	
기타	30,989,327	3,644	7,046,249	2,011	
	종속기업 계	103,715,053	11,917	50,183,473	5,463

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	128,256	-	792,366	172,753
	삼성전기㈜	47,427	-	486,789	-
	삼성SDI㈜	36,570	-	207,099	7,252
	㈜제일기획	29,923	-	441,732	-
	기타	248,805	-	400,521	2,404
	관계기업 및 공동기업 계	490,981	-	2,328,507	182,409
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	25,175	-	35,202	2,595,379
	기타	158,280	-	303,463	37,825
	그 밖의 특수관계자 계	183,455	-	338,665	2,633,204
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	875	-	12,995	1,030,441
	㈜에스원	2,117	-	208,373	11,040
	기타	69,002	-	76,038	66,110
	기타 계	71,994	-	297,406	1,107,591

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이㈜	93,887	-	373,297	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	14,165,928	-	78,995	-
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	73,849	169,934	3,144,758	4,591
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	2,718,976	686	9,115,155	68
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	24,655	-
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	769,981	-	4,135	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	1,602,809	202	6,771,463	264
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	-	-	8,397	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,649,323	-	206,912	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	29	1,183	1,953,255	6,681
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	12,609,499	-	576	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,890,549	2,609	1,469,262	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	516,398	-	-	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1,456,382	13	7,168	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	704,564	-	1,227,677	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	375,047	2,152	3,005,107	-
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	947,872	-	47,883	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	205,640	-	1,343	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	313,877	-	462	-
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,396,643	-	267	-
	세메스㈜	2,405	-	1,330,629	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,941,745	-	4,271	-
	Samsung International, Inc. (SII)	208,510	-	2,951,583	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	142,877	-	-	-
	기타	27,469,531	9,368	6,140,350	3,784
		종속기업 계	83,256,321	186,147	37,867,600

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	84,168	-	735,239	235,352
	삼성전기㈜	32,884	-	493,114	-
	삼성SDI㈜	31,561	269	160,971	15,243
	㈜제일기획	25,542	-	331,651	17
	기타	242,906	68	221,078	3,725
	관계기업 및 공동기업 계	417,061	337	1,942,053	254,337
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	43,131	-	24,796	1,775,628
	기타	175,971	-	290,587	47,119
	그 밖의 특수관계자 계	219,102	-	315,383	1,822,747
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	122	-	14,546	625,556
	㈜에스원	2,224	-	197,335	16,678
	기타	50,485	2,371	53,907	2,698
	기타 계	52,831	2,371	265,788	644,932

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.



다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이(주)	20,121	112,707
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	3,147,001	200,711
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	2,032	2,016
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	547,954	4,399,071
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	63,000	766,069
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	15,196
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	8,850,736	167,490
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	76,074	837
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	460,308	2,401,533
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	2,835	292,108
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,283,087	349,345
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	3,584,668	1,156
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	132,810	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	245,269	3,327
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	91,167	377,888
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	278,437	39,685
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	110,383	184,301
	Samsung International, Inc. (SII)	104,175	347,724
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	486,513	835
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	78,651	3,356
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	15,397	268
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	16,333	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	280,294	5,238
	세메스(주)	36,368	780,513
기타	8,955,312	1,661,297	
	종속기업 계(*3)	28,868,925	12,112,671

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(\*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스주	72,647	428,119
	삼성전기주	179	78,787
	삼성SDI(주)	117,453	40,575
	(주)제일기획	13	428,780
	기타	146,145	91,286
	관계기업 및 공동기업 계	336,437	1,067,547
그 밖의 특수관계자	삼성물산주	200,805	1,415,845
	기타	15,870	150,868
	그 밖의 특수관계자 계	216,675	1,566,713
기타(*3)	삼성엔지니어링주	747	278,939
	(주)에스원	675	31,608
	기타	2,771	71,448
	기타 계	4,193	381,995

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이(주)	23,791	119,401
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	4,708,011	143,310
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	59,110	726,945
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	734,283	4,049,400
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	7,541
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	414,781	2,301,949
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	138,307	77,540
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	316	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	7,320,890	123,555
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	1,736	2,164
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	4,645	277,682
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,099,927	463,652
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	4,337,520	217
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	161,441	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	258,490	1,040
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	201,717	19,595
	Samsung International, Inc. (SII)	32,564	259,847
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	132,508	334,943
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	167,225	430,960
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	372,716	32,145
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	58,694	99
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	629,882	1,715
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	45,171	3,351
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	223,603	2,272
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	18,025	-
	기타	9,220,424	2,284,643
	계	30,365,777	11,663,966

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(\*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	64,364	574,443
	삼성전기(주)	2,415	108,103
	삼성SDI(주)	113,845	54,076
	(주)제일기획	59	421,901
	기타	192,550	166,311
	관계기업 및 공동기업 계	373,233	1,324,834
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	195,355	1,640,615
	기타	15,839	125,470
	그 밖의 특수관계자 계	211,194	1,766,085
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	289	1,099,881
	(주)에스원	2,058	29,620
	기타	4,286	56,476
	기타 계	6,633	1,185,977

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당반기 및 전반기 중 종속기업에 58,364백만원 및 41,640백만원을 출자하였으며, 종속기업으로부터 출자원금 74,448백만원 및 310,538백만원을 회수하였습니다. 또한 당반기 중 관계기업 및 공동기업에 882,125백만원을 출자하였으며(전반기: 추가 출자 내역 없음), 당반기 및 전반기 중 회수한 출자원금 내역은 없습니다.

마. 회사가 당반기 및 전반기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 835,814백만원 및 2,683,584백만원입니다. 또한 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당반기 및 전반기 중 지급 결의한 배당금은 64,116백만원 및 203,623백만원입니다. 당반기말 및 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

바. 회사가 당반기 및 전반기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 20백만원 및 63,887백만원이며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 23,515백만원 및 27,641백만원입니다

사. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

아. 회사가 당반기 및 전반기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
단기급여	4,694	4,550
퇴직급여	289	443
기타 장기급여	3,873	4,046

## 6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2018~2020년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여 현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 주주환원 재원으로 활용하여, 매년 연간 총 9.6조원 수준의 정규 배당을 실시하고 잔여 재원 10.7조원을 특별 배당금 성격으로 2020년 기말 정규 배당에 더해 지급하였습니다. 또한, 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책을 2021년 1월에 발표하였습니다. 이에 따라 향후 3년의 사업연도에도 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하되 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 확대하고 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제54기 반기	제53기	제52기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		22,083,609	39,243,791	26,090,846
(별도)당기순이익(백만원)		15,843,251	30,970,954	15,615,018
(연결)주당순이익(원)		3,251	5,777	3,841
현금배당금총액(백만원)		4,904,308	9,809,438	20,338,075
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		22.2	25.0	78.0
현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.8	4.0
	우선주	1.3	2.0	4.2
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	722	1,444	2,994
	우선주	722	1,445	2,995
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은 제 54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제53기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제52기 1분기 2,404,605백만원(주당 354원), 2분기 2,404,605백만원(주당 354원), 3분기 2,404,605백만원(주당 354원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
35	41	2.8	2.7

- ※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.
- ※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
- ※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.1%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 3.2%입니다.
- ※ 최근 3년간은 2019년(제51기)부터 2021년(제53기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2017년(제49기)부터 2021년(제53기)까지 기간입니다. 2022년(제54기) 반기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다.(보통주 1.2%, 우선주 1.3%).

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.



[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	129,290	7.7%	Aa3 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	517,160	4.2%	Baa1 (Moody's), A- (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
Harman Finance International SCA (*1)	회사채	공모	2015.05.27	469,732	2.0%	Baa1 (Moody's), A- (S&P)	2022.05.27	상환	HSBC 등
㈜도우인시스	회사채	사모	2020.02.28	23,000	0.5%	-	2025.02.28	미상환	-
합 계	-	-	-	1,139,182	-	-	-	-	-

(\*1) 해당 사채는 2022년 3월 1일 전액 조기상환되었습니다.

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,465	6,465	523,625	6,465	6,465	6,462	-	555,947
	사모	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000
	합계	6,465	6,465	546,625	6,465	6,465	6,462	-	578,947

※ (주)도우인시스의 사모 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

### - 삼성전자(주)

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,462	-	38,787
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,462	-	38,787

### - Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	517,160	-	-	-	-	517,160
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	517,160	-	-	-	-	517,160

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

### - (주)도우인시스

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000
	합계	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000

※ (주)도우인시스의 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

### 마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

### 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	129,290	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2022년 반기 중 처분 자산은 전체의 0.1%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company,

N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

### 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

### 가. 재무제표 재작성 등 유의사항

#### (1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

#### (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

##### (SSL, SSM 법인 매각)

중속기업 삼성디스플레이(주)는 2020년 8월 28일자 이사회 결의에 의거 2021년 4월 1일자로 수익성 악화에 따른 LCD 사업 축소를 위하여 Samsung Suzhou Module Co.,Ltd. (SSM) 지분 100%와 Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) 지분 60%를 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)에게 매각하였습니다.

#### (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

##### (자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

##### (중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	1,328,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.08.20	2023.06.13	906,000	865,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	310,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2021.09.30	2022.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.12.17	2023.06.13	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.12.17	2023.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	807,000	807,000	102,275	127,907	230,182	28.6%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	130,000	130,000	33,334	65	33,399	30.4%
SECE	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.07.19	2022.12.16	73,722	72,811	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.05.31	877,579	824,834	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	141,000	342,000	-	129,096	129,096	8.3%
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	120,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.09.06	2023.06.13	712,400	833,400	-	-	-	
SERK	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.07.13	2023.06.13	290,000	140,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	15,600	15,600	10,947	△1,120	9,827	1.3%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	345,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	50,000	50,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자 율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.05.31	15,000	-	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	-	35,000	-	-	-	
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 등	지급보증	운영자금	2015.05.27	2022.03.01	396,304	-	396,304	△396,304	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2020.01.03	2024.11.22	671,908	633,352	571,121	△32,772	538,349	5.8%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무 소멸시	-	340,000	-	-	-	
합 계							9,333,513	9,184,997	1,113,981	△173,128	940,853	

※ 연결 기준입니다. Harman Finance International, SCA 건은 Harman International Industries, Inc.,

[△는 부(-)의 값임]

SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2021년 중 US\$266천의 수수료를 청구하였으며, 2022년 중 수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2021년 중 US\$2,529천 수수료를 청구하였으며, 2022년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결채무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구분	강조사항 등	핵심감사사항
제54기 반기	해당사항 없음	해당사항 없음
제53기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제52기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 2. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산 손상 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감



## 나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

### (1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제54기 반기말	매출채권	44,363,098	336,866	0.8%
	단기대여금	20,108	195	1.0%
	미수금	5,770,575	80,096	1.4%
	선급금	1,073,998	4,108	0.4%
	장기매출채권	326,188	-	0.0%
	장기미수금	565,704	289	0.1%
	장기선급금	1,969,345	8,628	0.4%
	장기대여금	236,770	1,182	0.5%
	합 계	54,325,786	431,364	0.8%
제53기말	매출채권	41,024,295	310,880	0.8%
	단기대여금	17,895	73	0.4%
	미수금	4,569,772	72,515	1.6%
	선급금	1,122,660	3,847	0.3%
	장기매출채권	225,739	-	0.0%
	장기미수금	1,002,404	290	0.0%
	장기선급금	1,770,999	9,003	0.5%
	장기대여금	199,577	917	0.5%
	합 계	49,933,341	397,525	0.8%
제52기말	매출채권	31,283,789	318,731	1.0%
	단기대여금	7,813	73	0.9%
	미수금	3,663,822	59,283	1.6%
	선급금	890,413	3,371	0.4%
	장기매출채권	85,575	-	0.0%
	장기미수금	401,582	204	0.1%
	장기선급금	1,397,698	5,972	0.4%
	장기대여금	113,944	1,309	1.1%
	합 계	37,844,636	388,943	1.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

**(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황**

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 반기	제53기	제52기
기초 대손충당금(손실충당금)	397,525	388,943	411,310
순대손처리액(① - ② + ③)	△4,358	25,926	65,575
① 대손처리액(상각채권액) 등	1,957	22,400	40,487
② 상각채권회수액	-	-	745
③ 기타증감액	△6,315	3,526	25,833
대손상각비 계상(환입)액	29,481	34,508	43,208
기말 대손충당금(손실충당금)	431,364	397,525	388,943

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

**(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침**

**(설정방침)**

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

**(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)**

- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	44,499,658	16,288	91,667	81,673	44,689,286
구성비율	99.6%	0.0%	0.2%	0.2%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

## 다. 재고자산 현황

### (1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제54기 반기말	제53기말	제52기말
DX 부문	제품 및 상품	10,702,194	8,894,766	7,088,063
	반제품 및 재공품	928,302	799,218	592,903
	원재료 및 저장품	14,224,013	11,384,887	7,862,310
	미착품	1,294,537	1,299,624	876,270
	소 계	27,149,046	22,378,495	16,419,546
DS 부문	제품 및 상품	5,392,571	2,490,097	1,719,095
	반제품 및 재공품	13,426,717	11,809,911	10,639,866
	원재료 및 저장품	2,640,929	2,118,424	1,674,081
	미착품	47,773	36,685	46,587
	소 계	21,507,990	16,455,117	14,079,629
SDC	제품 및 상품	582,271	294,777	134,963
	반제품 및 재공품	819,412	874,229	650,762
	원재료 및 저장품	1,023,047	810,325	603,779
	미착품	45,135	48,253	33,271
	소 계	2,469,865	2,027,584	1,422,775
Harman	제품 및 상품	683,686	533,008	502,117
	반제품 및 재공품	151,103	105,271	80,237
	원재료 및 저장품	986,618	736,109	337,386
	미착품	506,718	321,128	224,961
	소 계	2,328,125	1,695,516	1,144,701
총 계	제품 및 상품	17,574,112	12,280,579	9,387,886
	반제품 및 재공품	15,179,057	13,473,618	11,818,090
	원재료 및 저장품	17,841,277	14,184,841	9,790,766
	미착품	1,497,795	1,445,366	1,046,403
	소 계	52,092,241	41,384,404	32,043,145
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		11.6%	9.7%	8.5%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]		4.0회	4.5회	4.9회

※ 당사 연결 기준입니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

### (2) 재고자산의 실사내역 등

#### (실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

**(실사방법)**

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
    - ※ 반도체 및 DP 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
  - 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
  - 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
- ※ 당사는 2022년 5월 29일부터 6월 5일까지 상반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일 기준(5월말)으로 상반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기채화재고 등 내역)

채고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 채고자산의 재무상태표 가액을 결정하고 있으며, 2022년 반기말 현재 채고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	18,694,756	18,694,756	△1,120,644	17,574,112
반제품 및 재공품	16,005,040	16,005,040	△825,983	15,179,057
원재료 및 저장품	18,865,194	18,865,194	△1,023,917	17,841,277
미착품	1,497,795	1,497,795	-	1,497,795
합 계	55,062,785	55,062,785	△2,970,544	52,092,241

※ 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2022년 반기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

## 마. 공정가치평가 내역

### (1) 금융상품의 공정가치평가 방법

#### [금융자산]

##### (분류)

당사는 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 상각 후원가 측정 금융자산으로 금융자산을 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

##### (측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

## 1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

### ① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

### ② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

### ③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.



## 2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

### (손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

### (인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

## (금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

## [금융부채]

### (분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채  
과생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채  
이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약  
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
  - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
  - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정  
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
  - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
  - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가  
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

## (제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

### [파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

## (2) 범주별 금융상품 내역

### 1) 제54기 반기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,583,141	-	-	-	39,583,141
단기금융상품	84,428,822	-	-	-	84,428,822
단기상각후원가금융자산	1,253,196	-	-	-	1,253,196
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	55,505	-	55,505
매출채권	44,026,232	-	-	-	44,026,232
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,610,592	-	-	11,610,592
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,382,193	-	1,382,193
기타	9,949,776	-	334,806	78,075	10,362,657
계	179,241,167	11,610,592	1,772,504	78,075	192,702,338

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,560,726	-	-	12,560,726
단기차입금	3,404,897	-	9,584,291	12,989,188
미지급금	12,270,350	-	-	12,270,350
유동성장기부채	104,382	-	848,429	952,811
사채	553,783	-	-	553,783
장기차입금	8,500	-	2,934,708	2,943,208
장기미지급금	2,400,941	-	-	2,400,941
기타	10,981,962	343,437	19,869	11,345,268
계	42,285,541	343,437	13,387,297	56,016,275

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

2) 제53기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,031,415	-	-	-	39,031,415
단기금융상품	81,708,986	-	-	-	81,708,986
단기상각후원가금융자산	3,369,034	-	-	-	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	40,757	-	40,757
매출채권	40,713,415	-	-	-	40,713,415
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,965,839	-	-	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,525,344	-	1,525,344
기타	8,711,973	-	279,127	49,089	9,040,189
계	173,534,823	13,965,839	1,845,228	49,089	189,394,979

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,453,351	-	-	13,453,351
단기차입금	2,131,692	-	11,556,101	13,687,793
미지급금	14,126,970	-	-	14,126,970
유동성장기부채	518,065	-	811,903	1,329,968
사채	508,232	-	-	508,232
장기차입금	1,500	-	2,864,656	2,866,156
장기미지급금	2,562,158	-	-	2,562,158
기타	10,444,290	323,526	13,868	10,781,684
계	43,746,258	323,526	15,246,528	59,316,312

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 반기말		제53기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	39,583,141	(*1)	39,031,415	(*1)
단기금융상품	84,428,822	(*1)	81,708,986	(*1)
단기상각후원가금융자산	1,253,196	(*1)	3,369,034	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	55,505	55,505	40,757	40,757
매출채권	44,026,232	(*1)	40,713,415	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,610,592	11,610,592	13,965,839	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,382,193	1,382,193	1,525,344	1,525,344
기타(*2)	10,362,657	412,881	9,040,189	328,216
계	192,702,338		189,394,979	
금융부채:				
매입채무	12,560,726	(*1)	13,453,351	(*1)
단기차입금	12,989,188	(*1)	13,687,793	(*1)
미지급금	12,270,350	(*1)	14,126,970	(*1)
유동성장기부채	952,811	6,888	1,329,968	554,106
- 유동성장기차입금	946,457	(*1)(*3)	852,317	(*1)(*3)
- 유동성사채	6,354	6,888	477,651	554,106
사채	553,783	557,308	508,232	546,339
장기차입금	2,943,208	(*1)(*3)	2,866,156	(*1)(*3)
장기미지급금	2,400,941	(*1)	2,562,158	(*1)
기타(*2)	11,345,268	363,306	10,781,684	337,394
계	56,016,275		59,316,312	

(\*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 9,949,776백만원(전기말: 8,711,973백만원)

및 금융부채 10,981,962백만원(전기말: 10,444,290백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 반기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	36,796	18,709	55,505
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,039,307	-	2,571,285	11,610,592
당기손익-공정가치금융자산	341,326	-	1,040,867	1,382,193
기타	-	390,264	22,617	412,881
금융부채:				
유동성사채	-	6,888	-	6,888
사채	-	557,308	-	557,308
기타	-	357,868	5,438	363,306

(단위 : 백만원)

구 분	제53기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	35,620	5,137	40,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,608,708	-	2,357,131	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	478,401	-	1,046,943	1,525,344
기타	-	307,213	21,003	328,216
금융부채:				
유동성사채	-	554,106	-	554,106
사채	-	546,339	-	546,339
기타	-	331,956	5,438	337,394

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.



(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2022년 반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	28,458	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	15.2%~17.2%(16.2%)
㈜미코세라믹스	24,801	현금흐름할인법 등	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,477,845	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	371,371	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	10.7%~12.7%(11.7%)
기타:				
지분 풋옵션	22,617	이항모형	무위험 이자율	2.9%~3.0%, 2.5%
			가격 변동성	21.4%~31.4%(26.4%), 24.9%~34.9%(29.9%)

[△는 부(-)의 값임]

(수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제54기 반기	제53기 반기
기초	3,430,214	6,449,139
매입	108,009	919,311
매도	△160,465	△110,865
당기손익으로 인식된 손익	91,008	127,238
기타포괄손익으로 인식된 손익	183,532	1,194,086
기타	1,180	△5,692,367
반기말	3,653,478	2,886,542

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제54기 반기	제53기 반기
기초	5,438	9,248
기타	-	△2,176
반기말	5,438	7,072

[△는 부(-)의 값임]

(‘수준 3’으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2022년 반기말 현재 ‘수준 3’으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	161,590	-	△116,634
기타	2,912	-	△4,158	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(△1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

## V. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

#### 가. 회계감사인의 감사의견 등

안진회계법인은 제52기, 제53기 감사 및 제54기 반기 검토를 수행하였으며, 제52기, 제53기 감사결과 감사의견은 모두 적정이며, 제54기 반기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제54기 반기 (당반기)	안진회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제53기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제52기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 2. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산 손상 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제54기 반기 (당반기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	3,027	28,032
제53기 (전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	7,900	76,741	7,900	76,999
제52기 (전전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,400	85,721	8,400	86,128

(제54기 반기 일정)

구 분		일 정
제54기 1분기	사전검토	2022.03.07 ~ 2022.03.25
	본검토	2022.04.05 ~ 2022.05.13
제54기 2분기	사전검토	2022.06.06 ~ 2022.06.24
	본검토	2022.07.06 ~ 2022.08.12

※ 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

**[비감사용역 체결 현황]**

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제54기 반기 (당반기)	해당사항 없음	-	-	-	-
제53기 (전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2021.01~2021.12	394	안진회계법인
제52기 (전전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2020.01~2020.12	59	안진회계법인

**[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]**

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022.01.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사위원회: 위원 3명</li> <li>회사: 감사팀장</li> <li>감사인: 업무수행이사 외 1명</li> </ul>	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>핵심감사사항 등 중점 감사사항</li> <li>내부회계관리제도 감사 진행 상황</li> <li>기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항</li> </ul>
2	2022.04.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사위원회: 위원 3명</li> <li>회사: 감사팀장</li> <li>감사인: 업무수행이사 외 4명</li> </ul>	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 지배기구와의 커뮤니케이션 계획</li> <li>연간 회계감사 일정 계획</li> <li>분기 검토 경과보고</li> </ul>
3	2022.07.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사위원회: 위원 3명</li> <li>회사: 감사팀장</li> <li>감사인: 업무수행이사 외 4명</li> </ul>	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 감사계획 및 진행 상황</li> <li>핵심감사사항 선정계획</li> <li>내부회계관리제도 감사 진행 상황</li> <li>분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항</li> </ul>

**[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]**

해당사항 없습니다.

## 나. 회계감사인의 변경

제54기 반기말(당반기) 현재 당사의 종속기업은 233개이며, 당반기 중 종속기업의 회계감사인 신규 선임 및 변경 내역은 없습니다.

제53기말(전기) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 종속기업 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)와 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.(SETK-P)가 Deloitte를, 지에프(주)가 안진회계법인(Deloitte)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)이 Deloitte에서 E&Y로 감사인을 변경하였으며, 도우인시스(주)가 삼덕회계법인에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임 및 변경은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

또한, 당사는 제52기(전전기) 회계감사인을 삼일회계법인(PwC)에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다. 당사의 종속기업은 제52기말(전전기말, 2020년말) 현재 241개이며, 2020년 중 삼성디스플레이(주) 등 6개 국내종속기업은 삼일회계법인(PwC)에서 안진회계법인(Deloitte)으로 회계감사인을 변경하였으며, Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 24개 해외종속기업은 PwC에서 Deloitte로, Samsung Eletronica da AmazoniaLtda. (SEDA) 등 2개 해외종속기업은 KPMG에서 Deloitte로 회계감사인을 변경하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화를 위해 회계감사인을 변경하였습니다.

### [제52기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속법인명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자서비스(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자서비스씨에스(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자판매(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자로지텍(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
(주)미래로시스템	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	PwC	Deloitte
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	PwC	Deloitte
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	PwC	Deloitte
Samsung International, Inc. (SII)	PwC	Deloitte
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	PwC	Deloitte
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics GmbH (SEG)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	PwC	Deloitte



Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	PwC	Deloitte
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	PwC	Deloitte
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	PwC	Deloitte
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	PwC	Deloitte
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	PwC	Deloitte
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Turkey (SETK)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	PwC	Deloitte
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	KPMG	Deloitte
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	KPMG	Deloitte

또한, 제52기(전전기) 중 신규 인수한 종속기업 TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)는 PwC를 회계감사인으로 선임하였습니다. 회계감사인 신규 선임은 회사의 결정에 의한 것입니다.

## 2. 내부통제에 관한 사항

### [회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항
제54기 반기 (당반기)	안진회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제53기 (전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제52기 (전전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

#### 가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 5인(한중희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 4인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간의 견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김한조 사외이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사 와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 내 부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회(구, 거버넌스위원회) 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장·위원장	주요 역할
이사회	사내이사 5명, 사외이사 4명	한중희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성	김한조 (사외이사)	· 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회 를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 · 경영진의 업무집행 감독
경영위원회	사내이사 5명	한중희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배	한중희 (사내이사)	· 경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의·결의
감사위원회	사외이사 3명	김한조, 김선욱, 김종훈	김한조 (사외이사)	· 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
사외이사 후보추천위원회	사외이사 1명	김종훈	김종훈 (사외이사)	· 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱, 김한조, 김종훈	김선욱 (사외이사)	· 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고
보상위원회	사외이사 2명	김한조, 김준성	-	· 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보
지속가능경영위원회 (구, 거버넌스위원회)	사외이사 4명	김한조, 김선욱 김종훈, 김준성	김한조 (사외이사)	· 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

※ 2022년 1월 27일 김종훈 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와  
한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 1일 한중희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 4월 26일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

- ※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

(사외이사 및 그 변동 현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
9	4	3	-	2

- ※ 2022년 3월 16일 정기주주총회(2021년도)에서 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

## 나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명							
			사내이사							
			김기남 (출석률 :100%)	김현석 (출석률 :100%)	고동진 (출석률 :100%)	한종희 (출석률 :100%)	경계현 (출석률 :100%)	노태문 (출석률 :100%)	박학규 (출석률 :100%)	이정배 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부							
'22.01.27 (1차)	1. 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 ※ 보고사항 ① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
'22.02.15 (2차)	1. 대표이사 선정의 건 2. 제53기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 제1호: 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호 사외이사 김한조 선임의 건 · 제2-1-2호 사외이사 한화진 선임의 건 · 제2-1-3호 사외이사 김준성 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호 사내이사 경계현 선임의 건 · 제2-2-2호 사내이사 노태문 선임의 건 · 제2-2-3호 사내이사 박학규 선임의 건 · 제2-2-4호 사내이사 이정배 선임의 건 - 제2-3호 감사위원회 위원 선임의 건 · 제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 · 제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 □ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 4. 내부회계관리규정 개정의 건 5. 2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 6. 학교법인 흥남삼성학원 기부금 출연의 건 7. 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
		가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항	해당 사항	해당 사항	해당 사항
		가결	-	찬성	찬성	찬성	없음	없음	없음	없음
		가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(신규 선임)	(신규 선임)	(신규 선임)	(신규 선임)
		가결	찬성	찬성	찬성	찬성				
'22.03.16 (3차)	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선정의 건 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수 책정의 건 5. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		가결	해당	해당	해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		가결	사항	사항	사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		가결	없음	없음	없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'22.04.28 (4차)	1. 2022년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 2. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	가결	(사임)	(사임)	(사임)					
		가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사원 단체보험 가입의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4. 사회공헌 기부금 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5. 삼성SDI와의 임대차계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7. 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명							
			사외이사							
			박재완 (출석률 :67%)	김선욱 (출석률 :100%)	박병국 (출석률 :100%)	김종훈 (출석률 :100%)	안규리 (출석률 :67%)	김한조 (출석률 :100%)	한화진 (출석률 :100%)	김준성 (출석률 :100%)
			찬 반 여부							
'22.01.27 (1차)	1. 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 * 보고사항 ① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성		
'22.02.15 (2차)	1. 대표이사 선정의 건 2. 제53기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 제1호: 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호 사외이사 김한조 선임의 건 · 제2-1-2호 사외이사 한화진 선임의 건 · 제2-1-3호 사외이사 김종성 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호 사내이사 경계현 선임의 건 · 제2-2-2호 사내이사 노태문 선임의 건 · 제2-2-3호 사내이사 박학규 선임의 건 · 제2-2-4호 사내이사 이정배 선임의 건 - 제2-3호 감사위원회 위원 선임의 건 · 제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 · 제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 □ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 4. 내부회계관리규정 개정의 건 5. 2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 6. 학교법인 충남상성학원 기부금 출연의 건 7. 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
'22.03.16 (3차)	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선정의 건 3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수 책정의 건 5. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건	가결 가결 가결 가결 가결	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

'22.04.28 (4차)	1. 2022년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성		찬성		찬성
	2. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	가결	해당	찬성	찬성	찬성	해당	찬성	해당	찬성
	3. 사원 단체보험 가입의 건	가결	사항	찬성	찬성	찬성	사항	찬성	사항	찬성
	4. 사회공헌 기부금 출연의 건	가결	없음	찬성	찬성	찬성	없음	찬성	없음	찬성
	5. 삼성SDI와의 임대차계약 체결의 건	가결	(임기	찬성	찬성	찬성	(임기	찬성	없음	찬성
	6. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결	만료)	찬성	찬성	찬성	만료)	찬성	(사임)	찬성
	7. 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결		찬성	찬성	찬성		찬성		찬성

- ※ 2022년 2차 이사회 안건 중 '⑥ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사인 김기남 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.



## 다. 이사회내의 위원회

### (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 5명	한종희(위원장), 경계현, 노태문, 박학규, 이정배	하단 기재내용 참조	· 한종희 사내이사 위원장 선임('22.04.01)
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱(위원장), 김한조, 김종훈	하단 기재내용 참조	· 김선욱 사외이사 위원장 선임('21.04.27)
보상위원회	사외이사 2명	김한조, 김준성	하단 기재내용 참조	-
지속가능경영위원회 (구, 거버넌스위원회)	사외이사 4명	김한조(위원장), 김선욱, 김종훈, 김준성	하단 기재내용 참조	· 김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28)

- ※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
- ※ 2021년 7월 29일 이사회에서 거버넌스위원회가 지속가능경영위원회로 개편되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 1일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

## (경영위원회)

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.  
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

### 1. 경영일반에 관한 사항

- 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 2) 주요 경영전략
- 3) 사업계획·사업구조 조정 추진
- 4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
- 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
- 7) 기타 주요 경영현황
- 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 9) 지배인의 선임 또는 해임
- 10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
- 14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지
- 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

## 2. 재무 등에 관한 사항

- 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
- 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
- 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
  - 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
  - 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외
- 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
- 5) 내부거래의 승인  
내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
- 6) 사채발행
- 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
- 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

## 3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

### (내부거래위원회)

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
  - 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
    - ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
  - 내부거래 직권조사 명령권
  - 내부거래 시정조치 건의권

### (보상위원회)

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
  - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  - 등기이사에 대한 보상체계
  - 기타 이사회에서 위임한 사항

## (지속가능경영위원회)

- 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
  - 회사의 지속가능경영과 관련된 사항
    - 1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책
    - 2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고
    - 3) 지속가능경영보고서 발간 계획
  - 주주가치 제고와 관련된 사항
    - 1) 주주환원 정책 사전 심의
    - 2) 주주권익 관련 주요 사안 보고
  - 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항
  - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
  - 기타 이사회에서 위임한 사항

## (2) 이사회내의 위원회 활동내역

### (경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명									
				김기남 (출석률: 100%)	김현석 (출석률: 100%)	고동진 (출석률: 100%)	한중희 (출석률: 100%)	경계현 (출석률: 100%)	노태문 (출석률: 100%)	박학규 (출석률: 100%)	이경배 (출석률: 100%)		
				찬 반 여부									
경영위원회	'22.01.27	1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성						
		2. 메모리(평택) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성						
		3. 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당	해당	해당	해당		
		4. 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사항	사항	사항	사항		
	'22.02.25	1. 메모리(평택 3라인) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	없음	없음	없음	없음		
		2. 메모리(평택 4라인) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(신규	(신규	(신규	(신규		
		3. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임)	선임)	선임)	선임)		
		4. DS 부문 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성						
		5. 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성						
	'22.04.01	1. 경영위원회 위원장 선임의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 메모리('23년) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 메모리('25년) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. Foundry(평택) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. Foundry 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		7. TSP 총괄(천안) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		8. TSP 총괄 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		9. 임대차 계약 체결의 건	가결	해당	해당	해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		10. 반도체연구소(기흥) 투자의 건	가결	사항	사항	사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		11. 반도체연구소 투자의 건	가결	없음	없음	없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'22.04.05	1. 메모리 투자의 건	가결	(사임)	(사임)	(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
'22.04.28	1. 반도체연구소 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	2. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	3. 책임보험 가입의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
'22.05.27	1. Foundry(평택) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	2. Foundry(평택) 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
'22.06.30	1. 메모리 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	2. 천안단지 투자의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	3. 협력 계약 체결의 건	가결				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		

(내부거래위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명			
				김선욱 (출석률: 100%)	박재완 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부			
내부거래 위원회	'22.01.25	1. 2021년 4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-	해당
	'22.02.11	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-	사항 없음
	'22.03.11	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건	-	-	-	-	(신규 선임)
	'22.04.26	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건 ② 사원단체보험 가입의 건 ③ 사회공헌 기부금 출연의 건 ④ 삼성SDI와의 임대차 계약 체결의 건 2. 2022년 1분기 내부거래 현황 보고	- - - - -	- - - - -	해당 사항 없음 (임기 만료)	- - - - -	- - - - -

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명				
				박병국 (출석률: 100%)	박재완 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: -)	김준성 (출석률: -)
				찬 반 여 부				
보상 위원회	'22.02.11	1. 2022년 사내이사 개별 고정연봉 심의의 건 2. 2022년 이사보수 한도 심의의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)

(지속가능경영위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명								
				박재완 (출석률 :100%)	김선욱 (출석률 :100%)	박병국 (출석률 :100%)	김중훈 (출석률 :100%)	안규리 (출석률 :100%)	김한조 (출석률 :100%)	한화진 (출석률:- )	김준성 (출석률 :100%)	
				찬 반 여부								
지속가능 경영위원회 (구,거버넌스 위원회)	'22.02.11	1. 사회공헌활동(CSR) 2.0 보고의 건 2. UN Global Compact 가입 진행 현황 보고의 건 3. IR 동향 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	해당 사항	해당 사항
			-	-	-	-	-	-	-	-	없음 (신규 선임)	없음 (신규 선임)
	'22.04.28	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건 2. IR 동향 보고의 건 3. 투자자 ESG 미팅 결과 보고의 건 4. 지속가능경영보고서 발간 계획 보고의 건 5. 전자 지속가능경영 추진 과제 보고의 건 6. 기업평판 조사 결과 보고의 건	가결	해당	찬성	찬성	찬성	해당	찬성	찬성	해당	찬성
			-	사항	-	-	-	사항	-	-	해당	-
			-	없음	-	-	-	없음	-	-	사항	-
			-	(임기 만료)	-	-	-	(임기 만료)	-	-	없음	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	(사임)	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 7월 29일 이사회에서 거버넌스위원회가 지속가능경영위원회로 개편되었습니다.



## 라. 이사의 독립성

### (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, EHS 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령·정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

각 이사의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

직명	성명	임기 (연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관 계
사내이사 (대표이사)	한종희	'20.03~'23.03 (해당사항 없음)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 TV 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	경계현	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	DS부문장으로서, DRAM, Flash, Solution 메모리 3대 제품을 모두 섭렵한 기술력을 보유하고 있으며, 소통과 공감을 통해 조직의 근본적인 체질을 개선하고 세계 반도체시장 1위 지위를 굳건히 강화 하는데 가장 적임자로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	노태문	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 갤럭시 S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출 하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화 하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	MX사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	박학규	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	주요 사업부들의 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고, 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌었음. 현재는 DX부문 경영 지원실장으로서, 사업 성과창출을 위해 핵심 스텝 기 능과 진단 및 감사역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	이정배	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년 연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도 체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	메모리사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사외이사	김한조	'19.03~'25.03 (1회)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생·나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김선욱	'18.03~'24.03 (1회)	법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단 과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김종훈	'18.03~'24.03 (1회)	IT 분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김준성	'22.03~'25.03 (해당사항 없음 )	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네트워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 「상법」 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며,

동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고,

김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

## (2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2022년 6월 30일) 현재 위원회는 사외이사 1인(김종훈)으로 구성되어 있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명			
				김종훈 (출석률:100%)	박병국 (출석률:100%)	안규리 (출석률:100%)	한화진 (출석률:-)
				찬반여부			
사외이사 후보추천위원회	'22.01.27	1. 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당
		2. 사외이사 후보추천일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사항
	'22.02.11	1. 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	없음 (신규 선임)

- ※ 2022년 1월 27일 김종훈 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 한화진 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2021년 사업보고서 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 3인(박병국, 김종훈, 안규리)으로 구성되어 있었으나, 공시대상기간 중 한화진 사외이사가 사임하고, 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다. 회사는 향후 후속조치를 통하여 사외이사 후보추천위원회 구성을 보완할 예정입니다.

## (3) 사외이사의 전문성

### 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역
인사팀	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 부사장 1명(31년 7개월 / 3년 6개월),</li> <li>• 부사장 1명(28년 4개월 / 2년 5개월),</li> <li>• 직원(Principal Professional) 1명 (19년 5개월 / 2년 11개월),</li> <li>• 직원(Senior Professional) 2명 (평균 13년 2개월 / 평균 3년 6개월)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원</li> <li>• 사외이사 교육 및 직무수행 지원</li> <li>• 이사 후보에 대한 데이터베이스 구축</li> <li>• 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공</li> <li>• 회의 진행을 위한 실무 지원</li> <li>• 이사회 및 위원회의 회의내용 기록</li> </ul>

## 2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

### ① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.28	MX사업부	김한조, 김선욱, 박병국, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사

### ② 신입 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.27	경영지원실	김준성	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

※ 교육 참석 대상은 신입 사외이사입니다.

### ③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2020.11.27	기획팀	박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조	해당사항 없음	· 포스트 코로나 시대 환경변화와 중장기 전략

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2022년 반기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
김한조	예	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하나금융나눔재단 이사장('22~현재)</li> <li>· 하나금융공익재단 이사장('19~'21)</li> <li>· 하나금융나눔재단 이사장('15~'19)</li> <li>· ㈜하나금융지주 부회장('15~'16)</li> <li>· ㈜한국외환은행 은행장('14~'15)</li> <li>· 외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)</li> </ul>	예	4호 유형 (금융기관·정부· 증권유관기관 등 경력자)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ㈜하나금융지주 부회장('15~'16)</li> <li>· ㈜한국외환은행 은행장('14~'15)</li> <li>· 외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)</li> <li>· ㈜한국외환은행 - 기업사업그룹장('12~'13) - 지점장('99~'02, '04~'05)</li> </ul>
김선욱	예	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이화여대 법학전문대학원 명예교수('18~현재)</li> <li>· 이화여대 법학과(법학전문대학원) 교수('95~'18)</li> <li>· 이화여대 총장('10~'14)</li> <li>· 법제처 처장('05~'07)</li> </ul>	-	-	-
김종훈	예	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kiswe Mobile 공동 창업자 및 회장('13~현재)</li> <li>· Alcatel-Lucent 최고전략책임자(CSO)('11~'13)</li> <li>· Alcatel-Lucent Bell 연구소 사장('05~'13)</li> <li>· University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수('02~'13)</li> <li>· Lucent Technologies 사장('98~'01)</li> <li>· Yurie Systems 창업자, 회장 및 CEO('92~'98)</li> </ul>	-	-	-

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및 「상법 시행령」 제37조 제2항에 따른 회계·재무전문가 유형입니다.

· 4호 유형: 금융기관·정부·증권유관기관 등에서 회계·재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

※ 공시대상 기간 중 박재완 사외이사가 퇴임하고 2022년 3월 16일 김종훈 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

## 나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(김한조 위원)와 법률전문가(김선욱 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등
3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김한조 위원)	「상법」 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김한조 위원)	
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」 제542조의11 제3항

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

성명	임기 (연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 경력 현황
김한조	'19.03~'25.03 (1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김선욱	'18.03~'24.03 (1회)	법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김중훈	'18.03~'24.03 (1회)	글로벌 경영인으로서 여러 기업을 투명하고 공정하게 운영한 경험을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	Kiswe Mobile 회장 (13년~현재)

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 「상법」 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사회부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

#### 다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명			
				박재완 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)
				찬 반 여부			
감사 위원회	'22.01.25	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	해당 사항 없음 (신규 선임)
		2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	
		3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-	
		4. 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-	
		5. 2021년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-	
		6. 2021년 4분기 대외후원금 현황 보고	-	-	-	-	
		7. 2021년 감사실적 보고	-	-	-	-	
	'22.02.11	1. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 심의	-	-	-	-	
		2. 내부회계관리규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	
		3. 2021년 내부감시장치 가동현황 보고	-	-	-	-	
	'22.04.26	1. 감사위원회 위원장 선임	가결		찬성	찬성	찬성
		2. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-		-	-	-
		3. 2021년 외부감사 이행 평가 보고	-	해당	-	-	-
		4. 지정 외부감사인과의 감사계약조건 결정	가결	사항	찬성	찬성	찬성
		5. 2022년 1분기 보고서 보고	-	없음	-	-	-
6. 2022년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고		-	(임기	-	-	-	
7. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고		-	만료)	-	-	-	
8. 2022년 1분기 대외후원금 현황 보고		-		-	-	-	
9. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고		-		-	-	-	



## 라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

## 마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2020.07.28	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	• 내부회계관리제도
2021.07.27	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	• 내부회계관리제도
2022.05.25	재경팀, 외부전문가	김종훈	해당사항 없음	• 입문교육

## 바. 감사위원회 지원조직 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사팀	4	부사장 1명(2년 6개월), 직원(Principal Professional) 1명(4년 6개월), 직원(Senior Professional) 2명(평균 1년 11개월)	· 감사위원회 지원
내부회계 평가지원그룹	3	상무 1명(3년 6개월), 변호사 1명(1년 3개월) 직원(Senior Professional) 1명(1년 5개월)	· 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

## 사. 준법지원인에 관한 사항

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

구 분	내 용	
1. 인적사항 및 주요경력	성명	안덕호
	출생연월	1968.07
	성별	남
	담당업무	삼성전자(주) Compliance팀장('20.01~현재)
	주요경력	'97.~'05. : 서울지방법원, 서울행정법원 등 판사 '05.03. : 삼성구조조정본부 법무실 상무대우 '06.03. : 삼성전자(주) 법무실 상무대우 '10.12. : 삼성전자(주) 준법경영실 전무대우 '17.04. : 삼성전자(주) DS부문 법무지원팀장 전무대우 '17.11. : 삼성전자(주) DS부문 법무지원팀장 부사장대우 '20.01. : 삼성전자(주) Compliance팀장 부사장대우
	학력	서울대 법대(학사)
2. 이사회 결의일	2020.01.30	
3. 결격요건	해당사항 없음	
4. 기타	해당사항 없음	

※ 준법지원인은 관련 법령 「상법」 제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을 충족하고 있습니다.

## 아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기·비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

점검일시	점검 내용	점검 분야	점검 및 처리 결과	
'22.1분기	'22.01.	비밀정보 관리현황 점검	영업비밀	
	'22.03.	국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'22.2분기	'22.06.	'22.04.	국내 개발조직 준법 점검	영업비밀, 기술유용 등
		해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	
		해외 생산법인 준법 점검	기술유용, 반부패 등	
		해외 판매법인 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	

※ 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

※ 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

## 자. 준법지원인 지원 조직 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
Compliance팀 등	74	부사장 1명 (7개월) 상무 3명 (평균 5년 9개월) 직원(Principal Professional/Engineer) 17명(평균 8년 1개월), 변호사 11명(평균 4년 3개월), 직원(Senior Professional) 36명(평균 5년), 직원(Professional) 6명(평균 1년 5개월)	· 준법지원인 주요 활동 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

#### 가. 투표제도

당사는 2022년 반기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2022년 3월 16일 제53기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제53기('21년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

## 나. 의결권 현황

2022년 반기말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(597,470,209주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,372,312,341주입니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	5,969,782,550	-
	우선주	822,886,700	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	822,886,700	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	596,959,200	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험주) 508,157,148주, 삼성화재해상보험주 88,802,052주)
	보통주	511,009	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험주) 특별계정 일부)
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	5,372,312,341	-
	우선주	-	-

※ 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(596,959,200주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

## 다. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

주총일자	안 건	결의내용
제53기 정기주주총회 (2022.03.16)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건</li> <li>2. 이사 선임의 건               <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1호: 사외이사 선임의 건                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건</li> <li>2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건</li> <li>2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건</li> </ol> </li> <li>2-2호: 사내이사 선임의 건                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건</li> <li>2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건</li> <li>2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건</li> <li>2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건</li> </ol> </li> <li>2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건</li> <li>2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. 이사 보수한도 승인의 건</li> </ol>	<p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p>
제52기 정기주주총회 (2021.03.17)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제52기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건</li> <li>2. 이사 선임의 건               <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1호: 사외이사 선임의 건                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1-1호: 사외이사 박병국 선임의 건</li> <li>2-1-2호: 사외이사 김종훈 선임의 건</li> </ol> </li> <li>2-2호: 사내이사 선임의 건                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2-2-1호: 사내이사 김기남 선임의 건</li> <li>2-2-2호: 사내이사 김현석 선임의 건</li> <li>2-2-3호: 사내이사 고동진 선임의 건</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건</li> <li>4. 이사 보수한도 승인의 건</li> </ol>	<p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p>
제51기 정기주주총회 (2020.03.18)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제51기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건</li> <li>2. 사내이사 선임의 건               <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1호: 사내이사 한종희 선임의 건</li> <li>2-2호: 사내이사 최윤호 선임의 건</li> </ol> </li> <li>3. 이사 보수한도 승인의 건</li> </ol>	<p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p>

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.

## VII. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험(주)(특별계정)	최대주주 본인	보통주	13,860,804	0.23	13,332,034	0.22	장내매매
삼성생명보험(주)(특별계정)	최대주주 본인	우선주	548,463	0.07	538,029	0.07	장내매매
삼성물산(주)	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험(주)	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	137,244,666	2.30	117,302,806	1.96	시간외매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	최대주주의 특수관계인	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이서현	최대주주의 특수관계인	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한종희	계열회사 임원	보통주	5,000	0.00	15,000	0.00	장내매매
경계현	계열회사 임원	보통주	0	0.00	18,050	0.00	신규 선임
노태문	계열회사 임원	보통주	0	0.00	13,000	0.00	신규 선임
박학규	계열회사 임원	보통주	0	0.00	18,000	0.00	신규 선임
이정배	계열회사 임원	보통주	0	0.00	15,000	0.00	신규 선임
김한조	계열회사 임원	보통주	2,175	0.00	3,655	0.00	장내매매
김기남	계열회사 임원	보통주	210,000	0.00	0	0.00	이사 사임
김현석	계열회사 임원	보통주	99,750	0.00	0	0.00	이사 사임
고동진	계열회사 임원	보통주	75,000	0.00	0	0.00	이사 사임
안규리	계열회사 임원	보통주	3,800	0.00	0	0.00	이사 임기만료
박병국	계열회사 임원	보통주	1,000	0.00	0	0.00	이사 퇴임
계		보통주	1,261,846,679	21.14	1,241,062,029	20.79	-
		우선주	1,212,313	0.15	1,201,879	0.15	-

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.)

※ 2022년 6월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

## 2. 최대주주 관련 사항

### 가. 최대주주의 개요

#### (1) 최대주주(삼성생명보험주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성생명보험주 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

#### 4) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위 : 명, %)

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험주	121,283	전영목	0.00	-	-	삼성물산(주)	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 출자자수는 2021년 12월 31일 보통주 기준이며, 대표이사·업무집행자·최대주주의 성명 및 지분율은

2022년 6월 30일 기준입니다.

#### 5) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2020.03.19	현성철	0.00	-	-	-	-
2020.03.19	전영목	-	-	-	-	-
2020.03.23	전영목	0.00	-	-	-	-
2020.03.24	전영목	0.00	-	-	-	-
2021.03.16	전영목	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이건희	-
2021.04.29	-	-	-	-	삼성물산(주)	19.34

※ 2020년 3월 19일 현성철 대표이사가 사임하고, 전영목 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 최대주주(2020년 10월 25일 별세)가 소유하던 주식에 대한 상속으로 인하여 최대주주가 삼성물산(주)으로 변경되었습니다.



(2) 최대주주(삼성생명보험주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험주
자산총계	314,998,662
부채총계	291,121,526
자본총계	23,877,136
매출액	19,264,089
영업이익	594,180
당기순이익	501,162

※ 재무현황은 2022년 6월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

### (3) 최대주주(삼성생명보험주)의 사업현황 등

삼성생명보험주(주)은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

또한, 주요 종속기업인 삼성카드(주)는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성생명보험주(주)의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

### 나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

## 다. 최대주주의 최대주주의 개요

### (1) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성물산주 (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산주	188,087	고정석	0.00	-	-	이재용	18.13
		오세철	0.00	-	-	-	-
		한승환	0.00	-	-	-	-

※ 2022년 6월 30일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.19	이영호	-	-	-	-	-
2021.03.19	정금용	-	-	-	-	-
2021.03.19	오세철	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	한승환	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	고정석	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이재용	18.13

※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며,

고정석 대표이사가 재선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(17.48%→18.13%)되었습니다.

## (2) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산주
자산총계	57,322,058
부채총계	26,505,556
자본총계	30,816,502
매출액	21,258,300
영업이익	1,097,530
당기순이익	1,281,959

※ 재무현황은 2022년 6월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

## (3) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 사업현황 등

삼성물산주는 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

↳ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성물산주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

### 3. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고
2021.04.29	삼성생명보험(주)	1,263,050,053	21.16	변동전 최대주주의 피상속	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며, 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

### 4. 주식의 분포 현황

#### 가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	삼성생명보험(주)	521,489,182	8.74	특별계정 포함
	국민연금공단	466,643,796	7.82	-
	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03	2019년 1월 28일 기준
	삼성물산(주)	298,818,100	5.01	-
우리사주조합		-	-	-

※ 5% 이상 주주는 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.

※ BlackRock Fund Advisors의 소유주식수 및 지분율은 2019년 2월 7일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

#### 나. 소액주주 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주)

구분	주주			소유주식			비고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	5,922,693	5,922,810	99.99	3,959,902,598	5,969,782,550	66.33	-

※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

## 5. 주가 및 주식거래실적

### 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류		'22.01월	'22.02월	'22.03월	'22.04월	'22.05월	'22.06월	
보통주	주가	최 고	78,900	75,400	72,900	69,300	68,100	66,800
		최 저	71,300	71,500	69,500	64,800	64,900	57,000
		평 균	76,540	73,689	70,410	67,395	66,852	61,125
	거래량	최고(일)	25,470,640	17,781,783	37,943,357	26,190,390	24,365,002	34,111,306
		최저(일)	8,785,122	9,320,365	9,040,993	8,467,248	11,405,555	8,222,883
		월 간	280,187,100	233,201,135	307,432,780	309,880,731	310,129,252	428,473,209
우선주	주가	최 고	72,600	69,000	66,100	63,000	60,900	60,200
		최 저	65,600	65,300	63,000	58,000	57,500	52,000
		평 균	70,220	67,178	63,924	60,743	59,605	56,015
	거래량	최고(일)	2,335,000	1,872,958	2,673,569	2,109,901	2,118,486	2,545,751
		최저(일)	494,813	474,100	695,913	536,606	733,194	418,424
		월 간	23,118,454	17,930,656	27,615,464	26,485,950	23,400,057	25,677,153

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

## 나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)]

(단위 : US\$, 원, DR)

종류			'22.01월	'22.02월	'22.03월	'22.04월	'22.05월	'22.06월	
보통주	주가	최고	US\$	1,657.00	1,584.00	1,499.50	1,427.00	1,355.00	1,330.00
			₩환산	1,980,446	1,894,464	1,803,449	1,735,375	1,703,100	1,656,914
		최저	US\$	1,499.50	1,474.50	1,397.00	1,275.00	1,262.00	1,091.00
			₩환산	1,802,999	1,757,751	1,721,663	1,610,453	1,611,574	1,410,554
		평균	US\$	1,591.15	1,539.93	1,437.67	1,356.82	1,312.71	1,183.00
			₩환산	1,899,869	1,846,299	1,753,698	1,670,154	1,667,613	1,507,580
	거래량	최고(일)		95,468	54,976	36,849	23,557	27,528	32,345
		최저(일)		5,128	8,464	7,828	5,781	6,296	7,382
		월 간		587,147	420,313	459,185	269,043	290,837	298,591

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

(단위 : US\$, 원, DR)

종류			'22.01월	'22.02월	'22.03월	'22.04월	'22.05월	'22.06월	
우선주	주가	최고	US\$	1,532.00	1,440.00	1,390.00	1,294.00	1,226.00	1,200.00
			₩환산	1,831,046	1,722,240	1,671,753	1,573,633	1,540,959	1,494,960
		최저	US\$	1,372.00	1,344.00	1,250.00	1,136.00	1,118.00	1,004.00
			₩환산	1,649,693	1,602,182	1,548,250	1,418,069	1,427,686	1,300,883
		평균	US\$	1,461.90	1,402.10	1,308.00	1,228.11	1,176.00	1,087.70
			₩환산	1,745,542	1,681,053	1,595,519	1,511,720	1,493,937	1,386,132
	거래량	최고(일)		7,183	6,183	7,596	6,427	1,561	3,502
		최저(일)		363	428	276	543	377	375
		월 간		38,513	28,137	30,489	36,208	19,420	24,625

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.



## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

#### 가. 등기임원

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 주)

성명	성 별	출생년월	직위	등기 임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주 와의 관계	재직기 간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
한중희	남	1962.03	부회장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DX 부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부부장	15,000	-	계열회사 임원	28개월	2023.03.17
경계현	남	1963.03	사장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DS 부문 경영전반 총괄)	· 서울대 제어계측공학 박사 · 삼성전자 DS부부장	18,050	-	계열회사 임원	4개월	2025.03.15
노태문	남	1968.09	사장	사내 이사	상근	· MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	13,000	-	계열회사 임원	4개월	2025.03.15
박학규	남	1964.11	사장	사내 이사	상근	· CFO	· KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장	18,000	-	계열회사 임원	4개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	사장	사내 이사	상근	· 메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	15,000	-	계열회사 임원	4개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외 이사	비상근	· 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융그룹네트웍 이사장	3,655	-	계열회사 임원	40개월	2025.03.19
김선옥	여	1952.12	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수	-	-	계열회사 임원	52개월	2024.03.22
김종훈	남	1960.08	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 사외이사 후보추천위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Maryland대 신회성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장	-	-	계열회사 임원	52개월	2024.03.22
김준성	남	1967.10	이사	사외 이사	비상근	· 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르투자청 토달리터그롭 이사	-	-	계열회사 임원	4개월	2025.03.15

\* 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

\* 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

\* 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한중희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

\* 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

\* 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

\* 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

\* 2022년 3월 19일 박재원, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

\* 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

- ※ 2022년 4월 26일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김선욱 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 7월 28일 이사회를 통해 김중훈 사외이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

## 나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장	2013년~현재

## 다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
김기남	남	1958.04	회장	상근	종합기술원 회장	DS부문장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이재용	남	1968.06	부회장	비상근	부회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주 의 특수관 계인	
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
강인엽	남	1963.07	사장	상근	미주담당 사장	System LSI사업부장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대	계열회사 임원	22
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
승현준	남	1966.06	사장	상근	Samsung Research연구소장	Samsung Research 담당임원	Harvard Univ.(박사)	계열회사 임원	49
이원진	남	1967.08	사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
이인용	남	1957.03	사장	상근	Corporate Relations 담당	사회공헌업무총괄	서울대	계열회사 임원	
이재승	남	1960.07	사장	상근	생활가전사업부장	생활가전 개발팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	
임영빈	남	1957.08	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성생명 상근고문	Univ. of British Columbia(석사)	계열회사 임원	19
전경훈	남	1962.12	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 개발팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
정은승	남	1960.08	사장	상근	DS부문 CTO	Foundry사업부장	Univ. of Texas, Arlington(박사)	계열회사 임원	
진교영	남	1962.08	사장	상근	종합기술원장	메모리사업부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
황특규	남	1959.06	사장	상근	중국전략협력실장	기흥/화성단지장	Boston Univ.(석사)	계열회사 임원	

강문수	남	1969.08	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	36
강봉구	남	1962.02	부사장	상근	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	홍익대	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	Samsung Research Robot센터장	무선 개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	39
강현석	남	1963.08	부사장	상근	서남아총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대	계열회사 임원	
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	58
고관협	남	1966.01	부사장	상근	반도체연구소 차세대연구실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Stanford Univ., Research Fellow	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	28
고승환	남	1962.09	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	인하대	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형중	남	1970.11	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽성웅	남	1965.05	부사장	상근	System LSI 개발실 담당임원	Maxim, Integrated Executive Director	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	43
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실장	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
권대훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권환준	남	1971.09	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Qualcomm, Sr. Director	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	4
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경준	남	1965.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	무선 Global CS팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
김경진	남	1963.11	부사장	상근	DX부문 CSO, Global EHS센터장	영상디스플레이 Global제조팀장	숭실대	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 법무팀장	법무실 담당임원	서울대	계열회사 임원	32
김경훈	남	1974.01	부사장	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	중앙대	계열회사 임원	

김경희	여	1969.07	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Moda Operandi, CMO	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	46
김기원	남	1963.04	부사장	상근	상생협력센터 대외협력팀장	상생협력센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1964.08	부사장	상근	CIS총괄	SETK법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김도현	남	1975.03	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	DS부문 법무지원팀 담당임원	서울대	계열회사 임원	
김도형	남	1964.10	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	삼성물산 법무팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	30
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대	계열회사 임원	7
김동욱	남	1963.09	부사장	상근	생산기술연구소장	글로벌기술센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI SOC개발실장	System LSI SOC개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김사필	남	1965.04	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	경찰대	계열회사 임원	
김선식	남	1964.06	부사장	상근	DS부문 담당임원	메모리 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 온라인영업팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	동국대	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연성	남	1966.05	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략지원담당	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	

김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	12
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 부팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김우준	남	1968.05	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 전략마케팅 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	부사장	상근	Global Public Affairs팀장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김윤수	남	1967.12	부사장	상근	중국사업혁신팀장	SEIN-S법인장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	TSP총괄 GPO팀장	메모리 Global운영팀장	성균관대	계열회사 임원	
김이태	남	1966.02	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	기획팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(박사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	49
김재욱	남	1965.05	부사장	상근	공급망인사이드T/F장	상생협력센터 상생협력팀장	국민대	계열회사 임원	
김재윤	남	1963.03	부사장	상근	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SELA법인장	SEDA-S 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김중현	남	1966.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인사팀장	Foundry 인사팀장	육사	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준	남	1964.02	부사장	상근	종합기술원 미세먼지연구소장	연세대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	18
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI 기반설계실장	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대	계열회사 임원	
김진해	남	1963.12	부사장	상근	한국총괄 IM영업팀장	한국총괄 모바일영업팀장	광운대	계열회사 임원	
김찬우	남	1976.04	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	53
김창업	남	1969.08	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SELA법인장	한양대	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	생활가전 전략마케팅 담당임원	경북대	계열회사 임원	

김학상	남	1966.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형남	남	1965.06	부사장	상근	Global CS센터장	영상디스플레이 Global CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1966.01	부사장	상근	DS부문 CTO 담당임원	반도체연구소장	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	인사팀장	인사팀 담당임원	고려대	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	부사장	상근	DS부문 CSO, 글로벌 제조&인프라총괄	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터장	연세대(박사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
노형훈	남	1964.11	부사장	상근	생활가전 Global운영팀장	SEV법인장	고려대	계열회사 임원	
다니엘리	남	1969.12	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터장	SRA 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	49
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀 팀장	Morrow Sodali, Managing Director	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	5
더뫏라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 구주총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College	계열회사 임원	
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	17
도현호	남	1967.10	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Applied Materials, Managing Director	서울대(박사)	계열회사 임원	4
디페쉬	남	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	4
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	

문승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	SEDA-P(M) 공장장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문창록	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박길재	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	무선 Global CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	인사팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
박봉출	남	1964.01	부사장	상근	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	숭실대	계열회사 임원	
박성선	남	1965.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	충남대	계열회사 임원	
박성준	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	네트워크 Global운영팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박순철	남	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	연세대	계열회사 임원	
박용기	남	1963.04	부사장	상근	경영지원실장 보좌역	인사팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Virginia Tech, 교수	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	18
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	반도체연구소 DRAM TD실장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	43
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬익	남	1972.04	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 기획팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	35
박현정	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대	계열회사 임원	



반효동	남	1967.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질보증실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	부사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대	계열회사 임원	
부성종	남	1964.10	부사장	상근	경영혁신센터 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
서병훈	남	1963.07	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	43
서장석	남	1967.08	부사장	상근	혁신센터 담당임원	System LSI S/W Architecture팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
서한석	남	1968.02	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	무선 전략마케팅실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
성일경	남	1964.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	CIS총괄	연세대	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	북미총괄 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사수료)	계열회사 임원	
송두현	남	1964.01	부사장	상근	종합기술원 Device연구센터장	메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	TSE-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	39
송원득	남	1964.01	부사장	상근	DS부문 IP팀장	법무실 IP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	부사장	상근	반도체연구소장	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	인하대	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승철	남	1973.04	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	연세대	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	

신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신유균	남	1965.02	부사장	상근	반도체연구소 차세대연구실장	반도체연구소 공정개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심은수	남	1966.10	부사장	상근	종합기술원 System연구센터장	DIT센터장	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터장	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안덕호	남	1968.07	부사장	상근	Compliance팀장	DS부문 법무지원팀장	서울대	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당 임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안용일	남	1971.02	부사장	상근	CX·MDE센터 담당임원	디자인경영센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
안장혁	남	1967.12	부사장	상근	SEVT 담당임원	무선 지원팀 담당임원	육사	계열회사 임원	
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
안재우	남	1969.12	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	한국총괄 인사팀장	고려대	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	반도체연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양걸	남	1962.10	부사장	상근	중국전략협력실 부실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	설비기술연구소장	생산기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	세종대	계열회사 임원	
양태중	남	1970.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	United Health Group, SVP	Arizona State Univ.(석사)	계열회사 임원	28
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	56
염대현	남	1966.03	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	한양대	계열회사 임원	43
염재훈	남	1966.06	부사장	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 인사팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	충북대	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
오경석	남	1965.06	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 Package개발실장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 미주총괄 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	

오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
왕통	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 부팀장	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유승호	남	1968.06	부사장	상근	지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	연세대	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	20
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	LAM Research, Sr.Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	3
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	TSMC, Director	연세대	계열회사 임원	2
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤종식	남	1961.09	부사장	상근	Foundry CTO	Foundry 기술개발실장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	기획팀 담당임원	네트워크 기획팀장	건국대	계열회사 임원	
윤철운	남	1962.11	부사장	상근	SEHC법인장	영상디스플레이 Global운영팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	글로벌인프라총괄 평택사업장	고려대(석사)	계열회사 임원	
이강협	남	1962.12	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	한국총괄 CE영업팀장	고려대	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이광렬	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대	계열회사 임원	
이광현	남	1971.06	부사장	상근	인사팀 담당임원	북미총괄 인사팀장	연세대	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터장	TSP총괄 TP센터장	항공대	계열회사 임원	
이규필	남	1961.05	부사장	상근	DS부문 인사팀 담당임원	반도체연구소 메모리TD실장	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	

이규호	남	1969.06	부사장	상근	인사팀 담당임원	영상디스플레이 인사팀장	서강대	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이기수	남	1964.07	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 개발팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
이기호	남	1964.06	부사장	상근	SAVINA-S법인장	생활가전 전략마케팅 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이길호	남	1966.03	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명 기획1팀장	연세대	계열회사 임원	19
이동기	남	1969.05	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	
이동우	남	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	SEVT법인장	SVCC장	부산대	계열회사 임원	
이병준	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성전기 경영지원실장	경희대(석사)	계열회사 임원	30
이병철	남	1965.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	중국전략협력실 담당임원	淸華大(석사)	계열회사 임원	
이상도	남	1969.03	부사장	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대	계열회사 임원	
이상재	남	1965.12	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	TSP총괄 TP센터 담당임원	홍익대	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상현	남	1966.05	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이석준	남	1965.07	부사장	상근	System LSI LSI개발실장	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이성민	남	1964.09	부사장	상근	DS부문 동남아총괄	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이성수	남	1964.11	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	인사팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이승욱	남	1967.02	부사장	상근	전장사업팀장	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Akron(박사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 팀장	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado(석사)	계열회사 임원	16
이영수	남	1972.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

이영희	여	1964.11	부사장	상근	글로벌마케팅센터장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대	계열회사 임원	
이은철	남	1965.07	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry 제품기술팀장	광운대	계열회사 임원	
이재범	남	1970.10	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대	계열회사 임원	55
이종명	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종철	남	1968.01	부사장	상근	Compliance팀 담당임원	북미총괄 법무지원팀장	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	SRA연구소장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	TSE-P법인장	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	경희대	계열회사 임원	
이청울	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SGE법인장	MIT(석사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SERC 담당임원	고려대	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	네트워크 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	21
이현	남	1969.02	부사장	상근	TSE-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이흥모	남	1962.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Franklin Pierce Law Center(석사)	계열회사 임원	

임건	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	Qualcomm, Sr. Director Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	28
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	7
임석환	남	1974.11	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	42
임성택	남	1966.06	부사장	상근	중동총괄	SEI법인장	연세대	계열회사 임원	
임준서	남	1968.08	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀장	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장문석	남	1969.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global운영 팀장	SIEL-P(N)공장장	항공대	계열회사 임원	
장성대	남	1964.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라 기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터장	동국대	계열회사 임원	
장성재	남	1965.06	부사장	상근	생활가전 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서강대	계열회사 임원	
장성진	남	1965.07	부사장	상근	TSP총괄	메모리 품질보증실장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
장세연	남	1967.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	무선 차세대플랫폼센터 담당임 원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	39
장재혁	남	1967.10	부사장	상근	DS부문 중국총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	淸華大(석사)	계열회사 임원	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	반도체연구소 Flash TD실장	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장종산	남	1964.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전연구소장	글로벌인프라총괄 환경안전연 연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임 원	경북대	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	로봇사업팀장	로봇사업화T/F장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전병준	남	1966.02	부사장	상근	SEUK법인장	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
전준영	남	1962.05	부사장	상근	DS부문 구매팀장	System LSI 기획팀장	성균관대	계열회사 임원	
전충삼	남	1965.08	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	메모리제조센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정광열	남	1965.09	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임 원	DS부문 커뮤니케이션팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	DS부문 IP팀 담당임원	제일국제법률사무소 변호사	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	19
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정상섭	남	1966.11	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	

정서형	남	1967.05	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
정완영	남	1965.05	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEDA-S판매부문장	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재웅	남	1969.02	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	국민대(석사)	계열회사 임원	
정재현	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 미주총괄	메모리 Flash개발실장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
정해린	남	1964.11	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	무선 지원팀 담당임원	고려대	계열회사 임원	41
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	19
정현준	남	1964.06	부사장	상근	영상디스플레이 Micro LED팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
조기재	남	1967.01	부사장	상근	DS부문 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	감사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	System LSI A-Project팀장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	Mobile eXperience 인사팀장	인사팀 담당임원	경희대	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	북미총괄 인사팀장	네트워크 인사팀장	성균관대	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	SDI 법무팀장	한양대	계열회사 임원	3
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SENA법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대	계열회사 임원	
주드버클리	남	1970.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEA EVP	Queensland Univ.(석사)	계열회사 임원	7
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스 고객지원실 담당임원	성균관대	계열회사 임원	30
주은기	남	1962.01	부사장	상근	상생협력센터장	상생협력센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	

주혁	남	1971.10	부사장	상근	종합기술원 Device연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	49
지현기	남	1968.01	부사장	상근	메모리 기획팀장	SCS 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소 연구조정실 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	10
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 부실장	무선 상품전략팀장	광운대	계열회사 임원	
최강석	남	1965.12	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Univ. of California, Irvine	계열회사 임원	32
최경세	남	1969.04	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대	계열회사 임원	
최기환	남	1970.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
최길현	남	1966.10	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최방섭	남	1963.04	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실장	SEA 담당임원	서울대	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터장	서울대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	34
최수영	남	1965.11	부사장	상근	동남아총괄 지원팀장	중남미총괄 지원팀장	고려대	계열회사 임원	
최승걸	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	서울시립대	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	소프트웨어센터 S/W전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최원우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 인사팀장	메모리 인사팀장	서강대	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실장	생산기술연구소 설비개발실장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 개발팀장	고려대	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	LED사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	SESA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	



최정준	남	1965.08	부사장	상근	지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최종열	남	1967.06	부사장	상근	생활가전 담당임원	생활가전 디자인팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Design Platform개발실 장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	종합기술원 AI연구센터장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
추종석	남	1962.09	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀장	Univ. of Missouri, Columbia(석사)	계열회사 임원	
패트릭쇼 메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
하혜승	여	1967.11	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	Wellesley College	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 부팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
한승훈	남	1965.07	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	Iowa State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한인택	남	1966.10	부사장	상근	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
한지니	여	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Life팀장	무선 Digital Wallet팀장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	22
한진만	남	1966.10	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
허성희	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
허운행	남	1969.08	부사장	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
홍기채	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대	계열회사 임원	12
홍두희	남	1964.02	부사장	상근	감시팀장	무선 지원팀장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	아프리카총괄	Iran지점장	중앙대	계열회사 임원	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Univ. of California, LA(석 사)	계열회사 임원	

홍형선	남	1963.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리 제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실장	인하대(석사)	계열회사 임원	
황기현	남	1967.06	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 제조 시너지팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황대환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CE영업팀장	생활가전 전략마케팅실 담당임원	경희대	계열회사 임원	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	SCS법인장	SCS 담당임원	인하대	계열회사 임원	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	Qualcomm, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	10
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	43
강동구	남	1976.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	43
강동우	남	1971.04	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	30
강동훈	남	1970.12	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	30
강상범	남	1969.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강상용	남	1972.09	상무	상근	전장사업팀 담당임원	SEG 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	43
강석채	남	1971.06	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	56
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	30
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	15
강윤경	여	1968.12	상무	상근	인사팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	56
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
강재원	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
강정대	남	1970.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대	계열회사 임원	56
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대	계열회사 임원	7
강태규	남	1972.01	상무	상근	IR팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	56
강태우	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	43

강희성	남	1970.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술훈련센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술훈련센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	56
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	56
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	48
고승범	남	1971.07	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대	계열회사 임원	43
고알시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	23
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	37
고유상	남	1969.05	상무	상근	경영지원실 담당임원	삼성경제연구소 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	19
고의중	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대	계열회사 임원	7
고정욱	남	1976.02	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	30
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
고택균	남	1971.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	서강대	계열회사 임원	19
고형석	남	1972.09	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	43
공병진	남	1971.09	상무	상근	SIEL-P(C) 공장장	생활가전 Global운영팀 담당부장	항공대	계열회사 임원	19
곽진환	남	1968.01	상무	상근	종합기술원 미래기술육성센터장	SRIL연구소장	Santa Clara Univ.(석사)	계열회사 임원	
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	On Semiconductor, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	12
구봉진	여	1971.05	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
구윤본	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술훈련센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술훈련센터 담당임원	한양대	계열회사 임원	43
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	33
권기덕	남	1972.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술훈련센터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	43
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대	계열회사 임원	19
권상욱	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀 담당임원	SRUK연구소장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	56
권순범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	30
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	19

권영훈	남	1972.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	NXP, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	12
권오경	남	1977.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
권오상	남	1967.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
권오수	남	1968.04	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	SEA 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
권욱	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	Lazada, CMO	서울대(석사)	계열회사 임원	1
권진현	남	1968.07	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 담당 부장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	43
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEEG-P법인장	SEHC 담당부장	포항공대	계열회사 임원	19
권태훈	남	1971.02	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	19
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	System LSI 상품기획팀 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	30
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 동남아총괄 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	56
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀 담당임원	Samsung Research Platform팀 수석	New York Univ., Tandon School of Engineering(석 사)	계열회사 임원	19
길태호	남	1977.11	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	42
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀 장	성균관대	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	SEH-P 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부 장	MIT(석사)	계열회사 임원	7
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	7
김경준	남	1969.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	광운대	계열회사 임원	43
김경대	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	부산대	계열회사 임원	19
김광연	남	1965.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 부장	한양대	계열회사 임원	7
김구영	남	1975.03	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 Package개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	7
김규태	남	1970.12	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임 원	RPI(석사)	계열회사 임원	45
김기건	남	1964.02	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대	계열회사 임원	
김기남	남	1964.08	상무	상근	종합기술원 Material연구센터 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	

김기상	남	1965.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리 제조기술센터 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
김기수	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대	계열회사 임원	56
김기호	남	1966.03	상무	상근	SRA 담당임원	SRI-Delhi연구소장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	27
김대신	남	1970.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	43
김대우	남	1970.03	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	56
김대주	남	1969.10	상무	상근	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	상무	상근	Samsung Research Platform팀 담당임원	Samsung Research Media Research팀 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김덕현	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대	계열회사 임원	29
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	7
김동수	남	1975.10	상무	상근	반도체연구소 인사팀장	DS부문 인사팀 부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	7
김동욱	남	1969.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	51
김동준	남	1973.05	상무	상근	TSLED법인장	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	15
김릉	남	1971.12	상무	상근	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	중앙대	계열회사 임원	19
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	19
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	7
김문수	남	1977.12	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19
김민우	남	1978.06	상무	상근	SESP법인장	SAPL법인장	한양대	계열회사 임원	19
김병진	남	1975.02	상무	상근	SEAU 담당임원	SERC 담당임원	Southern Illinois Univ.(석사)	계열회사 임원	43
김병우	남	1968.03	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	경북대	계열회사 임원	
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	4
김보현	남	1973.02	상무	상근	Samsung Research 인사팀장	TSP총괄 인사팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	56

김봉수	남	1971.06	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	19
김상윤	남	1972.01	상무	상근	SECE법인장	SECE 담당부장	인하대	계열회사 임원	19
김상윤	남	1969.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Synopsys, Technical Member	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	29
김상호	남	1967.10	상무	상근	SRA 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
김상훈	남	1968.02	상무	상근	SEI 담당임원	SENA 담당임원	건국대	계열회사 임원	56
김석희	남	1971.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	19
김선정	남	1973.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	7
김성구	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	19
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대	계열회사 임원	43
김성기	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	복미총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	7
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대	계열회사 임원	
김성은	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대	계열회사 임원	30
김성한	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEAG법인장	광운대	계열회사 임원	43
김성한	남	1970.05	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	상무	상근	감사팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김수련	여	1967.04	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	43
김수홍	남	1972.11	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	56
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	인하대	계열회사 임원	30
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	단국대	계열회사 임원	56
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사 임원	19
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	7
김연정	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	56

김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사 임원	56
김영우	남	1976.09	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	7
김영정	남	1972.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
김영주	남	1973.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	7
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	29
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19
김용성	남	1973.09	상무	상근	종합기술원 Device연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
김용원	남	1970.04	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	30
김용주	남	1970.08	상무	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 중대형사업부 지원팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
김용찬	남	1969.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	경희대	계열회사 임원	43
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	7
김용훈	남	1972.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	한양대	계열회사 임원	19
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	42
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	7
김원우	남	1970.03	상무	상근	SEDA-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	30
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	43
김유나	여	1979.01	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Platform팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	7
김윤재	남	1973.02	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	19
김윤철	남	1967.10	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대	계열회사 임원	43
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대	계열회사 임원	43
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	19
김이수	남	1973.03	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SVCC 담당임원	아주대	계열회사 임원	
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	43
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43

김일룡	남	1974.02	상무	상근	System LSI 제품기술팀장	System LSI 기반설계실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
김장경	남	1973.05	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대	계열회사 임원	56
김장환	남	1975.08	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
김재성	남	1972.04	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	30
김재열	남	1965.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대	계열회사 임원	54
김재영	남	1971.11	상무	상근	SECA 담당임원	SIEL-S 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	56
김재윤	남	1970.07	상무	상근	전장사업팀 담당임원	재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	43
김재진	남	1969.11	상무	상근	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	항공대	계열회사 임원	19
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	19
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	9
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대	계열회사 임원	
김정주	남	1969.01	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	56
김정현	남	1975.06	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 기획팀 담당임원	고려대	계열회사 임원	56
김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	43
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대	계열회사 임원	
김종근	남	1967.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종환	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	56
김종훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대	계열회사 임원	56
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	56
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SEHC담당임원	SESK 담당임원	경기대	계열회사 임원	56
김중정	남	1973.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	56
김지영	남	1970.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	56
김지윤	여	1975.02	상무	상근	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	43



김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	감사팀 담당부장	서강대(박사)	계열회사 임원	7
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대	계열회사 임원	7
김진기	남	1972.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	인하대	계열회사 임원	7
김진성	남	1971.02	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	30
김진주	남	1969.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	56
김찬우	남	1972.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	19
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SESA 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	19
김창영	남	1973.03	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	중앙대	계열회사 임원	56
김창용	남	1973.04	상무	상근	종합기술원 인사팀장	종합기술원 부장	고려대(석사)	계열회사 임원	7
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	금오공대	계열회사 임원	56
김태균	남	1969.01	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	SSIC 담당임원	성균관대	계열회사 임원	56
김태균	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	7
김태수	남	1971.11	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부 장	부산대	계열회사 임원	30
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	14
김태영	남	1968.04	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	LBS(석사)	계열회사 임원	29
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	43
김태정	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	충북대	계열회사 임원	19
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	56
김태진	남	1969.01	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성경제연구소 사회인프라개 발실 담당부장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	56
김태훈	남	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	43
김태훈	남	1973.01	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	단국대	계열회사 임원	19
김평진	남	1973.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대	계열회사 임원	56
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대	계열회사 임원	7

김현	남	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	구미지원센터 인사팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	56
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 부장	경희대	계열회사 임원	7
김현석	남	1976.10	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	7
김현수	남	1970.09	상무	상근	Samsung Research 기술전략 팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임 원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현조	남	1970.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
김현종	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	19
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	43
김현철	남	1969.05	상무	상근	반도체연구소 CIS TD팀 담당임 원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	30
김형로	남	1973.01	상무	상근	인사팀 담당임원	법무법인 태평양, 변호사	고려대	계열회사 임원	7
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대	계열회사 임원	30
김형재	남	1970.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	56
김형준	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	송실대(석사)	계열회사 임원	7
김호균	남	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김호진	남	1966.08	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임 원	성균관대	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	34
김후성	남	1972.01	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희승	남	1970.09	상무	상근	DS부문 인사팀 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	30
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대	계열회사 임원	30
남경인	남	1973.03	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	43
남기돈	남	1972.09	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당부장	중앙대	계열회사 임원	30
남정만	남	1967.06	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임 원	전남기계공고	계열회사 임원	56
노강호	남	1978.05	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
노경래	남	1976.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	SEM-S 담당부장	서강대	계열회사 임원	43
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	10

노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	30
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	19
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	19
노승환	남	1974.08	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEF 담당부장	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	7
노태현	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	56
도성대	남	1966.12	상무	상근	서남아총괄 CS팀장	CS환경센터 담당부장	부산대	계열회사 임원	
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	19
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	19
류일곤	남	1968.07	상무	상근	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	56
류효경	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	20
마피유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	30
맹경무	남	1970.02	상무	상근	LED사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	30
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.	계열회사 임원	30
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	56
문국열	남	1969.01	상무	상근	SEVT 담당임원	SVCC 담당임원	구미1대	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	43
문진옥	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	30
문형준	남	1968.07	상무	상근	Foundry 기획팀장	System LSI 기획팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	56
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원 커뮤니케이션팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	7
민재호	남	1976.09	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
박건태	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박동수	남	1966.12	상무	상근	중남미총괄 CS팀장	Global CS센터 Global서비스팀 장	광주대	계열회사 임원	

박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	19
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	19
박민철	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
박범주	남	1966.04	상무	상근	Samsung Research S/W혁신센터 담당임원	Samsung Research 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박병률	남	1968.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	37
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
박봉태	남	1974.10	상무	상근	SCS 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	30
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	MBC 부장	서울대	계열회사 임원	16
박상도	남	1973.12	상무	상근	북미총괄 담당임원	북미총괄 담당부장	성균관대	계열회사 임원	30
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	7
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	7
박성욱	남	1972.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
박성제	남	1971.05	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	국민대(석사)	계열회사 임원	19
박세근	남	1974.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	30
박수남	남	1970.10	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	42
박장욱	남	1967.02	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	계명대	계열회사 임원	56
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대	계열회사 임원	19
박재범	남	1977.08	상무	상근	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
박재성	남	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	43
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	구주총괄 마케팅팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	19
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전연구소 담당임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	43

박정미	여	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 팀 담당임원	무선 GDC센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	남	1974.01	상무	상근	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	30
박정호	남	1971.09	상무	상근	Compliance팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정호	남	1974.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	30
박제영	남	1969.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리 제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	56
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당부장	California Polytechnic State Univ.	계열회사 임원	56
박종규	남	1969.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	경북대	계열회사 임원	56
박종만	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 모바일플랫폼센터 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	7
박종범	남	1969.02	상무	상근	SIEL-S 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	서울시립대	계열회사 임원	7
박종욱	남	1968.11	상무	상근	Global CS센터 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	56
박종진	남	1970.12	상무	상근	경영지원실 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor	계열회사 임원	28
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEBN법인장	SEA 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	19
박준호	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	상무	상근	SRA 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	43
박진수	남	1969.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	인하대	계열회사 임원	43
박진표	남	1972.11	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
박창서	남	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	16
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	56
박철민	남	1971.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	Intel, Director	서울대(박사)	계열회사 임원	29
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 담당임원	고려대	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대	계열회사 임원	7
박충신	남	1973.09	상무	상근	의료기기 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	19
박태상	남	1975.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43

박태호	남	1969.03	상무	상근	SEAG법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	7
박항엽	남	1968.01	상무	상근	DS부문 정보보호센터 담당임원	DS부문 인사팀 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	30
박행철	남	1970.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	부산대	계열회사 임원	19
박현근	남	1973.01	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	30
박형민	남	1977.03	상무	상근	SEAG 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	19
박형원	남	1966.09	상무	상근	System LSI 품질팀장	System LSI SOC개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
박호우	남	1971.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
박훈중	남	1967.08	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	인하대	계열회사 임원	
박훈철	남	1974.05	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	광운대	계열회사 임원	7
박희걸	남	1972.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Ericsson, Sr.Architect	고려대(석사)	계열회사 임원	17
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대	계열회사 임원	30
발라지	남	1969.09	상무	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	43
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	53
배광운	남	1968.03	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대	계열회사 임원	56
배상기	남	1974.04	상무	상근	SAS 담당임원	사업지원T/F 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	30
배승준	남	1976.03	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	43
배일환	남	1970.07	상무	상근	인사팀 담당임원	SEVT 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	56
배학범	남	1963.08	상무	상근	SESK법인장	SEHC 담당임원	경희대	계열회사 임원	
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	19
백승엽	남	1967.01	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Samsung Research 지원팀장	California State Univ., Hayward(석사)	계열회사 임원	
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	Samsung Research Robot센터 수석	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	7
백일섭	남	1968.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	

백종수	남	1971.01	상무	상근	지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	30
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사 )	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	생활가전 디자인팀장	생활가전 디자인팀 담당임원	제주대	계열회사 임원	
부장원	남	1973.06	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	30
서경욱	남	1966.10	상무	상근	SEPOL법인장	SAVINA-S법인장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
서경현	남	1970.05	상무	상근	인사팀 담당임원	삼성전기 인사팀 담당임원	광운대	계열회사 임원	7
서보철	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조 센터 담당임원	무선 Global운영팀 담당임원	동국대	계열회사 임원	
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	건국대	계열회사 임원	30
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	CS환경센터 담당부장	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	19
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서정혁	남	1972.07	상무	상근	네트워크 인사팀장	SRA 담당부장	건국대	계열회사 임원	7
서정현	남	1974.04	상무	상근	SCS 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	30
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	Airbnb, Director	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	4
서행룡	남	1967.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대	계열회사 임원	
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	8
석종욱	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 LED제조기술팀장	글로벌인프라총괄 LED제조기 술팀장	광운대	계열회사 임원	
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	30
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대	계열회사 임원	56
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	56
성덕용	남	1973.09	상무	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사 )	계열회사 임원	56
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 수석	한양공고	계열회사 임원	7

성한준	남	1971.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	성균관대	계열회사 임원	30
소재민	남	1983.04	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	7
손동우	남	1971.04	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	한양대	계열회사 임원	19
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	전남대(석사)	계열회사 임원	19
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
손영웅	남	1970.10	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	30
손용우	남	1968.09	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	TSTC 담당임원	경희대	계열회사 임원	56
손용훈	남	1973.03	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	7
손종을	남	1967.03	상무	상근	SAMCOL법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	건국대	계열회사 임원	56
손종근	남	1970.09	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(박사)	계열회사 임원	56
손태용	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	56
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	43
손호민	남	1969.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	30
손호성	남	1968.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 구매팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	19
송기환	남	1970.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
송명숙	여	1972.11	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	SIEL-S 담당임원	성균관대	계열회사 임원	43
송방영	남	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	43
송병우	남	1973.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송상철	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	16
송승엽	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	56
송원준	남	1969.04	상무	상근	생활가전 전략마케팅실 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	56
송윤중	남	1971.10	상무	상근	반도체연구소 차세대연구실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	43



송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	43
송대중	남	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	56
송호건	남	1966.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	30
웨인희비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	56
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대	계열회사 임원	19
신대중	남	1971.11	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	SEIN-P법인장	경북대	계열회사 임원	30
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	19
신승원	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	KAIST, 교수	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	16
신승주	남	1972.04	상무	상근	SESA 담당임원	SECZ법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	30
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
신인철	남	1974.06	상무	상근	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	19
신종신	남	1973.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	56
신현석	남	1969.05	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀장	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 인사팀장	인사팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	
심우철	남	1982.06	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	7
심재현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	동남아총괄 지원팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	56
심호준	남	1977.12	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	7
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 일본총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대	계열회사 임원	19
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	19
안성준	남	1975.01	상무	상근	System LSI S/W Architecture팀장	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
안승환	남	1970.10	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	43
안신현	남	1972.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 수석	한양대	계열회사 임원	7

안정희	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEMAG법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	56
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	AWS, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	7
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대	계열회사 임원	56
양병덕	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	54
양세영	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	56
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	19
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대	계열회사 임원	56
양준철	남	1972.06	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	30
양진기	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	43
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	43
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	30
여태정	남	1970.06	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	56
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 부장	연세대(석사)	계열회사 임원	7
영강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	19
영부호	남	1972.04	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	무선 GDC센터 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	7
오문욱	남	1974.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	56
오상진	남	1977.11	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	사업지원T/F 부장	MIT(석사)	계열회사 임원	7
오석민	여	1974.07	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	30
오승훈	남	1968.03	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
오양지	남	1968.10	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	淸華大	계열회사 임원	7
오재균	남	1972.02	상무	상근	System LSI 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	56
오정석	남	1970.03	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	System LSI 지원팀장	淸華大(석사)	계열회사 임원	
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	43

오창민	남	1965.02	상무	상근	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	SEV 담당임원	무선 구매팀 담당임원	동아대	계열회사 임원	19
오창환	남	1969.01	상무	상근	DS부문 담당임원	DS부문 경영지원실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	56
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	30
오형석	남	1970.09	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	TSP총괄 구매팀장	고려대	계열회사 임원	56
오화석	남	1972.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	7
우형동	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	경북대	계열회사 임원	43
원석준	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
원순재	남	1972.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	7
위훈	남	1970.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	10
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	19
유성호	남	1973.02	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임원	System LSI 지원팀 부장	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	7
유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	연세대	계열회사 임원	7
유종민	남	1974.04	상무	상근	SSC 담당임원	인사팀 담당부장	경희대	계열회사 임원	30
유한중	남	1973.10	상무	상근	SEF 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	19
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	30
육근성	남	1968.08	상무	상근	한국총괄 지원팀 담당임원	SESA 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	43
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	1
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	43
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	계열회사 임원	7

윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	17
윤석호	남	1972.07	상무	상근	LED사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	Mobile eXperience 인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	7
윤송호	남	1974.10	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	광운대	계열회사 임원	7
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Statschippac, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	33
윤여환	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	19
윤영조	남	1975.02	상무	상근	IR팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	27
윤우근	남	1972.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	17
윤인수	남	1974.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	43
윤주환	남	1970.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대	계열회사 임원	43
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SERC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	인하대	계열회사 임원	43
윤태식	남	1969.04	상무	상근	한국총괄 IMC팀장	한국총괄 IMC팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
윤하룡	남	1971.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	56
윤호용	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SECH법인장	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	30
이강규	남	1972.09	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	Foundry 지원팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	19
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global운영팀장	System LSI Global운영팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	30
이경우	남	1969.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	56
이경준	남	1976.06	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	19
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	7
이계복	남	1969.06	상무	상근	SEHA법인장	SEMA법인장	홍익대	계열회사 임원	30
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	인재개발원 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서울대	계열회사 임원	7

이관수	남	1969.11	상무	상근	SAMEX 담당임원	SEHZ 담당임원	영남대	계열회사 임원	
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	7
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대	계열회사 임원	30
이규영	남	1968.10	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	30
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대	계열회사 임원	43
이금주	여	1971.09	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	56
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	무선 개발2실 수석	동아대	계열회사 임원	56
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 Quality Engineering팀장	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	30
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	18
이달래	여	1970.04	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 상품전략팀 담당임원	한국외국어대	계열회사 임원	43
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	19
이동근	남	1971.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	43
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대	계열회사 임원	19
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	31
이동현	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원실 수석변호사	고려대	계열회사 임원	
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	56
이병섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대	계열회사 임원	7
이병시	남	1969.01	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	43
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	19
이병철	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 인사팀 담 당임원	글로벌기술센터 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
이병현	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	7
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 CX팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	7
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	19

이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	36
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대	계열회사 임원	56
이상원	남	1971.07	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEF 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	56
이상윤	남	1968.09	상무	상근	지원팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	경희대	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SEM-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	한국외국어대	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	SRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대	계열회사 임원	56
이상희	남	1974.09	상무	상근	반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
이석림	남	1974.03	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	7
이석원	남	1970.07	상무	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
이성원	남	1976.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	9
이성현	남	1966.07	상무	상근	SGE법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	홍익대	계열회사 임원	
이승관	남	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대	계열회사 임원	29
이승목	남	1973.09	상무	상근	System LSI 인사팀장	동남아총괄 인사팀장	고려대	계열회사 임원	43
이승엽	남	1968.08	상무	상근	SEIN-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대	계열회사 임원	56
이승재	남	1974.08	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	56
이승철	남	1975.12	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	경영혁신센터 담당부장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대	계열회사 임원	19
이승환	남	1971.05	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	7
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대	계열회사 임원	43
이애영	여	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
이영민	남	1964.03	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	SRPOL연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	

이영직	남	1967.08	상무	상근	SEH-P법인장	SERK법인장	아주대	계열회사 임원	
이영춘	남	1967.10	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	50
이영호	남	1967.07	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	19
이윤성	남	1971.09	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	19
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	19
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	30
이재환	남	1970.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	SEEG-S법인장	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대	계열회사 임원	7
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	43
이정삼	남	1967.06	상무	상근	TSP총괄 기획팀장	TSP총괄 GPO팀장	인하대	계열회사 임원	
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	34
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global운영팀장	네트워크 Global운영팀 담당임 원	경북대	계열회사 임원	19
이정원	남	1977.04	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	Marvell, Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	18
이정자	여	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	56
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	경북대	계열회사 임원	7
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	56
이종민	남	1971.09	상무	상근	차세대플랫폼전략T/F 담당임원	무선 기획팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	30
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임 원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	43
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	30
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	30
이종필	남	1973.11	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI SOC개발실 담당임 원	충남대(석사)	계열회사 임원	30
이종호	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	

이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
이주형	남	1972.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	34
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	19
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Carrier, Tech Engineer	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	7
이준환	남	1969.10	상무	상근	네트워크 전략마케팅 담당임원	네트워크 전략마케팅 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	30
이종원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 수석	제주대	계열회사 임원	7
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	30
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ., Evanston(석사)	계열회사 임원	19
이진구	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	56
이진석	남	1971.09	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	46
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	DS부문 상생협력센터 부장	아주대(석사)	계열회사 임원	7
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	30
이창엽	남	1970.04	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	영남대	계열회사 임원	43
이창원	남	1972.03	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	7
이지훈	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	상무	상근	TSP총괄 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	56
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	4
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	경희대	계열회사 임원	56
이현	남	1971.01	상무	상근	SEF 담당임원	SEROM법인장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이현동	남	1972.02	상무	상근	SELV법인장	Lebanon지점장	영남대	계열회사 임원	7
이현우	남	1974.10	상무	상근	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	19



이현정	여	1971.11	상무	상근	한국총괄 Retail마케팅팀장	한국총괄 Retail마케팅팀 담당 부장	고려대(박사)	계열회사 임원	7
이형우	남	1970.03	상무	상근	북미총괄 대외협력팀 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임 원	Univ. of Texas, Austin(석 사)	계열회사 임원	51
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	43
이흥빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임 원	명지대	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
이효석	남	1969.02	상무	상근	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 AI&SW연구센터 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	56
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Dupont, APAC EHS Head	성균관대(석사)	계열회사 임원	6
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	부산수산대	계열회사 임원	56
임경애	여	1975.02	상무	상근	생활가전 안식년	생활가전 CX팀 담당임원	이화여대(석사)	계열회사 임원	30
임근휘	남	1973.05	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	49
임백준	남	1968.07	상무	상근	SRUK연구소장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	58
임산	남	1973.03	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
임성수	남	1978.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	30
임성택	남	1970.10	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅 담당부 장	City Univ. of New York(석 사)	계열회사 임원	19
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	Honeywell, Sales Director	영남대	계열회사 임원	59
임용식	남	1971.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	19
임전식	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대	계열회사 임원	43
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Ogilvy Singapore, Mng. Partner	서울대	계열회사 임원	24
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대	계열회사 임원	
장경훈	남	1970.02	상무	상근	로봇사업팀 담당임원	Samsung Research Robot센 터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임 원	영상디스플레이 구매팀 담당부 장	경북대	계열회사 임원	56

장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대	계열회사 임원	30
장소연	여	1971.06	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	이화여대	계열회사 임원	43
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	부산대	계열회사 임원	19
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서울대	계열회사 임원	43
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	무선 Global Mobile B2B팀 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 DR사업팀장	의료기기 Global CS팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	19
장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEASA법인장	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대	계열회사 임원	19
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	23
장형택	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SIEL-S 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	56
전대호	남	1971.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	19
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대	계열회사 임원	43
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	7
전소영	여	1974.05	상무	상근	SEA 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Texas, Dallas(석사 )	계열회사 임원	19
전승수	남	1976.07	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	Samsung Research 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	19
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
전진규	남	1974.05	상무	상근	SENA 담당임원	SEAG 담당부장	한양대	계열회사 임원	19
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	19
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당부장	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	7
정광민	남	1971.07	상무	상근	SEPR법인장	Ecuador지점장	부산대	계열회사 임원	7
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	7
정광희	남	1971.08	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대	계열회사 임원	43
정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	생활가전 CX팀 담당임원	한국해양대	계열회사 임원	7
정다운	남	1980.09	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30

정우경	남	1971.05	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	30
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	송실대	계열회사 임원	7
정상규	남	1970.03	상무	상근	SEM-P법인장	생활가전 선행개발팀 담당임원	조선대	계열회사 임원	56
정상인	남	1969.06	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	
정상일	남	1967.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	중앙대	계열회사 임원	
정상태	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	계열회사 임원	
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀 담당임원	메모리 Global운영팀 부장	서울대(박사)	계열회사 임원	7
정성원	남	1971.12	상무	상근	SCA법인장	Senegal지점장	고려대	계열회사 임원	7
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	43
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	19
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	7
정용덕	남	1976.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
정용준	남	1969.10	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정원석	남	1971.07	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	30
정원철	남	1973.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30
정유진	여	1970.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	43
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	베트남복합단지 담당임원	감사팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
정의욱	남	1968.07	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Global운영팀장	인하대	계열회사 임원	
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.	계열회사 임원	30
정인호	남	1975.02	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	30
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	30
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	7
정일규	남	1968.05	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대	계열회사 임원	43
정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	7

정재연	여	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재용	남	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
정준수	남	1970.09	상무	상근	SERK법인장	SEA 담당부장	영남대	계열회사 임원	7
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	56
정진국	남	1975.10	상무	상근	SRR연구소장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	43
정진민	남	1972.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부장	전남대	계열회사 임원	7
정혜순	여	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대	계열회사 임원	56
정훈	남	1969.01	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SESA법인장	홍익대	계열회사 임원	
정희재	남	1971.04	상무	상근	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인팀 수석	서울시립대	계열회사 임원	19
제이콥	남	1978.11	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	30
제임스휘슬러	남	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melville High Sch.	계열회사 임원	7
조기호	남	1971.03	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 상품전략팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조민정	여	1974.07	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	43
조성대	남	1969.06	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
조성훈	남	1970.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	건국대(박사)	계열회사 임원	56
조성훈	남	1976.01	상무	상근	생활가전 인사팀장	생활가전 인사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	30
조신형	남	1972.10	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DS부문 커뮤니케이션팀 담당부장	서강대	계열회사 임원	30
조용호	남	1970.03	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	56
조욱래	남	1972.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	19
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마케팅팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	19
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Global EHS센터 담당부장	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	19
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	19

조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스 인사팀장	성균관대	계열회사 임원	7
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대	계열회사 임원	7
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	30
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대	계열회사 임원	19
조철호	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SECA법인장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	56
조학주	남	1969.03	상무	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	5
조희권	남	1976.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire	계열회사 임원	43
주명휘	남	1963.08	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	上海大(석사)	계열회사 임원	56
주재완	남	1968.02	상무	상근	Global CS센터 담당임원	중국총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현대	남	1972.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당부장	울산대	계열회사 임원	7
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SESAR법인장	SEIL법인장	경희대	계열회사 임원	19
지송하	여	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	이화여대	계열회사 임원	
지우정	남	1967.11	상무	상근	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
지응준	남	1968.01	상무	상근	종합기술원 기획지원팀장	반도체연구소 기술기획팀장	연세대(박사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	56
진인식	남	1971.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	19
차경환	남	1972.04	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	56
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	30
천기철	남	1970.09	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	19
천상필	남	1969.05	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	구주총괄 대외협력팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	30
최경수	남	1971.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 구매전략팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	19
최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Quality Engineering팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	

최동준	남	1972.05	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	56
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	19
최병희	남	1970.05	상무	상근	SETK법인장	SEB법인장	경북대	계열회사 임원	19
최상중	남	1973.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	19
최서림	남	1972.02	상무	상근	설비기술연구소 기획지원팀장	생산기술연구소 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계실 Master	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	7
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	상무	상근	SEA 담당임원	SIEL-S 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	56
최승림	남	1972.02	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	7
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 인사팀 담당부장	항공대	계열회사 임원	43
최영돈	남	1972.12	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
최영상	남	1975.01	상무	상근	종합기술원 AI연구센터 담당임원	종합기술원 AI&SW연구센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	56
최영일	남	1973.08	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	19
최영준	남	1967.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LG전자, 자문역	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	23
최원경	여	1973.08	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Statschippac, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30
최유중	남	1971.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	인사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	56
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	7
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
최윤정	여	1973.10	상무	상근	Samsung NEXT 담당임원	Samsung NEXT 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	36
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
최재혁	남	1974.06	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	19
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	43
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	19
최진필	남	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	30

최창훈	남	1972.02	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	43
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SIEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	인하대	계열회사 임원	7
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최현호	남	1979.06	상무	상근	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
최호규	남	1968.12	상무	상근	CX·MDE센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	7
코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEUK 담당임원	SEUK VP	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	43
편정우	남	1970.10	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	56
피터리	남	1970.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	7
한규환	남	1966.02	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	DS부문 구조총괄 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
한규희	남	1974.01	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
한상섭	남	1972.04	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	광운대(석사)	계열회사 임원	7
한상연	남	1969.01	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	56
한우섭	남	1967.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한의택	남	1974.02	상무	상근	SME법인장	SENZ법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	30
한인국	남	1964.11	상무	상근	인사팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터장	한양대	계열회사 임원	
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
한종호	남	1976.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEI 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	19
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	30
한진우	남	1980.07	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	NASA, Senior Scientist	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
함선규	남	1970.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	43
허준영	남	1977.02	상무	상근	구조총괄 인사팀장	무선 인사팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	7

허준희	남	1979.03	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	12
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대	계열회사 임원	56
허진욱	남	1971.09	상무	상근	북미총괄 CS팀장	ECSO장	한양대(박사)	계열회사 임원	19
허태영	남	1970.11	상무	상근	영상디스플레이 CX팀장	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Univ. of California, LA	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	19
현경호	남	1966.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	DS부문 감사팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
현상진	남	1972.02	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
홍경선	남	1970.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	43
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	56
홍성민	남	1969.06	상무	상근	Foundry 인사팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
홍성준	남	1969.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	삼성엔지니어링 담당임원	연세대	계열회사 임원	21
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	7
홍승환	남	1971.06	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	56
홍연석	남	1972.01	상무	상근	SEIN-P법인장	무선 Global제조센터 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	7
홍영기	남	1970.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍영주	남	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대	계열회사 임원	7
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	43
홍정호	남	1969.02	상무	상근	의료기기 지원팀장	전장사업팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	43
홍준식	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	19
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	30
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	30
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀 팀장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대	계열회사 임원	56



황보용	남	1970.10	상무	상근	신사업T/F 담당임원	경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	남	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	43
황완구	남	1972.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	삼성바이오로직스 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	7
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	30
황인철	남	1977.11	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼 센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
황제임스	남	1971.07	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	West Point	계열회사 임원	43
황찬수	남	1975.07	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Tinoq, Co-Founder	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	23
황호송	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	19
황희돈	남	1974.01	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	30

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 98,184,754주(이재용 부회장 97,414,196주 등),

우선주(의결권 없는 주식) 193,799주(이재용 부회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

## 라.미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분 (사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	김우평	남	1970.05	부사장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	계열회사 임원
	이지별	남	1971.03	부사장	글로벌마케팅센터 담당임원	계열회사 임원
	정성택	남	1976.09	부사장	신사업T/F장	계열회사 임원
	권혁우	남	1973.07	상무	Global Public Affairs팀 담당임원	계열회사 임원
	박래순	남	1969.05	상무	중국전략협력실 담당임원	계열회사 임원
	이수용	남	1967.12	상무	DS부문 구매팀 담당임원	계열회사 임원
임원사임	안재우	남	1969.12	부사장	중국전략협력실 담당임원	계열회사 임원
	정광열	남	1965.09	부사장	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	계열회사 임원
	고유상	남	1969.05	상무	경영지원실 담당임원	계열회사 임원
	최윤정	여	1973.10	상무	Samsung NEXT 담당임원	계열회사 임원
	황제임스	남	1971.07	상무	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임 원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

## 마. 직원 등의 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직원 수					평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
DX	남	37,786	-	331	-	38,117	15.9	-	-	-	-	-	
DX	여	11,581	225	85	-	11,666	12.8	-	-			-	
DS	남	49,005	-	144	-	49,149	10.5	-	-			-	
DS	여	18,949	181	23	-	18,972	10.7	-	-			-	
성별합계	남	86,791	-	475	-	87,266	12.9	4,641,522	55			-	
성별합계	여	30,530	406	108	-	30,638	11.5	1,137,602	40			-	
합 계		117,321	406	583	-	117,904	12.5	5,779,124	51			-	

※ 본사 기준이며, 휴직자는 포함하고 등기임원 9명(사내이사 5명, 사외이사 4명)은 제외한 기준입니다.

※ 반기급여 총액 및 1인평균 급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 113,604명(남 85,232명, 여 28,372명) 기준으로 산출하였습니다.

※ 소속 외 근로자는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

## 바. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	917	294,559	319	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 하였으며, '미등기임원 현황'의 임원 중 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 인원은 제외하였습니다.

※ 반기급여 총액과 1인평균 급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

※ 반기급여 총액은 성과급 지급 실적을 포함하고 있으며, 성과급 지급 시점은 매년 상이합니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 919명을 기준으로 산출하였습니다.

## 2. 임원의 보수 등

### 가. 임원의 보수

<이사·감사 전체의 보수현황>

#### (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	41,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 「상법」 제388조와 당사 정관에 따라 2022년 3월 16일 주주총회 결의를 통해 승인받은

이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.

#### (2) 보수지급금액

##### (2-1) 이사·감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
9	15,165	1,685	-

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한

등기이사·사외이사·감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다. (당해 사업연도 중 사임한 한화진 사외이사,

퇴임한 박병국 사외이사에 대한 보수를 포함하여 기재하였습니다.)

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	14,629	2,926	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	215	215	-
감사위원회 위원	3	321	107	-
감사	-	-	-	-

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한

등기이사·사외이사·감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다. (당해 사업연도 중 사임한 한화진 사외이사,

퇴임한 박병국 사외이사에 대한 보수를 포함하여 기재하였습니다.)

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 감사위원회 위원으로 선임된 김종훈 사외이사의 보수는 감사위원회 위원 보수총액에 포함하여 기재하였습니다.

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(3) 보수지급기준

당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구분	보수지급기준
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정</li> <li>· 설·추석상여: 각 월급여 100% 지급</li> <li>· 목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급)</li> <li>· 성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)</li> <li>· 장기성과인센티브: ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급</li> <li>· 복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원·건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공</li> </ul>
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정</li> <li>· 복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원·건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공</li> </ul>

감사위원회 위원	<ul style="list-style-type: none"><li>• 급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정</li><li>• 복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원 · 건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공</li></ul>
----------	---

<보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
한종희	대표이사	2,072	-
경계현	대표이사	990	-
노태문	이사	1,723	-
박학규	이사	777	-
이정배	이사	1,112	-
김기남	회장(前대표이사)	3,264	-
김현석	고문(前대표이사)	2,078	-
고동진	고문(前대표이사)	2,612	-

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임

또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여

산정하였으며, 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 한종희	근로 소득	급여	626	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 77백만원, 3월 170백만원, 4월부터 6월까지 매월 101백만원을 지급
		상여	1,415	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2021년 CE부문 매출액 55.83조원, 영업이익 3.65조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 어려운 경영 환경에서도 MICRO LED, Lifestyle TV 등의

			혁신 상품으로 16년 연속 TV 시장 세계 1위를 유지하는 등 견조한 성장을 견인한 점을 고려, 상여금 산정
	주식매수선택권 행사이익	-	-
	기타 근로소득	31	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-
	기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
대표이사 경계현	근로 소득	급 여	524	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 53백만원, 3월 170백만원, 4월부터 6월까지 매월 83백만원을 지급
		상 여	434	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 추가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 SSD, eMMC 등 Flash 및 Solution 제품의 경쟁력 제고를 통해 Flash 메모리 20년 연속 1위 달성에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	32	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	
	기타소득	-	-	

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이 사 노태문	근로 소득	급 여	578	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 82백만원, 3월 131백만원, 4월부터 6월까지 매월 94백만원을 지급
		상 여	1,120	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 추가상승률 54.8%를 달성하였고, 2021년 IM부문 매출액 109.25조원, 영업이익 13.65조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 갤럭시 S시리즈, 플더블 등 모바일 분야 기술 혁신과 웨어러블 및 Note PC 수요에 적기 대응하였으며 프리미엄 판매 강화 등 수익성 강화에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
	주식매수선택권 행사이익	-	-	



	기타 근로소득	25	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-
	기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이 사 박학규	근로 소득	급 여	448	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 67백만원, 3월 94백만원, 4월부터 6월까지 매월 74백만원을 지급
		상 여	265	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2021년 전사 매출액 279.60조원, 영업이익 51.63조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 사업리스크의 선제적 관리, 자원 운영 고도화로 견실한 실적개선을 이끌었고, 미래 기술에 대한 전략적인 투자와 ESG 강화로 지속가능 경영의 기반을 공고화한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	64	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	
	기타소득	-	-	

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이 사 이정배	근로 소득	급 여	427	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 55백만원, 3월 110백만원, 4월부터 6월까지 매월 69백만원을 지급
		상 여	633	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성하였고, 2021년 DS부문 매출액 125.09조원, 영업이익 33.73조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 기술경쟁이 심화되는 상황에서 10나노급 DRAM, 6세대 V-NAND 등 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년, Flash 메모리 20년 연속 1위를

			달성하였고 세계 반도체 매출 1위 재탈환에 기여한 점을 고려, 성과급 산정
	주식매수선택권 행사이익	-	-
	기타 근로소득	52 등의	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 처우를 제공
	퇴직소득	-	-
	기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김기남	근로 소득	급 여	862	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 144백만원을 지급
		상 여	2,335	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 메모리 시장 리더십 수성과 System LSI, Foundry 등 비메모리 사업에 대한 적극적인 투자로 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	67	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	
	기타소득	-	-	

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김현석	근로 소득	급 여	439	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 73백만원을 지급
		상 여	1,622	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 소비자 가전업계간 심화된 경쟁 환경 속에서 Lifestyle TV, BESPOKE 가전 라인업 확대 등 혁신 제품을 통해 시장 주도권을 공고히 하였고 Operation 구조 개선을 통한 건전한 수익구조 구축에도 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	17	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	
	기타소득	-	-	

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
고동진	근로	급 여	468	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과

	소득			등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매 월 78백만원을 지급
		상여	2,126	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설상여 : 월급여 100% 지급</li> <li>· 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급</li> </ul> ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 갤럭시S21, 폴더블 등 모바일 분야 기술 혁신으로 시장을 선도하였으며 차세대 통신 기술 확보에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	18	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험</li> </ul> 등의 처우를 제공
		퇴직소득	-	-
기타소득	-	-		

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
김기남	회장	3,264	-
권오현	고문	3,122	-
윤부근	고문	2,614	-
고동진	고문	2,612	-
신종균	고문	2,606	-

※ 보수총액은 「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
김기남	근로소득	급여	862	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 144백만원을 지급
		상여	2,335	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 메모리 시장 리더십 수성과 System LSI, Foundry 등 비메모리 사업에 대한 적극적인 투자로 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	67	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	-
	기타소득	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
권오현	근로 소득	급여	375	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 63백만원을 지급
		상여	2,735	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 중장기 사업 방향 제시, 차세대 경영자 육성 등에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	12	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	
	기타소득	-	-	

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
윤부근	근로 소득	급여	311	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 52백만원을 지급
		상여	2,269	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 CE 미래기술 및 중장기 사업 방향 제시, 대외 사업적 리스크 센싱 등을 통해 경영에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	34	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	
	기타소득	-	-	

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
고동진	근로 소득	급여	468	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매 월 78백만원을 지급
		상여	2,126	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 갤럭시S21, 폴더블 등 모바일 분야 기술 혁신으로 시장을 선도하였으며 차세대 통신 기술 확보에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	18	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	-
	기타소득	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
신종균	근로 소득	급여	311	· 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 52백만원을 지급
		상여	2,269	· 설상여 : 월급여 100% 지급 · 장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균 연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도내에서 산정하여 3년간 분할지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 IM 미래기술 및 중장기 사업 방향 제시, 경영 인사이드 전파와 차세대 경영자 육성 등을 통해 회사의 인적자원 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	26	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공
	퇴직소득	-	-	-
	기타소득	-	-	-



## 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

2022년 반기말 현재 이사·감사·업무집행지시자 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	1	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
업무집행지시자	1,101	-	-
계	1,110	-	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

### 1. 계열회사의 현황

#### 가. 기업집단에 소속된 회사(요약)

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서, 2022년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 2개 회사(주에스에이치피코퍼레이션, 성균관대학교기술지주(주))가 증가하여 61개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 45개사입니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
삼성	16	45	61

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

## 나. 계열회사간 출자현황

[국내]

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : %)

피출자회사 \\ 출자회사	삼성물산 주	삼성바이 오로지스 주	삼성생명 보험주	삼성에스 디아이주	삼성에스 디에스주	삼성엔지 니어링주	삼성전기 주	삼성전자 주	삼성중공 업주	삼성증권 주	삼성카드 주	삼성화재 해상보험 주	㈜멀티캠 퍼스 퍼스
삼성물산주		43.1	19.3		17.1	7.0		5.0	0.1				
삼성바이오로지스주													
삼성생명보험주	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.1	8.7	3.0	29.4	71.9	15.0	0.0
삼성에스디아이주						11.7			0.4				
삼성에스디에스주													47.2
삼성전기주									2.1				
삼성전자주		31.2		19.6	22.6		23.7		15.2				
삼성중공업주													
삼성증권주													
삼성카드주													
삼성화재해상보험주						0.2		1.5					
㈜에스원													
㈜제일기획									0.1				
㈜호텔신라													
삼성디스플레이주													
삼성자산운용주													
삼성전자서비스주													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치													15.2
Harman International Industries, Inc.													
계	0.1	74.3	19.3	19.7	39.7	19.0	23.8	15.2	20.8	29.4	71.9	15.0	62.4

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : %)

피출자회사 출자회사	주에스원	주제일기획	주호텔신라	삼성디스플레이주	삼성메디슨주	삼성바이오오피스주	삼성벤처투자주	삼성생명서비스손해사정주	삼성선물주	삼성액티브자산운용주	삼성에스알에이자산운용주	삼성웰스토리주	삼성자산운용주
삼성물산주							16.7					100.0	
삼성바이오로직스주						100.0							
삼성생명보험주	5.4	0.3	7.4					99.8			100.0		100.0
삼성에스디아이주	11.0		0.1	15.2			16.3						
삼성에스디에스주													
삼성전기주							17.0						
삼성전자주		25.2	5.1	84.8	68.5		16.3						
삼성중공업주							17.0						
삼성증권주	1.3		3.1				16.7		100.0				
삼성카드주	1.9	3.0	1.3										
삼성화재해상보험주	1.0												
주에스원													
주제일기획													
주호텔신라													
삼성디스플레이주													
삼성자산운용주										100.0			
삼성전자서비스주													
주미라콤아이앤씨													
주삼성글로벌리서치													
Harman International Industries, Inc.													
계	20.7	28.6	17.0	100.0	68.5	100.0	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼성전자로 지택(주)	삼성전자서 비스(주)	삼성전자서 비스씨에스 (주)	삼성전자판 매(주)	삼성카드고 객서비스(주)	삼성코닝어 드밴스드글 라스(유)	삼성해지자 산운용(주)	삼성화재서 비스손해사 정(주)	삼성화재애 니카손해사 정(주)	세메스(주)	수원삼성축 구단(주)	스테코(주)
삼성물산(주)												
삼성바이오로직스(주)												
삼성생명보험(주)												
삼성에스디아이(주)												
삼성에스디에스(주)												
삼성전기(주)												
삼성전자(주)	100.0	99.3		100.0						91.5		70.0
삼성중공업(주)												
삼성증권(주)												
삼성카드(주)					100.0							
삼성화재해상보험(주)								100.0	100.0			
(주)에스원												
(주)제일기획											100.0	
(주)호텔신라												
삼성디스플레이(주)						50.0						
삼성자산운용(주)							100.0					
삼성전자서비스(주)			100.0									
(주)미라콤아이앤씨												
(주)삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.												
계	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	91.5	100.0	70.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : %)

피출자회사 \ 출자회사	신라에이치 엠㈜	에스디플렉 스㈜	에스비티엠 ㈜	에스원씨알 엠㈜	에스유머티 리얼스㈜	에스코어㈜	에스티엠㈜	에이치디씨 신라면세점 ㈜	오픈핸즈㈜	제일패션리 테일㈜	㈜미라콤아 이앤씨	㈜삼성글로벌리서치
삼성물산㈜										100.0		1.0
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜												14.8
삼성에스디아이㈜		50.0					100.0					29.6
삼성에스디에스㈜						81.8			100.0		83.6	
삼성전기㈜												23.8
삼성전자㈜												29.8
삼성중공업㈜												1.0
삼성증권㈜												
삼성카드㈜												
삼성화재해상보험㈜												
㈜에스원				100.0		0.6					0.6	
㈜제일기획						5.2					5.4	
㈜호텔신라	100.0		100.0					50.0				
삼성디스플레이㈜					50.0							
삼성자산운용㈜												
삼성전자서비스㈜												
㈜미라콤아이앤씨						0.5						
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International Industries, Inc.												
계	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	88.1	100.0	50.0	100.0	100.0	89.6	100.0

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

피출자회사 \ 출자회사	주삼성라이 온즈	주삼성생명 금융서비스 보험대리점	주삼성화재 금융서비스 보험대리점	주삼우종합 건축사사무 소	주서올레이 크사이드	주시큐아이	주씨브이네 트	주에스에이 치피코퍼레 이션	주하만인터 내셔널코리 아	주휴먼 티에스에스
삼성물산주				100.0	100.0	8.7	40.1			
삼성바이오로직스주										
삼성생명보험주		100.0								
삼성에스디아이주										
삼성에스디에스주						56.5	9.4			
삼성전기주										
삼성전자주										
삼성중공업주										
삼성증권주										
삼성카드주										
삼성화재해상보험주			100.0							
주에스원										100.0
주제일기획	67.5									
주호텔신라								100.0		
삼성디스플레이주										
삼성자산운용주										
삼성전자서비스주										
주미라콤아이앤씨										
주삼성글로벌리서치										
Harman International Industries, Inc.									100.0	
계	67.5	100.0	100.0	100.0	100.0	65.2	49.5	100.0	100.0	100.0

\* 지분율은 보통주 기준입니다.

[해외]

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : %)

출자회사	피출자회사	지분율(%)
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO AUSTIN INC	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO (KL) SDN. BHD.	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	100.0
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Equipment Trading Solutions Group, LLC	70.0
Samsung C&T America Inc.	FLOWFY COMMERCE SERVICE LLC	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Belle River Wind LP	42.5
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	North Kent Wind 1 LP	35.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	South Kent Wind LP Inc.	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0



Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	Monument Power, LLC	100.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 2 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 3, LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung Solar Energy 3, LLC	SST SOLAR, LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	100.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, S.R.O	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	99.7
Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	70.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3

Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	0.2
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	65.2
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	100.0
CHEIL HOLDING INC.	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	75.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	6.8
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
삼성전자(주)	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자(주)	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Asia Pte. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0

삼성전자(주)	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성바이오로지스(주)	Samsung Biologics America, Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis United States Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis NL B.V.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis TW Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis HK Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Slovakia, s.r.o.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Noida Private Limited	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novald GmbH	9.9
세메스(주)	SEMES America, Inc.	100.0
세메스(주)	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Dacor Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	TeleWorld Solutions, Inc.	100.0

Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Dacor, Inc.	100.0
Dacor, Inc.	Dacor Canada Co.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Financial Group LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International, SCA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International GP S.a.r.l	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services AB.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Harman Financial Group LLC	Harman International (India) Private Limited	0.0
Harman Financial Group LLC	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.1
Harman Financial Group LLC	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3

Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkey	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Ukraine	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Corephotonics Ltd.	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman International s.r.o	100.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Deutschland GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Apostera GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. KG	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management GmbH	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services GmbH	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0

Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Finance International GP S.a.r.l	Harman Finance International, SCA	0.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics GmbH	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Harman France SNC	0.0
Harman Connected Services AB.	Harman Finland Oy	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman Automotive UK Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Apostera GmbH	Apostera UA, LLC	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Zhilabs, S.L.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	FOODIENT LTD.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novald GmbH	40.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.4

Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	43.1
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	98.4
Red Bend Ltd.	Red Bend Software Ltd.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Samsung Electronics Panama. S.A.	100.0
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	0.0
삼성에스디아이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Hungary., Zrt.	100.0

삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI India Private Limited	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	65.0
삼성에스디아이(주)	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	80.0
삼성에스디아이(주)	Novald GmbH	50.1
삼성에스디아이(주)	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0
삼성에스디아이(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI India Private Limited	0.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics GmbH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	99.9
삼성전기(주)	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	0.1
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	100.0
삼성화재해상보험(주)	PT. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	75.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험 (중국) 유한공사	100.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0



삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Rus LLC	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험(주)	Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	48.9
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산(주)	QSSC, S.A. de C.V.	80.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Lima S.A.C.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산(주)	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산(주)	POSS-SLPC, S.R.O	50.0
삼성물산(주)	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산(주)	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산(주)	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산(주)	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산(주)	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	93.0
삼성물산(주)	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	34.8
삼성물산(주)	Samsung C&T India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산(주)	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	100.0
삼성물산(주)	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	70.0
삼성물산(주)	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	100.0

삼성물산(주)	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	25.0
삼성물산(주)	CHEIL HOLDING INC.	40.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	30.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	10.0
삼성물산(주)	Cheil Industries Corp., USA	100.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성물산(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	81.6
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	82.4
Pengtai Greater China Company Limited	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	100.0
Pengtai Greater China Company Limited	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Medialytics Inc.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Neo EXpress Transportation (NEXT) Inc.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0

삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Australia Pty.,Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	50.0
삼성에스디에스(주)	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	99.7
삼성에스디에스(주)	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	100.0
(주)미라콤아이앤씨	MIRACOM INC ASIA PACIFIC LIMITED	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	0.3
Samsung SDS Europe, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	0.0
Samsung SDS China Co., Ltd.	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	100.0
Samsung SDS China Co., Ltd.	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Inc.	100.0

삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Hungary Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Italy S.R.L.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Limited	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Muharrag Wastewater Services Company W.L.L.	99.8
삼성엔지니어링(주)	Muharrag STP Company B.S.C.	6.6
삼성엔지니어링(주)	Muharrag Holding Company 1 Ltd.	65.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.A	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharrag Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering India Private Limited	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharrag Holding Company 1 Ltd.	Muharrag Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharrag Holding Company 2 Ltd.	Muharrag STP Company B.S.C.	89.9
Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	49.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	Iris Worldwide Holdings Limited	100.0
(주)제일기획	CHEIL EUROPE LIMITED	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	CHEIL SPAIN S.L	100.0
(주)제일기획	Cheil Benelux B.V.	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Private Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0

(주)제일기획	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
(주)제일기획	Cheil New Zealand Limited	100.0
(주)제일기획	CHEIL CHINA	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
(주)제일기획	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa (Pty) Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	100.0
(주)제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Egypt LLC	99.9
(주)제일기획	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	100.0
(주)제일기획	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	98.0
(주)제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
(주)제일기획	Cheil Peru S.A.C.	100.0
(주)제일기획	CHEIL ARGENTINA S.A.	98.0
(주)제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
(주)호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Taiwan Limited	64.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
에스비티엠(주)	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
삼성벤처투자(주)	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris (USA) Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	89 Degrees, Inc.	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Private Limited	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	2.0
Iris Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0

Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	98.6
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Korea Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Culture Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Concise Consultants Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Atom42 Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	WDMP Limited	49.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions (UK) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte. Ltd.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Sydney PTY Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper Technologies Pte. Ltd.	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Beattie McGuinness Bungay Limited	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Germany GmbH	Centrade Integrated SRL	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil HU Kft.	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	100.0
Cheil India Private Limited	Experience Commerce Software Private Limited	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	Pengtai Greater China Company Limited	95.7
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	100.0
Cheil Hong Kong Ltd.	Pengtai Greater China Company Limited	3.1
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Retail Limited	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ-LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil MEA FZ-LLC	Cheil Egypt LLC	0.1
Cheil South Africa (Pty) Ltd	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa (Pty) Ltd	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0

One Agency FZ-LLC	One RX India Private Limited	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	100.0
One Agency FZ-LLC	One Agency South Africa (Pty) Ltd	100.0
ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	One RX India Private Limited	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	CHEIL ARGENTINA S.A.	2.0

## 다. 관련법령상의 규제내용 등

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기: 2022년 5월 1일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

## 라. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

겸직자		계열회사 겸직현황		
성명	직위	기업명	직위	상근 여부
김용관	부사장	삼성메디슨(주)	대표이사	상근
김연성	부사장	삼성전자판매(주)	감사	비상근
		삼성전자로지텍(주)	감사	비상근
		삼성전자서비스(주)	감사	비상근
유승호	부사장	삼성메디슨(주)	감사	비상근
최정준	부사장	삼성벤처투자(주)	감사	비상근
유한종	상무	(주)삼성글로벌리서치	감사	비상근
조기재	부사장	삼성디스플레이(주)	감사	비상근
김현우	부사장	세메스(주)	감사	비상근
김명철	부사장	세메스(주)	기타비상무이사	비상근
성덕용	상무	세메스(주)	기타비상무이사	비상근
오재균	상무	스टे코(주)	감사	비상근
박동욱	상무	스टे코(주)	기타비상무이사	비상근



## 2. 타법인 출자 현황(요약)

2022년 반기말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 58조 8,671억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	20	78	98	57,768,459	1,136,615	-144,558	58,760,516
일반투자	0	0	0	0	0	0	0
단순투자	4	38	42	121,807	6,401	-21,596	106,612
계	24	116	140	57,890,266	1,143,016	-166,154	58,867,128

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

## X. 대주주 등과의 거래내용

### 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2022년 반기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채우자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	1,328,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.08.20	2023.06.13	906,000	865,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	310,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2021.09.30	2022.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.12.17	2023.06.13	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.12.17	2023.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	807,000	807,000	102,275	127,907	230,182	28.6%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	130,000	130,000	33,334	65	33,399	30.4%
SECE	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.07.19	2022.12.16	73,722	72,811	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.05.31	877,579	824,834	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	141,000	342,000	-	129,096	129,096	8.3%
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	120,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.09.06	2023.06.13	712,400	833,400	-	-	-	
SERK	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.07.13	2023.06.13	290,000	140,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	15,600	15,600	10,947	△1,120	9,827	1.3%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	345,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	50,000	50,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자 율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.05.31	15,000	-	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	-	35,000	-	-	-	
합 계							8,265,301	8,211,645	146,556	255,948	402,504	

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2021년 중 US\$ 266천의 수수료를 청구하였으며, 2022년 중 수취하였습니다.

## 2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2022년 반기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 국내 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각·매입	2022.05.30	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	6,743	4,266
SEHC	계열회사	자산매각·매입	2022.03.31	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	3,129	255
SESS	계열회사	자산매각·매입	2022.05.20	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	5,142	639
SAS	계열회사	자산매입	2022.03.22	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	1,430	-
SII	계열회사	자산매각	2022.05.09	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	216	△10
SEVT	계열회사	자산매입	2022.05.25	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	59	-
삼성메디슨㈜	계열회사	자산매각	2022.03.17	기계장치 등	생산설비 증설·생산효율화 등	5	5

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일·30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

### 3. 대주주와의 영업거래

당사는 2022년 반기 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출·입 등	2022.01~2022.06	반도체 매출 등	22,965,745
SEVT	계열회사	매출·입 등	2022.01~2022.06	HHP 매출·입 등	19,530,524
SEA	계열회사	매출·입 등	2022.01~2022.06	HHP 및 가전제품 매출·입 등	18,873,494
SEV	계열회사	매출·입 등	2022.01~2022.06	HHP 매출·입 등	11,207,262
SSS	계열회사	매출·입 등	2022.01~2022.06	반도체 매출 등	10,266,093

※ 별도 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

### 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2022년 반기말 현재 제품경쟁력 제고, 상생경영을 위한 협력사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,471억원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	대여금 변동 내역		
			기초	증감	기말
주이랜텍 등	협력업체 및 종업원	단기대여금	42,999	2,188	45,187
범진아이엔디(주) 등	협력업체 및 종업원	장기대여금	71,604	30,330	101,934
합 계			114,603	32,518	147,121

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 대여금은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

### 2. 우발부채 등에 관한 사항

#### 가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자(주), 삼성디스플레이(주))는 삼성디스플레이(주)의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

## 나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	1,328,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.08.20	2023.06.13	906,000	865,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	310,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2021.09.30	2022.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.12.17	2023.06.13	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.12.17	2023.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	807,000	807,000	102,275	127,907	230,182	28.6%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	130,000	130,000	33,334	65	33,399	30.4%
SECE	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.07.19	2022.12.16	73,722	72,811	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.05.31	877,579	824,834	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	141,000	342,000	-	129,096	129,096	8.3%
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	120,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.09.06	2023.06.13	712,400	833,400	-	-	-	
SERK	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.07.13	2023.06.13	290,000	140,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	15,600	15,600	10,947	△1,120	9,827	1.3%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	345,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2023.06.13	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	50,000	50,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자 율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.05.31	15,000	-	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2022.06.14	2023.06.13	-	35,000	-	-	-	
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 등	지급보증	운영자금	2015.05.27	2022.03.01	396,304	-	396,304	△396,304	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2020.01.03	2024.11.22	671,908	633,352	571,121	△32,772	538,349	5.8%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무 소멸시	-	340,000	-	-	-	
합 계							9,333,513	9,184,997	1,113,981	△173,128	940,853	

※ 연결 기준입니다. Harman Finance International, SCA 건은 Harman International Industries, Inc.,

[△는 부(-)의 값임]

SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2021년 중 US\$266천의 수수료를 청구하였으며, 2022년 중 수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2021년 중 US\$2,529천 수수료를 청구하였으며, 2022년 중 수취하였습니다.



### 3. 제재 등과 관련된 사항

#### 가. 수사·사법기관의 제재현황

[요약]

(단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	형량·배임등 금액	근거 법령
2019.04.18	서울중앙지방법원	당사 임직원	벌금	100	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조 제4항, 제68조 제4호
2019.12.09	서울중앙지방법원 (항소심 진행 중)	당사 임직원	징역	-	-	「형법」 제155조 제1항, 제31조 제1항, 제30조
2020.02.14	수원지방법원	당사 및 당사 임직원	벌금	12	-	「구.산업안전보건법」 제23조, 제24조, 제29조, 제67조, 제68조, 제70조, 제71조 등
2021.01.25	서울고등법원 (파기환송심)	당사 임직원	징역	-	약 8,681	「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」
2021.02.04	대법원	당사 임직원	징역	-	-	「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등
		자회사 및 임직원 (삼성전자서비스㈜)	벌금, 징역	50	-	「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등, 「조세범처벌법」 제10조
2022.07.07	광주지방법원	당사 임직원	벌금	6	-	「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제33조 7호, 제34조, 제18조 1항 등

공정거래위원회는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조 제4항에 따른 2014년도 기업집단 지정자료 제출 시 (주)삼우종합건축사사무소 및 (주)서영엔지니어링을 기업집단 「삼성」 소속회사에서 누락한 허위의 자료를 제출했다는 이유로, 2018년 11월 21일 당사 임원 이건희 회장을 고발 조치하였으며, 이에 따라 검찰은 이건희 회장을 약식기소하였습니다.

서울중앙지방법원은 위 혐의를 인정하여 이건희 회장에게 2019년 4월 18일 일억원의 벌금 납입을 명령하였으며, 이건희 회장은 위 벌금을 납입하였습니다.

서울중앙지방법원은 2019년 12월 9일 당사 임원이 삼성바이오로직스(주) 회계부정 의혹 사건에 관한 증거를 인멸·은닉하도록 삼성바이오로직스(주)와 삼성바이오에피스(주) 임직원을 교사했다는 혐의 일부를 인정하여 「형법」 제155조 제1항, 제31조 제1항, 제30조 위반으로 K부사장(근속연수 27년) 징역 1년 6개월, L부사장(근속연수 31년) 징역 1년 6개월, M부사장(근속연수 9년) 징역 2년, N상무(근속연수 16년) 징역 1년 6개월(3년간 집행유예), O상무(근속연수 10년) 징역 1년 6개월(3년간 집행유예)을 각 선고하였습니다. 이 사건은 현재 항소심 재판이 진행 중으로, 당사는 향후 진행 상황을 확인할 예정입니다.

수원지방법원은 2018년 9월 4일 발생한 기흥사업장의 이산화탄소 누출사고와 관련하여, 2020년 2월 14일 「구.산업안전보건법」 제23조(안전조치), 제24조(보건조치), 제29조(도급사업 시의 안전·보건조치) 등 위반으로 당사에 벌금(7백만원)과 당사 임원 1명(안전보건총괄책임자 P부사장, 근속연수 27년)에게 벌금(5백만원)을 선고하였으며, 당사 및 당사 임원은 위 벌금을 납입하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 임직원 및 협력사의 안전보건 역량 강화 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

대법원은 '박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건'에서 당사 임원 5명(이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무)의 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(횡령) 등의 혐의와 관련하여, 2019년 8월 29일 고등법원의 원심판결 중 일부를 파기하고 서울고등법원에 환송하였습니다. 서울고등법원은 2021년 1월 18일 파기 환송심에서 이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장에 대해 징역 2년 6개월, 박상진 前사장, 황성수 前전무에 대해 징역 2년 6개월(집행유예 4년)을 선고하였으며, 위 판결은 2021년 1월 25일 확정되었습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 대외 후원금 집행 관련 프로세스를 강화하고 외부 독립 조직인 삼성 준법감시위원회를 신설하였습니다.

대법원이 2021년 2월 4일 당사 및 당사 임직원의 「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등 위반 혐의에 관해 상고기각 판결을 내림에 따라 서울고등법원이 2020년 8월 10일 선고한 당사 A부사장(근속연수 29년) 징역 1년 4개월, B前부사장 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), C부사장(근속연수 34년) 징역 10개월(2년간 집행유예), D前부사장 징역 1년(2년간 집행유예), E전무(근속연수 32년) 징역 1년, F전무(근속연수 24년) 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), G상무(근속연수 27년) 징역 10개월(2년간 집행유예), H상무(근속연수 18년) 징역 10개월(2년 집행유예)형이 확정되었고, 당사 및 당사의 前이사회 의장(근속연수 39년) 등은 무죄로 확정되었습니다. 또한 위 사건에서 자회사 삼성전자서비스(주) 및 임직원의 「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등 위반과 허위 세금 계산서 수수에 대한 「조세범처벌법」 제10조 위반(위반금액 약 1,678백만원) 혐의에 대해 삼성전자서비스(주) 벌금 50백만원(추징세액 약 97백만원), 삼성전자서비스(주) 前대표이사(근속연수 4년) 징역 1년 4개월, I전무(근속연수 11년) 징역 1년, J상무(근속연수 21년) 징역 10개월(2년간 집행유예)의 형이 확정되었습니다. 당사는 행동규범 등에 노동3권 보장을 명시하고 부당노동행위 예방 관련 전 임직원 교육을 실시하는 등 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다.

광주지방법원 순천지원은 2021년 1월 20일 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반으로 당사 직원 A프로(근속연수 11년), B프로(근속연수 8년)에게 각 벌금(3백만원)을 선고하였고, 광주지방법원은 2022년 7월 7일 이 사건 항소심에서 항소 기각 판결을 선고하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

## 나. 행정기관의 제재현황

### (1) 공정거래위원회의 제재현황

[요약]

(단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2018.10.04	공정거래위원회	당사	시정명령, 과징금	488	「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제3조 제2항
2018.11.21	공정거래위원회	당사 임직원	검찰고발	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항
2019.08.23	공정거래위원회	당사	시정조치, 과태료	0.5	「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제5조 제4항(온라인 완결서비스 제공의무), 제10조 제1항(사이버몰 운영자의 표시의무)
2021.06.22	공정거래위원회	당사 및 당사 임직원	검찰고발	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.08.27.	공정거래위원회	당사	시정조치 과징금	101,217	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
		자회사 (삼성디스플레이㈜)	시정조치 과징금	22,857	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호
2021.11.17	공정거래위원회	자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜)	과태료	2.4	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시)
2022.03.17	공정거래위원회	당사 임직원	경고	-	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항
2022.06.27	공정거래위원회	당사	과태료	10	「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항

공정거래위원회는 당사의 공기청정기 등 공기청정 제품에 대한 광고와 관련하여, 2018년 10월 4일 당사에 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제3조 제2항 위반으로 시정명령 및 과징금(488백만원)을 부과 처분하였으며, 당사는 이를 납부하였습니다. 위 부과 처분의취소를 구하는 소송에서 대법원은 2021년 3월 11일 당사 일부 승소 판결을 선고하였습니다.

공정거래위원회는 2018년 11월 21일 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항에 따른 2014년도 기업집단 지정자료 제출 시 (주)삼우종합건축사사무소 및 (주)서영엔지니어링을 기업집단 「삼성」 소속회사에서 누락한 허위의 자료를 제출했다는 이유로 당사 임원 이건희 회장을 고발 조치하였습니다.

※ 처벌 내용 등 자세한 사항은 '가. 수사·사법기관의 제재현황'을 참조하시기 바랍니다.

공정거래위원회는 밀크 음원서비스와 관련하여, 2019년 8월 23일 당사에 「전자상거래 등에  
서의 소비자보호에 관한 법률」 제5조 제4항(온라인 완결서비스 제공의무) 및 제10조 제1항  
(사이버몰 운영자의 표시의무) 위반으로 시정조치 및 과태료(50만원)을 부과 처분하였으며,  
당사는 이를 납부하였습니다.

공정거래위원회는 2021년 6월 22일 삼성웰스토리(주)와의 단체급식 거래와 관련하여 검찰에  
당사 및 퇴직 임원인 최지성 전 미래전략실장을 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제  
23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 위반 혐의로 고발하였습니다.

또한 당사와 삼성디스플레이(주)는 삼성웰스토리(주)와의 단체급식 거래와 관련하여  
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조 제1항 제7호 위반 혐의로 공정거래위원회로  
부터 2021년 8월 27일 시정조치 및 과징금(당사: 1,012억 17백만원, 삼성디스플레이(주):  
228억 5천 7백만원) 처분을 받았습니다. 동 처분에 대해 현재 행정소송이 진행 중이며, 시정  
조치에 대해 2022년 1월 27일 집행정지 결정이 확정되었습니다.

공정거래위원회는 2021년 11월 5일 당사의 자회사인 삼성전자서비스씨에스(주)의 대규모 기  
업집단 현황 공시 자진 정정공시(이사회 구성원 누락) 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관  
한 법률」 제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시) 위반으로 과태료(2.4백만원)를 부과하였  
으며, 삼성전자서비스씨에스(주)는 2021년 11월 17일 이를 납부하였습니다. 삼성전자서비스  
씨에스(주)는 재발 방지를 위하여 담당자 추가 배치 등 내부관리 기준을 강화하여 관련 법규  
준수를 위해 노력하고 있습니다.

공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제31조 제4항에 따른 2018년과  
2019년 지정자료 제출시 삼성카드(주)의 사외이사가 지배하는 회사인 발백케이피엘코리아(주),  
발백케이피엘파트너스(주), 발백케이피엘자산운용(주) 3개사를 상호출자제한기업집단 「삼성」  
의 소속회사에서 누락했다는 이유로 2022년 3월 17일 당사의 이재용 부회장에 대해 「경고  
」 처분 하였습니다.

당사는 2022년 6월 27일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제5조  
(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 위반 혐의로 과태료 1천만원을 부과 받았으며, 이에  
대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

당사는 공정거래법, 표시광고법, 대리점법 등 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고  
임직원에게 대해 관련 예방교육을 시행하고 있습니다.

## (2) 기타 행정·공공기관(금융감독·과세 당국 등 포함)의 제재현황

[요약]

(단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2019.01.18	용인소방서	당사 (기흥사업장)	과태료	0.5	「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조 (특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항
2019.01.03 ~2022.02.23	고용노동부	당사 (평택, 온양, 천안, 기흥·화성사업장)	과태료	14.7	「구.산업안전보건법」 제48조(유해·위험 방지 계획서의 제출 등) 제1항, 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등
2019.12.02 ~2020.12.28	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	386.3	「구.산업안전보건법」 제41조(물질안전보건자료의 작성·비치 등) 제3항, 제10조(산업재해 발생 기록 및 보고 등) 제2항 등, 「산업안전보건법」 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항, 제164조(서류의 보존) 제1항 등
2021.03.02	환경부	당사 (광주사업장)	녹색기업 지정취소	-	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호
2021.08.10	법무부	당사	과태료	0.1	「출입국관리법」 제19조(외국인을 고용한 자 등의 신고의무)
2020.07.08	방송통신위원회	자회사 (삼성전자판매㈜)	시정명령, 과태료	36	「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제3조(지원금의 차별 지급 금지) 제1항, 제4조(지원금의 과다 지급 제한 및 공시) 제5항
2020.09.18	고용노동부	자회사 (삼성전자판매㈜)	공사중지명령, 과태료	5	「산업안전보건법」 제55조(중대재해 발생 시 고용노동부장관의 작업중지 조치), 제68조(안전보건조정자) 제1항
2021.04.01	고용노동부	자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜)	과태료	1	「고용보험법」 제15조(피보험자격에 관한 신고 등)
2021.09.29	고용노동부	자회사 (삼성전자서비스㈜)	부분작업중지 명령 과태료	14	「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제53조(고용노동부장관의 시정조치 등) 제3항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항
2021.11.23	고용노동부	자회사 (삼성디스플레이㈜)	과태료	0.2	「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항

당사는 2018년 9월 4일 발생한 기흥사업장의 이산화탄소 누출사고와 관련하여, 2018년 11월 27일부터 12월 6일까지 진행된 용인소방서의 소방특별조사에 따라 2019년 1월 18일 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항 위반으로 과태료(50만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 법적 안전검사 관리시스템을 구축하고 검사 주기를 강화하는 등 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2018년 9월 10일부터 9월 13일까지 진행된 평택사업장(P1-2)에 대한 고용노동부의 PSM 심사(2차)와 관련하여, 2019년 1월 3일 「구.산업안전보건법」 제48조(유해·위험 방지 계획서의 제출 등) 제1항 위반으로 과태료(10백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 2월 19일 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 2월 25일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(20만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 5월 26일부터 5월 28일까지 진행된 천안사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 6월 29일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(90만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 11월 16일부터 11월 18일까지 진행된 평택사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 11월 26일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(2.1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 12월 7일부터 12월 11일까지 진행된 기흥·화성사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 12월 14일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(90만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2022년 2월 21일부터 2월 23일까지 진행된 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태 정기평가와 관련하여 PSM 평가 등급은 한 단계 향상되었으나, 4월 21일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(60만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부에 개선 결과를 제출하였으며, PSM 혁신조직을 신설하여 인허가, 설계 반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2019년 11월 28일 광주사업장에 대한 고용노동부의 MSDS 경고표시 이행실태 감독과 관련하여, 2019년 12월 2일 「구.산업안전보건법」 제41조(물질안전보건자료의 작성·비치 등) 제3항 등 위반으로 과태료(1.4백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 화학물질 취급 장소에 대하여 전수조사 및 개선 조치하였으며, G-EHS 신규 화학물질의 사전평가 Process를 개선하고 화학 물질 사용부서 관리감독자를 교육하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2020년 5월 19일 광주사업장에서 발생한 산업재해와 관련하여, 고용노동부 광주지방고용노동청에 산업재해조사표를 지연 보고하여 2020년 6월 26일 「산업안전보건법」 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 위반으로 과태료(7백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 현장 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2020년 8월 18일부터 2021년 1월 18일까지 진행된 광주사업장에 대한 고용노동부 광주지방고용노동청의 현장조사 중 2015년부터 광주사업장에서 발생한 산업재해와 관련하여, 2020년 9월 1일 「구.산업안전보건법」 제10조(산업재해 발생 기록 및 보고 등) 제2항 위반으로 과태료(6백만원)가 발생하였고, 2020년 9월 10일과 9월 23일 「산업안전보건법」 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 및 제164조(서류의 보존) 제1항 위반으로 과태료(60.4백만원과 11.5백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 또한 2020년 10월 19일 「산업안전보건법」 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항 위반으로 과태료(20백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였으며, 2020년 12월 28일 「구.산업안전보건법」 제10조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제2항 위반으로 과태료(280백만원)가 발생하여 납부 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 현장 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2018년 녹색기업으로 지정된 광주사업장에 대해 2021년 3월 2일 환경부 영산강유역환경청으로부터 대기오염물질 측정값과 관련하여 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호를 이유로 녹색기업 지정취소를 통보받았습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.



당사는 2021년 8월 10일 「출입국관리법」 제19조 1항(외국인을 고용한 자 등의 신고의무)에 따른 외국인 고용 변동사실 신고의무를 위반하여 수원출입국·외국인청으로부터 과태료(10만원)가 발생하였으며, 자진납부 완료하였습니다. 당사는 퇴직프로세스 개선을 통해 외국인 퇴직자의 고용변동 신고기한을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자판매(주)는 2020년 7월 8일 방송통신위원회로부터 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제3조(지원금의 차별 지급 금지) 제1항, 제4조(지원금의 과다 지급 제한 및 공시) 제5항 위반으로 시정명령 및 과태료(36백만원) 부과 처분을 받아 납부하였습니다. 삼성전자판매(주)는 관련 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 대해 예방교육 등을 시행하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자판매(주)는 2020년 9월 16일 삼성디지털프라자 홍대점 신설 공사 현장에서 엘리베이터 벽체 공사 중 작업자가 사망한 사고와 관련하여, 2020년 9월 17일 현장 조사 후 고용노동부 서울지방고용노동청 서울서부지청으로부터 9월 18일 「산업안전보건법」 제55조(중대재해 발생 시 고용노동부장관의 작업중지 조치)에 따라 공사중지 명령을 받았고 「산업안전보건법」 제68조(안전보건조정자) 제1항 위반으로 과태료(5백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였으며, 이후 안전보건 조정자를 선임하였습니다. 삼성전자판매(주)는 재발 방지를 위하여 현장 안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스씨에스(주)는 고용보험 취득신고를 지연 신고하여 고용노동부 중부지방고용노동청으로부터 2021년 4월 1일 「고용보험법」 제15조(피보험자격에 관한 신고 등) 위반으로 과태료(1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 삼성전자서비스씨에스(주)는 재발 방지를 위하여 고용보험법 개정사항에 대해 주기적으로 검토하고 담당자 실무 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스(주)는 2021년 9월 28일 세탁기 수리 중 발생한 작업자의 감전사와 관련하여, 2021년 9월 29일 고용노동부 서울지방고용노동청 서울남부지청으로부터 「산업안전보건법」 제53조(고용노동부장관의 시정조치 등)에 따른 부분작업중지 명령을 받았습니다. 이에 삼성전자서비스(주)는 전국 사업장에 대한 안전보건조치 개선 대책(안)을 제출하여 2021년 11월 10일부로 부분작업중지명령이 해제되었습니다. 또한 2021년 11월 15일 「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항 등 위반으로 과태료 14백만원이 발생하였으며, 2021년 12월 28일 과태료를 자진납부 완료하였습니다.

삼성디스플레이(주)는 2021년 11월 15일부터 11월 16일까지 진행된 기흥사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여 2021년 11월 23일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료 16만원이 발생하였으며, 자진 납부 완료 하였습니다.

**다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황**

해당사항 없습니다

**라. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항**

해당사항 없습니다.

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

### 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

### 나. 대외후원 현황

현황	금액	내용	비고
삼성공장학재단 기부금 출연	11.2억원	· 저소득층 고등학생 학습지원	2020.01.30 이사회 결의
2020년 사회공헌 매칭기금 운영계획	118.9억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2020년 회사매칭기금으로 118.9억원 운영 · 청소년 교육 관련 사회공헌 활동에 사용	2020.02.21 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	25.76억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
코로나19 관련 긴급 구호지원	230억원	· 코로나19 관련 피해자 및 지역사회 긴급 구호지원	2020.02.26 이사회 결의
삼성복지재단 등 기부금 출연	518억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 106억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 메르스 백신개발 연구 지원 (삼성생명공익재단, 265억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 147억원)	2020.04.29 이사회 결의
DS 부문 우수협력사 인센티브	약 620억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS 부문 상주 1, 2차 협력회사 중 중소기업	
호암재단 기부금 출연	41억원	· 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상	2020.05.27 이사회 결의
희망2021나눔캠페인 기부금 출연	338억원	· 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2020.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	\$1,421,154 (약 15.7억원)	· UNDP(United Nations Development Programme)에 전달하여 각 국의 구호 활동 등에 활용	
2021년 사회공헌 매칭기금 운영계획	116.1억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2021년 회사매칭기금으로 116.1억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2021.02.16 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	24.46억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	601억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 115억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 응급헬기 운영 지원 (삼성생명공익재단, 299억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 37억원)	2021.04.29 이사회 결의
DS 부문 우수협력사 인센티브	약 632억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
국제기능올림픽	150만 유로	· 제46회 중국 상하이 국제기능올림픽대회 및	2021.10.28

후원	(약 20.9억원)	국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	이사회 결의
공동투자형 기술개발 협약기금 출연	150억원	· 중소기업부 주관 공동투자형 기술개발사업 참여 · 중소기업부와 협약기금을 조성, 협약기금은 중소기업이 제안한 로봇·AI / 바이오헬스 / 시스템 반도체, 소재부품장비 국산화 관련 과제 평가 후 최종 선정된 중소기업에 지급	2021.10.28 이사회 결의
희망2022 나눔캠페인 기 부금 출연	256억원	· 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연	2021.11.30 이사회 결의
Samsung Global Goals 기부금 출연	\$2,689,094 (약 32.0억원)	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용	2021.11.30 이사회 결의
2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획	117.5억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2022년 회사매칭기금으로 117.5억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2022.02.15 이사회 결의
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	23.24억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
삼성복지재단 등 기부금 출연	468억원	· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 44억원) · 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 232억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 42억원)	2022.04.28 이사회 결의
DS부문 우수협력사 인센티브	약 740억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	

※ 대외후원 현황 및 금액은 이사회 결의 기준으로 기재하였습니다.

## 다. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기업 지정' 및 '녹색기술 인증'을 확대하고 있습니다. 특히 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스배출량'과 '에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

### (녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 2022년 반기말 현재(별도 기준) 수원사업장, 구미사업장, 기흥·화성사업장, 평택사업장, 온양사업장이 녹색기업으로 지정되어 있습니다. 한편, 2021년 3월 광주사업장은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.

### (녹색기술 인증)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조(녹색기술·녹색산업의 표준화 및 인증 등) 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업 활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트(Planet First) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과, 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2022년반기말 현재 총 10건의 유효 녹색기술 인증을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 인증 받은 녹색기술이 적용된 상용화 제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증을 총 123개 모델에 대해서 보유 중입니다.

2022년 반기말 현재 녹색기술 인증 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

부문	녹색기술인증	건수
DX 부문	고효율 전력 변환 기술을 활용한 노트북 대기전력 저감기술, 고효율 히트펌프와 열교환기를 적용한 의류건조기 에너지 효율 향상 기술, 모니터 대기전력 저감 기술 등	10

※ 별도 기준입니다.

### (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3차 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO<sub>2</sub>-eq, TJ)

구 분	2021년	2020년	2019년
온실가스(tCO <sub>2</sub> -eq)	14,494,447	12,532,779	11,143,405
에너지(TJ)	200,500	177,122	161,123

※ 별도 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당합니다.

## XII. 상세표

### 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사의 연결대상 종속기업은 2022년 반기말 현재 233개사입니다. 전년말 대비 6개 기업이 증가하고 1개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	1978. 07	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA	전자제품 판매	42,982,054	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	O
Samsung International, Inc. (SII)	1983. 10	9335 Airway Rd. #105, San Diego, California, USA	전자제품 생산	2,064,637	상동	O
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	1988. 03	Parque Ind., El Florido 1ra y 2da Secc., Tijuana, B.C., Mexico	전자제품 생산	63,019	상동	X
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	2017. 08	284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina, USA	가전제품 생산	763,537	상동	O
Samsung Research America, Inc (SRA)	1988. 10	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	R&D	748,415	상동	O
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	해외자회사 관리	177,851	상동	O
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	신기술사업자, 벤처기업 투자	248,020	상동	O
NeuroLogica Corp.	2004. 02	14 Electronics Ave., Danvers, Massachusetts, USA	의료기기 생산 및 판매	211,236	상동	O
Samsung HVAC America, LLC	2001. 07	3001 Northern Cross Blvd. #361, Fort Worth, Texas, USA	에어컨공조 판매	59,622	상동	X
Joyent, Inc.	2005. 03	655 Montgomery St. #1600, San Francisco, California, USA	클라우드서비스	180,789	상동	O
Dacor Holdings, Inc.	1998. 12	14425 Clark Ave., City of Industry, California, USA	해외자회사 관리	27,464	상동	X
Dacor, Inc.	1965. 03	14425 Clark Ave., City of Industry, California, USA	가전제품 생산 및 판매	27,441	상동	X
Dacor Canada Co.	2001. 06	Summit Place 6F 1601 Lower Water St., Halifax, Nova Scotia, Canada	가전제품 판매	-	상동	X
SmartThings, Inc.	2012. 04	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	스마트홈 플랫폼	179,239	상동	O
TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	2002. 05	43130 Amberwood Plaza #210, Chantilly, Virginia, USA	네트워크장비 설치 및 최적화	26,061	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	1983. 07	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	반도체 · DP 판매	13,744,799	상동	O
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1996. 02	12100 Samsung Blvd., Austin, Texas, USA	반도체 생산	8,705,085	상동	O
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	2016. 06	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	해외자회사 관리	380,569	상동	O
SEMES America, Inc.	1998. 10	13400 Immanuel Rd., Pflugerville, Texas, USA	반도체 장비 서비스	2,070	상동	X



Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	1980. 07	2050 Derry Rd. West, Mississauga, Ontario, Canada	전자제품 판매	1,861,549	상동	O
AdGear Technologies Inc.	2010. 08	481 Viger West #300, Montreal, Quebec, Canada	디지털광고 플랫폼	103,625	상동	O
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1995. 01	Av. Dr. Chucuri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil	전자제품 생산 및 판매	4,589,505	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1995. 07	Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico	전자제품 판매	1,417,629	상동	O
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	2012. 12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro. Sta. Rosa Jauregui C.P. Queretaro, Mexico	가전제품 생산	944,189	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	1989. 04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	1,247,421	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	1995. 05	9800 NW 41st St. #200, Miami, Florida, USA	전자제품 판매	434,912	상동	O
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	1997. 03	Carrera 7 #114-43 Oficina 606, Bogota, Colombia	전자제품 판매	601,744	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	1996. 06	Bouchard 710 Piso #8, Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	72,793	상동	X
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	2002. 12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	737,184	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	2010. 04	Av. Rivera Navarrete 501 Piso 6, San Isidro, Lima, Peru	전자제품 판매	363,052	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	2010. 05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela	마케팅 및 서비스	5	상동	X
Samsung Electronics Panama, S.A. (SEPA)	2012. 07	Torre C Piso 23 Torre de Las Americas, Panama City, Panama	컨설팅	3,022	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980. 01	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	16,641,325	상동	O
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981. 06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA	오디오제품 생산, 판매, R&D	7,888,591	상동	O
Harman Connected Services, Inc.	2002. 02	636 Ellis St., Mountain View, California, USA	Connected Service Provider	2,115,037	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004. 09	636 Ellis St., Mountain View, California, USA	Connected Service Provider	225	상동	X
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	2005. 07	Av. Cupiuba 401, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas, Brazil	오디오제품 생산, 판매	53,360	상동	X
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997. 02	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 생산	135,106	상동	O
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	1958. 11	BR-386 KM 435, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brazil	오디오제품 판매, R&D	230,102	상동	O
Harman Financial Group LLC	2004. 06	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	Management Company	22,651	상동	X
Harman International Industries Canada Ltd.	2005. 05	2900-550 Burrard St., Vancouver, British Columbia, Canada	오디오제품 판매	180	상동	X
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	2014. 12	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 판매	22,143	상동	X
Harman KG Holding, LLC	2009. 03	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional, Inc.	2006. 07	8500 Balboa Blvd., Northridge, California, USA	오디오제품 판매, R&D	810,140	상동	O
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014. 12	89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	13,192	상동	X

China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017. 09	23 Lime Tree Bay Av., Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	7,200	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1995. 07	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	2,925,062	상동	O
Samsung Electronics Ltd. (SEL)	1999. 01	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	해외자회사 관리	7,030	상동	X
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	1997. 04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체 · DP 판매	95,032	상동	O
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1984. 12	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	전자제품 판매	2,289,391	상동	O
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	1982. 02	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	해외자회사 관리	395,130	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	1987. 12	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany	반도체 · DP 판매	1,200,667	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	1988. 01	1 Rue Fructidor, Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,727,313	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	1991. 04	Via Mike Bongiorno 9, Milano, Italy	전자제품 판매	1,477,767	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	1989. 01	Parque Empresarial Omega Edf. C Av. de Barajas 32, Alcobendas, Madrid, Spain	전자제품 판매	1,208,209	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	1982. 09	Lagoas, Edifício 5B, Piso 0, Porto Salvo, Portugal	전자제품 판매	271,224	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	1989. 10	Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, Hungary	전자제품 생산 및 판매	2,504,075	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1991. 05	Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands	물류	2,305,275	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1995. 07	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	2,612,357	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	해외자회사 관리	14,651,496	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	1992. 03	Kanal Vagen 10A, Upplands Vasby, Sweden	전자제품 판매	1,408,535	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	2002. 06	Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia	TV · 모니터 생산	1,644,977	상동	O
Samsung Display Slovakia, s.r.o. (SDSK)	2007. 03	Voderady 401, Voderady, Slovakia	DP 임가공	28,711	상동	X
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	1996. 04	ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland	전자제품 판매	1,141,465	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	2010. 02	ul. Mickiewiczza 52, Wronki, Poland	가전제품 생산	525,067	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	2007. 09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower, Voluntari, Romania	전자제품 판매	353,140	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	2002. 01	Praterstraße 31, Vienna, Austria	전자제품 판매	536,140	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	2013. 05	Binzallee 4, Zurich, Switzerland	전자제품 판매	354,611	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	2010. 01	V Parku 14, Prague, Czech Republic	전자제품 판매	320,233	상동	O
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	2001. 10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	156,054	상동	O
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	2010. 04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232, Athens, Greece	전자제품 판매	145,588	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	2017. 04	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	에어컨공조 판매	167,050	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	2004. 02	Torshamngatan 39, Kista, Sweden	R&D	29,111	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	2012. 09	c/o Novi Science park, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst, Denmark	R&D	28,330	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	2012. 09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Rd., Cambridge, UK	R&D	165,106	상동	O

Zhilabs, S.L.	2008. 11	Numancia 69-73, 5F, Barcelona, Spain	네트워크Solution 개발, 판매	14,277	상동	X
FOODIENT LTD.	2012. 03	Cornwall House, 31 Lionel St., Birmingham, UK	R&D	4,489	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	2006. 10	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia	전자제품 판매	1,714,693	상동	O
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	2007. 07	1 Vladenie, Perviy Severniy proezd St., Koryakovo, Borovsk, Kaluga, Russia	TV 생산	1,338,993	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	2008. 09	75A, Zhylianska St., Kiev, Ukraine	전자제품 판매	322,369	상동	O
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	2022. 02	57 L'va Tolstogo St. Kyiv Ukraine	R&D	-	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	2008. 09	Naurizbay batyr st., Almaty, Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	570,861	상동	O
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	1997. 01	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,863	상동	X
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	2011. 11	12, building 1, Dvintsev St., Moscow, Russia	R&D	49,064	상동	X
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	2014. 10	1065 Bridge Plaza Biz Centre 12F, 6 Bakikhanov St., Baku, Azerbaijan	마케팅	2,199	상동	X
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	2022. 03	International Business Center, 107 B - Amir Temur str., Tashkent Uzbekistan	마케팅	-	상동	X
AKG Acoustics GmbH	1947. 03	254, Laxenburger St., Vienna, Austria	오디오제품 생산, 판매	330,677	상동	O
Apostera GmbH	2017. 03	Feringastr. 10 A, 85774 Unterföhring, Germany	Connected Service Provider	7,462	상동	X
Apostera UA, LLC	2020. 10	3 Sumska St., Kyiv, Ukraine	Connected Service Provider	338	상동	X
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	2012. 11	C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain	오디오제품 판매	1,116	상동	X
Harman Automotive UK Limited	2012. 10	Salisbury House, London Wall, London, UK	오디오제품 생산	-	상동	X
Harman Becker Automotive Systems GmbH	1990. 07	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	오디오제품 생산, 판매, R&D	3,805,205	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005. 12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), Italy	오디오제품 판매	1,222	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1994. 08	19 Holland Fasar, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생산, R&D	3,127,200	상동	O
Harman Belgium SA	1967. 04	4 Drukperstraat, Brussels, Belgium	오디오제품 판매	1,969	상동	X
Harman Connected Services AB.	1984. 10	24 Nordenskiöldsgatan, Malmö, Sweden	Connected Service Provider	17,747	상동	X
Harman Finland Oy	1998. 07	Hermiankatu 1 A, Tampere, Finland	Connected Service Provider	-	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005. 12	45 Wittener Str., Bochum, Germany	Connected Service Provider	45,171	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007. 06	UL Kasprzaka 6, Lodz, Poland	Connected Service Provider	8,256	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008. 09	Devonshire House, 60 Goswell Rd., London, UK	Connected Service Provider	60,540	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995. 12	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands	오디오제품 판매	460,178	상동	O
Harman Deutschland GmbH	1998. 03	Parkring 3 B. Munich, Garching, Germany	오디오제품 판매	13,272	상동	X
Harman Finance International GP S.a.r.l	2015. 04	6, rue Eugene Ruppert, Luxembourg	해외회사 관리	-	상동	X

Harman France SNC	1995. 11	12 bis, rue des Colonnnes-du-Trone, Paris, France	오디오제품 판매	154,903	상동	O
Harman Holding Gmbh & Co. KG	2002. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	Management Company	5,256,219	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012. 06	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	Financing Company	35,823	상동	X
Harman Inc. & Co. KG	2012. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	4,247,706	상동	O
Harman International Estonia OU	2015. 05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, Estonia	R&D	193	상동	X
Harman International Industries Limited	1980. 03	Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK	오디오제품 판매, R&D	78,684	상동	O
Harman International Romania SRL	2015. 02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metroffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sec. 2, Bucharest, Romania	R&D	17,632	상동	X
Harman Finance International, SCA	2015. 04	6, rue Eugene Ruppert, Luxembourg	Financing Company	486,810	상동	O
Harman International s.r.o	2015. 02	Pobe n 394/12, Karl n, Prague, Czech Republic	오디오제품 생산	69	상동	X
Harman Management Gmbh	2002. 04	Becker Goering St. 16, Karlsbad, Germany	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman Professional Kft	2014. 12	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생산, R&D	54,034	상동	X
Harman Professional Denmark ApS	1987. 07	Olof Palmes Alle 18., Aarhus, Denmark	오디오제품 판매, R&D	47,985	상동	X
Red Bend Software Ltd.	2004. 08	25 Farringdon Street, London, UK	소프트웨어 디자인	-	상동	X
Red Bend Software SAS	2002. 10	Immeuble 15 place Georges Pompidou, MontignyLe Bretonneux, France	소프트웨어 디자인	7,784	상동	X
Studer Professional Audio GmbH	2003. 11	Althardstrasse 30, Regensdorf, Switzerland	오디오제품 판매, R&D	8,725	상동	X
Harman Connected Services OOO	1998. 11	8 Kovalikhinskaya St., Nizhny Novgorod, Russia	Connected Service Provider	17,799	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011. 08	RS 12/1 Dvintsev street, Moscow, Russia	오디오제품 판매	155,602	상동	O
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	1995. 05	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE	전자제품 판매	1,776,336	상동	O
Samsung Electronics Turkey (SETK)	1984. 12	Flatofis Is Merkezi Otakilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	422,159	상동	O
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	2021. 02	Flatofis Is Merkezi Otakilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 생산	131,811	상동	O
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	2009. 07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St., Amman, Jordan	전자제품 판매	349,640	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	2009. 11	Lot N°9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco	전자제품 판매	322,510	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	2012. 07	62815 Piece No. 98, Engineering Sector, Kom Abu Radi, Al Wasta, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	946,599	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	2012. 09	Holland Building 1F, Europark, Yakum, Israel	마케팅	14,889	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	2012. 09	2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy, Tunis, Tunisia	마케팅	5,206	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	2012. 11	No.4 1F Park Lane Tower 172 Turfail Rd., Cantt, Lahore, Pakistan	마케팅	3,343	상동	X

Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	2019. 11	Hamad Tower, Olaya District, Riyadh, Saudi Arabia	전자제품 판매	440,098	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center. Ltd. (SIRC)	2007. 10	10 Oholiav St., Ramat Gan, Israel	R&D	150,482	상동	O
Corephotonics Ltd.	2012. 01	25 Habarzel St., Tel Aviv, Israel	R&D	12,963	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	1994. 06	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa	전자제품 판매	500,605	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	2014. 07	35 Umkhomazi Drive, La Mercy, Kwa-Zulu Natal, South Africa	TV·모니터 생산	92,169	상동	O
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	2010. 03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	23,034	상동	X
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	2011. 12	Milford Suites 4F, Nairobi, Kenya	마케팅	16,851	상동	X
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002. 01	International Financial Services Ltd, IFS Court, TwentyEight CyberCity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	51,892	상동	X
Harman Connected Services Morocco	2012. 04	Technopark, Route Nouaceur, Rs 114 & CT1029, Casablanca, Morocco	Connected Service Provider	921	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009. 10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius	해외자회사 관리	87,624	상동	O
Red Bend Ltd.	1998. 02	4 HaCharash St., Neve Ne'emman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	오디오제품 생산	109,755	상동	O
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	2006. 07	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	해외자회사 관리	14,683,789	상동	O
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	2020. 10	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore	전자제품 판매	669,485	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	2003. 05	#E-09-01, Level 9, East Wing, No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	625,662	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	1995. 03	Tuanku Jaafar Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산	24,681	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	1989. 09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park, Port Klang, Selangor, Malaysia	가전제품 생산	263,523	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	1995. 01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh, Vietnam	전자제품 판매	105,109	상동	O
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	2008. 03	YenTrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	전자제품 생산	13,023,272	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	2013. 03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen, Vietnam	통신제품 생산	17,521,446	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	2015. 02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	3,129,104	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	2014. 07	Yenphong I I.P, YenTrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	DP 생산	6,821,066	상동	O
DOWWOINSYS VINA COMPANY LIMITED	2022. 06	Lot CN9, Song Cong II Industrial Zone, Tan Quang, SongCong, Thai Nguyen, Vietnam	DP 부품 생산	-	상동	X
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	1991. 08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	1,139,901	상동	O

PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	2003. 03	Prudential Tower 23F Jl. Jend. Sudirman Kav 79, Jakarta, Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	63,990	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1988. 10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung A.Sriracha Chonburi, Thailand	전자제품 생산 및 판매	3,018,358	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	2016. 09	3F Kolao Tower 2, 23 Singha Rd., Vientiane, Laos	마케팅	1,064	상동	X
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	1996. 03	8F HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City, Taguig, Philippines	전자제품 판매	358,559	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	1987. 11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay 2127, Sydney, Australia	전자제품 판매	765,487	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	2013. 09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, New Zealand	전자제품 판매	181,670	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1995. 08	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India	전자제품 생산 및 판매	7,765,019	상동	O
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	2012. 01	6th Floor, Salarpuria Sattva Magnificia, Old Madras Road, Bengaluru, Karnataka, India	마케팅	4,945	상동	X
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	2019. 07	B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India	DP 생산	657,924	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	2005. 05	Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India	R&D	477,710	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	2010. 08	Gualshan-1, Gulshan Ave., Dhaka, Bangladesh	R&D	18,277	상동	X
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	2017. 11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal	서비스	385	상동	X
Samsung Japan Corporation (SJC)	1975. 12	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan	반도체 · DP 판매	1,311,938	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	1992. 08	2-7, Sugasawa-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan	R&D	161,184	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	2008. 09	Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	전자제품 판매	880,101	상동	O
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002. 04	Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli, Bangalore, India	Connected Service Provider	311,892	상동	O
Harman International (India) Private Limited	2009. 01	Plot No. 9, Phase I, Doddenakkundi Industrial Area, K.R. Puram Hobli, Bangalore, India	오디오제품 판매, R&D	361,520	상동	O
Harman International Industries PTY Ltd.	2014. 12	Warehouse 25 26-18, Roberna St., Moorabbin, Victoria, Australia	해외자회사 관리	-	상동	X
Harman International Japan Co., Ltd.	1991. 06	14F Sumitomo Fudosan Akihabara-ekimae, Kanda, Chiyoda, Tokyo, Japan	오디오제품 판매, R&D	63,699	상동	X
Harman Singapore Pte. Ltd.	2007. 08	108, Pasir Panjang Rd., #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore	오디오제품 판매	10,738	상동	X
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1996. 03	Fortune Financial Center, No5, Dongsanhuan Zhong Rd., Chaoyang, Beijing, China	전자제품 판매	13,599,093	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	1988. 09	33F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong	전자제품 판매	1,788,990	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1994. 11	10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan	전자제품 판매	2,033,992	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	1993. 04	#12, no 4 Big St., Dong Ting Rd., Teda, Tianjin, China	TV · 모니터 생산	551,511	상동	O

Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	670,959	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	가전제품 생산	559,267	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	2002. 09	No.198, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial park, Suzhou, China	전자제품 생산, R&D	147,973	상동	O
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	2001. 03	No.9 WeiWu Rd. Micro Electronic Industrial Park, Xiqing, Tianjin, China	통신제품 생산	654,546	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	2000. 09	12/F Zhongdian fazhan Building, No. 9, xiaguangli, Chaoyang, Beijing, China	R&D	157,755	상동	O
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	2004. 05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Rd., Nanjing, China	R&D	81,122	상동	O
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	2010. 01	A3 Building, No.185 Kexue Ave., Science City, Luogang, Guangzhou, China	R&D	106,664	상동	O
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	2013. 03	22F, Building 2C, Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, China	R&D	42,903	상동	X
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	2001. 10	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China	반도체 · DP 판매	7,765,126	상동	O
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	2012. 09	No.1999, Xiaohu Rd., Changan, Xian, China	반도체 생산	19,049,536	상동	O
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	2016. 04	8F Customs Clearance Center, No.5 Tonghai First Rd., Changan, Xian, China	반도체 · DP 판매	1,154,516	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	1994. 12	No.15, JinJiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	반도체 임가공	1,477,600	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	2009. 05	No 1. Weisan Rd., Micro Electronic Industrial Park., Xiqing, Tianjin, China	LED 생산	567,151	상동	O
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	2003. 04	No.15, JinjiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	68,955	상동	X
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2001. 11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, China	DP 생산	2,149,277	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	2004. 06	No.25, Mip Fourth Rd., Xiqing, Tianjin, China	DP 생산	1,546,613	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013. 07	#A501, ZTE PLAZA, No.10 Tangyan South Rd., Gaoxin, Xian, China	반도체 · FPD 장비 서비스	3,491	상동	X
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	2021. 12	#409, Building 2, No. 599, Wanzhen Road, Zhenxinincun St., Jiading Dist., Shanghai, China	신기술사업자, 벤처기업 투자	18,409	상동	X
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011. 03	No.68, First Yinquan Rd., Zhengxing, Dandong, China	오디오제품 생산	140,969	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	2013. 03	20F, Modern Logistics No.88 Modern Ave., Suzhou, China	오디오제품 판매	5,791	상동	X
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006. 09	No.125, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	오디오제품 생산, R&D	313,303	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010. 10	Suite 2903B, Level 29, 288, West Nanjing Rd., Huangpu, Shanghai, China	오디오제품 판매	247	상동	X

Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	2007. 08	14F, 15F, No 383 Jiaozai Ave., High-tech, Chengdu, China	Connected Service Provider	14,865	상동	X
Harman Holding Limited	2007. 05	Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong	오디오제품 판매	567,202	상동	O
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	2009. 06	#3004, Chong Hing Finance Center, 288 Nanjing Road West, Huangpu, Shanghai, China	오디오제품 판매, R&D	697,932	상동	O
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	2004. 09	14F, China Merchants Bureau Port Building, Merchants St., Nanshan, Shenzhen, China	오디오제품 판매, R&D	28,762	상동	X
삼성디스플레이㈜	2012. 04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)	DP 생산 및 판매	54,967,156	상동	O
에스유머티리얼스㈜	2011. 08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	DP 부품 생산	34,863	상동	X
스테코㈜	1995. 06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20(백석동)	반도체 부품 생산	153,976	상동	O
세메스㈜	1993. 01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	반도체·FPD 장비 생산, 판매	1,931,476	상동	O
삼성전자서비스㈜	1998. 10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동)	전자제품 수리 서비스	553,466	상동	O
삼성전자서비스씨에스㈜	2018. 10	경기도 수원시 영통구 중부대로 324(매탄동)	고객상담서비스	20,082	상동	X
삼성전자판매㈜	1996. 07	경기도 성남시 분당구 백현로101번길 30	전자제품 판매	1,374,619	상동	O
삼성전자로지텍㈜	1998. 04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)	종합물류대행	386,841	상동	O
삼성메디슨㈜	1985. 07	강원도 홍천군 남면 한서로 3366	의료기기 생산 및 판매	451,830	상동	O
㈜미래로시스템	1994. 01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동)	반도체 소프트 웨어 개발 및 공 급	31,668	상동	X
㈜도우인시스	2010. 03	충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 605-1(송절동)	DP 부품 생산	62,894	상동	X
지에프㈜	2015. 10	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 38	DP 부품 생산	6,826	상동	X
㈜하만인터내셔널코리아	2005. 01	서울특별시 강남구 강남대로 298(역삼동), 푸르덴셜타워 5층	소프트웨어 개발 및 공급	21,682	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	123,575	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	93,345	상동	O
SVIC 26호 신기술투자조합	2014. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	81,623	상동	O
SVIC 28호 신기술투자조합	2015. 02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	498,438	상동	O
SVIC 29호 신기술투자조합	2015. 04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	42,774	상동	X
SVIC 32호 신기술투자조합	2016. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	355,271	상동	O
SVIC 33호 신기술투자조합	2016. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	396,087	상동	O
SVIC 37호 신기술투자조합	2017. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	77,214	상동	O
SVIC 40호 신기술투자조합	2018. 06	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	43,552	상동	X
SVIC 42호 신기술투자조합	2018. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	15,429	상동	X



SWIC 43호 신기술투자조합	2018. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	8,066	상동	X
SWIC 45호 신기술투자조합	2019. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	169,143	상동	O
SWIC 48호 신기술투자조합	2019. 12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	75,736	상동	O
SWIC 52호 신기술투자조합	2021. 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	9,102	상동	X
SWIC 55호 신기술투자조합	2021. 09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	85,899	상동	O
SWIC 56호 신기술투자조합	2021. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층	신기술사업자, 벤처기업 투자	22,404	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017. 03	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	74,436	상동	X
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	2020. 04	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	79,710	상동	O

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(종속기업의 변동)

(단위 : 개사)

구 분	미주	유럽 · CIS	중동· 아프 리카	아시아 (중국 제외)	중국	국내	합계	변 동 내 역	
								증 가	감 소
제51기말 (2019년말)	54	75	19	30	34	28	240	-	-
제52기 증감	1	-	-	-	△1	1	1	[미주: 4개사] · TeleWorld Solutions, Inc. (TWS) · TWS LATAM B, LLC · TWS LATAM S, LLC · SNB Technologies, Inc. Mexico, S.A. de C.V  [아시아(중국 제외): 1개사] · Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)  [국내: 1개사] · 시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	[미주: 3개사] · Harman Connected Services South America S.R.L. · EverythingDacor.com, Inc. · Distinctive Appliances of California, Inc.  [아시아(중국 제외): 1개사] · Martin Professional Pte. Ltd.  [중국: 1개사] · Samsung Tianjin Mobile Development Center (SRC-Tianjin)
제52기말 (2020년말)	55	75	19	30	33	29	241	-	-

제53기 증감	△9	△4	1	-	△3	2	△13	<p>[미국: 9개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viv Labs, Inc.</li> <li>• Stellus Technologies, Inc.</li> <li>• SigMast Communications Inc.</li> <li>• Prismview, LLC</li> <li>• Zhilabs, Inc.</li> <li>• TWS LATAM B, LLC</li> <li>• TWS LATAM S, LLC</li> </ul> <p>[중국: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsung Semiconductor Investment L.P. I</li> </ul> <p>[중동·아프리카: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)</li> </ul> <p>[국내: 3개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SVIC 52호 신기술투자조합</li> <li>• SVIC 55호 신기술투자조합</li> <li>• SVIC 56호 신기술투자조합</li> </ul>	<p>[유럽·CIS: 4개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arcam Limited</li> <li>• A&amp;R Cambridge Limited</li> <li>• Harman Connected Services Limited</li> <li>• Martin Manufacturing (UK) Ltd.</li> </ul> <p>[중국: 4개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsung Suzhou Module Co., Ltd. (SSM)</li> <li>• Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL)</li> <li>• Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. (SEHZ)</li> <li>• Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.(SSET)</li> </ul> <p>[국내: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SVIC 27호 신기술투자조합</li> </ul>
제53기 (2021년말)	46	71	20	30	30	31	228	-	-
제54기 증감	-	3	-	2	-	-	5	<p>[유럽·CIS: 4개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsung R&amp;D Institute Ukraine (SRUKR)</li> <li>• Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)</li> <li>• Apostera GmbH</li> <li>• Apostera UA, LLC</li> </ul> <p>[아시아(중국 제외): 2개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED</li> <li>• Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.</li> </ul>	<p>[유럽·CIS: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMX UK Limited</li> </ul>
제54기 (2022년 반기말)	46	74	20	32	30	31	233	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

### 가. 국내 계열회사 현황

2022년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 2개 회사가 증가하여 61개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 45개사입니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	16	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성엔지니어링(주)	1101110240509
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		(주)멀티캠퍼스	1101111960792
		(주)에스원	1101110221939
		(주)제일기획	1101110139017
		(주)호텔신라	1101110145519
비상장	45	삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		삼성자산운용(주)	1701110139833
		삼성전자로지텍(주)	1301110046797
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자서비스씨에스(주)	1358110352541
		삼성전자판매(주)	1801110210300
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656

	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140003466
	삼성해지자산운용(주)	1101116277390
	삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703
	삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
	성균관대학교기술지주(주)	1358110215426
	세메스(주)	1615110011795
	수원삼성축구단(주)	1358110160126
	스테코(주)	1647110003490
	신라에이치엠(주)	1101115433927
	에스디플렉스(주)	1760110039005
	에스비티엠(주)	1101116536556
	에스원씨알엠(주)	1358110190199
	에스유머티리얼스(주)	1648110061337
	에스코여(주)	1101113681031
	에스티엠(주)	2301110176840
	에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
	오픈핸즈(주)	1311110266146
	제일패션리테일(주)	1101114736934
	(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
	(주)삼성글로벌리서치	1101110766670
	(주)삼성라이온즈	1701110015786
	(주)삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
	(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
	(주)상우종합건축사사무소	1101115494151
	(주)서울레이크사이드	1101110504070
	(주)시큐아이	1101111912503
	(주)씨브이네트	1101111931686
	(주)에스에이치피코퍼레이션	1101118151310
	(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
	(주)휴먼티에스에스	1101114272706

※ 삼성코닝어드밴스드글라스는 2020년 10월 유한회사에서 주식회사로 변경하였다가, 2021년 2월 주식회사에서 유한회사로 재변경하였습니다.

## 나. 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일 )

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	소재국
비상장	578	SAMOO AUSTIN INC	USA
		SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	Hungary
		SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	India
		SAMOO (KL) SDN. BHD.	Malaysia
		SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	China
		Meadowland Distribution	USA
		Samsung Green repower, LLC	USA
		Samsung Solar Construction Inc.	USA
		QSSC, S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Solar Energy LLC	USA
		Equipment Trading Solutions Group, LLC	USA
		FLOWFY COMMERCE SERVICE LLC	USA
		SP Armow Wind Ontario LP	Canada
		SRE GRW EPC GP Inc.	Canada
		SRE GRW EPC LP	Canada
		SRE SKW EPC GP Inc.	Canada
		SRE SKW EPC LP	Canada
		SRE WIND PA GP INC.	Canada
		SRE WIND PA LP	Canada
		SRE GRS Holdings GP Inc.	Canada
		SRE GRS Holdings LP	Canada
		SRE K2 EPC GP Inc.	Canada
		SRE K2 EPC LP	Canada
		SRE KS HOLDINGS GP INC.	Canada
		SRE KS HOLDINGS LP	Canada
		SP Belle River Wind LP	Canada
		SRE Armow EPC GP Inc.	Canada
		SRE Armow EPC LP	Canada
		North Kent Wind 1 LP	Canada
		SRE Wind GP Holding Inc.	Canada
		South Kent Wind LP Inc.	Canada
		Grand Renewable Wind LP Inc.	Canada
SRE North Kent 2 LP Holdings LP	Canada		
SRE Solar Development GP Inc.	Canada		
SRE Solar Development LP	Canada		
SRE Windsor Holdings GP Inc.	Canada		

	SRE Southgate Holdings GP Inc.	Canada
	SRE Solar Construction Management GP Inc.	Canada
	SRE Solar Construction Management LP	Canada
	SRE BRW EPC GP INC.	Canada
	SRE BRW EPC LP	Canada
	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	Canada
	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	Canada
	SRE Belle River GP Holdings Inc	Canada
	SRE NK1 EPC GP Inc	Canada
	SRE NK1 EPC LP	Canada
	SRE Summerside Construction GP Inc.	Canada
	SRE Summerside Construction LP	Canada
	Monument Power, LLC	USA
	PLL Holdings LLC	USA
	PLL E&P LLC	USA
	Parallel Petroleum LLC	USA
	Grand Renewable Solar GP Inc.	Canada
	KINGSTON SOLAR GP INC.	Canada
	SP Armow Wind Ontario GP Inc	Canada
	South Kent Wind GP Inc.	Canada
	Grand Renewable Wind GP Inc.	Canada
	North Kent Wind 1 GP Inc	Canada
	SP Belle River Wind GP Inc	Canada
	Samsung Solar Energy 1 LLC	USA
	Samsung Solar Energy 2 LLC	USA
	Samsung Solar Energy 3, LLC	USA
	CS SOLAR LLC	USA
	SST SOLAR, LLC	USA
	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	Germany
	POSS-SLPC, S.R.O	Slovakia
	Solluce Romania 1 B.V.	Romania
	S.C. Otelinox S.A	Romania
	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	Malaysia
	Samsung Chemtech Vina LLC	Vietnam
	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Thailand
	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	Indonesia
	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	Malaysia
	S&G Biofuel PTE.LTD	Singapore
	PT. Gandaerah Hendana	Indonesia
	PT. Inecda	Indonesia
	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	Bangladesh

	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	Philippines
	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	China
	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	China
	Samsung Japan Corporation	Japan
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	Japan
	Samsung Electronics America, Inc.	USA
	Samsung Electronics Canada, Inc.	Canada
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Mexico
	Samsung Electronics Ltd.	United Kingdom
	Samsung Electronics (UK) Ltd.	United Kingdom
	Samsung Electronics Holding GmbH	Germany
	Samsung Electronics Iberia, S.A.	Spain
	Samsung Electronics France S.A.S	France
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Hungary
	Samsung Electronics Italia S.P.A.	Italy
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	Netherlands
	Samsung Electronics Benelux B.V.	Netherlands
	Samsung Electronics Overseas B.V.	Netherlands
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	Poland
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	Portugal
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Sweden
	Samsung Electronics Austria GmbH	Austria
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	Slovakia
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Netherlands
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Asia Pte. Ltd.	Singapore
	Samsung India Electronics Private Ltd.	India
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	India
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	Australia
	PT Samsung Electronics Indonesia	Indonesia
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Thailand
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	Malaysia
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	China
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	China
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	China
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	China
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	China



	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	China
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	China
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	China
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	China
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	China
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Utd.Arab Emir.
	Samsung Electronics Egypt S.A.E	Egypt
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	South Africa
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Panama
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Brazil
	Samsung Electronics Argentina S.A.	Argentina
	Samsung Electronics Chile Limitada	Chile
	Samsung Electronics Rus Company LLC	Russian Fed.
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	Russian Fed.
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	China
	Samsung Biologics America, Inc.	USA
	Samsung Bioepis United States Inc.	USA
	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	United Kingdom
	Samsung Bioepis NL B.V.	Netherlands
	Samsung Bioepis CH GmbH	Switzerland
	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	Poland
	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	Australia
	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	New Zealand
	Samsung Bioepis TW Limited	Taiwan
	Samsung Bioepis HK Limited	Hong Kong
	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	Israel
	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	Brazil
	Intellectual Keystone Technology LLC	USA
	Samsung Display Slovakia, s.r.o.	Slovakia
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Display Noida Private Limited	India
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	China
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	China
	Novald GmbH	Germany
	SEMES America, Inc.	USA
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	China
	NeuroLogica Corp.	USA
	Dacor Holdings, Inc.	USA
	Samsung HVAC America, LLC	USA
	SmartThings, Inc.	USA
	Samsung Oak Holdings, Inc.	USA

	Joyent, Inc.	USA
	TeleWorld Solutions, Inc.	USA
	Samsung Semiconductor, Inc.	USA
	Samsung Research America, Inc	USA
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	USA
	Samsung International, Inc.	USA
	Harman International Industries, Inc.	USA
	Dacor, Inc.	USA
	Dacor Canada Co.	Canada
	Samsung Austin Semiconductor LLC.	USA
	AdGear Technologies Inc.	Canada
	SAMSUNG NEXT LLC	USA
	SAMSUNG NEXT FUND LLC	USA
	Samsung Mexicana S.A. de C.V	Mexico
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	Mexico
	Harman International Japan Co., Ltd.	Japan
	Harman International Industries Canada Ltd.	Canada
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	USA
	Harman Professional, Inc.	USA
	Harman Connected Services, Inc.	USA
	Harman Financial Group LLC	USA
	Harman Belgium SA	Belgium
	Harman France SNC	France
	Red Bend Software SAS	France
	Harman Inc. & Co. KG	Germany
	Harman KG Holding, LLC	USA
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	Italy
	Harman Finance International, SCA	Luxembourg
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Luxembourg
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Mauritius
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	Harman International Estonia OU	Estonia
	Harman Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
	Harman Connected Services Engineering Corp.	USA
	Harman Connected Services AB.	Sweden
	Harman Connected Services UK Ltd.	United Kingdom
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	India
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Mauritius
	Harman International (India) Private Limited	India

	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	Samsung Semiconductor Europe Limited	United Kingdom
	Samsung Semiconductor Europe GmbH	Germany
	Samsung Electronics GmbH	Germany
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	Czech Republic
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	Latvia
	Samsung Electronics West Africa Ltd.	Nigeria
	Samsung Electronics East Africa Ltd.	Kenya
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	Saudi Arabia
	Samsung Electronics Israel Ltd.	Israel
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	Tunisia
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	Pakistan
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	South Africa
	Samsung Electronics Turkey	Turkey
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	Turkey
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	Israel
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	Jordan
	Samsung Electronics Maghreb Arab	Morocco
	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	Venezuela
	Samsung Electronics Peru S.A.C.	Peru
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	Ukraine
	Samsung R&D Institute Ukraine	Ukraine
	Samsung R&D Institute Rus LLC	Russian Fed.
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Kazakhstan
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	Azerbaijan
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd.	Uzbekistan
	Corephotonics Ltd.	Israel
	Samsung Nanoradio Design Center	Sweden
	Harman Professional Denmark ApS	Denmark
	Studer Professional Audio GmbH	Switzerland
	Martin Professional Japan Ltd.	Japan
	Harman International s.r.o	Czech Republic
	Harman International Romania SRL	Romania
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	Germany
	Harman Deutschland GmbH	Germany
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Hungary
	Apostera GmbH	Germany
	Harman RUS CIS LLC	Russian Fed.
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Germany
	Harman Management GmbH	Germany
	Harman Hungary Financing Ltd.	Hungary

	Harman Connected Services OOO	Russian Fed.
	Harman Professional Kft	Hungary
	Harman Consumer Nederland B.V.	Netherlands
	Red Bend Ltd.	Israel
	Harman International Industries Limited	United Kingdom
	AKG Acoustics Gmbh	Austria
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Spain
	Harman Holding Limited	Hong Kong
	Harman Finland Oy	Finland
	Harman Connected Services GmbH	Germany
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Poland
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	China
	Harman Automotive UK Limited	United Kingdom
	Harman International Industries PTY Ltd.	Australia
	Harman Connected Services Morocco	Morocco
	Apostera UA, LLC	Ukraine
	Samsung Electronics Switzerland GmbH	Switzerland
	Samsung Electronics Romania LLC	Romania
	Zhilabs, S.L.	Spain
	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	Italy
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	Poland
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	Greece
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	Netherlands
	FOODIENT LTD.	United Kingdom
	Samsung Denmark Research Center ApS	Denmark
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	United Kingdom
	iMarket Asia Co., Ltd.	Hong Kong
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	Japan
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	Samsung Electronics New Zealand Limited	New Zealand
	Samsung Electronics Philippines Corporation	Philippines
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	Bangladesh
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Electronics Vietnam THANGUYEN Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	Nepal
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	India
	PT Samsung Telecommunications Indonesia	Indonesia
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	Laos
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	China
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	China

	Samsung R&D Institute China–Shenzhen	China
	Beijing Samsung Telecom R&D Center	China
	Samsung Electronics China R&D Center	China
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	China
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	China
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	China
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	China
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	China
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	China
	Red Bend Software Ltd.	United Kingdom
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	USA
	Samsung Electronica Colombia S.A.	Colombia
	Samsung Electronics Panama. S.A.	Panama
	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	Japan
	Samsung SDI America, Inc.	USA
	Samsung SDI Hungary., Zrt.	Hungary
	Samsung SDI Europe GmbH	Germany
	Samsung SDI Battery Systems GmbH	Austria
	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	Malaysia
	Samsung SDI India Private Limited	India
	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
	Samsung SDI China Co., Ltd.	China
	Samsung SDI–ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	China
	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	China
	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	China
	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	China
	Samsung Electro–Mechanics Japan Co., Ltd.	Japan
	Samsung Electro–Mechanics America, Inc.	USA
	Samsung Electro–Mechanics GmbH	Germany
	Samsung Electro–Mechanics Philippines, Corp.	Philippines
	Calamba Premier Realty Corporation	Philippines
	Samsung Electro–Mechanics Pte Ltd.	Singapore
	Samsung Electro–Mechanics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Electro–Mechanics Software India Bangalore Private Limited	India
	Dongguan Samsung Electro–Mechanics Co., Ltd.	China
	Tianjin Samsung Electro–Mechanics Co., Ltd.	China
	Samsung High–Tech Electro–Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	China
	Samsung Electro–Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	China
	Kunshan Samsung Electro–Mechanics Co., Ltd.	China

Batino Realty Corporation	Philippines
Samsung Fire & Marine Management Corporation	USA
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	United Kingdom
PT. Asuransi Samsung Tugu	Indonesia
SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	Vietnam
Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	Singapore
삼성재산보험 (중국) 유한공사	China
Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	Utd.Arab Emir.
Camellia Consulting Corporation	USA
Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	India
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	Malaysia
삼성중공업(영파)유한공사	China
삼성중공업(영성)유한공사	China
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	Nigeria
Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	Mozambique
Samsung Heavy Industries Rus LLC	Russian Fed.
SHI – MCI FZE	Nigeria
Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	Thailand
Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	China
Samsung Asset Management (New York), Inc.	USA
Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	Cayman Islands
Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	USA
Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	Cayman Islands
Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	Cayman Islands
Samsung Asset Management(London) Ltd.	United Kingdom
Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	Cayman Islands
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	China
Samsung C&T Japan Corporation	Japan
Samsung C&T America Inc.	USA
Samsung E&C America, INC.	USA
Samsung Renewable Energy Inc.	Canada
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	USA
Samsung C&T Lima S.A.C.	Peru
Samsung C&T Deutschland GmbH	Germany
Samsung C&T U.K. Ltd.	United Kingdom
Samsung C&T ECUK Limited	United Kingdom
Whessoe engineering Limited	United Kingdom
SAM investment Manzanilo.B.V	Netherlands
Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	Malaysia

	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	Malaysia
	Erdsam Co., Ltd.	Hong Kong
	Samsung C&T India Private Limited	India
	Samsung C&T Corporation India Private Limited	India
	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Singapore
	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	Mongolia
	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	Mongolia
	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	Philippines
	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	Vietnam
	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Singapore
	CHEIL HOLDING INC.	Philippines
	Samsung C&T Hongkong Ltd.	Hong Kong
	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	China
	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	China
	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	Saudi Arabia
	SAM Gulf Investment Limited	Utd.Arab Emir.
	Samsung C&T Chile Copper SpA	Chile
	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	Chile
	Samsung C&T Corporation Rus LLC	Russian Fed.
	Cheil Industries Corp., USA	USA
	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	Italy
	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	China
	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	Malaysia
	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	China
	Shanghai Welstory Food Company Limited	China
	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	USA
	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	China
	PengTai Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	China
	PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD.	China
	Medialytics Inc.	China
	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	China
	iMarket China Co., Ltd.	China
	Samsung Securities (America), Inc.	USA
	Samsung Securities (Europe) Limited.	United Kingdom
	Samsung Securities (Asia) Limited.	Hong Kong
	Samsung SDS America, Inc.	USA
	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	Canada

	Neo EXpress Transportation (NEXT) Inc.	USA
	Samsung SDS Europe, Ltd.	United Kingdom
	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	Hungary
	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	Slovakia
	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	Poland
	Samsung GSCL Sweden AB	Sweden
	Samsung SDS Global SCL France SAS	France
	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	Greece
	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	Italy
	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	Spain
	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Netherlands
	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	Germany
	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	Romania
	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	Singapore
	Samsung Data Systems India Private Limited	India
	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	Indonesia
	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	Philippines
	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	Thailand
	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	Malaysia
	SAMSUNG SDS Global SCL Australia Pty.,Ltd.	Australia
	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	Thailand
	ALS SDS Joint Stock Company	Vietnam
	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	Vietnam
	Samsung SDS China Co., Ltd.	China
	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	Egypt
	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	South Africa
	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	Turkey
	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	Utd.Arab Emir.
	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	Brazil
	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	Mexico
	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	Russian Fed.
	MIRACOM INC ASIA PACIFIC LIMITED	Hong Kong
	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	Mexico
	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	Panama
	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	Chile
	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	Peru
	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	Colombia
	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	China



	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd.	China
	Samsung Engineering America Inc.	USA
	Samsung Engineering Hungary Ltd.	Hungary
	Samsung Engineering Italy S.R.L.	Italy
	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Malaysia
	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	Indonesia
	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
	Samsung Engineering India Private Limited	India
	Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	China
	Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	China
	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Saudi Arabia
	Muharrag Wastewater Services Company W.L.L.	Bahrain
	Muharrag STP Company B.S.C.	Bahrain
	Muharrag Holding Company 1 Ltd.	Utd.Arab Emir.
	Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	Mexico
	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	Trinidad,Tobago
	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	Mexico
	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	Mexico
	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	Mexico
	Samsung Engineering Bolivia S.A	Bolivia
	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	Mexico
	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	Kazakhstan
	SEA Construction, LLC	USA
	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	USA
	Samsung EPC Company Ltd.	Saudi Arabia
	Muharrag Holding Company 2 Ltd.	Utd.Arab Emir.
	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	Mexico
	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	Hungary
	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
	Samsung Beijing Security Systems	China
	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	China
	Cheil USA Inc.	USA
	Cheil Central America Inc.	USA
	Iris Worldwide Holdings Limited	United Kingdom
	CHEIL EUROPE LIMITED	United Kingdom
	Cheil Germany GmbH	Germany
	Cheil France SAS	France
	CHEIL SPAIN S.L	Spain
	Cheil Benelux B.V.	Netherlands

	Cheil Nordic AB	Sweden
	Cheil India Private Limited	India
	Cheil (Thailand) Ltd.	Thailand
	Cheil Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Philippines
	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
	Cheil New Zealand Limited	New Zealand
	CHEIL CHINA	China
	Cheil Hong Kong Ltd.	Hong Kong
	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	China
	Cheil MEA FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
	Cheil South Africa (Pty) Ltd	South Africa
	CHEIL KENYA LIMITED	Kenya
	Cheil Communications Nigeria Ltd.	Nigeria
	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	Jordan
	Cheil Ghana Limited	Ghana
	Cheil Egypt LLC	Egypt
	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	Brazil
	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
	Cheil Chile SpA.	Chile
	Cheil Peru S.A.C.	Peru
	CHEIL ARGENTINA S.A.	Argentina
	Cheil Rus LLC	Russian Fed.
	Cheil Ukraine LLC	Ukraine
	Cheil Kazakhstan LLC	Kazakhstan
	Samsung Hospitality America Inc.	USA
	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Singapore
	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	China
	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Hong Kong
	Shilla Travel Retail Taiwan Limited	Taiwan
	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	China
	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	United Kingdom
	Samsung Hospitality Europe GmbH	Germany
	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	Romania
	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
	Samsung Hospitality Philippines Inc.	Philippines
	Samsung Hospitality India Private Limited	India
	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	China
	Iris (USA) Inc.	USA
	Iris Atlanta, Inc.	USA

	89 Degrees, Inc.	USA
	The Barbarian Group LLC	USA
	McKinney Ventures LLC	USA
	Iris Nation Worldwide Limited	United Kingdom
	Iris Americas, Inc.	USA
	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	Mexico
	Pricing Solutions Ltd	Canada
	Iris London Limited	United Kingdom
	Iris Promotional Marketing Ltd	United Kingdom
	Iris Ventures 1 Limited	United Kingdom
	Founded Partners Limited	United Kingdom
	Iris Korea Limited	United Kingdom
	Iris Digital Limited	United Kingdom
	Iris Amsterdam B.V.	Netherlands
	Iris Ventures (Worldwide) Limited	United Kingdom
	Iris Culture Limited	United Kingdom
	Concise Consultants Limited	United Kingdom
	Atom42 Ltd	United Kingdom
	WDMP Limited	United Kingdom
	Pricing Solutions (UK) Limited	United Kingdom
	Iris Services Limited Dooel Skopje	Macedonia
	Irisnation Singapore Pte. Ltd.	Singapore
	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	India
	Iris Sydney PTY Ltd	Australia
	Iris Worldwide (Thailand) Limited	Thailand
	Iris Partners LLP	United Kingdom
	Holdings BR185 Limited	Brit.Virgin Is.
	Iris Germany GmbH	Germany
	Founded, Inc.	USA
	Pepper NA, Inc.	USA
	Pepper Technologies Pte. Ltd.	Singapore
	Beattie McGuinness Bungay Limited	United Kingdom
	Cheil Italia S.r.l	Italy
	Cheil Austria GmbH	Austria
	Centrade Integrated SRL	Romania
	Centrade Cheil HU Kft.	Hungary
	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	Serbia/Monten.
	Experience Commerce Software Private Limited	India
	Pengtai Greater China Company Limited	Hong Kong
	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	Indonesia

	Cheil Philippines Inc.	Philippines
	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	Singapore
	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	China
	Shilla Retail Limited	Macau
	Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	Hong Kong
	One Agency FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
	One RX Project Management Design and Production Limited Company	Turkey
	One RX India Private Limited	India
	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	Utd.Arab Emir.
	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	Utd.Arab Emir.
	One Agency South Africa (Pty) Ltd	South Africa
	Brazil 185 Participacoes Ltda	Brazil
	Iris Router Marketing Ltda	Brazil

### 3. 타법인출자 현황(상세)

2022년 반기말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 58조 8,671억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
								수량	금액						
삼성전기주	상장	1977.01.01	경영참여	250	17,693	23.7	445,244	-	-	-	17,693	23.7	445,244	9,941,374	915,432
삼성SDI주	상장	1977.01.01	경영참여	304	13,463	19.6	1,242,605	-	-	-	13,463	19.6	1,242,605	25,833,193	1,250,402
삼성중공업주	상장	1977.09.01	경영참여	125	134,027	15.2	759,935	-	-	53,611	134,027	15.2	813,546	12,138,596	-1,452,070
㈜호텔신라	상장	1979.12.01	경영참여	252	2,005	5.1	156,368	-	-	-13,632	2,005	5.1	142,736	2,656,450	27,059
㈜제일기획	상장	1988.09.01	경영참여	185	29,038	25.2	491,599	-	-	-	29,038	25.2	491,599	2,542,111	167,599
삼성에스디에스주	상장	1992.07.01	경영참여	6,160	17,472	22.6	560,827	-	-	-	17,472	22.6	560,827	10,517,432	633,381
삼성바이오로직스주	상장	2011.04.21	경영참여	30,000	20,837	31.5	443,193	1,380	1,152,699	-	22,217	31.2	1,595,892	7,970,011	393,589
삼성디스플레이주	비상장	2012.04.01	경영참여	16,009,547	221,969	84.8	18,509,307	-	-	-	221,969	84.8	18,509,307	59,994,104	3,511,314
스태코주	비상장	1995.06.29	경영참여	24,000	2,590	70.0	35,861	-	-	-	2,590	70.0	35,861	153,976	9,630
세메스주	비상장	1992.12.31	경영참여	1,000	2,173	91.5	71,906	-	-	-	2,173	91.5	71,906	1,934,072	264,283
삼성전자서비스주	비상장	1998.01.01	경영참여	30,000	6,000	99.3	48,121	-	-	-	6,000	99.3	48,121	562,348	21,122
삼성전자판매주	비상장	2000.12.21	경영참여	3,100	1,767	100.0	247,523	-	-	-	1,767	100.0	247,523	1,374,619	7,448
삼성전자로직주	비상장	1999.04.01	경영참여	76	1,011	100.0	46,669	-	-	-	1,011	100.0	46,669	386,841	6,076
삼성메디슨주	비상장	2011.02.16	경영참여	286,384	87,350	68.5	369,169	-	-	-	87,350	68.5	369,169	451,830	58,928
㈜삼성글로벌리서치	비상장	1991.05.01	경영참여	320	3,576	29.8	24,942	-	-	-	3,576	29.8	24,942	174,491	190
삼성벤처투자주	비상장	1999.11.01	경영참여	4,900	980	16.3	22,198	-	-	6,260	980	16.3	28,458	186,149	39,250
SVIC 21호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	5,707	-	-	-	0	99.0	5,707	123,575	98,824
SVIC 22호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	1	99.0	75,458	-0	-25,938	-	0	99.0	49,520	93,345	30,312
SVIC 26호 신기술투자조합	비상장	2014.11.07	경영참여	19,800	2	99.0	96,443	-0	-20,790	-	1	99.0	75,653	81,623	-435
SVIC 28호 신기술투자조합	비상장	2015.02.13	경영참여	7,425	1	99.0	69,710	0	228	-	1	99.0	69,938	498,438	231,970
SVIC 32호 신기술투자조합	비상장	2016.08.09	경영참여	19,800	2	99.0	171,141	-0	-27,720	-	1	99.0	143,421	355,271	75,710
SVIC 33호 신기술투자조합	비상장	2016.11.11	경영참여	4,950	2	99.0	166,974	0	5,148	-	2	99.0	172,122	396,087	60,496
SVIC 42호 신기술투자조합	비상장	2018.11.30	경영참여	4,950	0	99.0	18,657	0	7,858	-	0	99.0	26,515	15,429	-741
SVIC 45호 신기술투자조합	비상장	2019.05.10	경영참여	19,800	2	99.0	173,042	0	7,411	-	2	99.0	180,453	169,143	7,121
SVIC 52호 신기술투자조합	비상장	2021.05.17	경영참여	9,900	0	99.0	9,900	0	34,749	-	0	99.0	44,649	9,102	-1,532
SVIC 56호 신기술투자조합	비상장	2021.11.12	경영참여	22,084	0	99.0	22,084	0	2,970	-	0	99.0	25,054	22,404	-112
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2017.03.03	경영참여	500	50,000.00	66.7	50,000	-	-	-	50,000.00	66.7	50,000	74,436	-646
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	비상장	2020.04.27	경영참여	25,000	50,000.00	62.5	50,000	-	-	-	50,000.00	62.5	50,000	79,710	-330
㈜아이마켓코리아	상장	2000.12.07	경영참여	1,900	647	1.9	6,926	-	-	-259	647	1.9	6,667	1,120,160	44,499
㈜케이티스카이라이프	상장	2001.12.01	단순투자	3,344	240	0.5	2,194	-	-	-228	240	0.5	1,966	1,275,645	62,309
㈜용평리조트	상장	2007.05.11	단순투자	1,869	400	0.8	1,958	-	-	-358	400	0.8	1,600	841,500	8,674
에이테크솔루션주	상장	2009.11.26	단순투자	26,348	1,592	15.9	26,188	-	-	-4,776	1,592	15.9	21,412	199,719	5,590
㈜원익홀딩스	상장	2013.12.18	경영참여	15,411	1,759	2.3	8,761	-	-	-2,067	1,759	2.3	6,694	1,944,702	142,889
㈜원익아이피에스	상장	2016.04.01	경영참여	16,214	1,851	3.8	78,295	-	-	-23,137	1,851	3.8	55,158	1,167,586	145,117
㈜동진씨피엠	상장	2017.11.01	경영참여	48,277	2,468	4.8	125,863	-	-	-46,644	2,468	4.8	79,219	1,186,189	102,879
솔브레인홀딩스주	상장	2017.11.01	경영참여	30,752	462	2.2	15,976	-	-	-7,087	462	2.2	8,889	1,523,516	29,996
솔브레인주	상장	2020.07.01	경영참여	24,866	373	4.8	103,983	-	-	-18,631	373	4.8	85,352	829,947	152,221
㈜에스엔에스텍	상장	2020.08.14	경영참여	65,933	1,716	8.0	63,153	-	-	-29,260	1,716	8.0	33,893	197,439	11,499

와이어케이이쑀	상장	2020.08.14	경영참여	47,336	9,602	11.7	59,530	-	-	-21,076	9,602	11.7	38,454	459,888	50,931
쑀케이씨텍	상장	2020.11.16	경영참여	20,720	1,022	4.9	24,584	-	-	-6,133	1,022	4.9	18,451	453,026	41,947
쑀엘오티베콤	상장	2020.11.16	경영참여	18,990	1,268	7.1	21,804	-	-	-7,543	1,268	7.1	14,261	263,803	20,897
쑀뉴파워프라즈마	상장	2020.11.16	경영참여	12,739	2,141	4.9	13,723	-	-	-5,427	2,141	4.9	8,296	534,746	27,299
쑀에프에스티	상장	2021.03.16	경영참여	43,009	1,523	7.0	38,607	-	-	-16,448	1,523	7.0	22,159	345,877	28,216
쑀디엔에프	상장	2021.08.11	경영참여	20,964	810	7.0	18,509	-	-	-7,250	810	7.0	11,259	191,707	11,775
Marvell	상장	2021.10.05	단순투자	11,705	173	0.0	17,963	-	-	-8,216	173	0.0	9,747	26,103,337	-481,666
한국경제신문쑀	비상장	1987.05.01	단순투자	150	72	0.4	365	-	-	-	72	0.4	365	446,272	41,775
쑀한국비즈니스금융대부	비상장	1995.01.01	단순투자	5,000	1,000	17.2	2,964	-	-	-	1,000	17.2	2,964	85,896	1,150
쑀씨아이뱅크	비상장	2000.12.30	단순투자	8,000	1,083	7.5	0	-	-	-	1,083	7.5	0	0	0
화인칩스쑀	비상장	2001.12.01	단순투자	10	2	3.2	10	-	-	-	2	3.3	10	12,090	1,187
쑀인켈	비상장	2006.11.01	단순투자	130	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	60,103	-1,142
인텔렉추얼디스커버리쑀	비상장	2011.05.13	단순투자	5,000	357	10.7	1,922	-	-	-	357	10.7	1,922	60,847	10,718
쑀말타니	비상장	2012.04.01	단순투자	16,544	45	15.0	8,825	-	-	-262	45	15.0	8,563	67,792	-1,641
쑀팬택자선권리	비상장	2013.06.19	단순투자	53,000	53,000	10.0	0	-	-	-	53,000	10.0	0	8,151	-11,411
쑀인공지능연구원	비상장	2016.07.28	단순투자	3,000	600	14.3	3,000	-	-	-	600	14.3	3,000	9,040	-3,519
쑀미코세라믹스	비상장	2020.11.16	경영참여	21,667	747	13.7	24,636	-	-	165	747	13.7	24,801	143,870	9,419
쑀신성건설	비상장	2010.07.29	단순투자	1	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	165,328	3,411
쑀우방	비상장	2010.07.01	단순투자	0	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	650,568	104,874
쑀삼보컴퓨터	비상장	2012.09.27	단순투자	0	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	58,785	2,300
대우산업개발쑀	비상장	2012.12.18	단순투자	0	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	308,326	10,859
대우송도개발쑀	비상장	2012.12.18	단순투자	0	9	0.0	0	-	-	-	9	0.0	0	19,369	-350
자일자동차판매쑀	비상장	2012.12.18	단순투자	0	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	395,780	-10,354
성원건설쑀	비상장	2014.04.30	단순투자	0	1	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0	27,744	-627
쑀인회	비상장	2014.04.30	단순투자	0	0	0.1	0	-	-	-	0	0.1	0	2,232	-128
포인트애니빌쑀	비상장	2019.12.26	단순투자	61	12	3.5	61	-	-	-	12	3.5	61	1,359	-181
JNT(반도체펀드)	비상장	2011.02.28	단순투자	1,800	0	24.0	1,758	-	-	-	0	24.0	1,758	3,501	-2
대신아주비(반도체펀드)	비상장	2011.08.16	단순투자	258	0	3.0	258	0	-258	-	-	-	-	-	-
L&S(반도체펀드)	비상장	2012.07.30	단순투자	848	0	7.5	1	-	-	-	0	7.5	1	53,924	-967
KTCNP-GC(반도체펀드)	비상장	2013.12.01	단순투자	960	0	3.6	1,816	-	-	-	0	3.6	1,816	82,179	-15,438
포스코사회적기업펀드	비상장	2013.12.01	단순투자	600	0	10.0	60	-	-	-	0	10.0	60	726	324
베어포트리조트	비상장	2022.04.18	단순투자	-	-	-	-	51	0	-	51	0.5	0	94,074	641
SEA	비상장	1978.07.01	경영참여	59,362	492	100.0	17,166,557	-	-	-	492	100.0	17,166,557	42,982,054	823,914
SECA	비상장	1992.08.13	경영참여	3,823	0	100.0	90,922	-	-	-	0	100.0	90,922	1,861,549	9,679
SEDA	비상장	1994.01.01	경영참여	13,224	77,205.709	87.0	647,620	-	-	-	77,205.709	87.0	647,620	4,589,505	490,202
SEM	비상장	1995.07.01	경영참여	3,032	3,837	63.6	165,638	-	-	-	3,837	63.6	165,638	1,417,629	74,731
SELA	비상장	1989.04.01	경영참여	319	40	100.0	86,962	-	-	-	40	100.0	86,962	687,592	30,921
SEASA	비상장	1996.06.01	경영참여	4,696	21,854	98.0	6,779	-	-	-	21,854	98.0	6,779	72,793	8,097
SECH	비상장	2002.12.19	경영참여	597	0	4.1	597	-	-	-	0	4.1	597	737,184	69,566
SEUK	비상장	1995.07.01	경영참여	33,908	109,546	100.0	433,202	-	-	-	109,546	100.0	433,202	2,925,062	241,403
SEL	비상장	1998.12.31	경영참여	8,280	4,393	100.0	0	-	-	-	4,393	100.0	0	7,030	0
SEHG	비상장	1982.02.01	경영참여	28,042	0	100.0	354,846	-	-	-	0	100.0	354,846	395,130	113,378
SEF	비상장	1991.08.21	경영참여	230	2,700	100.0	234,115	-	-	-	2,700	100.0	234,115	1,727,313	73,640
SEI	비상장	1993.05.24	경영참여	862	677	100.0	143,181	-	-	-	677	100.0	143,181	1,477,767	55,657
SESA	비상장	1989.01.01	경영참여	3,276	8,021	100.0	142,091	-	-	-	8,021	100.0	142,091	1,208,209	46,703
SEP	비상장	1982.09.01	경영참여	204	1,751	100.0	37,616	-	-	-	1,751	100.0	37,616	271,224	7,183
SEH	비상장	1991.05.31	경영참여	1,954	753	100.0	650,157	-	-	-	753	100.0	650,157	2,504,075	157,616
SELS	비상장	1991.05.01	경영참여	18,314	1,306	100.0	24,288	-	-	-	1,306	100.0	24,288	2,305,275	13,943
SEBN	비상장	1995.07.01	경영참여	236	539,138	100.0	914,751	-	-	-	539,138	100.0	914,751	2,612,357	284,816
SEEH	비상장	2008.01.01	경영참여	4,214	0	100.0	1,369,992	-	-	-	0	100.0	1,369,992	14,651,496	24,527
SENA	비상장	1992.03.01	경영참여	392	1,000	100.0	69,372	-	-	-	1,000	100.0	69,372	1,408,535	43,962
SESK	비상장	2002.06.01	경영참여	8,976	0	55.7	263,767	-	-	-	0	55.7	263,767	1,644,977	77,453

SEPOL	비상장	1996.04.01	경영참여	5,462	106	100.0	78,267	-	-	-	106	100.0	78,267	1,141,465	61,622
SEAG	비상장	2002.01.01	경영참여	40	0	100.0	32,162	-	-	-	0	100.0	32,162	536,140	22,163
SERC	비상장	2006.01.01	경영참여	24,877	0	100.0	188,290	-	-	-	0	100.0	188,290	1,714,693	93,530
SERK	비상장	2007.07.19	경영참여	4,600	0	100.0	204,555	-	-	-	0	100.0	204,555	1,338,993	77,697
SEO	비상장	1997.01.01	경영참여	120	0	100.0	-10,043	-	-	-	0	100.0	-10,043	1,863	-166
SGE	비상장	1995.05.25	경영참여	827	0	100.0	32,836	-	-	-	0	100.0	32,836	1,776,336	30,755
SEEG	비상장	2012.07.09	경영참여	23	0	0.1	39	-	-	-	0	0.1	39	946,599	56,203
SSA	비상장	1998.12.01	경영참여	263	2,000	100.0	32,622	-	-	-	2,000	100.0	32,622	500,605	37,741
SAPL	비상장	2006.07.01	경영참여	793	877,133	100.0	981,483	-	-	-	877,133	100.0	981,483	14,683,789	4,668,478
SME	비상장	2003.05.01	경영참여	4,796	17,100	100.0	7,644	-	-	-	17,100	100.0	7,644	625,662	19,314
SDMA	비상장	1995.03.01	경영참여	21,876	71,400	75.0	18,741	-	-	-	71,400	75.0	18,741	24,681	-716
SEMA	비상장	1989.09.01	경영참여	4,378	16,247	100.0	103,402	-	-	-	16,247	100.0	103,402	263,523	19,651
SAVINA	비상장	1995.01.17	경영참여	5,839	0	100.0	28,365	-	-	-	0	100.0	28,365	105,109	26,857
SEIN	비상장	1991.08.28	경영참여	7,463	46	100.0	118,909	-	-	-	46	100.0	118,909	1,139,901	48,291
TSE	비상장	1988.01.01	경영참여	1,390	11,020	91.8	279,163	-	-	-	11,020	91.8	279,163	3,018,358	142,191
SEAU	비상장	1987.11.01	경영참여	392	53,200	100.0	111,964	-	-	-	53,200	100.0	111,964	765,487	36,667
SIEL	비상장	1995.08.01	경영참여	5,414	216,787	100.0	75,263	-	-	-	216,787	100.0	75,263	7,765,019	522,672
SRI-Bangalore	비상장	2005.05.30	경영참여	7,358	17	100.0	31,787	-	-	-	17	100.0	31,787	477,710	52,314
SJC	비상장	1975.12.01	경영참여	273	1,560	100.0	253,108	-	-	-	1,560	100.0	253,108	1,311,938	19,009
SRJ	비상장	1992.08.25	경영참여	3,120	122	100.0	117,257	-	-	-	122	100.0	117,257	161,184	3,222
SCIC	비상장	1996.03.01	경영참여	23,253	0	100.0	640,452	-	-	-	0	100.0	640,452	13,599,093	451,062
SEHK	비상장	1988.09.01	경영참여	349	274,250	100.0	79,033	-	-	-	274,250	100.0	79,033	1,788,990	21,613
SET	비상장	1994.11.01	경영참여	456	27,270	100.0	112,949	-	-	-	27,270	100.0	112,949	2,033,992	50,966
TSEC	비상장	1993.04.01	경영참여	15,064	0	48.2	103,134	-	-	-	0	48.2	103,134	551,511	82,218
SSEC	비상장	1995.04.01	경영참여	32,128	0	69.1	130,551	-	-	-	0	69.1	130,551	670,959	77,078
SESC	비상장	2002.09.01	경영참여	5,471	0	73.7	34,028	-	-	-	0	73.7	34,028	147,973	14,071
TSTC	비상장	2001.03.01	경영참여	10,813	0	90.0	260,092	-	-	-	0	90.0	260,092	654,546	8,285
SSS	비상장	2001.01.01	경영참여	1,200	0	100.0	19,189	-	-	-	0	100.0	19,189	7,765,126	325,397
SCS	비상장	2012.09.19	경영참여	111,770	0	100.0	5,275,760	-	-	-	0	100.0	5,275,760	19,049,536	1,708,832
SSCX	비상장	2016.04.25	경영참여	1,141	0	100.0	1,141	-	-	-	0	100.0	1,141	1,154,516	46,597
SESS	비상장	1994.12.30	경영참여	18,875	0	100.0	504,313	-	-	-	0	100.0	504,313	1,477,600	94,586
TSLED	비상장	2012.04.01	경영참여	119,519	0	100.0	119,519	-	-	-	0	100.0	119,519	567,151	-35,518
SSCR	비상장	2006.09.01	경영참여	3,405	0	100.0	9,332	-	-	-	0	100.0	9,332	68,955	7,843
TSST Japan	비상장	2004.03.29	경영참여	1,639	30	49.0	0	-	-	-	30	49.0	0	159	-21
STE	비상장	1996.01.01	경영참여	4,206	2	49.0	0	-	-	-	2	49.0	0	6,643	0
Semiconductor Portal Inc.	비상장	2002.12.01	단순투자	38	0	1.2	10	-	-	-	0	1.2	10	1,981	159
Nanosys Inc.	비상장	2010.08.13	단순투자	4,774	2,000	0.8	2,387	-	-	-	2,000	0.8	2,387	144,024	-10,951
One-Blue, LLC	비상장	2011.07.14	경영참여	1,766	0	16.7	1,766	-	-	-	0	16.7	1,766	19,960	603
TidalScale Inc.	비상장	2013.08.12	단순투자	1,112	2,882	4.3	1,112	-	-	-	2,882	4.3	1,112	6,067	-6,521
Sentilance NV	비상장	2012.12.01	단순투자	3,422	7	7.2	3,422	-	-	-	7	7.2	3,422	13,840	-2,927
Mantis Vision Ltd.	비상장	2014.01.16	단순투자	1,594	355	2.1	1,980	-	-	-	355	2.1	1,980	19,901	-27,332
Leman Micro Devices SA	비상장	2014.08.14	단순투자	1,019	17	3.4	1,019	-	-	-	17	3.4	1,019	3,602	-3,363
Keyssa, Inc.	비상장	2016.01.28	단순투자	3,332	1,235	1.9	3,332	-	-	-	1,235	1.9	3,332	6,371	-16,193
Sensifree LTD	비상장	2016.01.01	단순투자	2,111	666	9.5	2,111	-	-	-	666	9.5	2,111	1,119	-1,710
Unispectral Ltd.	비상장	2016.02.29	단순투자	1,112	2,308	7.9	2,130	-	-	-	2,308	7.9	2,130	3,357	-2,757
Quobyte, Inc.	비상장	2016.04.28	단순투자	2,865	729	11.8	2,865	-	-	-	729	11.8	2,865	2,391	-82
Afero, Inc.	비상장	2016.05.04	단순투자	5,685	723	5.5	5,685	-	-	-	723	5.5	5,685	59,600	-6,289
Graphcore Limited	비상장	2016.06.30	단순투자	3,494	12,000	1.4	3,494	-	-	-	12,000	1.4	3,494	279,496	-148,852
SoundHound Inc.	상장	2016.12.01	단순투자	7,059	306	1.1	7,059	1,415	6,659	-7,756	1,721	0.9	5,962	58,330	-91,002
Almotive GmbH.	비상장	2017.12.22	단순투자	3,302	2	3.2	3,302	-	-	-	2	3.2	3,302	50,466	-6,913
Fasetto, Inc.	비상장	2019.01.29	단순투자	6,701	475	5.2	12,554	-	-	-	475	5.2	12,554	4,129	-7,665

합 계	-	-	57,890,266	2,846	1,143,016	-166,154	-	-	58,867,128	-	-
-----	---	---	------------	-------	-----------	----------	---	---	------------	---	---

※ 별도재무제표 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 최초취득일자의 날짜는 일부 과거 취득시 자료 확보가 현실적으로 곤란한 경우 일괄적으로 1일로 기재하였습니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.

※ 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여, 성원건설(주)은 2016년 12월 31일, 대우중도개발(주)는 2017년 12월 31일,

Mantis Vision은 2019년 12월 31일, Keyssa, Graphcore는 2020년 12월 31일 현재의 재무 현황을 기재하였습니다.



## 4. 연구개발실적(상세)

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Flat QLED 8K TV (65 · 75 · 85")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최초 화면과 베젤 간 경계 없는 Infinity 스크린, 플랫한 디자인으로 벽면과의 조화, Floating한 느낌의 메탈 스탠드 적용한 혁신적 폼팩터</li> <li>- 실재를 보는 듯한 화질을 제공하는 QLED 8K 화질, AI Upscaling을 통한 고해상도 화질 경험, 어떤 환경에서도 True Reality화질 제공</li> <li>- 멀티사운드 채널과 Object Tracking Sound+ 적용하여 영상과 사운드가 일치되어 입체감 극대화</li> <li>- 다양한 콘텐츠, Multimedia Experience 및 엔터테인먼트 특화된 기능으로 편리하고 다양한 경험 제공</li> </ul> </li> </ul>
	Neo QLED 8K (2021.03. ~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mini LED 기반 초고화질 &amp; 슬림 8K TV (65 · 75 · 85")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- QN900 (65 · 75 · 85") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN700 (65 · 75")</li> <li>- 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실재를 보는 듯한 QLED 8K 화질</li> <li>- 'OTS Pro(Object Tracking Sound Pro)' 기능 추가</li> </ul> </li> </ul>
	Neo QLED 4K (2021.03. ~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98")</li> <li><input type="checkbox"/> Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED</li> <li>- 계조 표현력 4배 향상으로 밝고 어두운 영역을 더욱 자세하게 표현</li> </ul> </li> </ul>
	QD-Display TV (~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65")</li> <li><input type="checkbox"/> Quantum Dot 기반 self-emitting Display 고화질과 Sleek한 Blade Slim Design에 OTS 및 True Ch. ATMOS 까지 모두 적용된 진정한TV 가치를 제공하는QD-Display TV</li> </ul>
	QLED 4K TV (~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV (43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED</li> <li>- 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화</li> <li>- 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공</li> <li>- 외장 Camera 적용을 통한 Google Duo 지원</li> </ul> </li> </ul>
	UHD TV (~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV</li> <li>- Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질</li> <li>- Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공</li> <li>- Game Home, IoT Hub, Watch/Chat together 기능 추가를 통한Smart 경험 강화</li> </ul> </li> </ul>
	Lifestyle TV (~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> The Sero (43")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modern &amp; Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design</li> <li>- 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공</li> <li>- 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성</li> <li>- 다양한 영화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용</li> <li>- 초대형 Life Style 제품 니즈에 따른 85" 추가도입</li> <li>- 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> The Serif (43 · 49 · 55 · 65")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화</li> <li>- 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입</li> <li>- 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Outdoor TV(55 · 65 · 75")               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품</li> </ul> </li> </ul>

		<input type="checkbox"/> The Premiere (100~130") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초단초점 · 레이저 · 고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공</li> <li>- Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영</li> <li>- 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질 · 음질을 제공하는 프로젝트더</li> </ul> <input type="checkbox"/> The Freestyle (30 ~ 100") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 언제 어디서나 다양한 콘텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen</li> <li>- 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone)</li> <li>- 기본Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능</li> </ul>
	Micro-LED TV (~2022.01.)	<input type="checkbox"/> The Wall 2.0 (110") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tech. leadership 및 Micro-LED 시장 장악력 강화하기 위해 Micro-LED 완품형 출시</li> <li>- 실제 세상을 화면에 재현하는 초대형 Home Screen</li> <li>- 해상도 제약없이, 실재를 보는 듯한 공간감 및 깊이감/입체감 있는 Micro-LED 화질</li> </ul>
	Sound Bar (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Sound Bar <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV와 조화로운 'Bar' 형태의 오디오 제품</li> <li>- 음성 인식 AI Solution 채용</li> <li>- 3D 서라운드 채용으로 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현</li> </ul> <input type="checkbox"/> Sound Bar Q990B <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS)</li> <li>- TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공</li> <li>- 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재</li> </ul>
	모니터 (2021.01. ~2022.06.)	<input type="checkbox"/> 스페이스 모니터 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모니터가 차지하는 공간을 최소화한 일체형 Arm Stand 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> Neo QLED 게이밍 모니터(49") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neo QLED 적용하여 향상된 명암비를 기반으로 블랙 표현력 강화</li> <li>- 세계 최고 곡률 1000R 적용하여 게이밍 몰입 강화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 고해상도 QHD 모니터(34") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intelligent Eye Care 솔루션 등으로 눈에 편안한 화질 솔루션 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> LCD 스마트 모니터: 스마트 TV 서비스 활용하여 PC 없이 VOD 시청 (Netflix, Youtube 등) <input type="checkbox"/> 스마트 모니터 M80B (32") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인</li> <li>- Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션</li> <li>- 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 게이밍 모니터 G85NB (32") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved)</li> <li>- 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000)</li> </ul>
	사이니지 (2019.10. ~2021.06.)	<input type="checkbox"/> LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall 등) (49 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 <input type="checkbox"/> 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 향균 코팅</li> </ul> <input type="checkbox"/> FLIP-Edu (75 / 85") 교육용 인터랙티브 제품
생활가전	냉장고 (~2022.02.)	<input type="checkbox"/> Chef Collection 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프리미엄 Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용</li> <li>- Water &amp; Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Auto Ice Maker (Dual Mode: Cocktail Ice, Standard Ice)</li> <li>- FDSR 에너지 1등급 구현</li> </ul> <input type="checkbox"/> Cube 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multi Cube 냉장고, 나에게 맞춘 디자인과 수납(와인, 맥주, 화장품 등 온도별 저장)</li> <li>- Peltier System 구현, 최적의 온도 제어 (5~18℃ 온도 조절 가능)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2중 Glass System 적용으로 자외선 차단 및 정온 유지</li> <li>- Wi-Fi Control로 상시 모니터링 · 제어</li> <li>- RM(Remote Management) Function: 각종 오류 원격 진단 · 조치 및 보관중 음료의 유통기한 알림</li> <li>□ 북미/중남미 신규 TMF <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대용량, 전문보관, New Design으로 경쟁력 강화 및 제품 차별화(440L/480L)</li> <li>- Flex Zone(Fridge 1℃ / Chilled -1℃ / Soft Freezing) &amp; Quick Chill Smart Alarm</li> <li>- Flat Door &amp; Bespoke CMF, 용량 및 최적 사이즈로 경쟁력 강화(20ℓ More)</li> <li>- Bi Volt(Free Voltage), Auto Icemaker, Water Dispenser, Big Box, Hygiene</li> </ul> </li> <li>□ 1-Door Premium Kitchen Fit 냉장고 (냉동/냉장/김치/와인) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premium Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용</li> <li>- Auto Door Open</li> <li>- Water &amp; Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Dual Auto Ice Maker(Cocktail Ice, Standard Ice)</li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;">세탁기 (~2022.01.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ BESPOKE 세탁기 &amp; 건조기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당신의 공간에 딱 맞추는 비스포크 Flat 디자인</li> <li>- 국내 최대 용량 올인원 컨트롤 UX 디자인</li> <li>- 세탁부터 건조까지 AI 의류 케어(AI 맞춤세탁, 건조)</li> <li>- 99.9% 살균부터 세탁실 제습까지 위생관리 솔루션</li> </ul> </li> <li>□ Agitator 세탁기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북미 Agitator 신규 시장 진입(Top Loader 시장 중 50% 점유)</li> <li>- ActiveWave™ Agitator 구현으로 소음, 진동 및 엉킴 줄이는 동시에 강력 세탁 가능</li> <li>- 'Active Water Jet' 구현으로 애벌 세탁 가능</li> </ul> </li> <li>□ 구주향 친환경 신냉매 건조기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 냉매 : 온실가스감축을 위한 친환경 냉매(R290) 적용</li> <li>- 에너지 A+++ : 구주 에너지 최고 등급 달성</li> <li>- Sensor Dry : 건조행정 중 건조도 감지, 추가 건조부터 행정 종료까지 알아서 판단</li> <li>- Simple UX : 제품 사용성 개선 (상세한 건조 정보 전달 및 맞춤형 패널 설정)</li> <li>- Hygiene Care : 유해 세균3종(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 99% 이상 살균</li> </ul> </li> <li>□ 그랑데 AI 24kg 세탁기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24kg, Flat Design (Glass Type)</li> <li>- 핏케어 코스 적용(열룩, 냄새, 알러젠 제거)</li> <li>- Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림)</li> </ul> </li> <li>□ BESPOKE 그랑데 AI 20kg 건조기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내최초 최대 용량 20kg, Flat Design</li> <li>- 핏케어 코스 적용(털제거 특화),</li> <li>- Auto open door 적용(건조 종료 후 자동으로 문 열림)</li> <li>- 온/습도 센서추가하여 세탁실 주변 습도 감지하여 제습 솔루션 제공</li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;">에어컨 (~2021.04.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 무풍 갤러리 스탠드 에어컨(56.9 · 62.6 · 75.5 · 81.8 · 92.5㎡) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 에너지 우위 확보가 가능한 최고 효율 Next 무풍 플랫폼 개발(56.9㎡ 싱글 에너지 2등급 달성)</li> <li>- 1.5배 넓어진 무풍 면적(패널)과 강력한 부스터풍</li> <li>- 부스터 청정: 집진효율 99.95% 필터, 가구같이 편안한 갤러리 디자인</li> </ul> </li> <li>□ 무풍 벽걸이 와이드 에어컨(24.4 · 29.3 · 39.6 · 49.5㎡) <ul style="list-style-type: none"> <li>- QMD 기반의 신규 통합 플랫폼 개발로 원가경쟁력 확보, 제품 경쟁력 강화</li> <li>- 12% 더 커진 팬으로 빠르고 시원한 패스트 쿨링</li> <li>- 전기로 부담을 최대 77% 덜어주는 무풍 미세 초절전</li> <li>- 초미세먼지까지 제거하는 PM1.0 필터시스템의 무풍청정</li> </ul> </li> <li>□ BESPOKE 원도우핏 에어컨(17㎡, 그린/블루/핑크/베이지/그레이) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내외기 일체형으로 셸프 간편 설치</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2중 바람 날개로 냉기를 빠르게 순환하는 강력 회전 냉방</li> <li>- 트윈 인버터 컴프레서로 도서관 수준의 37dB 저소음&amp;저진동</li> <li>- 저소음 모드 사용 시 소비전력 최대70% 절전</li> </ul>
	청소기 (~2021.05.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 제트 스타크 청소기(최고 흡입력 210W) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일체형 자동 먼지배출기, 스마트한 정보전달(LCD Display)</li> <li>- 물분사 물걸레 브러시, 슬림 용 브러시</li> </ul> <input type="checkbox"/> 제트봇 AI 로봇 청소기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Active 3D 센서 개발 및 세계최초 적용하여 세계 최소(1cm<sup>2</sup>) 감지 실현으로 걸림 없는 주행</li> <li>- 우리집 구조와 사물 종류까지 인식하는 AI 자율주행</li> <li>- 제트 사이클론과 디지털 인버터모터로 강력한 흡입력</li> <li>- 충전과 동시에 자동 먼지비움 일체형 청정스테이션</li> <li>- SmartThings로 더욱 편리해진 청소(AI 스마트컨트롤)</li> </ul> <input type="checkbox"/> BESPOKE 슬림 스타크 청소기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강력한 사이클론과 디지털 인버터모터로 최대 150W 흡입력</li> <li>- 셀프 스탠딩 및 허리 부담없이 간편 먼지 비움(POP &amp; SHOOT)</li> <li>- 손목에 무리없이 가볍게 청소(인체공학 설계)</li> </ul>
	조리기기 (2021.03.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 쿠키(Qooker) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 열원이나 온도/시간이 다른 식품을 한번에 맞춤 조리하는 "멀티쿡"</li> <li>- Multi Cook: 하나 이상의 조리가 동시에 완료되어지는 모드 적용</li> <li>- 식품사(8개 회사)와 연계 쿠키 전용 알고리즘 적용</li> <li>- SmartThings 연계 스캔 한번으로 쉽게 자동 조리 구현</li> <li>- 열효율 및 고급강 STS 조리실: 법랑 → STS 적용</li> </ul>
	정수기 (2021.03.)	<input type="checkbox"/> 가정용 Water Purifier <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소비자 라이프스타일에 따라 업그레이드하고 스스로 케어하는 모듈형 정수기</li> <li>- 소비자 니즈에 따라 선택 가능한 모듈(정수/냉수/온수)</li> <li>- Smart AI 케어 및 직수형 최다항목 NSF 인증 필터</li> <li>- 라이프 스타일과 공간 맞춤 『BESPOKE 정수기』</li> </ul>
	의류관리기 (2019.02. ~2021.05.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 에어드레서 (18 · 24") <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 건조 및 세탁기 코스 연동</li> <li>- 긴 옷도 편리하게 관리하는 긴 옷 케어존, 18인치 3벌 →5벌 용량 확장</li> <li>- 리얼 케어(안감 케어, 저소음), 리얼 청정(미세먼지필터), 리얼 탈취(냄새분해필터)</li> <li>리얼 살균(제트스팀), 주름관리, 리얼 공간제습</li> </ul> <input type="checkbox"/> 슈드레서 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 에어워시와 UV 냄새분해필터로 강력 탈취</li> <li>- 매일 신는 신발 기분 좋게 저온세세검조</li> <li>- 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 99.9% 살균</li> <li>- 제트슈트리로 다양한 신발 맞춤케어 관리</li> </ul>
	공기청정기 (2020.12.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE Cube 공기청정기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespoke를 적용한 프리미엄 공기청정기</li> <li>- 살균 · 탈취 · Pet 3가지 전문 필터를 소비자의 필요에 따라 사용</li> <li>- 공간, 인테리어, 라이프 스타일 맞춤 Bespoke 공기청정기</li> <li>- 인테리어에 어울리게 벽에 붙여 사용해도 성능 저하 없는 입체 흡입 구조</li> </ul>
	청정환기 시스템 (2020.09.)	<input type="checkbox"/> 청정환기 시스템 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청정성능 33㎡, 환기풍량 40~50CMH</li> <li>- 환기장치에 실내청정모듈 연결로 환기와 실내청정 동시 구현</li> <li>- 각 재실공간별 개별&amp;독립 청정 및 순환&amp;무풍 청정</li> <li>- CO2센서 등의 센서 탑재를 통한 상황맞춤 자동 환기제어</li> </ul>

		인버터 제습기 (2022.05.)	<input type="checkbox"/> 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습</li> <li>- 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어</li> <li>- 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조</li> <li>- 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈</li> <li>- 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드</li> </ul>
		식기세척기 (2022.06.)	<input type="checkbox"/> 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구주 시장 Tall Tub 대응</li> <li>- 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보</li> <li>- 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화</li> <li>- Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화</li> </ul>
MX		갤럭시 폴더블 (2019.09. ~2021.08.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Fold (2019.09.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최초 In-Foldable Smart Phone 개발을 통한 신규 시장 창출 및 Market Share 확보</li> <li>- 7.3" QXGA+(1,536×2,152) 1.5R In-Foldable Display</li> <li>- 세계 최초 In-Foldable용 Hinge 개발을 통해 표준 기술 확보(2019.02. 공개)</li> <li>- 폴더블 스마트폰에 맞는 새로운 User Experience 제공</li> <li>- 3분할 Multi Active Window 기능으로 독보적인 멀티태스킹 환경 제공</li> <li>- 폴딩 · 언폴딩 시 다른 스크린 간 자연스러운 연속적인 앱 사용성 경험 제공</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip (2020.02.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: The New Style with Innovative Foldable Display</li> <li>- 인치: Main 6.7" Flexible Ultra Thin Glass(2,636 x 1080) Cover 1.1" Super AMOLED(300 x 112)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (Unfolded) 73.6mm x 167.3mm x 6.9~7.2mm (Folded) 73.6mm x 87.4mm x 15.4~17.3mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM855+, Android 10.0</li> <li>- Ultra Thin Glass 기술로 갤럭시 최초 접히는 유리 디스플레이 탑재하여 내구성 강화</li> <li>- Flip 폴드 형태의 Compact한 신규 폼팩터로 휴대성 강화</li> <li>- Free-Stop 기능을 통해 접히는 각도를 자유롭게 조절하는 Flex Mode 사용 경험 제공</li> <li>- 21.9 : 9 화면 비율로 상하 Multi Active Window 사용성 강화</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold2 (2020.09.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (접힘상태) 68 x 159.2 x 13.8 (~16.8) mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM865 Plus, Android 10.0, One UI 2.5</li> <li>- 초고속 5G 이동통신 지원, 1,200만 화소 카메라</li> <li>- 인피니티 플렉스 디스플레이(Infinity Flex Display), 플렉스 모드 지원</li> <li>- 120Hz 가변 주사율의 다이내믹 아몰레드 2X 디스플레이(Dynamic AMOLED 2X display)</li> <li>- 삼성 Ultra Thin Glass</li> <li>- 무선 연결 삼성 덱스(Samsung Dex), UWB(초광대역) 지원</li> <li>- 최대 3개의 앱을 동시에 사용할 수 있는 진화된 멀티 액티브 윈도우</li> <li>- 커버 디스플레이에서 메인 디스플레이로 앱 연속성 제공</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold3 5G (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 158.2mm x 67.1mm x 14.4~16.0mm (펼쳤을 때) 158.2mm x 128.1mm x 6.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1</li> <li>- 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원)</li> <li>- 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7.6"인피니티 플렉스 디스플레이 탑재 및 언더 디스플레이 카메라 (Under Display Camera) 적용</li> <li>- 에코스퀘어(Eco2) 기술로 디스플레이 화면 약 29% 밝기 향상</li> <li>- 메인 / 커버 디스플레이 모두 120Hz 화면 주사율 지원</li> <li>- 폴더블폰 최초로 S펜 적용</li> <li>- 플렉스 모드패널(Flex Mode Panel)로 최적화 되지 않은 앱도 원하는 각도에서 상하단 표시 지원</li> <li>- 최대 3개 앱까지 화면 분할해 사용하는 멀티 액티브 윈도우 (Multi-Active Windows) 지원</li> </ul> <p>□ Galaxy Z Flip3 5G (2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 86.4mm x 72.2mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 166mm x 72.2mm x 6.9mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1</li> <li>- 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원)</li> <li>- 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화</li> <li>- 커버 디스플레이 사용성 강화: 알림/메시지 8줄까지 확인가능, 날씨/걸음수 위젯 지원, 삼성페이 결제 지원</li> <li>- 플렉스 모드 활용 강화: 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절하는 자동 프레임링(Auto Framing), 듀얼 프리뷰 (Dual Preview) 등 지원</li> <li>- 메인 디스플레이 120Hz 화면 주사율 지원</li> </ul>
	갤럭시 S (~2022.02.)	<p>□ Galaxy S10e · S10 · S10+ · S10 5G (5.8 · 6.1 · 6.4 · 6.7") (2019.03., 5G: 2019.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Full Front Punch Hole Infinity Display</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos9820, SDM855, Android 9.0</li> <li>- 세계 최초 5G 기술 상용화 단말</li> <li>- Triple Camera 조합으로 Zoom, Tele, Ultra Wide 촬영 가능 (12M(Wide)+12M(Tele)+16M(Ultra Wide))</li> <li>- 세계 최초 HDR10+ 동영상 모바일 녹화 지원</li> <li>- Dynamic AMOLED Display로 원본에 가까운 색 표현, HDR 화질 지원</li> <li>- 초음파 방식 On-Screen 지문인식 센서 탑재</li> </ul> <p>□ Galaxy S20 · S20+ · S20 Ultra 5G (2020.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Best Fit in hand compact, yet large screen design</li> <li>- 인치: S20 6.2", S20+ 6.7", S20 U 6.9"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): S20 69.1 x 151.7 x 7.9 mm, S20+ 73.7 x 161.9 x 7.8 mm, S20 U 76.0 x 166.9 x 8.8 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865, Android 10.0, One UI 2.1</li> <li>- 비약적으로 향상된 해상도와 8K 동영상 촬영으로 전에 없던 퀄리티의 사진과 영상을 찍고 5G로 쉽고 빠르게 공유하여 모바일과 사진의 미래를 바꿀 스마트폰</li> <li>- 비약적으로 향상된 해상도로 완성하는 사진과 동영상: S20 · S20+ 64MP, S20 U 108MP</li> <li>- 스마트폰 사상 가장 높은 배율의 스페이스 줌(100배): S20 U 108MP</li> <li>- 3배 가까이 커진 센서로 야간에도 더 밝고 선명한 사진 · 동영상 기록(AI기술점목)</li> <li>- 스마트폰 사상 가장 뛰어난 8K 해상도의 동영상 촬영</li> <li>- 떨리는 순간에도 흔들림은 적게, 역동적인 모습은 고스란히 담은 슈퍼스테디</li> <li>- 단 한번의 촬영으로 베스트 사진과 동영상을 남길 수 있는 싱글테이크</li> </ul> <p>□ Galaxy S20 FE (2020.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 더 많은 고객에게 S 시리즈의 경험 제공</li> <li>- 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED Infinity-O (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 74.5mm x 159.8mm x 8.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865, Android 10.0, One UI 2.5</li> <li>- 프리미엄 기능을 흡수한 새로운 Entry Flagship Line 제품으로 시장 영향력 확대 및 소비자에게 최적화된 다양한 기능의 경험 기회 부여</li> </ul>

		<p>- S20 핵심 기능 제공: 120Hz display, Camera, Battery 등 동일 체험 제공, Flagship 동등 AP 사용 및 One UI 2.5 UX</p> <p>☐ Galaxy S21 5G · S21+ 5G · S21 Ultra 5G (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design</li> <li>- 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm, S21 Ultra 5G 75.6 x 165.1 x 8.9 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos2100, SDM888, Android 11.0, One UI 3.1</li> <li>- 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6E 지원, 고화소 카메라 탑재</li> <li>· 카메라: S21 Ultra 1억 8백만 화소, S21 · S21+ 6,400만 화소, Multi Camera Recording 기능</li> <li>· 최대 120Hz 가변 주사율 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 디스플레이 탑재</li> <li>· SmartTag와 연동한 쉬운 사물 등록 · 찾기 기능 지원</li> <li>· Digital Car Key 서비스 지원(S21+ 5G · S21 Ultra 5G only)</li> <li>· S Pen 지원(S21 Ultra 5G only)</li> </ul> <p>☐ Galaxy S22 · S22+ · S22 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality</li> <li>- 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8"</li> <li>- 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM8450   Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1</li> <li>- 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화</li> <li>· 동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화</li> <li>· 저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용</li> <li>- S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra)</li> <li>- Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,800nit(S22 Ultra)</li> <li>- All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+)</li> <li>- 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus Glass 적용</li> <li>- Galaxy Foundation 경험 완성도 제고</li> <li>· One UI 4.1: 감성적 Interaction경험과 사용자 개인경험 고도화</li> <li>· Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화</li> </ul> <p>☐ Galaxy Note10 · 10+ (6.3 · 6.8") (2019.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Full Front Punch Hole Infinity Display</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos9825, SDM855, Android 9.0</li> <li>- 업그레이드된 S Pen</li> <li>· Battery 증대 및 BT Latency 개선으로 Pen 사용성 강화</li> <li>· 사진 촬영(모드 변경, 줌인아웃), 음량조절, 앱 실행, 스톱워치 동작 지원 등</li> <li>- Note10+: Quad 카메라 탑재로 다양한 조도 환경에서 고해상도 및 최대 시야각 촬영 지원</li> <li>· 12M(Wide) + 12M(Tele) + 16M(Ultra Wide) + VGA</li> <li>※ Note10은 Triple 카메라 탑재</li> </ul> <p>☐ Galaxy Note20 · 20 Ultra (6.7 · 6.9") (2020.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사이즈(W x H x D): Note20 75.2 x 161.6 x 8.3 mm, Note20 Ultra 77.2 x 164.8 x 8.1 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865 Plus, Android 10, One UI 2.5</li> <li>- 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6 지원</li> <li>- 갤럭시 스마트폰 최초로 UWB(Ultra Wideband, 초광대역통신) 지원(Note 20 Ultra)</li> <li>- 1억 8백만 화소 카메라(Note 20 Ultra), 6,400만 화소 카메라(Note 20)</li> <li>- 최대 120Hz 주사율의 디스플레이(Note 20 Ultra)</li> <li>- 최초 무선 연결 삼성 맥스(Samsung DeX) 연결 지원</li> </ul>
	갤럭시 노트 (~2020.08.)	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 완벽한 필기감과 함께 편리한 사용성을 제공하는 S펜과 삼성 노트, MS 엑스박스(Xbox) 게임 지원</li> </ul>
갤럭시 탭 (~2022.02.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Tab S7 · S7+ (2020.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Premium Tablet (Display, Pen, Performance)</li> <li>- 인치: 12.4" WQXGA sAMOLED(16:10, 2800x1752/120Hz), 11" WQXGA LTPS TFT(16:10, 2,560x1,600/120Hz)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 285.0 x 185.0 x 5.7mm(12.4"), 253.8 x 165.3 x 6.3mm(11")</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM865+, Android 10.0, One UI 2.5</li> <li>- 대형 Display 박형 Metal 디자인 구현으로 프리미엄 제품 경쟁력 확보</li> <li>- Tablet 최초 5G (mmWave) 탑재하여 Global 및 미주 4대 사업자 출시</li> <li>- 120Hz Display 고속 구동 및 Pen Latency(9ms) 최적화로 Samsung Notes 사용성 강화</li> <li>- N세대 AP 탑재로 Performance 극대화(Seamless multi-tasking &amp; gaming experience)</li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> Galaxy Tab S7 FE (2021.06.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 12.4" WQXGA (2560 x 1600)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 284.8mmx 185mm x 6.3mm, 608g(LTE 기준)</li> <li>- 12.4" 대화면 Display와 slim 베젤로 몰입감 있는 디스플레이</li> <li>- 긴 배터리 사용시간 (10,090mAh, Up to 13 hours video play)</li> <li>- Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드</li> <li>- Samsung Note 사용성 강화             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 간편하게 손글씨를 TEXT로 변환</li> <li>· 입력창에 직접 S Pen으로 입력</li> </ul> </li> <li>- PENUP Drawing 기능 강화             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Layer 구조 적용 및 컬러링 &amp; 라이브 드로잉 제공</li> </ul> </li> <li>- 경량화 키보드 커버 (330g)</li> <li>- 3Mic를 통한 주변 Noise 50%감소로 깨끗한 보이스 전달</li> <li>- Device 연결성 강화             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용</li> <li>· Hand off: Phone에서 사용하던 걸 Tablet에서 바로 이어서 사용 (Internet, Samsung Notes)</li> <li>· Copy &amp; Paste: Phone과 Tablet 간 Text 및 이미지를 복사 &amp; 붙이기</li> <li>· Auto Switching: 자동으로 Phone/Tablet 간 버즈 스위칭</li> </ul> </li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> Galaxy Tab A8 (2021.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 10.5" WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 246.8mm x 161.9mm x 6.9mm, 508 g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): UniSOC T618(12nm) 프로세서, Android 11, One UI 3</li> <li>- Memory : 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 4GB + 128GB, microSD 최대 1TB 전작 대비 RAM 4GB 및 ROM 128GB 옵션 신규 제공</li> <li>- 당사 Tablet Design ID 확립 및 적용 (Samsung Logo, Camera 형상 및 위치, 측면 전후면 대칭), Tab S8 Flagship Family 와 동일 컬러 적용 (Gray, Silver, Pink Gold)</li> <li>- 당사 태블릿 표준 Display 비율 16:10 적용, 10.5"대화면 및 Slim Bezel로 몰입감 있는 멀티미디어 경험 제 공</li> <li>- Dolby Atmos 지원 및 Quad Speaker 탑재, Samsung TV Plus 등 콘텐츠 특화 앱 프리로드 (무료 Live Streaming 및 VOD 제공)</li> <li>- Multi-Active Window 로 2 Split Windows 및 Pop-up 창 지원, Fold3 적용된 Drag &amp; Split 태블릿 최초 지 원으로 멀티태스킹 경험 강화</li> <li>- Tab A 시리즈 최초 Screen Recorder 지원으로 온라인 클래스 활용도 강화</li> <li>- One UI 3.1.1 Galaxy Experience 확산 지원 (Copy&amp;Paste, Auto Sync, Auto Switch)</li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> Galaxy Tab S8 · S8+ · S8 Ultra (2022.02.) <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : Tab S8      11" WQXGA+ (2560 x 1600)</li> <li style="padding-left: 20px;">Tab S8+      12.4" WQXGA+ (2800 x 1752)</li> <li style="padding-left: 20px;">Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : Tab S8      253.8mm x 165.3mm x 6.3mm, 503g</li> <li style="padding-left: 20px;">Tab S8+      285.0mm x 185.0mm x 5.7mm, 567g</li> <li style="padding-left: 20px;">Tab S8 Ultra 326.4mm x 208.6mm x 5.5mm, 726g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SM8450 프로세서, Android 12, One UI 4.1</li> <li>- Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB</li> <li>- 화상 통화 경험 향상</li> <li style="padding-left: 20px;">[Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공</li> <li style="padding-left: 20px;">[Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공</li> <li>- AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상</li> <li>- S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화</li> <li style="padding-left: 20px;">Writing &amp; Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선</li> <li>- 3 MIC Noise Cancelation 성능 강화 (3중 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상</li> <li>- 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선</li> <li>- D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축</li> </ul>
	갤럭시 A (~2022.04.)	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Galaxy A52 LTE · 5G (2021.03.)       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화</li> <li>- 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 75.1mm x 159.9mm x 8.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM750G(5G) / SDM720G(LTE), Android 11, One UI 3.1</li> <li>- Supreme smooth UX/Dynamic refresh rate and Brightest (6.5" sAMOLED with 120Hz(5G)/90Hz(LTE), 800nit)</li> <li>- High-resolution 64MP Quad Camera (64M OIS/12M UW/5M Depth/5M Macro)</li> <li>- Powerful AP with High Capacity Battery (4,500mAh)</li> </ul> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Galaxy A72 (2021.03.)       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화</li> <li>- 인치: 6.7" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 77.4mm x 165.0mm x 8.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM720G, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- High refresh Rate Brightest Display (6.7" FHD+ sAMOLED with 90Hz, 800nit)</li> <li>- Advanced High-res/Multi Camera, More detail with blur-less (64M OIS/12M UW/8M Tele/5M Macro)</li> <li>- Long-lasting Battery with bigger capacity (5,000mAh)</li> </ul> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Galaxy A32 LTE · 5G (LTE: 2021.03., 5G: 2021.01.)       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화</li> <li>- 인치: LTE 6.4" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080) / 5G 6.5" HD+ TFT (1,600 x 720)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): LTE 73.6mm x 158.9mm x 8.4mm / 5G 76.1mm x 164.2mm x 9.1mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): LTE MT6769T / 5G MT6853V, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- LTE           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Brightest Display: 800nit Super AMOLED</li> <li>· High Resolution Camera: 64MP Quad (64M W/8M UW/5M Macro/5M Depth)</li> <li>· High Capacity Battery: 5,000mAh</li> </ul> </li> <li>- 5G           <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rich Camera Experience of 48MP Quad(48M W/8M UW/5M Macro/2M Depth)</li> <li>· High Capacity Battery: 5000mAh</li> </ul> </li> </ul> </div> <div style="padding-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Galaxy Quantum2 A82 (2021.04.)     </div>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 6.7" QHD+ (3200 x 1440)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 161.9mm x 73.8mm x 8.1mm, 176g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM855+, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- QRNG 보안칩셋 적용</li> <li>- 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원</li> <li>- 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP)</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy A03-Core (2021.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.5" HD+(1480 x 720) TFT 60Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 164.2mm x 75.9mm x 9.1mm, 211g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : 28나노 옥타코어 프로세서, Android 11(Android GO)</li> <li>· 전작 A01-Core(28나노 쿼드코어 프로세서) 대비 CPU 성능 향상</li> <li>- Entry 시장 대응을 위한 대화면/대용량 배터리 적용 초저가 제품</li> <li>· 전작A01-Core 대비 디스플레이(5.3"→6.5" HD+), 배터리(3,000→5,000mAh) 강화</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy A23 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.6"FHD+ (2400 x 1080) 90Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : 6나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI 4.1</li> <li>- 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz)</li> <li>- 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능</li> <li>- 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy A13 5G (2022.01.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.5"HD+ (1600 x 720) 90Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g</li> <li>- 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz)</li> <li>- LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델</li> <li>- Entry 시장 대응을 위한 AP(5G) AP(MT6765 → MT6833v)강화</li> <li>- 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy A13 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.6"FHD+ (2400 x 1080) 60Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : 8나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI Core 4.1</li> <li>- 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공</li> <li>- 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능</li> <li>- 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy A73 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.7"FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1</li> <li>- 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능</li> <li>- 120Hz 고주사율과 sAMOLED display적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험</li> <li>- 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2days battery) 및 25W 초고속 충전 지원</li> <li>- Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공</li> <li>- One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy A53 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.5"FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작비 0.3t↓, 500mAh↑)</li> <li>- 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험</li> <li>- Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상</li> <li>- One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공</li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy A33 5G (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1</li> <li>- 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz)</li> <li>- 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능</li> <li>- Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&amp;방진 지원으로 내구성 향상</li> <li>- 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원</li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book Flex 2 (2020.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: QLED 적용 2-in-1 PC with S Pen</li> <li>- 인치: 15.6" QLED FHD (16:9, 1920 x 1080), 13.3" QLED FHD (16:9, 1920 x 1080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (15.6") 355.0mm x 227.2mm x 14.9mm, (13.3") 302.6mm x 202.9mm x 12.9mm</li> <li>- Platform, OS: Intel 11세대 CPU, Windows 10</li> <li>- QLED: Color Volume 100%, Super Bright Outdoor Mode Max 600nit</li> <li>- S Pen: Samsung Notes, Clip Studio, Gesture</li> <li>- SSD: Powerful performance &amp; Latest Gen4 SSD</li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book Flex2 5G (2020.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 13.3" QLED FHD Up to 600nit Brightness, Color Volume 100%</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 304.9mm x 202.3mm x 13.9~14.9mm</li> <li>- Platform, OS: Intel 11세대 CPU, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10</li> <li>- 초고속 5G통신을 지원 (Sub-6)</li> <li>- 최신 무선랜 연결 802.11 ax (Wi-Fi6)</li> <li>- Double Camera: 키보드부 고화질 13M AF Camera와 전면부 1M Camera</li> <li>- 긴 배터리 사용시간 (20 hours battery life, based on MM14)</li> <li>- 제품에 내장된 S-Pen으로 창의적 영감 표현 가능 (Digitizer)</li> <li>- Tablet, Phone 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Link to Windows: Phone의 App을 PC에서 바로 실행</li> <li>· Samsung Notes: Phone-Tablet-PC간 노트 연동</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book Go (2021.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 14" FHD (1920 x 1080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 323.9mm x 224.8mm x 14.9mm, 1,380 g</li> <li>- Platform: 2세대 스냅드래곤 7C, Windows 10</li> <li>- 언제 어디서나 인터넷이 가능한 LTE 지원</li> <li>- 휴대에 최적화된 슬림 디자인 (14.9mm 두께)</li> <li>- Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드</li> <li>- 긴 배터리 사용시간 (up to 18 hours battery life)</li> <li>- Tablet, Phone 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Quick Share: Phone, Tablet의 파일을 손쉽게 공유</li> <li>· Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용</li> <li>· Galaxy Book Smart Switch: 기존 노트북의 데이터를 간편하게 전송</li> <li>· SmartThings: 스마트 기기 연동</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%</li> </ul>
--	--	---

			<p>13.3”FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 15.6” 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg</li> <li style="padding-left: 40px;">13.3” 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg</li> <li>- Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11</li> <li>- sAMOLED: Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120%</li> <li>- S Pen &amp; Touchscreen support</li> <li>- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원)</li> <li>- SSD : Gen4 SSD , Expendable SSD (M.2 2230)</li> <li>- WiFi 6E 지원</li> <li>- Battery : 15.6” 68Wh (21hrs), 13.3”63Wh (21hrs)</li> <li>- Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 <ul style="list-style-type: none"> <li>· QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인</li> </ul> </li> <li>- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된Secured-Core PC 지원</li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book2 Pro (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 15.6”FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%</li> <li style="padding-left: 40px;">13.3”FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 15.6” 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg</li> <li style="padding-left: 40px;">13.3” 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg</li> <li>- Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11</li> <li>- AMOLED: Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120%</li> <li>- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원)</li> <li>- SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6”Only, M.2 2280)</li> <li>- WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6”Only) 지원</li> <li>- Battery : 15.6”68Wh (21hrs), 13.3”63Wh (21hrs)</li> <li>- Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 <ul style="list-style-type: none"> <li>· QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인</li> </ul> </li> <li>- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원</li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Watch3 (2020.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Real Watch 디자인의 Premium Smart Watch</li> <li>- 인치: 1.4”(45mm), 1.2”(41mm) OLED Display(360 x 360)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 45.0 x 46.2 x 11.1mm(45mm), 41.0 x 42.5 x 11.3mm(41mm)</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos9110, Tizen 5.5</li> <li>- Titanium 소재의 고급 seg. Portfolio 확대</li> <li>- 헬스 관련 차별화 서비스 발굴 및 탑재 <ul style="list-style-type: none"> <li>· BP(혈압), ECG(심전도), Fall Detection(낙상 감지) 글로벌 상용화 등</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Watch4 &amp; Galaxy Watch4 Classic(2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: Watch4 : (44mm) 1.4” (450 x 450), (40mm) 1.2”(396 x 396)</li> <li style="padding-left: 40px;">Watch4 Classic : (46mm) 1.4” (450 x 450), (42mm) 1.2”(396 x 396)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): Watch4 : (44mm) 44.4 x 43.3 x 9.8mm, (40mm) 40.4 x 39.3 x 9.8mm</li> <li style="padding-left: 40px;">Watch4 Classic : (46mm) 45.5 x 45.5 x 11.0mm, (42mm) 41.5 x 41.5 x 11.2mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : AP Exynos W920(5나노 64비트 Dual-Core),</li> <li style="padding-left: 40px;">Wear OS Powered By Samsung. One UI Watch 버전 3.0</li> <li>- Memory : 1.5GB RAM + 16GB ROM 탑재하여 성능 개선 및 사용자 가용량 확대 제공</li> <li>- 330 ppi Display 적용을 통한 가독성 개선</li> <li>- 체성분 측정 기능 최초 탑재 및 Health 사용성 강화로 차별화 추진</li> <li>- 산소포화도, 코골이 등 수면 상태 모니터링 강화</li> <li>- Wear OS 기반 App Eco 확장 및 Phone 연동 경험 강화</li> </ul>
	갤럭시 워치 (~2021.08.)		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Play store/구글맵/YT Music 등 구글 주요 서비스 제공</li> <li>· 최적화된 Fitness 전용 앱 및 다양한 서비스 앱 지원</li> </ul>
	갤럭시 버즈 (2020.01. ~2021.08.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Buds+ (2020.01.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Canal형 TWS(True Wireless Stereo)</li> <li>- Platform(H/W, S/W): MCU(BCM43015), OS(RTOS), BT 5.0</li> <li>- Battery: (Earbuds) 85mAh x 2, (Cradle) 270mAh</li> <li>- 2 Way 스피커(Woofers, Tweeter) 적용을 통한 중저음 강화 및 음질 최고 성능 확보</li> <li>- 외부 Beamforming Mic(2개), 내부 Mic(1개) 적용으로 통화 품질 최적화</li> <li>- Grip 센서 추가로 착용감지 오동작 개선</li> <li>- 업그레이드된 배터리 탑재를 통해 동급 최고의 사용시간 확보: 스트리밍 시 22H(Earbuds 11H, Cradle 11H)</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy Buds Live (2020.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: 혁신적 Design과 고품질 Sound 를 구현한 오픈형 TWS</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (Earbuds) 16.5 x 27.3 x 14.9mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): BCM43015, RTOS</li> <li>- 귀 형상에 최적화된 인체 공학적 설계로 편안하고 부드러운 착용감 제공</li> <li>- 귀가 먹먹하지 않는 오픈형ANC 기능 탑재로 저소음 모드 지원</li> <li>- 12mm 대형 스피커와 Bass Duct로 풍부하고 입체감 있는 라이브 사운드 제공</li> <li>- 3개의 마이크와 가속도 센서(보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy Buds Pro (2021.01.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Intelligent ANC 기능을 갖춘 커널 타입 Premium TWS</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (Earbuds) 20.5 x 19.5 x 20.8mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): BCM43015, RTOS</li> <li>- 2Way(Woofers + Tweeter) 11mm 스피커 탑재를 통한 사운드 품질 향상</li> <li>· 3개의 마이크와 가속도 센서 (보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공</li> <li>· 커널 타입 및 Intelligent ANC 기능 탑재 및 대화감지를 통해 주변소리 듣기로 자동 전환</li> <li>· 영화관에 온 듯한 공간감을 느낄 수 있는 3D Audio 기능 제공</li> <li>- IPx7 등급 방수 지원</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> Galaxy Buds 2 (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본기능 강화와 ANC기능 추가로 Buds Mass모델의 경쟁력 강화</li> <li>- 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 17.0 x 20.9 x 21.1 mm (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8 mm</li> <li>- BES2500 ZP-83 (BT + Codec + Flash) 저전력 신규 솔루션 *</li> <li>· ANC 기능 제공</li> <li>· 음악 재생 총 사용시간 29시간 확보 (Streaming, ANC OFF 기준)</li> <li>- Touch + BT Antenna FPCB 일체형 적용하여 RF 방사 성능 최적화</li> <li>- Canal형 무선 이어폰 Audio 성능 고도화</li> <li>· DNN 활용 통화 잡음 제거 성능 극대화 알고리즘 적용(DNN + 3-Mic +VPU)</li> <li>* DNN : Deep Neural Network , VPU : Voice Pickup Unit</li> <li>· 자연스러운 주변소리듣기 모드 전환 지연 속도 개선(3.2ms→0.65ms)</li> <li>· Woofer 진동판 신소재 적용을 통한 저역 강화</li> <li>· 무결점 Mic 단품 도입으로 Mic 노이즈 차단 강화</li> <li>· 통기홀 밀도 변경 및 FeedBack Mic 관로 개선을 통한 ANC 성능 및 음질 개선</li> <li>· Mic 챔버 공간 극대화 및 위치 최적화를 통한 Wind Noise 개선</li> </ul>
네트워크	RAN S/W	<input type="checkbox"/> SVR18.3 5G S/W PKG (2019.04.)

		<p>Package (2019.04.~2021.06.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 5G NR 세계 최초 상용화를 위한 S/W Package</li> <li>· 서울/수도권에서 LTE 상용망 연동을 통해 NSA 기반 상용화</li> <li>· 5G 기지국 지원(3.5GHz, 28GHz, 39GHz 5G Massive MIMO)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> SVR21B NR vDU SW PKG (2021.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TDD 기반 C-Band vDU</li> <li>· H/W 변경없이 유연한 기지국Upgrade 및 자원 할당 가능</li> </ul> <p>* vDU(virtual DU): 5G 기지국 기능을 상용 서버 기반의 S/W 개발로 구현</p>
		<p>Core S/W Package (2020.03.)</p>	<p><input type="checkbox"/> SVR19B 5G Core S/W Package (2020.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Containerized 기반 5G Core Network Function 개발</li> <li>· 서버(Host OS)의 자원을 필요한 만큼 유동성 있게 할당하여 효율적이고 빠른 서비스 배포 및 유지보수 비용 절감 가능</li> </ul>
	<p>기지국 (2019.09.~2022.02.)</p>		<p><input type="checkbox"/> NR DU 개발 (2019.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 Dual CPU Based-Main Card, 5G 최초 SoC 모뎀 적용</li> <li>- 단일 HW 형상으로 LTE, NR Above/Below제품과 혼용실장</li> <li>- 고용량, 저전력(Power Saving 포함) 및 가상화/비가상화 지원</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 26GHz NR RFIC Chip 개발 (2020.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 1세대(28GHz/39GHz) 이후 2세대 RFIC Chip 개발 (1세대 대비 전력소모 개선, 양산성 향상 등)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> FSU10 개발 (2020.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vRAN 사업 지원을 위한 FSU(Fronthaul Switch Unit) 개발</li> <li>- LTE/NR(Below 6GHz) Spectrum Sharing 역할</li> <li>· 사업자의 LTE DU와 NR vRAN을 Spectrum Sharing을 통해 한 개의 RU에서 LTE/NR 모두 정합 가능</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> NR Indoor AU 개발 (2020.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 5G In-Building Solution AU 첫 제품</li> <li>- Small Form-Factor로 저전력, 실내(벽면, 기동, 천장) 설치 가능</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> NR C-Band MMU(Massive MIMO Unit) 개발(3.7GHz 64T64R 200W) (2020.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미주 C-Band 대역 TDD 기반 MMU 첫 제품</li> <li>- 광대역(순시 대역폭 280MHz) 지원(C-Band 전 사업자 및 전국 Cover가능)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> MMU Beam Forming SoC 개발 (2021.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMU 보드 내 Beam Forming FPGA가 수행하는 기능을 SoC로 구현</li> <li>- 기존 소모 전력의30% 수준으로 감축(최대 소모전력40W 이하)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 미주 ORAN* RU 5종 개발 (2021.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DU-RU간 표준 interface를 정의하여, DU에서 RU 벤더에 상관없이 연동가능</li> <li>- AWS/PCS, 700/850 4T4R 40W 2종, 320W 2종, C-Band 8T8R 320W</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 북미향 AWS/PCS Dualband 16T16R FDD MMU (2021.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 최초16T16R FDD Dualband MMU 상용 제품(자체 개발 Chip 적용)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용</li> <li>* 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어</li> </ul>
<p>DS 부문</p>	<p>메모리</p>	<p>모바일용 DRAM (2019.07.~2022.03.)</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최고 속도 · 최대 용량 모바일용 2세대 10나노급(1y) 12Gb LPDDR5 DRAM 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 속도, 용량, 절전 특성 동시 강화 차세대 모바일 솔루션 제공</li> <li>- 1.3배 속도(5,500Mbps), 소비전력 30% 절감 5G 스마트폰 출시 기여</li> <li>- 12Gb LPDDR5 기반 라인업(6GB, 12GB) 최초 제공</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 역대 최고 속도 · 최대 용량을 구현한 초격차 '16GB LPDDR5 모바일 DRAM' 세계 최초 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 8GB LPDDR4X 대비 성능 약 30% 향상, 용량 2배, 소비전력 20% 감소</li> <li>- 스마트폰으로도 게이밍 PC 이상의 게임 퍼포먼스(화질 · 타격감) 가능</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 제품 대비 속도 30% 이상, 소비전력 효율 약 20% 개선</li> <li>- 업계 최선단 14나노 기반, 단일 패키지 용량 64GB까지 확대 가능하여 모바일 외, 서버/Automotive 등 고성능 저전력 메모리 적용 분야 확대</li> <li>- 퀄컴 스냅드래곤 모바일 플랫폼에 8GB LPDDR5X D램 패키지 탑재해 업계 최고 동작 속도(7.5Gbps) 검증</li> </ul> </li> </ul>
	서버용 DRAM (2019.08. ~2021.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최대 용량 서버용 1세대 10나노급(1x) 256GB 3DS DDR4 DRAM 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초고성능 · 초고용량 256GB DRAM 세계 최초 양산</li> <li>- 128GB 대비 용량 2배 · 소비전력 효율 30% 향상</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 세계 최고 서버용 3세대 10나노급(1z) 나노기반 8Gb DDR4 DRAM 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DDR5 · LPDDR5 양산 위한 초고속 · 초절전 솔루션 확보</li> <li>- 기존 2세대(1y나노) DRAM 대비 20% 이상 효율 향상</li> <li>- 펄텍 라인 1z나노DRAM 라인업 9월 양산으로 차세대 비중 확대</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 HKMG 공정 적용 고용량 DDR5 메모리 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- High-K Metal Gate, 8단 TSV 적용으로 512GB DDR5 모듈 구현</li> <li>- 기존 공정 대비 약 13% 전력소모 낮추고, 성능은 2배 이상 향상</li> <li>- 차세대 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨터, 대용량 데이터센터 등에 적용 예정</li> </ul> </li> </ul>
	HBM DRAM (2019.10. ~2021.08.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최대 HBM DRAM 용량 12단 3DS TSV PKG 기술 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슈퍼컴용 최고성능 · 최대용량 12GB HBM DRAM 업계 최초 개발</li> <li>- 8GB 패키지로 용량 1.5배 · 시스템 설계 편의성 향상</li> <li>- 패키지 기술 한계 돌파로 차세대 HPC DRAM 시장 선도 역량 강화</li> <li>- 고객 수요에 맞춰 업계 최대 24GB HBM 양산 예정</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> AI · 차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 세계최초 출시 (16GB HBM2E 'Flashbolt') <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10나노급(1y) 16기가비트(Gb) DRAM 8개 쌓아 최고용량(16GB) 구현</li> <li>- 1초에 3.2기가비트 속도로 Full HD 영화 82편(410기가바이트) 전송 가능</li> <li>- 2세대 HBM2 및 3세대 HBM2E 동시 공급해 시장 확대 지속 주도</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 세계 최초로 AI 엔진을 탑재한 인공지능 HBM-PIM 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 HBM2 대비 성능 2배 이상 향상, 시스템 에너지 약 70% 이상 감소</li> <li>- 반도체 분야 최고 권위 학회 ISSCC에서 논문 공개('21.2월)</li> <li>- 기존 메모리 인터페이스 사용으로 별도 시스템 변경없이 적용 가능</li> <li>- 데이터센터, AI 고객들과 PIM 표준화, 예코 시스템 구축 협력</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 인공지능 탑재 메모리 제품군 확대 (HBM-PIM 성능 평가결과 및 AXDIMM/LPDDR5-PIM 개발) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지난 2월 개발한 HBM-PIM 실제 시스템 적용 사례 공개 (자일링스 AI 가속시스템에 탑재시 성능 2.5배, 에너지사용 60% 이상 감소)</li> <li>- D램 모듈에 AI 기능 탑재한 AXDIMM은 기존 대비 성능 2배, 에너지사용 40% 감소</li> <li>- 모바일 D램과 PIM 기술을 결합한 LPDDR5-PIM 공개</li> </ul> </li> </ul>
	eStorage (2019.02. ~2022.05.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 스마트폰 메모리 eUFS 3.0 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5세대(9x단) 셀 적층 512Gb 3비트 V낸드 업계 최초 탑재</li> <li>- eUFS 2.0 대비 2배 빠른 읽기 · 쓰기 속도 구현</li> <li>- 초고해상도 차세대 모바일 시장 선점 고성장 주도</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 유일 1200MB/s 쓰기 속도 구현한 초격차 '1TB eUFS 2.1' 본격 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 512GB eUFS 3.0(연속 쓰기 속도 410MB/s) 대비 성능 3배 향상</li> <li>- 스마트폰 메모리 저장 속도(1200MB/s)가 PC(SSD 540MB/s)보다 2배 빨라짐</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선</li> <li>- 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능</li> <li>- 최신 보안 기술 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트폰, Automotive 및VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상</li> </ul>
PC용 SSD (2019.07.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 세계 최고 속도 6세대(1xx) 256Gb V낸드기반 PC SSD 양산</li> <li>- 100단 이상 셀 단일 공정 적층 V낸드 유일 양산</li> <li>- 기존 대비 속도 1.2배, 생산성 20% 이상 향상</li> <li>- 초고속·초절전 특성 우위로 스토리지 시장 성장 주도</li> </ul>
서버용 SSD (2019.08. ~2021.12.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 세계 최고 속도·최대 용량 서버용 5세대(9x단) V낸드 기반 30.72TB NVMe SSD 양산</li> <li>- 속도, 용량, 경제성 강화 차세대 SSD 솔루션 확보</li> <li>- 기존 대비 2.2배 속도 8GB/s PCIe Gen4 SSD 출시</li> <li>- 3대 SW(Never Die SSD, FIP, ML) 솔루션 유일 제공</li> <li>□ 데이터센터 전용 고성능 OCP SSD 양산</li> <li>- 6세대 V낸드로는 업계 최초로 OCP 규격의 SSD 양산</li> <li>- 데이터센터 업계가 요구하는 성능, 전력효율, 신뢰성, 보안 모두 만족</li> <li>- 업계 최고 전력효율 특성으로 비용 절감 및 탄소 저감 효과에 기여</li> <li>□ 업계 최고 성능 SAS 24Gbps 서버용 SSD 양산</li> <li>- 이전 세대 SSD 대비 약 2배 향상된 속도 지원</li> <li>- 6세대 V낸드 기반으로 800GB 부터 30.72TB까지 고용량 제공</li> <li>- 전력효율 약40% 향상되어 서버 운영 비용 절감 및 탄소 저감 효과 기대</li> <li>□ 차세대 기업 서버용 ZNS SSD 업계 최초 양산</li> <li>- 데이터 성격에 따라 구역(Zone)별로 분류하여 저장하는 ZNS 기술 적용</li> <li>- 기존 SSD 대비 수명연장 및 SSD 용량 최대 활용</li> <li>- AI, 빅데이터, IOT등 차세대 서버/스토리지 시스템 효율 제고에 기여 및 다양한 오픈소스 프로젝트 활동으로 ZNS SSD 저변 확대</li> <li>□ PCIe 5.0 기반 고성능 SSD PM1743 개발</li> <li>- PCIe 4.0 기반 SSD 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배 및 전력효율 약 30% 개선</li> <li>- 듀얼포트 지원 및 최신 보안 기술 적용으로 서버 운영 안전성 보장</li> </ul>
브랜드 SSD (2020.01. ~2022.04.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 업계 최고수준 성능의 프리미엄 포터블 SSD 'T7 Touch' 출시</li> <li>- 세계 최고 성능의 5세대 512Gb V낸드와 초고속 인터페이스 NVMe 컨트롤러를 탑재</li> <li>- 외장형 HDD(110MB/s) 대비 최대 9.5배, 전작(삼성전자 포터블 SSD 'T5') 대비 약 2배 빨라진 1,050MB/s·1,000MB/s의 읽기·쓰기 속도를 구현</li> <li>□ 고용량 4비트 SSD '870 QVO' 글로벌 출시</li> <li>- 업계 최대 용량 8TB 모델 포함, 1/2/4TB 등 SATA SSD 4종 출시</li> <li>- SATA 인터페이스 한계치에 근접한 빠른 데이터 처리 속도로 고용량·고성능의 컴퓨팅 환경을 원하는 소비자에게 최적의 솔루션 제공</li> <li>- 속도와 용량, 합리적인 가격으로 전세계40개국에 순차 출시</li> <li>□ PCIe Gen4 적용한 업계 최고 성능 SSD '980 PRO' 글로벌 출시</li> <li>- 업계 최고 속도 소비자용 SSD로 최고해상도 구현</li> <li>- 8K·4K급 영상편집, 고사양 게임 등에 활용되는 전문가용 PC·워크스테이션 시장 지속 주도</li> <li>- 보증기간 5년(업계 최고 수준)</li> <li>□ 소비자용 SATA SSD 870 EVO 글로벌 출시</li> <li>- 최신 V낸드, 컨트롤러 탑재, 인텔리전트 터보라이트 기술 적용</li> <li>- 업계 최고 수준 내구성 보유, 지속성능 30% 이상 향상</li> <li>- 250GB~4TB까지 5개 모델로, 한국·미국·독일·중국 등 40여개국 순차 출시</li> <li>□ 성능과 경제성을 모두 만족한 고성능 NVMe SSD 980 출시</li> <li>- 6세대 V낸드 탑재, SATA SSD 대비 최대 6배 빠른 성능 제공</li> <li>- 비용을 고려한 DRAMless 설계와 컨트롤러, 펌웨어 최적화 기술 적용</li> <li>- 하이엔드 제품에 적용되는 열 제어 기능 탑재</li> <li>- 970 EVO 대비 전력효율56% 향상, 소비자들 '착한 소비' 가능</li> </ul>



		<input type="checkbox"/> 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시 - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송
	EUV (2020.03. ~2021.10.)	<input type="checkbox"/> 1세대 10나노급(D1x) DRAM 모듈 1백만개 공급 - EUV DRAM 양산으로 업계 유일 EUV DRAM 양산체제 구축 - 10나노급 공정 미세화 기술 및 양산성 확보로 차세대 DRAM 적기 출시 가능 - 4세대 10나노급 DRAM부터 EUV전면 적용 후 5세대, 6세대도 확대 적용 <input type="checkbox"/> 업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산 - EUV 멀티레이어 적용 및 업계 최고 웨이퍼 집적도 구현으로 생산성 약 20% 향상 - DDR4 대비 속도 2배 및 이전 공정 대비 소비전력 약 20% 개선
	CXL (2021.05. ~2022.05.)	<input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 기반 DRAM 메모리 기술 개발 - 대용량 데이터센터가 요구하는 차세대 메모리 솔루션으로 DRAM 모듈의 물리적 한계 극복, 용량 대역폭의 획기적인 확장 가능 - CXL 컨트롤러를 통해 인터페이스 컨버팅, 에러 관리 등 지원 - 데이터센터, 서버, 칩셋 업체들과 협력으로 CXL DRAM 메모리에 최적화된 컨트롤러, 소프트웨어 기술 개발 <input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 메모리 오픈소스 소프트웨어 솔루션 개발 - 메인 메모리와 CXL 메모리가 최적으로 동작할 수 있도록 지원하여 시스템 메모리의 성능/용량 확장 가능 <input type="checkbox"/> 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발 - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소
	복합칩 (2021.06.)	<input type="checkbox"/> 업계 최고 성능의 uMCP5(LPDDR5 + UFS3.1) 멀티칩 패키지 양산 - 기존 LPDDR4X 대비 속도 1.5배, UFS2.2 대비 2배 향상 - 중저가 5G 스마트폰까지 탑재하여 5G 대중화 견인
	브랜드 Card (2021.09. ~2022.05.)	<input type="checkbox"/> 성능·안정성을 강화한 마이크로 SD카드 신제품 출시 - 'PRO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.6배, 쓰기 속도 약 1.3배 - 'EVO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.3배 - 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라 4K UHD 영상과 같은 고사양의 콘텐츠를 제작, 고객까지 만족 기대 <input type="checkbox"/> 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시 - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영
	Automotive (2021.12.)	<input type="checkbox"/> Automotive용 메모리 토털 솔루션 양산 - IVI용 256GB SSD, 2GB DDR4/GDDR6 및 AD용 2GB GDDR6, 128GB UFS - 서버급에 탑재되는 고성능 SSD와 그래픽D램 공급 및 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 안전성 확보(영하 40℃~영상 105℃ 동작보증구간 지원)
System LSI	이미지센서 (2019.01. ~2022.06.)	<input type="checkbox"/> 초소형 픽셀 적용 ISOCELL Slim 센서(3T2, 0.8um/20Mp) - 1/3.4" 센서 중 최고 화소(20Mp)로 베젤리스 디스플레이에 최적화된 고화소 구현 - 전면 테트라셀 기술 적용으로 저조도 촬영 성능 우수, 후면 고배율 사용시 모듈 사이즈 감소, 화질 개선 <input type="checkbox"/> 초고화소 ISOCELL Bright 센서(GW1, 0.8um/64Mp) - DCG 구조 적용으로 Dynamic Range 증가 - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 480 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공 - 실시간 HDR 기능 지원으로 풍부한 색감 구현 <input type="checkbox"/> 고화소 ISOCELL Bright 센서(GM2, 0.8um/48Mp) - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 240 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공 <input type="checkbox"/> 세계 최초 1억8백만 화소 ISOCELL Bright 센서(HMX, 0.8um/108Mp)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- AI-ISO 적용하여 S/W로 광량 조절, 색재현력 향상</li> <li>- 최대 6K 해상도로 초당 30 프레임 촬영 가능</li> <li>- 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선</li> <li><input type="checkbox"/> 세계 최초 최소 픽셀 적용 ISOCELL Slim 센서(GH1, 0.7um/43.7Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모듈의 크기와 두께 소형화 가능하여 Full-Screen Display 세트 탑재 용이</li> <li>- 고해상도 녹화 지원 및 화각 손실 최소화</li> <li>- 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 '노나셀' 기술로 감도 2배 높은 차세대 1억8백만 화소 ISOCELL Bright센서(HM1, 0.8um/108Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강화된 줌 기능으로 피사체 3배 확대해도 화질 저하 없이 프리뷰 가능</li> <li>- 스마트 ISO, 실시간 HDR, 전자식 이미지 흔들림 보정 등 최신 기술 적용</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 듀얼 픽셀 및 테트라셀 적용 센서(GN1, 1.2um/50Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한 픽셀당 2개 포토다이오드 탑재하는 듀얼 픽셀 기술로 1억 화소 수준 이미지도 출력 가능</li> <li>- 어두운 곳에서 감도 4배 향상되는 테트라셀 적용으로 밝고 섬세한 이미지 촬영</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 0.7um 픽셀 적용 이미지센서 라인업 구축(HM2, GW3, GM5, JD1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '아이소셀 2.0' 등 첨단 기술 적용해 초소형, 고화질 기술 리더십 선도</li> <li>- (HM2) 0.7um픽셀 최초 1억8백만 화소</li> <li>- (GW3) 4K 60프레임 동영상 촬영 가능한 6천4백만 화소</li> <li>- (GM5) 초광각과 폴디드줌 지원하는 4천8백만 화소</li> <li>- (JD1) 베젤리스 디자인 구현에 최적화된 초소형 3천2백만 화소</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 1억8백만화소 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시 (HM3, 0.8um/108Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0.8um 크기 작은 픽셀 1억 8백만개를 '1/1.33인치'에 집적</li> <li>- '스마트 ISO 프로'로 잔상 최소화, 밝고 선명한 이미지 촬영 가능</li> <li>- 자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용... 초점 검출 능력 50% 향상</li> <li>- 설계 최적화로 프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6% 절감</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 사람 눈과 더욱 가까워진 이미지센서 '아이소셀 GN2' 출시 (GN2, 1.4um/50Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최초, 픽셀을 대각선 분할하는 '듀얼 픽셀 프로' 적용</li> <li>- 1.4um 픽셀 구조, 보다 밝고 선명한 이미지 촬영</li> <li>- 스테거드 HDR, 기존 제품 대비 동작 전력 약 24% 감소</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 0.64um 픽셀 적용 '아이소셀 JN1' 출시(JN1, 0.64um/50Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초소형 픽셀 크기 양산, 고화소 모바일 카메라 슬림 디자인 적용</li> <li>- 어두운 곳에서 촬영 감도 높이는 최첨단 이미지센서 기술 적용</li> <li>- 카메라 렌즈 모듈사 협력, 1/2.8" 제품과 호환 가능한 생태계 구축</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 차량용 이미지센서 '아이소셀 오토 4AC' 본격 출시(4AC, 3.0um/1.2Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서라운드 뷰 모니터, 후방 카메라에 적용 예정</li> <li>- 극한 환경에서도 운전자 보조, 사각지대를 최소화하는 안전 솔루션</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 초격차 모바일 이미지센서 신기술 공개(HP1, 0.64um/200Mp 및 GN5, 1.0um/50Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최초 '2억화소' 벽을 넘어선 '아이소셀 HP1'</li> <li>- 업계 최소 크기의 듀얼 픽셀 이미지센서 '아이소셀 GN5'</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소</li> <li>- '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현</li> <li>- '테트라 스캐어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질</li> </ul> </li> </ul>
	<p>엑시노스 (2019.01. ~2022.03.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계최초 5G 스마트폰용 모뎀 솔루션(엑시노스 모뎀 5100, 엑시노스 RF 5500, 엑시노스 SM 5800) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터 통신 속도 1.7배 증가 (LTE대비)</li> <li>- 신규 RF·SM 탑재, 송수신 전력 효율 개선</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최고 수준의 7나노 5G 모뎀(엑시노스 5123) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6GHz 이하 5G 환경에서 기존대비 최고 2배 속도 향상</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4G 네트워크에서 최고속도 3.0Gbps 달성</li> <li>- 글로벌 Sub-6GHz/mmWave 대역 지원</li> <li><input type="checkbox"/> 차량용 인포테인먼트용 SoC(엑시노스 오토 V9) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥타코어 CPU활용하여 디스플레이 6개 및 카메라 12개 동시 제어</li> <li>- GPU 3개 탑재로 계기판·CID·HUD 개별 지원</li> <li>- NPU 탑재로 디지털 음성·얼굴·동작 인식</li> <li>- ASIL-B 기능안전 지원으로 안정성 강화</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 저전력·보안강화 단거리 IoT 전용 SoC(엑시노스 i T100) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로세서·메모리·통신기능 패키지화</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Sub-6GHz 대역 지원 5G 모뎀 + AP 통합 원칩(엑시노스 980) <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN-DC, Wi-Fi 6 등 최신 통신 기능 지원</li> <li>- 전세대 및 프리미엄 제품 대비 NPU 성능 향상</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 5세대 CPU 및 프리미엄 GPU 탑재로 성능 강화(엑시노스 990) <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 연산 성능 10TOPS 이상 확보로 이미지 분석 및 안전 인식 기능 강화</li> <li>- 최신 LPDDR5 DRAM 및 50MP↑ 고해상도 카메라 지원</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 5G 통합 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시(엑시노스 2100) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최첨단 5나노 EUV 공정·최신 CPU/GPU 적용, 성능 대폭 향상</li> <li>- 설계 최적화로 전작 대비 성능 CPU 30%, GPU 40% 이상 개선</li> <li>- 온디바이스 AI 성능 강화, 초당 26조번 인공지능(AI) 연산</li> <li>- 소비전력 최대 20% 감소, 자체 전력 관리 솔루션 'AMIGO'도 적용</li> <li>- 초고주파 대역 5G 통신 지원, 최대 6개 이미지센서 처리 등</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> EUV(Extreme UltraViolet, 극자외선) 공정 기반 웨어러블용 '엑시노스 W920' 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최신 5나노 EUV 공정 및 설계 기술 적용으로 성능과 전력효율 향상</li> <li>- 최첨단 패키지 기술을 적용, 웨어러블용 초소형 패키지로 구현</li> <li>- 최신 ARM 코어 적용, 전세대(Exynos 9110) 대비 CPU 성능 20%, 그래픽 성능 10배 향상</li> <li>- 저전력 디스플레이용 코어 탑재, AOD(Always On Display) 모드에서 프로세서 전력소모 97% 개선</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 5G 통신 서비스 제공하는 차량용 통신칩 '엑시노스 오토 T5123' 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초당 5.1Gb 다운로드 지원, 주행 중에도 끊김없이 고용량·고화질 콘텐츠 이용 가능</li> <li>- 최신 5G 기반 멀티모드 통신칩 내장돼 5G 단독망 및 LTE 혼합망 모두 지원</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V7' 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신경망처리장치(NPU), 카메라 센서의 불량화소 및 왜곡 보정 기술, 이미지 압축기술 등 최신 차량용 기술 적용</li> <li>- 그래픽 장치는 디지털 계기판, 중앙 정보 디스플레이(CID, Center Information Display), 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 독립된 4개 디스플레이 구동 및 최대 12개의 카메라 센서 지원</li> <li>- 보안 프로세서 탑재해 차량 주요 정보를 안전하게 보관 및 물리적 복제 방지 기술 제공</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화</li> <li>- 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현</li> <li>- ARM 최신 CPU 아키텍처 'ArmV9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화</li> <li>- NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상</li> </ul> </li> </ul>
	LSI (2019.01. ~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> USB-PD 3.0 표준 및 고속 충전 프로토콜 지원 TA용 PDIC(MM101) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수분 감지, 전압 보호 기능 탑재</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 세계최초 PDIC + SE 통합 원 칩(SE8A) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type-C 인증 지원으로 비인증 제품 차단</li> <li>- 보안키·인증서 저장, 암호화·복호화 지원 등 고성능 보안기능 탑재</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최초 무선이어폰용 통합 전력관리 칩(MUA01, MUB01)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여러 칩을 하나로 통합해 소형 배터리에 최적화된 전력관리 칩</li> <li>- 급성장하는 무선이어폰 시장을 위한 최적의 솔루션 제공</li> <li><input type="checkbox"/> 8K TV 초고화질 영상 구현 최적화 및 전송 효율 향상 DDI(S6CT93P)</li> <li>- 이퀄라이저 S/W화로 신호 품질 및 개발 효율 향상</li> <li><input type="checkbox"/> 모바일 최고 수준의 통합 보안 솔루션(S3K250AF)</li> <li>- 보안 국제 공통 평가 기준(CC)에서 'EAL 5+' 등급을 획득한 H/W 보안칩에 독자 개발 S/W 탑재</li> <li>- 모바일 보안 솔루션으로 신규 모바일서비스 위한 기반 마련</li> <li><input type="checkbox"/> 모바일기기 최고 등급인 EAL 6+ 획득, 자체 S/W 탑재 솔루션(S3FV9RR)</li> <li>- 다양한 프로세서에 독립적으로 적용해 여러 종류의 스마트기기에 활용 가능</li> <li>- 하드웨어 보안 부팅, 기기 인증 등 다양한 기능 탑재해 보안 강화</li> <li><input type="checkbox"/> DDR5 D램 모듈용 전력관리반도체(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01)</li> <li>- 차세대 기기 성능향상 및 전력절감에 핵심, 전력관리반도체 3종</li> <li>- 전력 소비 및 발열 낮추는 자체 기술 적용, 동작 효율 최고 91%까지 향상</li> <li>- 메모리용 전력관리반도체 라인업 지속확대 및 기술 리더십 강화</li> <li><input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트 프로세서용 전력공급반도체(S2VPS01)</li> <li>- 차량용 시스템 안전기준 '에이실-B' 인증 획득, 기능 안전성 강화</li> <li>- 발열 차단 기능, 자가 진단 기능 등 시스템 안정성 강화</li> <li><input type="checkbox"/> 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C)</li> <li>- 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합</li> <li>- 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득,</li> <li>글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증</li> </ul>												
	Foundry	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="335 1019 510 1272"> eMRAM 솔루션 제품 출하 (28나노 FD-SOI 공정기반) (2019.03.) </td> <td data-bbox="510 1019 1461 1272"> <input type="checkbox"/> 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며, 데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화</li> <li>- 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원</li> </ul> <input type="checkbox"/> 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능</li> </ul> <input type="checkbox"/> 저전력, 소형화 특성으로 MCU·IoT·AI 등에 최적화 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="335 1272 510 1400"> EUV 기술 적용 5나노 공정 (2019.04.) </td> <td data-bbox="510 1272 1461 1400"> <input type="checkbox"/> EUV 노광기술 적용한 5나노 공정 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 셀 설계를 최적화해 7나노 공정 대비 로직면적 25% 감소, 전력효율 20% 및 성능 10% 향상 기대</li> <li>- 7나노에 적용된 설계자산(IP)을 활용 가능해 기존 7나노 고객의 설계 부담 경감</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="335 1400 510 1653"> 3차원 적층 패키지 기술 'X-Cube' (2020.08.) </td> <td data-bbox="510 1400 1461 1653"> <input type="checkbox"/> 3차원 적층 기술 'X-Cube' 및 설계 인프라 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 별도의 웨이퍼로 제조된 이중 칩을 실리콘 관통 전극(TSV)으로 얇게 적층하여 하나의 반도체로 구현</li> <li>· 전체 칩 면적을 줄이면서 고용량 메모리 솔루션 장착 가능해 설계 자유도 확보</li> <li>· 시스템 반도체의 데이터 처리속도 및 전력 효율 획기적 향상</li> <li>- 5, 7나노 공정에 'X-Cube' 적용을 위한 설계방법론 및 설계툴 검증 완료</li> <li>· EUV 7나노 공정 기반 로직·SRAM을 적층한 테스트칩 업계 최초 생산</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="335 1653 510 1825"> 2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.) </td> <td data-bbox="510 1653 1461 1825"> <input type="checkbox"/> 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="335 1825 510 2072"> 8나노 RF 공정 (2021.06.) </td> <td data-bbox="510 1825 1461 2072"> <input type="checkbox"/> 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="335 2072 510 2128"> 2.5D 반도체 </td> <td data-bbox="510 2072 1461 2128"> <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube' </td> </tr> </table>	eMRAM 솔루션 제품 출하 (28나노 FD-SOI 공정기반) (2019.03.)	<input type="checkbox"/> 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며, 데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화</li> <li>- 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원</li> </ul> <input type="checkbox"/> 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능</li> </ul> <input type="checkbox"/> 저전력, 소형화 특성으로 MCU·IoT·AI 등에 최적화	EUV 기술 적용 5나노 공정 (2019.04.)	<input type="checkbox"/> EUV 노광기술 적용한 5나노 공정 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 셀 설계를 최적화해 7나노 공정 대비 로직면적 25% 감소, 전력효율 20% 및 성능 10% 향상 기대</li> <li>- 7나노에 적용된 설계자산(IP)을 활용 가능해 기존 7나노 고객의 설계 부담 경감</li> </ul>	3차원 적층 패키지 기술 'X-Cube' (2020.08.)	<input type="checkbox"/> 3차원 적층 기술 'X-Cube' 및 설계 인프라 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 별도의 웨이퍼로 제조된 이중 칩을 실리콘 관통 전극(TSV)으로 얇게 적층하여 하나의 반도체로 구현</li> <li>· 전체 칩 면적을 줄이면서 고용량 메모리 솔루션 장착 가능해 설계 자유도 확보</li> <li>· 시스템 반도체의 데이터 처리속도 및 전력 효율 획기적 향상</li> <li>- 5, 7나노 공정에 'X-Cube' 적용을 위한 설계방법론 및 설계툴 검증 완료</li> <li>· EUV 7나노 공정 기반 로직·SRAM을 적층한 테스트칩 업계 최초 생산</li> </ul>	2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.)	<input type="checkbox"/> 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상	8나노 RF 공정 (2021.06.)	<input type="checkbox"/> 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소</li> </ul>	2.5D 반도체	<input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube'
eMRAM 솔루션 제품 출하 (28나노 FD-SOI 공정기반) (2019.03.)	<input type="checkbox"/> 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며, 데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화</li> <li>- 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원</li> </ul> <input type="checkbox"/> 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능</li> </ul> <input type="checkbox"/> 저전력, 소형화 특성으로 MCU·IoT·AI 등에 최적화													
EUV 기술 적용 5나노 공정 (2019.04.)	<input type="checkbox"/> EUV 노광기술 적용한 5나노 공정 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 셀 설계를 최적화해 7나노 공정 대비 로직면적 25% 감소, 전력효율 20% 및 성능 10% 향상 기대</li> <li>- 7나노에 적용된 설계자산(IP)을 활용 가능해 기존 7나노 고객의 설계 부담 경감</li> </ul>													
3차원 적층 패키지 기술 'X-Cube' (2020.08.)	<input type="checkbox"/> 3차원 적층 기술 'X-Cube' 및 설계 인프라 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 별도의 웨이퍼로 제조된 이중 칩을 실리콘 관통 전극(TSV)으로 얇게 적층하여 하나의 반도체로 구현</li> <li>· 전체 칩 면적을 줄이면서 고용량 메모리 솔루션 장착 가능해 설계 자유도 확보</li> <li>· 시스템 반도체의 데이터 처리속도 및 전력 효율 획기적 향상</li> <li>- 5, 7나노 공정에 'X-Cube' 적용을 위한 설계방법론 및 설계툴 검증 완료</li> <li>· EUV 7나노 공정 기반 로직·SRAM을 적층한 테스트칩 업계 최초 생산</li> </ul>													
2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.)	<input type="checkbox"/> 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상													
8나노 RF 공정 (2021.06.)	<input type="checkbox"/> 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소</li> </ul>													
2.5D 반도체	<input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube'													

		패키지 기술 'H-Cube' (2021.11.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인터포저 위에 로직과 고대역폭 메모리(HBM)를 배치, 최대 6HBM 집적 구현</li> <li>- 하이브리드 기판은 상단의 고사양 메인 기판이 로직/메모리 칩을 연결하고, 대면적 구현이 용이한 하단의 보조 기판이 시스템 보드 연결을 담당하는 이중 구조</li> <li>- 두 기판을 전기적으로 연결하는 솔더볼(Solder ball) 간격을 35% 좁혀 기판 크기 감소</li> <li>- 칩 분석기술 적용해 안정적으로 전원을 공급하고 신호의 왜곡 및 손실을 축소</li> <li>- 고성능/대면적이 요구되는 데이터센터, AI, 네트워크 등 분야 반도체에 최적화</li> </ul>
		세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화</li> <li>- 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓</li> </ul> <input type="checkbox"/> GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소</li> <li>- 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상</li> <li>- 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상</li> </ul> <input type="checkbox"/> 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중 <input type="checkbox"/> 고성능·저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SoC 등에 적용 확대 계획
SDC	DP	갤럭시 S10용 홀 디스플레이 OLED (2019.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Flexible Hole in Display 상품화로 화면공간 극대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S10 6.1" 3K QHD+(3,040 × 1,440) Hole 1개, S10+ 6.4" Hole 2개</li> </ul> <input type="checkbox"/> 블루라이트의 획기적인 감소로 눈이 편안한 디스플레이 제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S9 대비 블루라이트 42% 감소(TUV 라인란드 아이컴포트 인증)</li> </ul>
		NPC용 15.6" UHD OLED (2019.05.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 NPC용 4K OLED 디스플레이 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.6" UHD(3,840 x 2,160), 16:9</li> <li>- Blue Light 저감, 빠른 응답속도, 넓은 시야각으로 선명한 화질 제공</li> </ul>
		스마트폰용 4K 고해상도 OLED (2019.06.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 4K 모바일 OLED 디스플레이 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.5" UHD(1,644 × 3,840), 643ppi, 16M Color</li> <li>- 21 : 9 화면 비율로 영화의 원본 비율 그대로 감상 가능</li> </ul>
		Gaming 모니터용 Curved LCD (2019.06.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 240Hz Curved LCD 디스플레이 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27" FHD(1920 × 1080), 16:9</li> <li>- 240Hz 고속주사율과 G-sync 지원으로 부드럽고 끊김없는 게임환경 제공</li> <li>- 곡률 1500R, 광시야각 기술로 몰입감 극대화</li> </ul>
		갤럭시 폴드용 폴더블 OLED (2019.09.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 폴더블 디스플레이 개발로 디스플레이 혁신 <ul style="list-style-type: none"> <li>- In-Foldable AM OLED (곡률반경 1.5R)</li> <li>- 7.3" QXGA+(1,536 × 2,152), 4:3</li> <li>- 복합 폴리머 소재 개발로 기존 디스플레이 대비 약 50% 두께 감소</li> </ul>
		갤럭시 Z 플립용 폴더블 OLED (2020.02.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Glass type Window 폴더블 디스플레이 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.7" Full HD+(1,080 x 2,640)</li> <li>- UTG(Ultra Thin Glass)적용 내구성 향상 및 폴더블 최초 카메라 홀 적용</li> </ul>
		갤럭시 S20용 WQ+ 고속구동 OLED (2020.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 WQ+ 해상도 120Hz 고속구동으로 Touch 성능 극대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S20 6.23"/6.67"/6.87" QHD+(3,200 × 1,440)</li> <li>- 유해 Blue 6.5% 이하로 Eye Care Display 인증(국제 인증기관, SGS)</li> </ul>
		갤럭시 Z 폴드2용 폴더블 OLED (2020.09.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 곡률(1.4R) 폴더블 디스플레이 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7.6"(2,208 × 1,768) In - Foldable</li> <li>- 응력최소화 구조설계로 곡률반경 1.4R 달성</li> <li>- 어댑티브 프리퀀시(화면에 맞춘 주사율 조정, 10~120Hz구동)로 소비전력 개선</li> </ul>
		갤럭시 S21용 저소비전력 OLED (2021.01.)	<input type="checkbox"/> 저소비전력, 고휘도 혁신 OLED 디스플레이 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S21 시리즈: 6.24" · 6.67" · 6.81" QHD+(3,200×1,440)</li> <li>- 신규 유기재료 적용으로 발광효율 개선: 전작 대비 소비전력 16% 개선</li> <li>- 휘도 · 명암비 향상으로 우수한 야외시인성 확보 (Max/HBM 420/800 →500/1100nit, Peak 1,785nit)</li> </ul>

		→ Sunlight Visibility 인증(UL, 글로벌 안정인증회사)
	갤럭시Z 폴드3용 폴더블 OLED개발 (2021.08.)	<input type="checkbox"/> 다양한 신기술의 폴더블 최초 적용 - 7.6" QXGA+7.55" (2,208×1,768) - 언더 패널 카메라(Under Panel Camera) 기술로 화면 사각지대 제거 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 전작 대비 배터리 소모 절감
	55/65" QD-Display (2022.01.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 TV형 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
	34" QD-Display (2022.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 모니터형 QD-Display (34" QHD) - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화

## 【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계